本次发行股票拟在科创板上市,科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、 退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险 及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。



厦门恒坤新材料科技股份有限公司

Xiamen Hengkun New Materials Technology Co., Ltd.

(厦门市海沧区东孚镇山边路 389 号)

首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书

保荐人(主承销商)



(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

联席主承销商



(山东省济南市市中区经七路 86 号)

声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者声明

一、发行人上市的目的

公司致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用,是中国境内少数具备 12 英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一,主要从事光刻材料和前驱体材料等产品的研发、生产和销售。通过本次上市,公司可以加大技术开发和产业化布局,不断拓展产品线,提升公司核心竞争力和品牌影响力,持续增强盈利能力,为股东和行业持续创造价值。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

公司建立健全了完善的现代企业制度,已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构,公司股东会、董事会、监事会规范运作,各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益,保持股利分配政策的持续性和稳定性,提高股东对公司经营和分配的监督,稳定投资者预期,公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次募集资金将投资于集成电路前驱体二期项目、集成电路用先进材料项目。公司募集资金围绕公司的主营业务展开,通过本次募投项目的实施,将带动公司创新产品的研发与应用,进一步完善公司产品结构,推动公司技术创新,促进相关产品国产化水平的提升。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

集成电路是信息技术产业的核心和国民经济信息化的基础,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,是国家创新驱动发展战略的重点发展领域。集成电路关键材料作为集成电路产业的基石,在集成电路制造技术升级和产业创新发展中扮演着重要角色。目前,我国集成电路关键材料虽然基本实现重点材料领域的布局或量产,但产品整体仍然以中低端为主,高端材料依然被欧美、日韩等境外厂商主导,且在产能及市场占有率方面与境外厂商也有较大差距,自主化率低,国产化需求迫切,市场空间巨大。

公司历经多年发展,已成为一家致力于光刻材料、前驱体材料等集成电路关键材料研发、生产和销售的创新企业,拥有自主研发能力和知识产权,产品主要应用于 12 英寸集成电路晶圆制造各类工艺,填补多项国内空白。最近三年,公司自产产品销售收入分别为 12,357.89 万元、19,058.84 万元和 34,418.93 万元,复合增长率 66.89%。

公司未来将持续深耕集成电路关键材料领域,加大技术开发和产业化布局,不断拓展产品线,稳固产品品质,积极参与客户的定制化开发,为客户提供集成电路关键材料整体解决方案;协同上下游产业链创新发展,建立安全可控的供应链;打造品牌效应,积极拓展海外市场,力争成为具有核心竞争力,国内领先、国际先进的集成电路关键材料本土企业。

董事长签字:

易荣坤

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

5年6月30日

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股 (A 股)
发行股数	本次公开发行新股数量 6,739.7940 万股,占本次发行后公司总股本的 15.00%;本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	2025年11月7日
拟上市的证券交 易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	44,931.9600 万股
保荐人(主承销 商)	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商	中泰证券股份有限公司
招股意向书签署 日期	2025年10月30日

目 录

第-	一节	释义	10
	一,	普通名词释义	10
	_,	专业术语释义	14
第二	二节	概览	17
	一,	重大事项提示	17
	_,	发行人及本次发行的中介机构基本情况	20
	三、	本次发行概况	21
	四、	发行人主营业务经营情况	23
	五、	发行人符合科创板定位	27
	六、	发行人报告期主要财务数据和财务指标	31
	七、	财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况	32
	八、	发行人选择的具体上市标准	33
	九、	发行人公司治理特殊安排等重要事项	34
	十、	募集资金用途与未来发展规划	34
	+-	一、其他对发行人有重大影响的事项	35
第	三节	风险因素	36
	一,	与发行人相关的风险	36
	Ξ,	与行业相关的风险	38
	三、	其他风险	38
第	四节	发行人基本情况	39
	一,	发行人基本情况	39
	_,	发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况	39
	三、	发行人成立以来重要事件(含报告期内重大资产重组)	57
	四、	公司在其他证券市场的上市或挂牌情况	61
	五、	公司股权关系	63
	六、	公司控股、参股公司及分公司情况	64
	七、	持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况	71

	九、发行人协议控制架构的情况	.73
	十、发行人股本情况	.73
	十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况	.83
	十二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与公司签订的协议及履	行
	情况	.89
	十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年变动情况	.89
	十四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持有本公司	服
	份情况	.91
	十五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的兼职情况	.92
	十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关	的
	对外投资情况	.93
	十七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的薪酬情况	.93
	十八、发行人已经制定或实施的股权激励及执行情况	.94
	十九、发行人员工及其社会保障情况1	06
第三	五节 业务与技术1	109
	一、发行人主营业务、主要产品及服务情况1	09
	二、发行人所处行业基本情况及竞争状况1	24
	三、发行人销售情况及主要客户1	55
	四、发行人采购情况及主要供应商1	58
	五、主要固定资产及无形资产1	61
	六、发行人核心技术及研发情况1	67
	七、安全生产及环境保护情况1	82
	八、发行人境外经营情况1	83
第7	六节 财务会计信息与管理层分析1	184
	一、财务报表1	84
	二、审计意见1	89
	三、关键审计事项	89
	四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况1	91
	五、重要会计政策和会计估计1	93
	六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表	16

七、	主要税种及税收政策	217
八、	分部信息	221
九、	主要财务指标	221
十、	经营成果分析	223
+-	、资产质量分析	249
十二	、偿债能力、流动性与持续经营能力分析	274
十三	、现金流量分析	288
十四	、重大资本性支出分析	291
十五	、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项	291
十六	、盈利预测情况	292
十七	、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况	292
第七节	募集资金运用与未来发展规划	293
– ,	募集资金概况	293
_,	募集资金投资项目实施的必要性和可行性	295
三、	募集资金投资项目对同业竞争和发行人独立性的影响	298
四、	募集资金投资项目实施对财务状况和经营成果的影响	298
五、	未来发展与规划	299
第八节 ·	公司治理与独立性	302
– ,	报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况	302
_,	发行人的内部控制情况	302
三、	报告期内发行人存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、	纪律
处分	或自律监管措施的情况	303
四、	公司控股股东资金占用及为控股股东担保的情况	303
五、	发行人面向市场独立持续经营能力的情况	304
六、	同业竞争情况	305
七、	关联方及关联交易	306
第九节:	投资者保护	316
一、	本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序	316
_	发行人股利分配政等	316

_	E、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排,	个仔仕
片	6未盈利或累计未弥补亏损的情况	324
第十节	节 其他重要事项	325
_	一、重大合同	325
_	二、对外担保情况	328
=	E、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项	328
第十-	一节 声明	329
_	一、全体董事、监事、高级管理人员声明	329
_	二、发行人控股股东、实际控制人声明	330
Ξ	E、保荐人(主承销商)声明	331
Д]、发行人律师声明	334
\pm	i、会计师事务所声明	335
六	大、资产评估机构声明	336
t	1、验资机构声明	338
J\	、验资复核机构声明	341
第十二	二节 附件	342
	二 节 附件 一、备查文件	
_		342
_	一、备查文件	342
=======================================	一、备查文件 二、申报前十二个月新增股东的基本情况	342 342 345
	一、备查文件 工、申报前十二个月新增股东的基本情况 E、落实投资者管理相关规定的安排	342 342 345 346
二 三 匹 五	一、备查文件	342 342 345 346
二 三 匹 五 六	一、备查文件	342 342 345 346 347 的约束
二三四五六措	一、备查文件	342 342 345 346 347 的约束
一二三匹五六措七	一、备查文件	342 345 346 347 的约束 348 全及运
一二三匹五六措七行	一、备查文件	342 342 345 346 347 的约束 348 全及运
一二三匹五六提七行八	一、备查文件	342 342 345 346 347 的约束 348 全及运 372
一二三匹五六指七行八九	一、备查文件	342 342 345 346 347 的约束 348 全及运 372 374
一二三匹五六措七行八九十	一、备查文件	342 345 346 347 的约束 348 全及运 372 374 376

十三、	发行人非重要子公司及参股公司情况	392
十四、	员工持股平台	396

第一节 释义

在本招股意向书中,除非另有说明或文义另有所指,下列简称具有如下特定 含义:

一、普通名词释义

股份公司、恒坤新 材、本公司、公司、 发行人	指	厦门恒坤新材料科技股份有限公司
恒坤有限、有限公司	指	厦门恒坤精密工业有限公司,系发行人前身
控股股东、实际控 制人	指	易荣坤
恒坤工贸	指	厦门市恒坤工贸有限公司,系发行人历史股东
福建泓光	指	福建泓光半导体材料有限公司,系发行人的全资子公司
大连恒坤	指	大连恒坤新材料有限公司,系发行人的全资子公司
安徽恒坤	指	安徽恒坤新材料科技有限公司,系发行人的全资子公司
上海楚坤	指	楚坤 (上海) 新材料科技有限公司, 系发行人的全资子公司
香港恒坤	指	恒坤精密工业香港有限公司,系发行人的全资子公司
泓坤微电子	指	泓坤微电子(厦门)有限公司,系发行人的全资子公司
武汉恒坤	指	武汉恒坤新材料科技有限公司,系发行人的全资子公司
福建恒晶	指	福建恒晶新材料科技有限公司,系发行人的全资子公司
漳州链芯	指	漳州链芯半导体有限公司,系发行人的全资子公司
司理可	指	福建司理可新材料有限公司,系发行人的全资子公司
上海芯远	指	上海芯远精材新材料有限公司,系发行人的全资子公司
恒坤创研	指	厦门恒坤新材创研有限公司,系发行人的全资子公司
晟明坤	指	晟明坤(厦门)材料科技有限公司,系报告期内发行人控股子公司, 已于 2024 年 8 月 9 日注销
日本精容	指	精容株式会社,系发行人的控股子公司
恒星电子	指	湖北恒星电子材料有限公司,系发行人曾经的参股公司,已于 2024 年7月3日注销
祐尼三的	指	厦门祐尼三的新材料科技有限公司,系发行人的参股公司
湖北三维	指	湖北三维半导体集成创新中心有限责任公司,系发行人的参股公司
大晶信息	指	大晶信息化学品(徐州)有限公司,系发行人的参股公司
长存产投	指	长存产业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙),系发行人的参股企业
上海八亿时空	指	上海八亿时空先进材料有限公司,系发行人的参股公司

翌光半导体	指	图光半导体(厦门)有限公司,系发行人报告期内的全资子公司,于 2022 年 9 月 23 日注销
厦门神剑	指	厦门神剑投资合伙企业(有限合伙),系发行人员工持股平台
兆莅恒	指	厦门兆莅恒投资合伙企业(有限合伙),系发行人员工持股平台
晟临芯	指	厦门晟临芯股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人员工持股平台
晟临坤	指	厦门晟临坤投资合伙企业(有限合伙),系发行人员工持股平台
恒众坤合	指	厦门恒众坤合投资合伙企业(有限合伙),系发行人员工持股平台
苏州恒坤	指	苏州恒坤精密电子有限公司,发行人实际控制人控制的企业
深圳欣恒坤	指	深圳市欣恒坤科技有限公司,发行人实际控制人控制的企业
厦门积能	指	厦门积能电子科技有限公司,发行人实际控制人控制的企业
新投春霖	指	无锡新投春霖科创投资合伙企业(有限合伙)
浙港春霖	指	嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业(有限合伙)
勾陈资本	指	勾陈资本(厦门)投资管理有限公司
安徽和壮	指	安徽和壮高新技术成果基金合伙企业(有限合伙)
前海投资	指	前海股权投资基金 (有限合伙)
中原前海	指	中原前海股权投资基金 (有限合伙)
恒坤投资	指	福建恒坤投资有限公司,曾用名"恒坤(厦门)投资管理有限公司"
勾陈合伙	指	勾陈(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
宜兴高易	指	宜兴高易创业投资合伙企业(有限合伙)
福州红土	指	福州市红土创业投资合伙企业(有限合伙)
漳州高新	指	漳州高新区创业投资有限公司
创合鑫材	指	创合鑫材(厦门)制造业转型升级基金合伙企业(有限合伙)
昇葆元启	指	厦门市昇葆元启创业投资合伙企业(有限合伙)
苏州厚望	指	苏州厚望新业创业投资合伙企业(有限合伙)
安徽安华	指	安徽安华创新风险投资基金有限公司
建信领航	指	建信领航战略性新兴产业发展基金(有限合伙)
鑫恒舜	指	厦门鑫恒舜投资合伙企业(有限合伙)
九州晟德	指	厦门九州晟德股权投资合伙企业(有限合伙)
平阳启众	指	平阳启众股权投资合伙企业(有限合伙)
天健力丰	指	厦门天健力丰创业投资合伙企业(有限合伙)
赣州九派	指	赣州九派允公股权投资合伙企业(有限合伙)
晟芯盈	指	厦门晟芯盈投资合伙企业(有限合伙)
铜陵垣涪	指	铜陵垣涪企业管理合伙企业(有限合伙)
	_	

青岛中胶	指	青岛中胶创智企业管理合伙企业(有限合伙)		
枣庄钧鑫	指	枣庄钧鑫创锦股权投资基金合伙企业(有限合伙)		
博润多	指	博润多策略(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)		
江苏高易	指	江苏高易创业投资管理有限公司		
天健周行	指	厦门天健周行创业投资合伙企业 (有限合伙)		
北京元培	指	北京元培科技创新投资中心(有限合伙)		
龙岩昊嘉	指	龙岩昊嘉创业投资合伙企业(有限合伙)		
泉州华诺	指	泉州华诺创业投资合伙企业 (有限合伙)		
长兴虢实	指	长兴虢实股权投资合伙企业(有限合伙)		
济宁弘科	指	济宁弘科股权投资基金合伙企业 (有限合伙)		
重庆制造业	指	重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)		
湖北江城	指	湖北江城创新壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)		
合肥穗禾	指	合肥穗禾科创股权投资基金合伙企业(有限合伙)		
中电基金	指	中电科(南京)产业投资基金合伙企业(有限合伙)		
中化创新	指	中化创新 (泉州) 产业投资基金合伙企业 (有限合伙)		
杭州嘉港	指	杭州嘉港世纪创业投资合伙企业(有限合伙)		
成都交子	指	成都交子九颂数智创业投资合伙企业(有限合伙)		
淄博金控	指	淄博市财金控股集团有限公司		
厦门羽嘉	指	厦门羽嘉科技合伙企业(有限合伙),曾用名"长兴羽嘉科技合伙企业(有限合伙)",现已注销		
日本合成橡胶	指	JSR 株式会社		
信越化学	指	信越化学工业株式会社		
德国默克	指	Merck KGaA		
东京应化	指	东京应化工业株式会社		
日产化学	指	日产化学株式会社		
富士胶片	指	富士胶片株式会社		
美国杜邦	指	DuPont de Nemours, Inc.		
Brewer Science	指	Brewer Science, Inc.		
SKMP	指	SK Materials Performance Co., Ltd.		
Soulbrain	指	Soulbrain Co., Ltd.		
SK 集团	指	SK Inc.		
SK 海力士	指	SK Hynix Inc		
南大光电	指	江苏南大光电材料股份有限公司,A 股上市公司,股票代码: 300346.SZ		
上海新阳	指	上海新阳半导体材料股份有限公司,A 股上市公司,股票代码: 300236.SZ		

	Г	
艾森股份	指	江苏艾森半导体材料股份有限公司,A 股上市公司,股票代码: 688720.SH
飞凯材料	指	上海飞凯材料科技股份有限公司,A 股上市公司,股票代码: 300398.SZ
彤程新材	指	彤程新材料集团股份有限公司,A股上市公司,股票代码:603650.SH
北京科华	指	北京科华微电子材料有限公司,彤程新材子公司
晶瑞电材	指	晶瑞电子材料股份有限公司,A股上市公司,股票代码: 300655.SZ
瑞红苏州	指	瑞红(苏州)电子化学品股份有限公司,晶瑞电材子公司,新三板挂牌公司,股票代码: 873886.NQ
股东(大)会	指	厦门恒坤新材料科技股份有限公司股东(大)会
董事会	指	厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	厦门恒坤新材料科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》
《公司章程(草案)》	指	《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程(草案)》
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
新三板、股转系 统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
两岸股权中心	指	厦门两岸股权交易中心
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
本次发行	指	厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市
本招股意向书、招 股意向书	指	为本次发行而制作的招股意向书,《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》
A 股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和 进行交易的普通股股票
境内、中国境内	指	中华人民共和国境内区域,就本招股意向书而言,不包括中国台湾地区、中国香港特别行政区及中国澳门特别行政区
境外	指	境内以外的国家和地区
引进业务	指	公司依靠对集成电路晶圆制造各类工艺的专业理解与技术积累,从境外引进销售光刻材料、前驱体材料、电子特气及其他湿电子化学品等集成电路关键材料

保荐人、保荐机 构、主承销商、中 信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商	指	中泰证券股份有限公司
锦天城、发行人律 师	指	上海市锦天城律师事务所
容诚会计师、申报 会计师	指	容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
弗若斯特沙利文	指	弗若斯特沙利文咨询公司,是一家全球化的企业增长咨询公司,研 究板块覆盖了信息和通讯技术、汽车与交通、航空航天等各个细分 板块
报告期、最近三年 及一期	指	2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月
报告期各期末	指	2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日、2025年6月30日
报告期末	指	2025年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、专业术语释义

指 品主要分为集成电路、分立器件、光电子器件及传感器四类。 Integrated Circuit 的简称,指集成电路,通常也叫芯片(Chip),是一种微型电子器件或部件。采用半导体制造工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及它们之间的连接导线全部制作在一小块半导体晶片如硅片或介质基片上,然后焊接封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的电子器件。 晶圆指制造集成电路芯片的衬底(也叫基片)。由于其形状为圆形,所以称为晶圆。在晶圆上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能的集成电路产品。按其直径主要分为 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等规格。 科底 指 具有特定晶面和适当电学、光学和机械特性的用于生长外延层的洁净单晶薄片。 晶圆制造、芯片制造 指 通过一系列特定加工工艺,将晶圆加工制造成芯片的过程,晶圆制造分为前道工艺和后道工艺。 指 通过一系列特定加工工艺,在晶圆上加工制造半导体器件的生产厂商。集成电路制造过程中,以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺,尺寸越小,工艺水平越高,意味着在同样面积的晶圆上,可以制造出更多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间。完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。晶圆良率越高,同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多。			
届主要分为集成电路、分立器件、光电子器件及传感器四类。 Integrated Circuit 的简称,指集成电路,通常也叫芯片(Chip),是一种微型电子器件或部件。采用半导体制造工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及它们之间的连接导线全部制作在一小块半导体晶片如硅片或介质基片上,然后焊接封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的电子器件。 晶圆指制造集成电路芯片的衬底(也叫基片)。由于其形状为圆形,所以称为晶圆。在晶圆上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能的集成电路产品。按其直径主要分为 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等规格。 具有特定晶面和适当电学、光学和机械特性的用于生长外延层的洁净单晶薄片。 晶圆制造、芯片制造 指 通过一系列特定加工工艺,将晶圆加工制造成芯片的过程,晶圆制造分为前道工艺和后道工艺。 指 通过一系列特定加工工艺,在晶圆上加工制造半导体器件的生产厂商。集成电路制造过程中,以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺,尺寸越小,工艺水平越高,意味着在同样面积的晶圆上,可以制造出更多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间。完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。晶圆良率越高,同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多。	半导体	指	半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,半导体产
集成电路、芯片 指		Ī	
集成电路、芯片 指 晶体管、电阻、电容和电感等元件及它们之间的连接导线全部制作在一小块半导体晶片如硅片或介质基片上,然后焊接封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的电子器件。			Integrated Circuit 的简称,指集成电路,通常也叫芯片(Chip),是一
一小块半导体晶片如硅片或介质基片上,然后焊接封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的电子器件。			种微型电子器件或部件。采用半导体制造工艺,把一个电路中所需的
成为具有所需电路功能的电子器件。 晶圆指制造集成电路芯片的衬底(也叫基片)。由于其形状为圆形,所以称为晶圆。在晶圆上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能的集成电路产品。按其直径主要分为 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等规格。 村底 指 指 指 指 指 通过一系列特定加工工艺,将晶圆加工制造成芯片的过程,晶圆制造分为前道工艺和后道工艺。 晶圆厂 指 通过一系列特定加工工艺,在晶圆上加工制造半导体器件的生产厂商。 技术节点、工艺制程、工艺线宽 指 集成电路制造过程中,以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺,尺寸越小,工艺水平越高,意味着在同样面积的晶圆上,可以制造出更多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间。 完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。晶圆良率越高,同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多。	集成电路、芯片	指	晶体管、电阻、电容和电感等元件及它们之间的连接导线全部制作在
成为具有所需电路功能的电子器件。 晶圆指制造集成电路芯片的衬底(也叫基片)。由于其形状为圆形,所以称为晶圆。在晶圆上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能的集成电路产品。按其直径主要分为 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等规格。 村底 指 指 指 指 指 通过一系列特定加工工艺,将晶圆加工制造成芯片的过程,晶圆制造分为前道工艺和后道工艺。 晶圆厂 指 通过一系列特定加工工艺,在晶圆上加工制造半导体器件的生产厂商。 技术节点、工艺制程、工艺线宽 指 集成电路制造过程中,以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺,尺寸越小,工艺水平越高,意味着在同样面积的晶圆上,可以制造出更多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间。 完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。晶圆良率越高,同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多。			一小块半导体晶片如硅片或介质基片上,然后焊接封装在一个管壳内,
指 以称为晶圆。在晶圆上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能的集成电路产品。按其直径主要分为 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等规格。 衬底 指 具有特定晶面和适当电学、光学和机械特性的用于生长外延层的洁净单晶薄片。 晶圆制造、芯片 指 通过一系列特定加工工艺,将晶圆加工制造成芯片的过程,晶圆制造分为前道工艺和后道工艺。 晶圆厂 指 通过一系列特定加工工艺,在晶圆上加工制造半导体器件的生产厂商。 技术节点、工艺 指 集成电路制造过程中,以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺,尺寸越小,工艺水平越高,意味着在同样面积的晶圆上,可以制造出更多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间。 良率 指 完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。晶圆良率越高,同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多。			
指 以称为晶圆。在晶圆上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能的集成电路产品。按其直径主要分为 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等规格。 衬底 指 具有特定晶面和适当电学、光学和机械特性的用于生长外延层的洁净单晶薄片。 晶圆制造、芯片 指 通过一系列特定加工工艺,将晶圆加工制造成芯片的过程,晶圆制造分为前道工艺和后道工艺。 晶圆厂 指 通过一系列特定加工工艺,在晶圆上加工制造半导体器件的生产厂商。 技术节点、工艺 指 集成电路制造过程中,以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺,尺寸越小,工艺水平越高,意味着在同样面积的晶圆上,可以制造出更多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间。 良率 指 完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。晶圆良率越高,同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多。			晶圆指制造集成电路芯片的衬底(也叫基片)。由于其形状为圆形,所
指 定电性功能的集成电路产品。按其直径主要分为 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等规格。 村底 指 具有特定晶面和适当电学、光学和机械特性的用于生长外延层的洁净单晶薄片。 晶圆制造、芯片 指 通过一系列特定加工工艺,将晶圆加工制造成芯片的过程,晶圆制造分为前道工艺和后道工艺。 晶圆厂 指 通过一系列特定加工工艺,在晶圆上加工制造半导体器件的生产厂商。 技术节点、工艺制程、工艺线宽 指 集成电路制造过程中,以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺,尺寸越小,工艺水平越高,意味着在同样面积的晶圆上,可以制造出更多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间。 完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。晶圆良率越高,同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多。			
英寸、8 英寸、12 英寸等规格。 村底 指 具有特定晶面和适当电学、光学和机械特性的用于生长外延层的洁净单晶薄片。 晶圆制造、芯片制造 指 通过一系列特定加工工艺,将晶圆加工制造成芯片的过程,晶圆制造分为前道工艺和后道工艺。 晶圆厂 指 通过一系列特定加工工艺,在晶圆上加工制造半导体器件的生产厂商。 技术节点、工艺制程、工艺线宽 指 提成电路制造过程中,以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺,尺寸越小,工艺水平越高,意味着在同样面积的晶圆上,可以制造出更多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间。 完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。晶圆良率越高,同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多。	晶圆	指	
村底 指 具有特定晶面和适当电学、光学和机械特性的用于生长外延层的洁净单晶薄片。 晶圆制造、芯片 指 通过一系列特定加工工艺,将晶圆加工制造成芯片的过程,晶圆制造分为前道工艺和后道工艺。 晶圆厂 指 通过一系列特定加工工艺,在晶圆上加工制造半导体器件的生产厂商。 技术节点、工艺制程、工艺线宽 集成电路制造过程中,以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺,尺寸越小,工艺水平越高,意味着在同样面积的晶圆上,可以制造出更多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间。 良率 指 完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。晶圆良率越高,同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多。			
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本			211 211 211
晶圆制造、芯片 制造 指 通过一系列特定加工工艺,将晶圆加工制造成芯片的过程,晶圆制造分为前道工艺和后道工艺。 晶圆厂 指 通过一系列特定加工工艺,在晶圆上加工制造半导体器件的生产厂商。 技术节点、工艺制程、工艺线宽 集成电路制造过程中,以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺,尺寸越小,工艺水平越高,意味着在同样面积的晶圆上,可以制造出更多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间。 良率 指 完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。晶圆良率越高,同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多。	衬底	指	
制造 指 分为前道工艺和后道工艺。			7 7777
晶圆厂 指 通过一系列特定加工工艺,在晶圆上加工制造半导体器件的生产厂商。 技术节点、工艺制程、工艺线宽 指 集成电路制造过程中,以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺,尺寸越小,工艺水平越高,意味着在同样面积的晶圆上,可以制造出更多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间。 完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。晶圆良率越高,同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多。		指	
技术节点、工艺制程、工艺线宽 指 集成电路制造过程中,以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺,尺寸越小,工艺水平越高,意味着在同样面积的晶圆上,可以制造出更多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间。 完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。晶圆良率越高,同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多。		+1/1	
指 寸越小,工艺水平越高,意味着在同样面积的晶圆上,可以制造出更多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间。 完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。晶圆良率越高,同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多。	前四 <i>)</i>	1百	
制程、工艺线宽 指 可越小,工艺水平越高,意味看在同样面积的晶圆上,可以制造出更多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间。 完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。晶圆良率越高,同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多。	技术节占, 工艺	指	
多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间。 良率 指 完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。晶圆良率越高,同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多。			寸越小,工艺水平越高,意味着在同样面积的晶圆上,可以制造出更
良率 指 的比值。晶圆良率越高,同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多。	刚性、工乙线见		多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间。
的比值。晶圆艮率越局,同一片晶圆上产出的好心片数量就越多。	白 宓	指	完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片
	尺半		的比值。晶圆良率越高,同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多。
		指	晶圆制造分为前道工艺和后道工艺,前道工艺主要包括晶圆清洗、光
前道工艺、后道 拟 刻、刻蚀、离子注入、扩散、薄膜沉积、研磨抛光、晶圆检测等;后	前道工艺、后道		刻、刻蚀、离子注入、扩散、薄膜沉积、研磨抛光、晶圆检测等;后
工艺	工艺		道工艺主要包括晶圆减薄、晶圆切割、贴片、引线键合、模塑、切晶
成塑、测试等。			成塑、测试等。
利用光化学反应原理把事先制备在掩模板上的图形转印到一个衬底上	1, 2 , 2 + +	-UL	利用光化学反应原理把事先制备在掩模板上的图形转印到一个衬底上
光刻工艺 指 的过程,是集成电路晶圆制造的一道关键工艺。	光刻上艺	指	

	F	
薄膜沉积工艺	指	利用含有薄膜元素的一种或几种气相化合物或单质,通过气相沉积(包括物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD)以及原子气相沉积(ALD)等)方式在衬底表面形成薄膜的过程,系集成电路晶圆制造的重要工艺之一。
光刻材料	指	光刻工艺中用到的各类型高纯化学材料,包括 SOC (碳膜涂层)、ARC (抗反射涂层)、光刻胶、Top Coating、稀释剂、冲洗液、显影液等。
前驱体材料	指	携有目标元素,呈气态或易挥发液态或固态,具备化学热稳定性,同时具备相应的反应活性或物理性能的一类物质;是集成电路制造中薄膜沉积工艺中使用到的一种重要介质,用于形成符合半导体制造要求的各类薄膜层的核心原材料。
电子特气	指	电子特种气体,较传统气体一般具有特殊用途且纯度更高,特种气体的重要分支,用于半导体、显示 面板、光伏及其它电子产品生产。
树脂	指	Resin,一种高分子聚合物,系光刻材料的主要成份之一,不同类型或品种的光刻材料所用树脂存在较大差异。树脂原材料主要系单体,系小分子化合物,通过化学合成将小分子化合物聚合成为树脂。
碳膜涂层/SOC	指	Spin on Carbon,简称 SOC,高碳含量的交联芳香结构聚合物,一般由聚酰胺酸树脂、交联剂和溶剂等混配而成,系一种有机涂层。
抗反射涂层 /ARC	指	Anti-Reflection Coating,简称 ARC,指涂布在光刻胶底部或顶部等的涂层,由高分子树脂、染料、热致产酸剂、溶剂等组成,系各类抗反射涂层总称,可包括 SiARC、BARC、TARC 等。
底部抗反射涂 层/BARC	指	Bottom Anti-Reflection Coating,简称 BARC,涂布在光刻胶底部的抗反射涂层。
含硅抗反射涂 层/SiARC	指	Silicon containing Anti-Reflection Coating,简称 SiARC,三层光刻工艺 涉及光刻材料之一。
顶部抗反射涂 层/TARC	指	Top Anti-Reflection Coating,简称 TARC,涂布在光刻胶顶部的抗反射涂层。
顶部涂层/Top Coating	指	Top Coating,一种涂布光刻胶顶部的防水涂层,隔绝光刻胶与水的物理接触,主要应用于浸没式光刻工艺。
光刻胶	指	为利用光化学反应进行微细加工图形转移的媒体,由感光树脂、光敏剂、溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光材料,被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作,是微细加工技术的关键性材料。
正性光刻胶	指	在光刻工艺中,涂层经曝光、显影后,曝光部分在显影液中溶解而未 曝光部分保留下来形成图像的光刻胶。
负性光刻胶	指	与正性光刻胶相反,其中被溶解的是未曝光部分,而曝光部分形成图像。
i-Line 光刻胶	指	应用紫外曝光光源波长为 365nm 的光刻胶,可应用于集成电路、分立器件等领域。
KrF 光刻胶	指	应用氟化氪曝光光源波长为 248nm 的光刻胶,又称氟化氪光刻胶,主要应用于集成电路领域。
ArF 光刻胶	指	应用氟化氩曝光光源波长为 193nm 的光刻胶,又称为氟化氩光刻胶,可进一步分为 ArF 干式光刻胶和 ArF 浸没式光刻胶,干法工艺的折射介质是空气;湿法工艺的折射介质是水,均主要应用于集成电路领域。
EUV 光刻胶	指	应用极紫外曝光光源波长为 13.5nm 的光刻胶,主要应用于集成电路 领域。
掩模板	指	又称光掩模、光罩、掩膜版,是微电子加工技术常用的光刻工艺所使用的图形母版。掩模板作为图形信息的载体,通过曝光过程,将图形转移到基体材料上,从而实现图形的转移。
显影液	指	Developer,溶解由曝光造成的光刻胶的可溶解区域的一种化学溶剂。

稀释剂	指	Thinner,用于调整光刻胶的浓度和粘度的一种化学溶剂。		
冲洗剂	指	Rinse,用于光刻工艺中清洗的一种化学溶剂。		
TEOS	指	正硅酸乙酯,又名四乙氧基硅烷,化学式为 C ₈ H ₂₀ O ₄ Si,一种硅基前驱体材料。		
HCDS	指	六氯乙硅烷,化学式为 Cl ₆ Si ₂ ,一种硅基前驱体材料。		
BDEAS	指	双(二乙氨基)硅烷,化学式为 C ₈ H ₂₂ N ₂ Si, 一种硅基前驱体材料。		
TMA	指	三甲基铝,化学式为C3H9Al,一种金属基前驱体材料。		
ТЕРО	指	磷酸三乙酯,化学式为 $C_6H_{15}O_4P$,一种磷基前驱体材料。		
TEB	指	硼酸三乙酯,化学式为 $C_6H_{15}BO_3$,一种硼基前驱体材料。		
四氯化铪	指	化学式为 HfCl4, 一种金属基前驱体材料。		
EUV	指	Extreme Ultra-violet 的简称,指极紫外光刻,是一种使用极紫外波长的下一代光刻技术,其波长为 13.5nm, EUV 光刻技术需使用到 EUV 光刻机。		
DUV	指	Deep Ultraviolet 的简称,指深紫外光刻,是一种使用波长较短的紫外光(通常为 248nm,193nm 或更短波长)的光刻技术。		
逻辑芯片	指	一种电子元器件,是一种用于数字系统设计的专用集成电路,包含着 复杂的逻辑门电路。		
存储芯片	指	也叫半导体存储器,是电子数字设备中用来存储的主要部件,是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用。		
DRAM	指	动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory),是一种半导体存储器,每隔一段时间要刷新充电一次以维持内部的数据,故称"动态"。		
NAND 闪存	指	数据型闪存芯片,一种非易失闪存技术及基于该技术的产品。		
3D NAND 闪存	指	一种新兴的闪存类型,通过把内存颗粒堆叠在一起来解决 2D 或者平面 NAND 闪存带来的限制。		
摩尔定律	指	由英特尔创始人之一戈登·摩尔提出来的,其内容为: 当价格不变时, 集成电路设计技术每 18 至 24 个月就更新换代一次,即芯片上可容纳 的晶体管数目每隔约 18 至 24 个月便会增加一倍,性能也提升一倍。 摩尔定律并非数学、物理定律,而是对发展趋势的一种分析预测。		
三层结构	指	Tri-layer,特指光刻胶、SiARC 以及 SOC 三层光刻材料组合结构。		
FinFET	指	Fin Field-Effect Transistor 的简称,指鳍式场效应晶体管,是一种新的互补式金属氧化物半导体晶体管,可以改善电路控制并减少漏电流,缩短晶体管的闸长。		
多重曝光技术	指	主要包括 LELE 多重曝光、LFLE 多重曝光或 SADP 技术,目的系提高光刻分辨率与细节,最终提升芯片技术节点。		
浸没式光刻工 艺	指	将传统光刻工艺中空气介质换成液体,利用光通过液体介质后光源波长缩短来提高分辨率,其缩短的倍率即为液体介质的折射率。目前业 界以超纯水作为浸没式液体。		
加仑	指	一种容积单位,英文全称 gallon		

注:本招股意向书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入原因所致。

第二节 概览

本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股意向书全文。

一、重大事项提示

本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股意向书全文,并特别关注以下重要事项及公司风险。

(一) 特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读招股意向书"第三节 风险因素"章节,特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险:

1、新产品未能实现产业化的风险

公司主要从事 12 英寸集成电路晶圆制造关键材料的研发、生产和销售,旨在解决集成电路制造领域关键材料自主可控。为持续满足客户的国产化需求,并保持公司的核心竞争力和市场地位,公司需不断进行新产品的开发。但是,新产品开发能否取得预期的研发成果,并通过客户验证以顺利实现量产存在一定不确定性。如新产品开发失败或因客户需求发生变化,导致新产品无法实现产业化,则将对公司未来的业绩增长造成不利影响。

2、与引进产品供应商合作终止或交易条件发生重大不利变化的风险

报告期内,公司引进产品销售毛利分别为 18,940.90 万元、16,791.56 万元、19,230.92 万元和 3,625.95 万元,占公司主营业务毛利的比例分别为 82.05%、74.42%、65.86%和 30.51%;自产产品销售毛利分别为 4,142.52 万元、5,772.07 万元、9,970.85 万元和 8,259.39 万元,占主营业务毛利的比例分别为 17.95%、25.58%、34.14%和 69.49%。2025 年 1-6 月,公司引进产品销售毛利占主营业务毛利的比例进一步下降。公司引进产品销售毛利占比逐年降低,但仍是公司的利润来源之一。

其中,发行人报告期各期向第一大客户销售的引进自 SKMP 的光刻材料销售毛利分别为 13,756.04 万元、11,633.86 万元、14,201.87 万元和 672.07 万元。

为进一步跟进国家集成电路国产化战略,自 2025 年起,发行人与 SKMP 之间已终止该部分光刻材料产品合作,公司引进业务收入和毛利将较 2024 年同比下滑,预计短期将对公司业绩造成不利影响。2025 年 1-6 月,公司向第一大客户的自产业务收入增长迅速,同比增长超过 80%,抵消了 SKMP 直接向第一大客户销售对公司引进业务收入的影响,公司向第一大客户整体销售收入保持同比增长。

报告期内,公司自产产品销售收入保持较高复合增长率,但是,如果未来公司与其他主要引进产品供应商合作终止或交易条件发生重大不利变化,则将导致公司引进产品销售收入和毛利进一步下降,并对公司的经营产生不利影响。

3、客户集中度较高及单一客户依赖的风险

报告期内,公司前五大客户(同一控制下合并计算)的收入占主营业务收入的比例分别为99.22%、97.92%、97.20%和95.38%,客户集中度较高。其中,向第一大客户的销售占比分别为72.35%、66.47%、64.07%和55.15%,对其存在较大依赖。鉴于公司产品目前主要应用于集成电路领域,下游客户主要系晶圆厂,行业集中度较高,公司预计在未来一定时期内仍将存在客户集中度较高的情形。

若未来公司与重要客户的长期合作关系发生变化或终止,或主要客户因其自身经营原因而减少对公司产品的采购,或因公司在产品质量、技术创新和产品开发、生产交货等方面无法满足客户需求而导致与客户的合作关系发生不利变化,将会对公司的经营业绩产生不利影响。

4、贸易摩擦影响原材料与设备供应的风险

报告期内,公司自产产品所需的主要原材料、生产及检测设备或设备核心组件仍需通过进口,受国际贸易形势的影响较大。虽然,公司已通过技术转让和自主研发相结合方式,致力将光刻材料核心原材料树脂实现国产化应用落地,降低原材料供应链的潜在风险,但是,受国际政治经济不确定性增强、国际贸易保护主义抬头等因素影响,将可能导致关键原材料和设备供应紧张甚至断供,进而对公司的技术升级及产品交付能力造成不利影响。

5、自产前驱体材料毛利率为负的风险

报告期内,公司自产前驱体材料销售收入分别为189.31万元、1,855.93万元、4,420.26万元和3,048.70万元,占主营业务收入的比例分别为0.60%、5.13%、

8.19%和 10.58%,毛利率分别为-329.59%、-19.91%、-1.56%和 9.62%,前三年毛利率持续上升但仍为负值,主要是因为产品处于市场推广期,产量较低,单位固定成本较高。2025 年 1-6 月,随着自产前驱体材料产量的进一步提升,毛利率已由负转正。

未来,如公司自产前驱体材料无法获得持续的规模化订单以降低单位固定成本,则相关产品的毛利率将降低或可能持续为负,相关固定资产亦将面临减值风险,进而对公司的整体盈利能力造成不利影响。

6、募投项目新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险

报告期各期末,公司固定资产和在建工程账面原值分别为 51,606.24 万元、93,006.07 万元、126,647.45 万元和 133,663.62 万元,其中固定资产每年计提折旧金额分别为 2,818.78 万元、3,350.74 万元、4,832.79 万元和 3,288.02 万元,固定资产投入及折旧金额逐年增加。根据本次募投项目实施计划,公司拟投入135,247.51 万元用于场地建设和设备购置,每年最高将新增折旧摊销 9,675.42 万元(含报告期内购建的已转固资产和在建工程转固后折旧)。受发行人与 SKMP之间部分产品合作终止和募投项目实施新增折旧摊销等因素影响,预计短期将导致公司经营业绩出现下滑。若本次募投项目在实施过程中,产业政策、市场环境、技术、管理、人才等方面出现重大不利变化,将影响项目的实施进度,致使项目的实际效益情况与公司预测存在差异,项目新增的折旧摊销将对公司盈利能力造成不利影响。

7、募投项目新增产能无法消化的风险

报告期内,公司自产产品的产能尚处于爬坡阶段,产能利用率相对较低,主要是由于:(1)对于原材料组分存在较大差异的产品,如共线生产存在交叉污染的风险,公司需为相关产品配备单独的产线;(2)大容量的生产设备符合成本效益原则,同时能够通过减少生产批次提高产品质量的稳定性;(3)提前进行产能储备以满足客户持续扩张的需求,有利于维持公司与客户之间的稳定合作。

本次募投项目拟新建约 500 吨 KrF/ArF 光刻胶等光刻材料、760 吨 TEOS 等前驱体材料产能。若现有客户需求的增长、新客户的拓展以及新产品的开发和验证进度不及预期,则可能会导致公司本次募投项目新增产能无法得到有效消化的

情况,对公司的业务发展与经营业绩造成不利影响。

(二)本次发行相关主体作出的重要承诺

发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人就业绩下滑延长股份锁定期事宜承诺如下:"发行人上市当年较上市前一年净利润(以扣除非经常性损益后归母净利润为准,下同)下滑 50%以上的,延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月;发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月;发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月。前述'届时所持股份'分别指本人上市前取得,上市当年及之后第二年、第三年发行人年报披露时仍持有的股份。"

本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施,具体承诺事项参见本招股意向书"第十二节附件"之"六、本次发行相关各方作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施"。

(三)利润分配政策的安排

公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润 分配计划和长期回报规划参见本招股意向书"第九节 投资者保护"之"二、发 行人股利分配政策"。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

(一) 发行人基本情况				
发行人名称	厦门恒坤新材料科技股份有限 公司	成立日期	2004年12月10日	
注册资本	38,192.166 万元人民币	法定代表人	易荣坤	
注册地址	厦门市海沧区东孚镇山边路 389号	主要生产经营 地址	厦门市海沧区海沧大道 567 号厦门中心 E 座	
控股股东	易荣坤	实际控制人	易荣坤	
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子 设备制造业	在其他交易场所 (申请)挂牌或 上市的情况		
(二)本次发行的有关中介机构				
保荐人	中信建投证券股份有限公司	主承销商	中信建投证券股份有限公司	

发行人律师	上海市锦天城律师事务所	联席主承销商	中泰证券股份有限公司	
审计机构	容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)	评估机构	北京国融兴华资产评估有限 公司	
验资机构	北京兴华会计师事务所(特殊 普通合伙)	验资复核机构	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		截至本招股意向书签署日,浙港春霖、新投春霖分别持有发行人 536.11 万股、222.00 万股股份,持股比例分别为 1.40%、0.58%。浙港春霖、新投春霖的执行事务合伙人系保荐人中信建投证券的全资子公司中信建投资本管理有限公司。除上述情形外,发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在其他任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。		
	(三)本次发行其他有关机构			
股票登记机 构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	收款银行	中信银行北京京城大厦支行	
其他与本次发	行有关的机构	无		

三、本次发行概况

股票种类	境内上市人民币普通股(A股)股票			
每股面值	人民币 1.00 元			
发行股数	6,739.7940 万股	占发行后总股本比例	15.00%	
其中:发行新股数量	6,739.7940 万股	占发行后总股本比例	15.00%	
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-	
发行后总股本	44,931.9600 万股			
每股发行价格	人民币【】元			
发行市盈率	【】倍(根据发行价格除以发行后每股收益计算,发行后每股收益按照 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)			
发行前每股净资产	4.06 元 (按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算) 0.25 元(按 2024 年度经审计的 扣除非经常性 损益前后孰低的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)			
发行后每股净资产	【】元 (按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属	发行后每股收益	【】元(按2024 年度经审计的	

	于母公司所有者权益与 扣除非经常性		
	本次募集资金净额之和 除以本次发行后总股本 计算)		
发行市净率	【】倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)		
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者 询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行		
发行对象	符合资格的战略投资者、网下投资者和上交所开户的境内自然人、法人等投资者(中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外)		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	人民币【】万元		
募集资金净额	人民币【】万元		
募集资金投资项目	集成电路前驱体二期项目		
	集成电路用先进材料项目		
发行费用概算	本次发行费用明细如下: 1、承销及保荐费:保荐费为 460.00 万元;承销费为募集资金总额*7.5%+200 万元,且不低于 6,200.00 万元; 2、审计及验资费: 2,165.00 万元; 3、律师费:834.91 万元; 4、用于本次发行的信息披露费:544.34 万元; 5、发行手续费及其他费用:52.30 万元。 上述发行手续费中暂未包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为 0.025%,将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费。上述各项发行费用均为不含增值税金额,含税金额=不含税金额×(1+6%)。各项费用根据发行结果可能会有调整。		
高级管理人员、员工拟参 与战略配售情况	发行人高级管理人员与核心员工拟通过资产管理计划参与本次战略配售,参与战略配售的数量合计不超过本次发行规模的10.00%,即 673.9794 万股;同时参与认购金额合计不超过8,000.00万元,最终战略配售数量将在T-2日确定发行价格后确定。资管计划获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月		
保养人将安排相关子公司中信建投投资有限公司(以下信建投投资")参与本次发行战略配售,初始跟投比例次发行数量的 5%,即 336.9897 万股。最终战略配售数定发行价格后确定。中信建投投资承诺获得本次配售的期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月			
	期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月		
	期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 (二)本次发行上市的重要日期		
刊登初步询价公告日期			

刊登发行公告日期	2025年11月6日
申购日期	2025年11月7日
缴款日期	2025年11月11日
股票上市日期	本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市

(三) 本次战略配售情况

本次发行初始战略配售发行数量为 1,347.9588 万股,占本次发行数量的 20%。最终战略配售比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨,具体如下:

1、发行人的高级管理人员与核心员工参与战略配售的情况

(1) 投资主体

发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划分别为中信建投基金一共赢 58 号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称"共赢 58 号员工资管计划")、中信建投基金-共赢 62 号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称"共赢 62 号员工资管计划"),共赢 58 号员工资管计划和共赢 62 号员工资管计划后文统称为"发行人员工资管计划"。

(2) 参与规模和具体情况

发行人员工资管计划参与战略配售合计不超过本次发行规模的 10.00%,即 673.9794 万股;同时参与认购金额合计不超过 8,000.00 万元,具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。

①共赢 58 号员工资管计划

产品名称	中信建投基金-共赢 58 号员工参与战略配售集合资产管理计划
成立日期	2025年9月26日
备案日期	2025年9月29日
产品编号	SBHA09
募集资金规模	2,465.00 万元
 认购金额上限	2,465.00 万元
 管理人名称	中信建投基金管理有限公司
托管人名称	中国银行股份有限公司厦门市分行

实际支配主体	中信建投基金管理有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体。
具体情况	参与共赢 58 号员工资管计划的人员均为发行人的高级管理人员或发行人核心员工。该等人员情况详见本招股意向书"第十二节附件"之"附件十五:发行人高级管理人员与核心员工拟参与战略配售情况"

②共赢62号员工资管计划

产品名称	中信建投基金-共赢 62 号员工参与战略配售集合资产管理计划
成立日期	2025年9月26日
备案日期	2025年10月9日
产品编号	SBHB08
募集资金规模	5,535.00 万元
认购金额上限	5,535.00 万元
管理人名称	中信建投基金管理有限公司
托管人名称	兴业银行股份有限公司厦门分行
实际支配主体	中信建投基金管理有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体。
具体情况	参与共赢62号员工资管计划的人员均为发行人的高级管理人员或发行人核心员工。该等人员情况详见本招股意向书"第十二节附件"之"附件十五:发行人高级管理人员与核心员工拟参与战略配售情况"

发行人员工资管计划获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后,对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

2、保荐人相关子公司参与战略配售的情况

(1) 投资主体

企业名称	中信建投投资有限公司	
统一社会信用代码	91110111МA0193JP0G	
类型	有限责任公司 (法人独资)	
住所	北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦 C座 109	
法定代表人	李旭东	
注册资本	610,000 万元	
营业期限	2017年11月27日至无固定期限	
经营范围	投资管理;股权投资管理;投资咨询(中介除外);项目投资。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金	

	不受损失或者承诺最低收益";市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)			
	股东名称	认缴出资金额(万元)	出资比例(%)	
股东情况	中信建投证券	610,000	100	
	合计	610,000	100	

(2) 参与规模

根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》要求,中信建投投资的投资比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定。

中信建投投资初始跟投比例为本次发行数量的 5%,即 336.9897 万股,具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。

中信建投投资获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后,对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

3、其他战略投资者参与战略配售的情况

除上述主体外,公司拟引入"与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业"参与战略配售。

其他战略投资者均已同发行人签署认购协议。具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后最终确定。

其他战略投资者承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行 并上市之日起 12 个月。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国 证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

四、发行人主营业务经营情况

(一) 主要业务、主要产品或服务及其用途

公司致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用,是境内少数具备 12 英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一,主要从事 光刻材料和前驱体材料等产品的研发、生产和销售。报告期内,公司自产产品主 要包括 SOC、BARC、KrF 光刻胶、i-Line 光刻胶等光刻材料以及 TEOS 等前驱体材料,ArF 浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售,主要应用于先进 NAND、DRAM 存储芯片与 90nm 技术节点及以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节。此外,在境内集成电路产业替代需求增加的背景下,为快速获取客户资源,并积累产品导入和品控经验,公司以引进境外产品为切入点,引进并销售光刻材料、前驱体材料、电子特气及其他湿电子化学品等集成电路关键材料,创新性地走出了一条"引进、消化、吸收、再创新"的发展路径。报告期内,公司客户涵盖了多家中国境内领先的 12 英寸集成电路晶圆厂,实现境外同类产品替代,打破 12 英寸集成电路关键材料国外垄断。

报告期内,公司主营业务收入的构成情况如下:

单位:万元、%

项目	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自产产品	24,977.42	86.68	34,418.93	63.77	19,058.84	52.72	12,357.89	38.94
光刻材料	21,928.71	76.10	29,998.67	55.58	17,202.90	47.58	12,168.58	38.35
前驱体材料	3,048.70	10.58	4,420.26	8.19	1,855.93	5.13	189.31	0.60
引进产品	3,836.84	13.32	19,556.25	36.23	17,094.17	47.28	19,376.03	61.06
光刻材料	981.16	3.41	14,711.02	27.26	12,141.90	33.58	14,290.10	45.03
前驱体材料	1,065.70	3.70	1,828.08	3.39	2,449.56	6.78	3,556.56	11.21
电子特气	768.96	2.67	1,921.99	3.56	1,728.88	4.78	1,208.19	3.81
其他	1,021.00	3.54	1,095.17	2.03	773.83	2.14	321.18	1.01
主营业务收 入合计	28,814.25	100.00	53,975.18	100.00	36,153.01	100.00	31,733.92	100.00

(二)主要原材料及供应商情况

报告期内,对于自产产品,公司对外采购包括树脂、添加剂、溶剂以及其他 辅料耗材等主要原材料;对于引进产品,公司根据客户需求向供应商进行成品采购。报告期内,公司主要原材料供应商具体参见本招股意向书"第五节业务与技术"之"四、发行人采购情况及主要供应商"。

(三) 生产模式、销售方式及重要客户

报告期内,对于自产产品,公司子公司福建泓光与大连恒坤分别负责光刻材

料与前驱体材料的生产工作,并采用以销定产的生产模式。报告期内,公司产品销售均采用直销模式,主要客户包括多家中国境内领先的 12 英寸集成电路晶圆厂,具体参见本招股意向书"第五节业务与技术"之"三、发行人销售情况及主要客户"。

(四) 行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

现阶段,中国境内 12 英寸集成电路用光刻材料与前驱体材料仍然系由境外厂商占据主要市场份额,境内关键材料厂商虽然已有突破,但是尚未在先进制程形成大规模量产供货局面。公司 SOC、BARC、KrF 光刻胶、i-Line 光刻胶以及TEOS 均已实现量产供货,ArF 浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售。2024 年度,公司自产产品销售收入为 34,418.93 万元,已实现对日产化学、信越化学、美国杜邦、德国默克、日本合成橡胶、东京应化等境外厂商同类产品替代,成为境内主要的集成电路光刻材料与前驱体材料供应企业之一,实现对境内主流 12 英寸集成电路晶圆厂广泛覆盖。具体情况参见本招股意向书"第五节 业务与技术"之"二、发行人所处行业基本情况及竞争状况"之"(七)发行人市场地位和行业竞争格局"。

五、发行人符合科创板定位

(一) 发行人符合科创板支持方向

1、公司主营业务围绕集成电路关键材料,符合国家战略和新质生产力发展 方向

2020 年 7 月,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,明确为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量,从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等方面制定政策。2020 年 9 月,国家发改委、科技部、工信部、财政部联合发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》,意见提出:加快新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定,加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。2021 年 12 月,国务院发布《关于

印发"十四五"数字经济发展规划的通知》,提出: 瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能等战略性前瞻性领域,提高数字技术基础研发能力。着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平,强化关键产品自给保障能力。2024年3月,政府工作报告提出: 加快推动高水平科技自立自强。充分发挥新型举国体制优势,全面提升自主创新能力。积极培育新兴产业和未来产业。加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。

2024 年,证监会相继出台《关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》和《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》,明确"优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的'硬科技'企业在科创板上市"以及"集中力量支持重大科技攻关。加强与有关部门政策协同,精准识别科技型企业,优先支持突破关键核心技术的科技型企业上市融资、并购重组、债券发行,健全全链条'绿色通道'机制"。

集成电路关键材料是培育和发展集成电路新质生产力的关键领域,实现关键材料自主可控是解决集成电路核心技术难题的上游基础。公司主营业务为集成电路领域关键材料的研发与产业化应用,已实现量产供货产品包括 SOC、BARC、KrF 光刻胶、i-Line 光刻胶等光刻材料和 TEOS 等前驱体材料,ArF 浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售,相关产品主要应用于先进 NAND、DRAM 存储芯片与 90nm 技术节点以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节,系 12 英寸集成电路晶圆制造核心制程与核心工艺不可或缺的关键材料,全面助力实现国家集成电路国产化战略。因此,公司主营业务符合国家战略方向,系集成电路领域突破关键核心技术的"硬科技"企业。

公司主营业务产品介绍具体参见本招股意向书"第五节业务与技术"之"一、发行人主营业务、主要产品及服务情况"之"(二)公司主要产品及服务"。

2、公司拥有关键核心技术,产品已陆续产业化并实现替代

公司专注于集成电路关键材料的研发与产业化应用,核心技术均系围绕关键材料的研发和生产展开,并进一步延伸至对关键材料上游原材料的研发储备。公司主营业务产品中,光刻材料属于配方型精细化学品,前驱体材料属于高纯化学

试剂,在产品研发过程中需要对客户工艺制程与应用需求充分理解,并根据不同客户情况对产品进行改良调整,同时在产品生产过程中需要对产品品质与量产能力全面管控,确保产品品质与生产规模持续满足客户使用需求。

近年来,境内集成电路产业保持蓬勃发展,随着国家战略与行业政策多方位 扶持,集成电路产业国产化进程加速,境内晶圆厂在先进制程的研发创新能力、 生产制造能力以及市场开拓能力均不断提升。上游关键材料与设备企业作为影响 集成电路工艺制程先进性的核心要素,核心技术不仅需具备自主研发和持续创新 能力,同时还需具备规模生产和品控管理能力。公司承担并完成国家 02 科技重 大专项子课题与国家发改委专项研究任务系具备自主研发和持续创新能力的良 好体现,公司累计自产销售超过 55,000 加仑光刻材料系公司规模生产和品控管 理的有效佐证。截至报告期末,公司自产产品在研发、验证以及量供款数累计已 超过百款,公司与多家中国境内领先的 12 英寸集成电路晶圆厂均已形成稳定合 作机制,提供国产化关键材料技术支撑,为境内集成电路产业发展作出重要贡献。

公司核心技术介绍具体参见本招股意向书"第五节业务与技术"之"六、 发行人核心技术及研发情况"。

3、公司集中力量支持重大科技攻关,已承接多个国家部委专项任务

截至报告期末,公司已承接国家部委专项情况如下表所示:

序号	项目名称	项目状态
1	国家 02 科技重大专项子课题	已验收
2	国家发改专项研究任务	已验收
3	材料攻关项目 A	进行中
4	材料攻关项目 B	进行中
5	材料攻关项目 C	进行中

上述国家专项中,国家 02 科技重大专项子课题和国家发改专项研究任务均已结题并通过主管部门验收,对应产品已实现销售,成功助力集成电路国产化战略。

4、公司行业地位突出,市场认可度高

现阶段,境内光刻材料与前驱体材料仍然系由境外厂商占据主要市场份额,

境内关键材料企业虽然已有突破,但是尚未在先进技术节点形成大规模替代的局面。以公司自产光刻材料为例,根据弗若斯特沙利文市场研究,在 12 英寸集成电路领域,i-Line 光刻胶、SOC 国产化率 10%左右,BARC、KrF 光刻胶国产化率 1-2%左右,ArF 光刻胶国产化率不足 1%。在未来一定时期内,境内关键材料企业仍将以国产化应用为主要突破方向。公司是境内少数实现光刻材料与前驱体材料量产供货企业之一,根据弗若斯特沙利文市场研究,2023 年度,公司 SOC与 BARC 销售规模均已排名境内市场国产厂商第一位。

截至本招股意向书签署日,境内前十大晶圆厂中,多家均已成为公司客户且 对部分客户已形成稳定持续的销售规模。其中,报告期内,公司自产产品在部分 客户累计销售规模均已突破亿元,并先后获得了其颁发的"价值创造奖"和"研 发合作奖"。

(二) 发行人符合科创板行业领域的规定

公司主营业务为集成电路领域关键材料的研发与产业化应用,主要覆盖关键材料包括光刻材料与前驱体材料两大类,并根据客户需求引进包括电子特气等其他关键材料产品。

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)下属的电子专用材料制造(C3985)。根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》,公司属于新一代信息技术产业中的集成电路产业,具体为"1 新一代信息技术产业一1.3 电子核心产业一1.3.1 集成电路(集成电路材料)"。根据国家统计局《战略性新兴行业分类(2018)》,公司产品属于"3 新材料产业一3.3 先进石化化工新材料—3.3.6 专用化学品及材料制造(C3985 电子专用材料制造)"。根据国家统计局《新产业新业态新商业模式统计分类(2018)》,公司产品属于"020106 高储能和关键电子材料制造——3985 电子专用材料制造"。此外,根据工信部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录(2024 年版)》,公司产品属于关键战略材料,具体为"关键战略材料"之"三、先进半导体材料和新型显示材料"之"242 超高纯化学试剂"与"243 集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂"。

从相关目录分析,公司兼具"新一代信息技术"和"新材料"的产业属性,

从公司产品主要应用领域、主要客户群体、承担重大科研专项等方面分析,公司"新一代信息技术"产业属性更为突出:一方面,公司销售产品主要应用于 12 英寸集成电路制造领域,报告期内主要客户均系中国境内领先的 12 英寸集成电路晶圆厂;另一方面,公司先后承接并完成国家 02 科技重大专项子课题及国家发改委专项研究任务,打破境外厂商对集成电路关键材料垄断。

综上所述,公司所属行业符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中第四条第(一)款规定的"新一代信息技术领域"。

(三)发行人符合科创属性相关指标要求

公司同时符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》 第六条科创属性规定的 4 项指标,符合科创板定位,具体指标情况如下:

科创属性评价标准一		符合	指标情况	
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例≥5%,或最近三年累计研发投入金额≥8000万元	☑是	□否	公司最近三年累计研发投入金额 18,501.48万元,超过8,000万元。	
研发人员占当年员工总数的比例超过 10%	☑是	□否	截至 2024 年末,公司研发人员占比 15.56%,超过 10%。	
应用于公司主营业务并能够产业化的 发明专利≥7 项	☑是	□否	截至报告期末,公司应用于主营业务 并能够产业化的发明专利 43 项,超过 7 项。	
最近三年营业收入复合增长率>25%, 或最近一年营业收入金额>3亿	☑是	□否	2024 年实现营业收入 5.48 亿元,超过 3 亿元。	

六、发行人报告期主要财务数据和财务指标

报告期内,公司主要财务数据和财务指标情况如下:

项目	2025.6.30/ 2025 年 1-6 月	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度
资产总额 (万元)	293,750.66	264,536.63	209,108.60	163,289.60
归属于母公司所有者权益(万 元)	155,160.90	150,088.11	138,162.07	127,356.58
资产负债率(%)	47.18	43.26	33.92	22.19
营业收入 (万元)	29,433.73	54,793.88	36,770.78	32,176.52
净利润 (万元)	4,159.64	9,691.11	8,976.26	9,972.83
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	4,160.04	9,691.92	8,984.93	10,090.30
扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润(万元)	3,073.97	9,430.36	8,152.78	9,103.53

项目	2025.6.30/ 2025 年 1-6 月	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度
基本每股收益 (元)	0.11	0.25	0.24	0.30
稀释每股收益 (元)	0.11	0.25	0.23	0.30
加权平均净资产收益率(%)	2.73	6.78	6.78	14.72
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	19,128.30	19,158.76	8,796.42	14,933.43
现金分红 (万元)	-	-	1	-
研发投入占营业收入的比例(%)	14.13	16.17	14.59	13.28

注: 上述财务指标的计算公式如下:

- 1、资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
- 2、基本每股收益=P0÷S

 $S=S0+S1+Si\times Mi+M0-Si\times Mj+M0-Sk$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mi 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数

3、稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si\times Mi+M0-Sj\times Mj+M0-Sk+$ 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

4、加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中: P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M0 为报告期月份数; Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的,计算加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从报告期期初起进行加权;计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时,被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权;计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

5、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

七、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况

(一) 审计基准日后主要经营情况

本招股意向书已披露的财务报告的审计基准日为 2025 年 6 月 30 日。自财务报告审计截止日后至招股意向书签署日之间,公司经营情况良好,公司产业政策、

税收政策、行业市场环境、主要经营模式、主要客户及供应商的构成、经营管理 层及核心技术人员未发生重大变化,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 未发生重大变更,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

(二) 2025年1-9月业绩预计

基于公司目前的经营状况和市场环境,公司预计 2025 年 1-9 月主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例
营业收入	44,000.00 至 50,000.00	39,118.38	12.48%至 27.82%
归属于母公司所有者的净 利润	6,200.00 至 6,800.00	7,004.39	-11.48%至-2.92%
扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润	4,900.00 至 5,500.00	6,685.16	-26.70%至-17.73%

2025年1-9月,公司预计营业收入较上年同期增加12.48%至27.82%,扣非前后归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期减少11.48%至2.92%、26.70%至17.73%,主要变动原因与2025年1-6月相关变动原因一致。

上述 2025 年 1-9 月业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计,未经注册会计师审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

八、发行人选择的具体上市标准

公司根据《上市规则》的要求,结合企业自身规模、经营情况、盈利情况等 因素综合考量,选择的具体上市标准为:"预计市值不低于人民币 10 亿元,最近 两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000.00 万元,或者预计市值不低 于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。"

公司 2023 年度和 2024 年度归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为 8,152.78 万元和 9,430.36 万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000.00 万元。结合公司同行业可比公司在境内市场近期估值情况,基于对公司市值的预先评估,预计公司本次发行后总市值不低于人民币 10 亿元,满足市值及财务指标标准。

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股意向书签署日,发行人在公司治理中不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排等需要披露的重要事项。

十、募集资金用途与未来发展规划

(一)募集资金用途

2025 年 3 月 26 日,公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于调整公司募投项目的议案》,为满足公司漳州二期工程建设需要,公司对原计划用于 "SiARC 开发与产业化项目"实施的场地用途进行了调整,因此同意"SiARC 开发与产业化项目"不再作为募投项目,拟募资总额降低至 100,669.50 万元。

公司本次拟公开发行人民币普通股 6,739.7940 万股, 所募集资金扣除发行费用后, 将按项目建设轻重缓急投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	实施主体
1	集成电路前驱体二期项目	51,911.33	39,980.22	大连恒坤
2	集成电路用先进材料项目	90,916.74	60,689.28	安徽恒坤
合计		142,828.07	100,669.50	

如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,不足部分将由公司以银行贷款或其他途径解决。如本次发行实际募集资金超过预计募集资金数额的,剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

(二) 未来发展规划

公司历经多年发展,系一家致力于先进制程光刻材料、前驱体材料等集成电路关键材料研发、生产和销售的创新企业,拥有自主研发能力和知识产权,产品主要应用于 12 英寸集成电路晶圆制造,填补多项国内空白。未来,公司将持续深耕集成电路关键材料领域,加大技术开发和产业化布局,不断拓展产品线,稳固产品品质,积极参与客户的定制化开发,为客户提供集成电路关键材料整体解决方案;协同上下游产业链创新发展,建立安全可控的供应链;打造品牌效应,

积极拓展海外市场,力争成为具有核心竞争力,国内领先、国际先进的集成电路 关键材料本土企业。

本次募集资金运用与未来发展规划的具体情况请参见本招股意向书"第七节 募集资金运用与未来发展规划"。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股意向书签署日,公司不存在其他有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价及投资公司本次发行的股票时,除本招股意向书提供的其他各项资料以外,应特别注意下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序,但并不表示风险因素依次发生。

一、与发行人相关的风险

(一) 经营风险

- 1、与引进产品供应商合作终止或交易条件发生重大不利变化的风险
- 2、客户集中度较高及单一客户依赖的风险
- 3、自产前驱体材料毛利率为负的风险

上述风险详见本招股意向书"第二节 概览"之"一、重大事项提示"之"(一)特别风险提示"。

4、与客户 C 持续合作存在不确定性的风险

报告期内,公司对客户 C 实现销售收入分别为 4,307.83 万元、3,308.90 万元、2,961.37 万元和 1,779.97 万元,占主营业务收入的比例分别为 13.57%、9.15%、5.49%和 6.18%,随着公司业务的快速发展占比呈下降趋势。报告期内,公司向客户 C 销售的主要产品分别采购自 Soulbrain 和 SK 集团下属企业,且根据公司与 Soulbrain 签订的《生产技术转让协议》,公司自产 TEOS 可销售至除三星、SK 海力士及其所属公司外其他所有境内晶圆厂及其海外子公司,并可在 Soulbrain 同意基础上向境外其他非韩国、非 Soulbrain 客户销售。根据公开信息,SK 海力士已完成对客户 C 的收购,该笔收购可能导致公司与客户 C 之间的持续合作存在不确定性,进而对公司经营业绩产生不利影响。

5、安全生产与环境保护的风险

公司生产产品系集成电路关键材料,生产工序、生产设备、生产人员较多,管理难度较大。公司生产过程产生的污染物包括废气、废水和固废等,可能会对周围环境产生一定影响。随着监管政策的趋严、公司业务规模的扩张,安全与环境保护的难度相应增大,可能会产生因操作不当、设备故障、不可抗力等因素导

致的安全、环保事故,进而可能遭到有关政府部门的责令整改、处罚、停产,影响公司的正常生产经营。

(二) 技术风险

1、新产品未能实现产业化的风险

该风险详见本招股意向书"第二节 概览"之"一、重大事项提示"之"(一)特别风险提示"。

(三) 财务风险

1、汇率波动的风险

报告期内,公司引进光刻材料、前驱体材料、电子特气及其他产品以及自产产品的原材料主要采购自韩国、日本等国家或地区,主要采用美元结算。报告期内,公司汇兑损益的金额分别为-722.29万元、-45.72万元、-116.94万元和 140.53万元,占利润总额的比例分别为-5.76%、-0.44%、-1.09%和 3.16%。由于我国汇率市场化进程速度加快,加之受贸易摩擦、全球经济形势的影响,不排除未来汇率出现较大波动的可能性,进而对公司业绩带来一定的影响。

2、政府补助减少的风险

报告期各期,公司获得的计入当期损益的政府补助分别为 1,911.72 万元、1,676.20 万元、1,624.18 万元和 1,439.26 万元,占公司各期利润总额比例分别为 15.24%、16.05%、15.16%和 32.34%。若未来政府补助政策发生变化,或公司未能满足相关要求导致无法取得政府补助或获得的政府补助减少,可能对公司的利润水平产生一定程度的不利影响。

(四) 内控风险

1、实际控制人控制风险

本次发行前,实际控制人易荣坤先生直接持有公司 19.52%的股份表决权,并通过厦门神剑、晟临芯、兆莅恒间接控制公司 5.94%的股份表决权,另外通过与公司股东肖楠、杨波、张蕾、王廷通、陈江福、李湘江签订《一致行动协议书》控制公司 15.41%的股份表决权,合计控制的公司股份表决权比例为 40.87%。本次发行后,易荣坤先生预计合计控制公司 34.74%的股份。虽然易荣坤先生及一

致行动人、厦门神剑、晟临芯、兆莅恒承诺本次发行后 36 个月内不转让股份,但限售股解禁后,股份减持将导致实际控制人控制股份比例下降,因此公司存在股权相对分散而可能导致控制权变动的风险。

二、与行业相关的风险

(一) 宏观经济和行业周期波动的风险

集成电路行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点,公司主营业务处于集成电路产业链前端的材料行业,其市场需求和全球及国内集成电路行业的发展状况息息相关,业务发展会受到集成电路行业周期性波动的影响。受国际贸易摩擦、地缘政治矛盾加剧及供需关系变动的影响,公司下游客户需求将存在一定的波动性,进而影响公司的盈利水平。

(二) 市场竞争加剧的风险

公司定位为专注于集成电路关键材料产业化应用,以 12 英寸集成电路晶圆制造所需光刻材料与前驱体材料国产化应用为主要突破方向。公司的主要竞争对手既包括以美国、日本关键材料厂商为主的境外厂商,这类企业具有先发优势,长期处于垄断地位;也包括境内上市公司,其凭借良好背景、持续投入以及技术积累也已在光刻材料与前驱体材料取得一定突破。公司所处行业市场竞争将日趋激烈,如果公司不能保证产品质量,或无法持续提升技术水平、工业化生产能力、及时供应能力和成本管控能力,则公司可能无法有效应对激烈的市场竞争,进而对公司的竞争地位以及经营业绩产生不利影响。

(三) 贸易摩擦影响原材料与设备供应的风险

该风险详见本招股意向书"第二节 概览"之"一、重大事项提示"之"(一)特别风险提示"。

三、其他风险

(一) 募投项目新增折旧影响公司盈利能力的风险

(二)募投项目新增产能无法消化的风险

上述风险详见本招股意向书"第二节 概览"之"一、重大事项提示"之"(一)特别风险提示"。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	厦门恒坤新材料科技股份有限公司
英文名称	Xiamen Hengkun New Materials Technology Co., Ltd.
注册资本	38,192.1660 万元
法定代表人	易荣坤
成立日期	2004年12月10日
整体变更为股份公司日期	2014年4月1日
住所	厦门市海沧区东孚镇山边路 389 号
邮政编码	361026
电话	0592-6208266
传真	0592-6207888
互联网网址	www.hengkun.com
电子信箱	ir@hengkun.com
信息披露和投资者关系部门	证券部
信息披露和投资者关系负责人	陈颖峥(董事会秘书)
信息披露和投资者关系负责人电话	0592-6208266

二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况

(一) 有限公司设立情况

恒坤有限由恒坤工贸、陈江福于 2004 年 12 月共同出资设立,注册资本为 200 万元,由恒坤工贸认缴 190 万元,其中实物出资 126.795 万元,货币出资 63.205 万元; 陈江福以货币认缴 10 万元。

2004年11月16日,福建光明资产评估有限责任公司出具了"光明评估字(2004)第L06号"《资产评估报告书》,对恒坤工贸拟用以出资的实物资产即26台(套)机器设备进行了评估,评估值为126.795万元。

2004年11月23日,厦门市和祥会计师事务所有限公司出具了"和祥所(2004) 验资字第1616号"《验资报告》,审验确认截至2004年11月22日,恒坤有限(筹) 已收到恒坤工贸、陈江福合计缴纳的第一期出资。

2004年12月10日,恒坤有限取得了厦门工商行政管理局核发的注册号为

3502032021081 的《企业法人营业执照》。

恒坤有限设立时的股权结构及股东出资情况如下:

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	恒坤工贸	190.00	126.795	95.00	实物、货币
2	陈江福	10.00	10.00	5.00	货币
	合计	200.00	136.795	100.00	-

2005 年 4 月 12 日,恒坤工贸与易荣坤签署了《股权转让协议》,约定恒坤工贸将其持有的恒坤有限 95%股权(对应出资额 190.00 万元,含 126.795 万元实缴出资额及 63.205 万元认缴出资额)转让给易荣坤,转让价格 126.795 万元,并由易荣坤继受该部分股权中尚余的实缴出资义务。

2005年6月15日,厦门市和祥会计师事务所有限公司出具了"和祥所(2005) 验资字第1310号"《验资报告》,审验确认截止2005年6月13日,恒坤有限收到易荣坤缴纳的第二期货币出资63.205万元。

恒坤有限第二期货币出资缴纳完成后的股权结构及股东出资情况如下:

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	易荣坤	190.00	190.00	95.00	实物、货币
2	陈江福	10.00	10.00	5.00	货币
	合计	200.00	200.00	100.00	-

2004 年 12 月,恒坤有限设立时,其注册资本当时未全部实缴,后于 2005 年 6 月实缴全部出资,不符合当时有效的《公司法》第二十三条规定,"有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东实缴的出资额"。但是鉴于:

①恒坤有限股东分期缴纳注册资本符合当时地方性政策。根据《厦门市人民政府办公厅转发市工商行政管理局关于全面深化投资软环境建设大力促进我市民营经济发展的若干实施意见(试行)的通知》(厦府办[2003]261号)第二条,"设立公司制企业时,…注册资本在500万元以下的也可分期出资,但首期出资额必须达到注册资本的15%以上,且最低不低于3万元;1年内实际到资注册资本须达到50%以上,3年内全部到位",经核查,恒坤有限股东已于2005年6月13日前将其余部分注册资本实缴出资完毕,符合前述规定。

②恒坤有限设立已经工商主管部门核准登记,并核发了营业执照。

综上所述,恒坤有限设立时未全部实缴注册资本符合当时厦门市地方性政策的规定,且获当时的工商主管部门的核准,后续在短时间内补缴了出资,纠正了出资瑕疵,未对公司造成任何实质性影响,恒坤有限设立合法、有效。

(二) 股份公司设立情况

恒坤新材系恒坤有限整体变更设立。2013 年 12 月 20 日,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具[2013]京会兴审字第12220001号《审计报告》,截至2013年 10 月 31 日,恒坤有限经审计的净资产为20,781,441.13元。2013年 12 月 22日,北京国融兴华资产评估有限公司出具国融兴华评报字[2013]第1-185号《资产评估报告》,截至2013年10月31日,恒坤有限经评估的净资产值为4,400.07万元。

2014年1月6日,恒坤有限股东会做出决议,同意由恒坤有限全体股东作为发起人,以恒坤有限截至2013年10月31日经审计净资产20,781,441.13元为基数折合股本2,000万股,差额部分计入资本公积,整体变更为股份公司。2014年1月21日,北京兴华会计师事务所有限责任公司对上述整体变更事项出具了《验资报告》([2014]京会兴验字第12220001号)。2024年12月3日,容诚会计师出具了《验资复核报告》(容诚专字[2024]510Z0122号),对上述出资进行了验证。

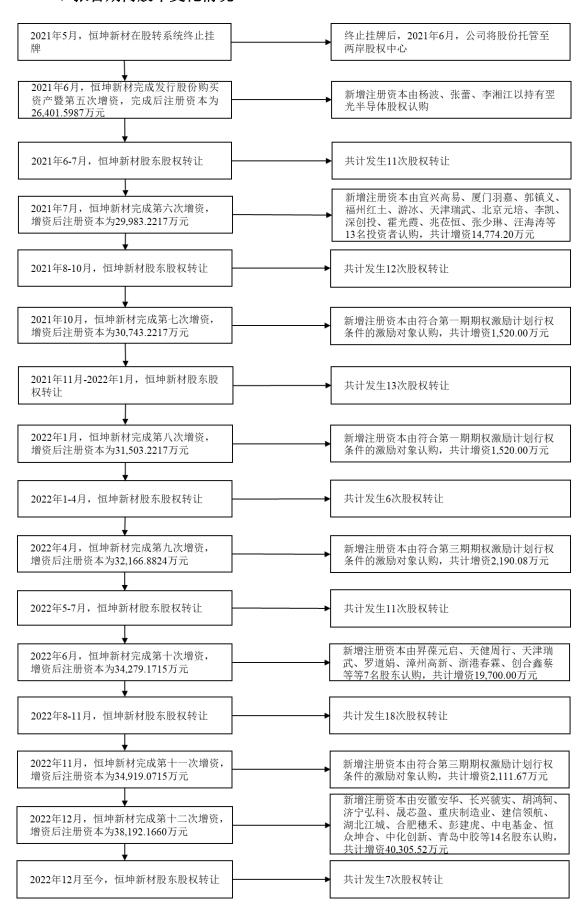
2014年4月1日,恒坤新材依法在厦门市工商行政管理局办理了注册登记,并领取了注册号为 350203200028557 的《营业执照》。整体变更后,公司的股权结构如下:

序号	股东	持股数量 (万股)	持股比例(%)
1	易荣坤	1,900.00	95.00
2	陈江福	100.00	5.00
	合计	2,000.00	100.00

(三)报告期内股本、股东变化情况

报告期内,公司共进行 8 次增资,多次股权转让,具体情况如下:

1、报告期内股本变化情况



(1) 2021 年 6 月,股份公司第五次增加注册资本(注册资本增加至 26,401.5987 万元)

2021年6月15日,公司召开2021年第七次临时股东大会并作出决议,同意发行3,690.9091万股收购翌光半导体35.00%股权。本次发行的具体情况如下:

序号	认购对象	认购数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购总额 (万元)	出资方式
1	李湘江	1,054.5455	2.75	2,900.00	股权
2	张蕾	1,265.4545	2.75	3,480.00	股权
3	杨波	1,370.9091	2.75	3,770.00	股权
	合计	3,690.9091	-	10,150.00	-

注: 经厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司估值确认,截至 2020 年 6 月 30 日,翌光半导体股权全部投资价值为 33,022.12 万元。在前述估值基础上,经各方协商确定本次交易中翌光半导体的股权作价。本次收购具体情形详见本招股意向书"第四节 发行人基本情况/三、发行人成立以来重要事件(含报告期内重大资产重组)/(二)收购翌光半导体少数股东股权"。

2021年6月21日,发行人完成工商变更登记。本次变更完成后,发行人注册资本增加至26,401.5987万元。

2021年7月15日,厦门欣洲会计师事务所有限公司出具了厦欣洲验字(2021) 第063号《验资报告》,确认截至2021年6月30日,发行人已收到认缴的出资款101,500,000.00元,其中计入注册资本36,909,091.00元。

(2) 2021 年 7 月,股份公司第六次增资(注册资本增加至 29,983.2217 万元)

2021年6月21日,公司召开2021年第八次临时股东大会并作出决议,同意以4.125元/股价格发行不超过3,636.3636万股股份,公司部分员工通过持股平台兆莅恒参与认购股票,认购价格与外部投资者认购价格相同。本次增资的具体情况如下:

序号	认购对象	认购数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购总额 (万元)
1	宜兴高易	727.0000	4.125	2,998.88
2	厦门羽嘉	500.0000	4.125	2,062.50
3	郭镇义	363.7000	4.125	1,500.26
4	福州红土	290.9090	4.125	1,200.00

序号	认购对象	认购数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购总额 (万元)
5	游冰	242.8000	4.125	1,001.55
6	天津瑞武	242.4242	4.125	1,000.00
7	北京元培	242.4000	4.125	999.90
8	李凯	220.0000	4.125	907.50
9	深创投(CS)	193.9394	4.125	800.00
10	霍光霞	170.0000	4.125	701.25
11	兆莅恒	146.4504	4.125	604.11
12	张少琳	121.0000	4.125	499.13
13	汪海涛	121.0000	4.125	499.13
	合计	3,581.6230	-	14,774.20

注:深创投属于国有实际控制股东,标识为"CS",具体详见本招股意向书"第四节发行人基本情况/十、发行人股本情况/(四)发行人国有股份或外资股份情况"。

2021年7月8日,公司完成了工商变更登记。本次变更完成后,公司的注册资本增加至29,983.2217万元。

2021年7月15日,厦门欣洲会计师事务所有限公司出具了厦欣洲验字(2021) 第063号《验资报告》,确认已收到认购对象的全部出资款。

(3) 2021 年 10 月,股份公司第七次增资(注册资本增加至 30,743.2217 万元)

2021年7月31日,公司召开2021年第十一次临时股东大会并作出决议,同意以2元/股价格向第一期期权激励计划中达成行权条件的激励对象发行不超过800万股股份。本次增发系第一期期权激励计划的第一个行权期行权,本次增资的具体情况如下:

序号	认购对象	认购/行权数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)
1	易荣坤	610.00	2.00	1,220.00
2	陈颖峥	20.00	2.00	40.00
3	陈志明	20.00	2.00	40.00
4	王静	20.00	2.00	40.00
5	宋里千	20.00	2.00	40.00
6	赵明海	20.00	2.00	40.00

序号	认购对象	认购/行权数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)
7	陶懿宗	20.00	2.00	40.00
8	肖忠根	30.00	2.00	60.00
	合计	760.00	-	1,520.00

注:关于第一期股票期权激励计划的实施情况详见本招股意向书"第四节发行人基本情况/十八、发行人已经制定或实施的股权激励及执行情况/(一)报告期内已经实施的股权激励情况"。

2021 年 10 月 18 日,公司完成工商变更登记。本次变更完成后,公司的注册资本增加至 30,743.2217 万元。

2022年1月17日,厦门欣洲会计师事务所有限公司出具了厦欣洲验字(2022) 第001号《验资报告》,确认公司已收到认购对象的全部出资款。

(4) 2022 年 1 月,股份公司第八次增资(注册资本增加至 31,503.2217 万元)

2021年12月30日,公司召开2021年第十七次临时股东大会并作出决议,同意以2元/股价格向第一期期权激励计划中达成行权条件的激励对象发行不超过800万股股份。本次发行系第一期期权激励计划的第二个行权期行权,本次增资的具体情况如下:

序号	姓名	认购/行权数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)
1	易荣坤	610.00	2.00	1,220.00
2	陈颖峥	20.00	2.00	40.00
3	陈志明	20.00	2.00	40.00
4	王静	20.00	2.00	40.00
5	宋里千	20.00	2.00	40.00
6	赵明海	20.00	2.00	40.00
7	陶懿宗	20.00	2.00	40.00
8	肖忠根	30.00	2.00	60.00
	合计	760.00	-	1,520.00

注:关于第一期股票期权激励计划的实施情况详见本招股意向书"第四节发行人基本情况/十八、发行人已经制定或实施的股权激励及执行情况/(一)报告期内已经实施的股权激励情况"。

2022年1月19日,公司完成工商变更登记。本次变更完成后,公司的注册

资本增加至 31,503.2217 万元。

2022年1月27日,厦门欣洲会计师事务所有限公司出具了厦欣洲验字(2022) 第001号《验资报告》,确认已收到认购对象的全部出资款。

(5) 2022 年 4 月,股份公司第九次增资(注册资本增加至 32,166.8824 万元)

2022 年 3 月 22 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会并作出决议,同意以 3.30 元/股价格向符合第三期期权激励计划行权条件的激励对象发行不超过 738 万股股份。本次发行系第三期期权激励计划的第一个行权期行权,本次增资的具体情况如下:

序号	姓名/名称	认购/行权数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)
1	王廷通	40.00	3.30	132.00
2	陈博实	20.00	3.30	66.00
3	谭旭影	20.00	3.30	66.00
4	毛鸿超	12.00	3.30	39.60
5	晟临芯	420.00	3.30	1,386.00
6	晟临坤	151.6607	3.30	500.48
	合计	663.6607	1	2,190.08

注:关于第三期股票期权激励计划的实施情况详见本招股意向书"第四节发行人基本情况/十八、发行人已经制定或实施的股权激励及执行情况/(一)报告期内已经实施的股权激励情况"; 晟临芯、晟临坤均系发行人为进行本次期权激励而设立的员工持股平台,其出资人均为发行人或其子公司在职员工。

2022年4月18日,公司完成工商变更登记。本次变更完成后,公司的注册资本为32,166.8824万元。

2022年7月11日,厦门欣洲会计师事务所有限公司出具了厦欣洲验字[2022] 第033号《验资报告》,确认已收到认购对象的全部出资款。

(6) 2022 年 6 月,股份公司第十次增资(注册资本增加至 34,279.1715 万元)

2022年6月,公司召开2022年第三次临时股东大会并作出决议,同意向昇葆元启等7名认购对象发行股份2,112.2891万股。本次增资的具体情况如下:

序号	认购对象	认购数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购总金额 (万元)
1	昇葆元启	343.1120	9.3264	3,200.00
2	天健周行	321.6688	9.3264	3,000.00
3	天津瑞武	107.2226	9.3264	1,000.00
4	罗道娟	53.6113	9.3264	500.00
5	漳州高新(SS)	214.4450	9.3264	2,000.00
6	浙港春霖	536.1147	9.3264	5,000.00
7	创合鑫材	536.1147	9.3264	5,000.00
	合计	2,112.2891	1	19,700.00

注: 漳州高新属于国有股东,标识为"SS",具体详见本招股意向书"第四节 发行人基本情况/十、发行人股本情况/(四)发行人国有股份或外资股份情况"。

2022年6月17日,公司完成工商变更登记。本次变更完成后,公司的注册 资本增加至34,279.1715万元。

2022年7月11日,厦门欣洲会计师事务所有限公司出具了厦欣洲验字[2022] 第033号《验资报告》,确认已收到认购对象的全部出资款。

(7) 2022 年 11 月,股份公司第十一次增资(注册资本增加至 34,919.0715 万元)

2022 年 10 月 5 日,公司召开 2022 年第九次临时股东大会并作出决议,同意以 3.30 元/股价格向符合第三期期权激励计划行权条件的激励对象发行不超过 738 万股股份。本次发行系第三期期权激励计划的第二个行权期行权,本次增资的具体情况如下:

序号	姓名/名称	认购/行权数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)
1	王廷通	40.00	3.30	132.00
2	陈博实	20.00	3.30	66.00
3	谭旭影	20.00	3.30	66.00
4	毛鸿超	20.00	3.30	66.00
5	晟临芯	420.00	3.30	1,386.00
6	晟临坤	119.90	3.30	395.67
	合计	639.90	-	2,111.67

注:关于第三期股票期权激励计划的实施情况详见本招股意向书"第四节 发行人基本情况/十八、发行人已经制定或实施的股权激励及执行情况/(一)报告期内已经实施的股权激励

情况";晟临芯、晟临坤均系发行人为进行本次期权激励而设立的员工持股平台,其出资人均为发行人或其子公司在职员工。

2022年11月7日,公司完成工商变更登记。本次变更完成后,公司的注册 资本增加至34,919.0715万元。

2023年2月13日,厦门欣洲会计师事务所有限公司出具了厦欣洲验字(2023) 第001号《验资报告》,确认已收到认购对象的全部出资款。

(8) 2022 年 12 月,股份公司第十二次增资(注册资本增加至 38,192.166 万元)

2022 年 12 月 6 日,公司召开 2022 年第十一次临时股东大会并作出决议,同意按照投前不高于 45 亿元估值发行股票,募集资金总额不超过 6 亿元。公司部分员工通过持股平台恒众坤合参与认购股票,认购价格与外部投资者认购价格相同。本次增资的具体情况如下:

序号	认购对象	认购股份数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)
1	安徽安华	243.6210	12.3142	3,000.00
2	长兴虢实	276.1041	12.3142	3,400.00
3	胡鸿轲	40.6036	12.3142	500.00
4	济宁弘科	121.8106	12.3142	1,500.00
5	晟芯盈	121.8105	12.3142	1,500.00
6	重庆制造业	406.0359	12.3142	5,000.00
7	建信领航	406.0359	12.3142	5,000.00
8	湖北江城	77.1468	12.3142	950.00
9	合肥穗禾	406.0357	12.3142	5,000.00
10	彭建虎	243.6212	12.3142	3,000.00
11	中电基金	406.0353	12.3142	5,000.00
12	恒众坤合	36.9916	12.3142	455.52
13	中化创新	471.0009	12.3142	5,800.00
14	青岛中胶	16.2414	12.3142	200.00
	合计	3,273.0945	-	40,305.52

2022 年 12 月 29 日,公司完成工商变更登记。本次变更完成后,公司的注册资本增加至 38,192.166 万元。

2023年2月13日,厦门欣洲会计师事务所有限公司出具了厦欣洲验字(2023) 第001号《验资报告》,确认已收到认购对象的全部出资款。

2024年12月3日,容诚会计师出具了容诚专字[2024]510Z0122号《验资复核报告》,对公司成立以来历次实收资本(股本)变动情况进行了复核。

2、报告期内股东变化情况

2021 年初至摘牌期间,公司股权转让均通过股转系统进行交易。2021 年 6 月,公司将股份委托两岸股权中心进行托管交易,根据股份变动方提供的股份转让协议以及两岸股权交易中心出具的《历史股权流水》,股份托管后,公司在两岸股权在交易中心办理登记的股权转让情况如下:

转让时间	转让方	受让方	股数 (万股)	金额(万元)
2021.06.10	李湘江	周建华	500.00	1,250.00
2021.06.10	李湘江	郭芳菲	500.00	1,250.00
2021.06.10	李湘江	王蓉	433.16	1,082.90
2021.06.10	李湘江	鑫恒舜	500.00	1,250.00
2021.07.08	魏程玲	陈宜锦	14.43	59.53
2021.07.09	魏程玲	陈通齐	40.00	150.00
2021.07.13	易荣坤	任少虎	122.00	503.25
2021.07.20	易荣坤	谢丽云	50.00	206.25
2021.07.28	易荣坤	杨波(注)	48.00	198.00
2021.07.28	易荣坤	陈颖峥	40.00	22.00
2021.07.30	易荣坤	徐铭骏	50.00	206.25
2021.08.12	易荣坤	洪梅香	20.00	82.50
2021.08.15	易荣坤	赵智	10.00	41.25
2021.08.15	易荣坤	徐国标	15.00	61.88
2021.08.19	易荣坤	黄建慧	33.00	136.13
2021.08.21	陈永来	陈宜锦	64.00	211.20
2021.09.10	李湘江	王晶	104.00	301.60
2021.09.14	勾陈资本	曾镇聪	100.00	300.00
2021.09.15	勾陈资本	李湘江	344.48	344.48
2021.09.15	勾陈资本	孙越	98.00	284.20
2021.09.15	易荣坤	李卫东	242.00	998.25

转让时间	转让方	受让方	股数 (万股)	金额(万元)
2021.09.19	林卫鸿	陈江福	40.00	116.00
2021.10.10	付端端	廖生根	14.50	43.50
2021.11.07	李湘江	张宇	200.00	600.00
2021.11.08	陈宜锦	曾令军	25.00	103.13
2021.11.18	吴其敬	王晶	32.00	96.00
2021.11.24	王晓辉	魏子衿	40.00	120.00
2021.11.24	王晓辉	杨小敏	60.00	180.00
2021.12.01	陈亚发	吴雅萍	8.00	33.00
2021.12.09	陈宜锦	洪永生	8.00	33.00
2021.12.15	陈亚发	肖忠根	9.00	37.13
2021.12.23	易荣坤	林志鹏	40.00	360.00
2021.12.24	易荣坤	吴松	11.00	99.00
2021.12.24	易荣坤	高坤	22.00	198.00
2022.01.10	易荣坤	九州晟德	220.00	2,002.00
2022.01.14	易荣坤	王维泽	110.00	1,001.00
2022.02.20	易荣坤	黄丽恩	10.00	90.00
2022.02.21	易荣坤	庄海华	10.00	90.00
2022.03.02	易荣坤	卓珠萍	8.00	72.00
2022.04.29	易荣坤	平阳启众	257.40	2,000.00
2022.05.20	王晓辉	黄健	108.00	1,007.21
2022.06.08	游冰	杨志辉	242.80	2,264.45
2022.06.25	厦门神剑	天健力丰	100.00	932.64
2022.06.27	张蕾	徐国标	55.00	495.00
2022.06.28	易荣坤	李婷婷	20.00	120.00
2022.06.28	易荣坤	安辉	80.00	480.00
2022.06.28	易荣坤	王宝正	12.00	72.00
2022.06.28	易荣坤	陈小璟	12.00	72.00
2022.07.25	勾陈合伙	朱龙清	160.40	1,495.95
2022.07.25	陈宜锦	孟娜	56.95	531.16
2022.07.25	陈宜锦	唐良祝	40.00	373.06
2022.08.04	陈亚发	龙岩昊嘉	104.60	975.54
2022.08.12	恒坤投资	枣庄钧鑫	278.83	2,600.50
2022.08.31	恒坤投资	苏州厚望	448.44	4,042.92

转让时间	转让方	受让方	股数 (万股)	金额(万元)
2022.08.31	王蓉	苏州厚望	333.16	3,003.60
2022.08.31	王廷通	苏州厚望	50.00	450.78
2022.08.31	肖楠	苏州厚望	165.00	1,487.56
2022.08.31	杨波	苏州厚望	165.00	1,487.56
2022.08.31	张蕾	苏州厚望	113.90	1,026.86
2022.08.31	厦门羽嘉	博润多	278.00	2,506.309
2022.08.31	厦门初茄	新投春霖	222.00	1,998.00
2022.09.01	杨忆南	江苏高易	80.00	720.00
2022.09.01	郭镇义	赣州九派	178.70	1,666.63
2022.09.12	郭镇义	罗江涛	40.00	373.06
2022.09.12	李湘江	贺国文	55.00	512.95
2022.09.12	李湘江	杨思琦	40.00	373.06
2022.09.12	杨忆南	林韵哲	16.00	144.00
2022.09.26	郭镇义	王彩缎	145.00	1,352.33
2022.11.30	李湘江	泉州华诺	111.00	999.00
2023.12.20	张宇	杭州嘉港	80.00	886.62
2023.12.25	杨波(注)	成都交子	48.00	515.00
2024.2.27	口給抗	淄博金控(SS)	1,404.91	司法划转,不涉及资 金支付
2024.5.28	吕俊钦	海傳金拉(SS)	260.00	司法划转,不涉及资 金支付
2024.10.16	上、W 吨 分	吕文旭	138.10	1,700.64
2024.10.16	长兴虢实	姚婉珠	138.00	1,699.36
2024.10.21	吕俊钦	郭芳菲	480.00	司法执行,系股权代 持还原,不涉及资金 支付

注 1: 股份变动方杨波与实际控制人一致行动人杨波系重名,非同一人 注 2: 淄博金控属于国有股东,标识为"SS",具体详见本招股意向书"第四节 发行人基本情况/十、发行人股本情况/(四)发行人国有股份或外资股份情况"

吕俊钦因个人原因,其所持发行人 2,144.9088 万股股份由淄博市公安局博山 分局冻结,此后经山东省淄博市博山区人民法院作出的审理判决及执行裁定,吕 俊钦所持发行人 1,664.9088 万股股份被司法划转至国有全资单位淄博金控名下; 其余 480.00 万股股份经山东省泰安仲裁委员会裁决系为郭芳菲代持。2024 年 10 月 10 日,厦门市中级人民法院作出(2024)闽 02 执 1333 号《执行裁定书》,裁 定将吕俊钦名下 480.00 万股发行人股份过户至郭芳菲名下,2024 年 10 月 21 日, 前述 480.00 万股在两岸股权中心完成变更登记。

截至报告期末,淄博市博山区人民法院已完成对吕俊钦直接持有或与其相关 的发行人股份的强制执行程序,针对吕俊钦其他财产权益的相关执行程序均与发 行人无关,发行人现有股东出资来源亦不涉及吕俊钦违法所得。截至报告期末, 吕俊钦未直接、间接或通过委托持股、信托持股等任何方式持有发行人股份。

(四)发行人历史沿革中的股权代持情况

公司历史沿革过程中,曾经存在股份代持情形。截至本招股意向书签署日,股份代持情形均已解除。股份代持的形成、演变及解除情形具体如下:

1、直接股东代持及清理情况

序号	实际股东	代持人	形成原因及演变过程	代持清理情况
1		勾陈资 本、李湘 江	为方便后续股权交易,易荣坤委托李湘江代为持有股票。易荣坤于2016年7月、2017年6-7月将直接持有的302.50万股股份以及通过厦门神剑间接持有的259.30万股股份转让至李湘江控制的勾陈资本名下,形成代持。经过期间交易和2020年10月派送红股,2021年9月,勾陈资本将其余344.48万股代持股份转让至李湘江名下,由李湘江继续代持。	2017年9月至2022年9月, 勾陈资本与后续李湘江的代 持股份已陆续转让给第三 方,截至2022年10月,代 持股份已全部对外转让完 毕,易荣坤与李湘江、勾陈 资本股权代持关系解除。
2	易荣坤	陈亚发	2017年,为方便后续股权交易,易荣坤委托陈亚发通过新三板交易合计取得85.95万股股份,形成代持。	2018年期间,陈亚发将81.70 万股代持股份分别出售给深 圳形鑫资产管理企业(有限 合伙)、高文质以及王廷通。 经2020年10月派送红股, 剩余代持股份变更为17.00 万股。2021年12月,陈亚 发将剩余17.00万股代持股份出售给吴雅萍、肖忠根。 交易完成后,股权代持关系 解除。
3		高金飘	2019年,高金飘将持有 41.00 万股 转让给易荣坤。由于交易时股票属 于限售股,委托高金飘代持。	2020 年 3-6 月, 高金飘将 41.00 万股转让给陈宜锦、 勾陈资本。交易完成后,股 权代持关系解除。
4		陈宜锦	2020 年 6 月,为方便股权交易, 易荣坤委托陈宜锦受让高金飘 40.88 万股股份;2020 年 10 月, 易荣坤继续委托陈宜锦通过新三 板交易取得10.00 万股,后经2020	2021 年 1 月, 陈宜锦将 152.00 万股转让给铜陵垣 涪、刘清泽; 2021 年 8 月, 将 25.00 万股转让给曾令 军; 2022 年 7 月,将 40.9524

序号	实际股东	代持人	形成原因及演变过程	代持清理情况
			年 10 月派送红股变更为 203.52 万股。2021 年 7 月,易荣坤继续委托陈宜锦受让魏程玲 14.4324 万股公司股份。	交易完成后,股权代持关系 解除。
5		王蓉	2021 年 6 月,王蓉受让李湘江 433.16 万股股份,其中 80.00 万股 系为易荣坤代持。由于易荣坤资金 不足,因此委托王蓉代持。	2022年8月,王蓉将333.16 万股转让给苏州厚望,转让 股份中包括为易荣坤代持 的80.00万股。交易完成后, 股权代持关系解除。
6		厦门羽 嘉	2021年6月,厦门羽嘉以4.125元/股价格认购500.00万股股份,其中110.00万股系为易荣坤代持。由于易荣坤资金不足,因此委托厦门羽嘉代持。	2022 年 8 月,厦门羽嘉将 500.00 万股转让给外部投资者博润多、新投春霖,其中包括为易荣坤代持的 110.00 万股。交易完成后,股权代持关系解除。
7		张少琳	2021年6月,张少琳以4.125元/股价格认购121.00万股股份,其中12.121万股系为易荣坤代持。由于易荣坤资金不足,因此委托张少琳代持。	2022 年 7 月,张少琳按照 9.3264 元/股受让其为易荣 坤代持的 12.121 万股。交 易完成后,股权代持关系解 除。
8		郭镇义	2021年6月,郭镇义以4.125元/股价格认购363.70万股股份,其中120.00万股系为易荣坤代持。由于易荣坤资金不足,因此委托郭镇义代持。	2022 年 9 月,郭镇义将 363.70 万股转让给赣州九 派、罗江涛、王彩缎,其中 包括为易荣坤代持的 120.00 万股。交易完成后, 股权代持关系解除。
9	许振梁		2012 年 7 月,许振梁与易荣坤、陈艺琴签署《出资协议书》,出资300.00 万元受让易荣坤 5.00%股权,为方便工商登记手续,股权由易荣坤代持。	2017年10月,许振梁与易荣坤协商解除股份代持,代持关系解除后,易荣坤合计退还425.00万元
10	李奇泽		2013年12月,李奇泽与易荣坤、陈艺琴、恒坤有限签署《委托持股协议》,出资 185.00 万元受让易荣坤3.08%股权,为方便工商登记手续,股权由易荣坤代持。	2014 年末,李奇泽从公司 离职,与易荣坤解除代持关 系,代持关系解除后,易荣 坤出资合计退还 215.00 万 元。
11	邓文标	易荣坤	2014 年 6 月,邓文标与易荣坤签署《股份代持协议书》,出资 125.00万元受让易荣坤 17.40万股股份,为方便股权管理,股权由易荣坤代持。	2018年1月,易荣坤出资 125.00万元购回全部代持 股份。交易完成后,股权代 持关系解除。
12	贾玉龙		2014 年 8 月,贾玉龙与易荣坤签署《股份出资协议书》,出资 54.00万元受让易荣坤 22.50万股股份,由易荣坤代持。2015 年 7 月,贾玉龙出资 8.80 万元受让易荣坤4.00万股股份,为方便股权管理,股份由易荣坤代持。	2017 年 6 月, 易荣坤出资 49.00 万元购回 16.50 万股 股份。经 2020 年 10 月派送 红股,剩余代持股份变更为 40.00 万股。2021 年 3 月, 易荣坤出资 136.60 万元购 回剩余 40.00 万股代持股 份。交易完成后,股权代持

序号	实际股东	代持人	形成原因及演变过程	代持清理情况
				关系解除。
13	朱源勇		2014年11月,朱源勇与易荣坤签署《股份代持协议书》,出资60.00万元受让易荣坤7万股股份,为方便股权管理,股份由易荣坤代持。	2020 年 5 月,易荣坤出资 85.60 万元购回全部代持股份,交易完成后,股权代持 关系解除。
14	吕俊钦		2016 年 7 月, 吕俊钦与易荣坤签署 《股份代持协议》, 约定出资 1,000.00 万元, 受让易荣坤 250.00 万股股份,由易荣坤代持。	2017 年 10 月, 勾陈资本将 250.00 万股转让至吕俊钦名 下,交易完成后,股权代持 关系解除。
15	熊绍咏		2016 年 7 月,熊绍咏与易荣坤签署《股份代持协议书》,出资 13.00万元受让易荣坤 5.91 万股股份,为了便捷交易程序,股份由易荣坤代持。	2018 年 7 月,易荣坤出资 17.68 万元购回全部代持股份。交易完成后,股权代持 关系解除。
16	张宇		2017年7月,张宇与易荣坤签署《股份出资协议》,出资100万元受让易荣坤50.00万股,因张宇未开通交易账户,约定由易荣坤代持。经2020年10月派送红股,代持股份变更为200.00万股。	2021 年 11 月,李湘江将 200.00 万股转让给张宇,交 易完成后,股权代持关系解 除。
17	孙越		2018年1月,孙越通过深圳形鑫资产管理企业(有限合伙)取得24.50万股,2020年3月,为方便代持股份后续还原,深圳形鑫资产管理企业(有限合伙)将24.50万股股份转让给勾陈资本并由其代持。经2020年10月派送红股,代持股份变更为98.00万股。	2021 年 9 月, 勾陈资本将 98.00 万股转让给孙越,交易完成后,股权代持关系解除。
18	宋增超		2019年,宋增超以 184.00 万元受让易荣坤持有的发行人 28.40 万股股份。由于宋增超尚未开通交易账户,由易荣坤代持。经 2020年10月派送红股,代持股份变更为113.60 万股。	2021 年,宋增超从公司离职,易荣坤出资 411.68 万元购回全部代持股份。交易完成后,股权代持关系解除。
19	邱凡		2019 年 1 月,邱凡与易荣坤签署 《股份代持协议书》,出资 120.00 万元受让易荣坤 12.00 万股股份。 由于邱凡尚未开通交易账户,由易 荣坤代持。经 2020 年 10 月派送红 股,代持股份变更为 48.00 万股。	2022 年 9 月,易荣坤出资 330.91 万元购回全部代持 股份。交易完成后,股权持 关系解除。
20	肖忠根		2019年5月,肖忠根以20.00万元受让易荣坤持有的发行人2.25万股股份。由于肖忠根尚未开通交易账户,由易荣坤代持。经2020年10月派送红股,代持股份变更为9.00万股。	关系解除。
21	曾镇聪		2019年5月,易荣坤以10.00元/股价格认购50.00万股股份,其中	

序号	实际股东	代持人	形成原因及演变过程	代持清理情况
			25.00 万股系代曾镇聪认购并持有。 经 2020 年 10 月派送红股,代持股份变更为 100.00 万股。	交易完成后,股权代持关系 解除。
22	丰雷		2019 年 7 月,丰雷与易荣坤签署《股份代持协议书》,出资 60.00万元受让易荣坤 6.00万股股份。由于丰雷尚未开通交易账户,由易荣坤代持。经 2020 年 10 月派送红股,代持股份变更为 24.00万股。	2021 年 3 月,易荣坤出资 90.00 万元购回全部代持股份,交易完成后,股权代持 关系解除。
23	康文兵		2019年11月,康文兵以30.00万元受让易荣坤持3.00万股股份。由于康文兵尚未开通交易账户,取得股份由易荣坤代持。经2020年10月派送红股,代持股份变更为12.00万股。	1
24	郑海山		2021 年 3-6 月,郑海山出资 55.00 万元受让易荣坤 13.75 万股股份, 由易荣坤代持。	2024年11月,易荣坤出资 121.00万元购回全部代持 股份,交易完成后,股权代 持关系解除。
25	洪耀坤		2019年3月,洪耀坤认为公司属于优质投资标的,为后续变现退出的便捷性,与李湘江协商后委托其代持,出资20.00万元受让2.00万股。经2020年10月派送红股,代持股份变更为8.00万股。	2022年3月至2024年2月, 洪耀坤有资金需求,李湘江 共计出资67.83万元按照同 期交易价格分期购回全部代 持股份,交易完成后,股权 代持关系解除。
26	魏涛		2019年5月,魏涛、沈晓英看好半导体行业及公司的发展前景,决定投资公司,考虑到投资股份数量较	万股转让给魏涛, 交易完成
27	沈晓英	李湘江	少,为方便股权管理,与李湘江协商后委托其代持,其中,魏涛出资15.00 万元认购 1.50 万股; 沈晓英出资10.00 万元认购 1.00 万股,经2020 年 10 月派送红股,代持股份变更为 4.00 万股。	37.00 万元购回全部代持股票。交易完成后,股权代持
28	吕俊钦		2019年5月,李湘江以10元/股认购550.00万股股份,其中483.29万股股份的认购资金来源于吕俊钦关联账户,系吕俊钦委托李湘江代持。	2020年7月,吕俊钦因个人原因被司法机关采取强制措施。2021年6月,李湘江将代持股份按照认购价格卖出并将所得资金上交。交易完成后,股权代持关系解除。
29	余荟文		2022年3月,余荟文认为公司属于优质投资标的,为后续变现退出的便捷性,与李湘江协商后委托其代持,出资20.00万元受让2.00万股。	2024 年 4 月,李湘江出资 24.00 万元购回全部代持股 票。交易完成后,股权代持 关系解除。
30	林曼	郭芳菲	2018年9月,林曼与郭芳菲协商后以10.00元/股认购60.00万股股份,即郭芳菲委托吕俊钦代持的185.00万股股份中,60.00万股系替林曼代持。	2020 年末,林曼考虑到股权被冻结后的不确定性,与郭芳菲协商一致由郭芳菲按照600.00 万元向其退回投资款。交易完成后,股权代持

序号	实际股东	代持人	形成原因及演变过程	代持清理情况
				关系解除。
31	郭芳菲	吕俊钦	经淄博市博山区人民法院、淄博市中级人民法院、泰安市仲裁委员会查明,郭芳菲曾于 2018-2019 年通过其母亲委托吕俊钦代持 185 万股股份。经 2020 年 10 月派送红股,代持股份变更为 740.00 万股。	260 万股已由李湘江交易后将款项上交淄博市公安局博山分局; 480.00 万股已于2024 年 10 月根据相关裁定还原给真实权利人郭芳菲。至此,吕俊钦与郭芳菲之间的股权代持关系解除。

2、员工持股平台中代持及清理情况

持股平台	代持人	实际股东	代持形成情形	代持清理情况
投版工 员	陈颖峥	易荣坤	2021 年,发行人实施第三期期权激励,易荣坤考虑预留部分股份作为未来股权激励的股票来源,安排陈颖峥作为激励对象为其代持。2022 年,期权行权,陈颖峥认购 80.00 万股,对应晟临芯264.00 万元出资额,系为易荣坤	2024 年 10 月,陈颖峥与易荣坤签署《代持解除协议》,由陈颖峥将名下晟临芯 264.00 万元财产份额还原至易荣坤,还原后,股权代持关系解除。
晟临坤	蒋 圆 美 (公司 员工)	甘志星	代持。 2021年,发行人实施第三期期权激励。蒋圆美作为本次激励对象,通过晟临坤取得20.00万股,对应晟临坤66.00万元出资额,其中33.00万元来源于朋友甘志星,为其代持晟临坤33.00万元财产份额。	2024 年 10 月, 蒋圆美与甘志星签署《代持解除协议》,以 33.00 万元受让为甘志星代持的 33.00 万元财产份额,股权代持关系解除。
	郑 美 如 (公司员工)	郑美花	2022 年 12 月,恒众坤合认购36.9916 万股。郑美如作为恒众坤合有限合伙人出资52.95 万元,其中5.00 万元来源于其朋友郑美花,为其代持恒众坤合5.00 万元财产份额。	2024 年 10 月,郑美如与郑美花签署《代持解除协议》,以 5.00 万元受让为郑美花代持的恒众坤合 5.00 万元财产份额,股权代持关系解除。
恒众坤合	郭() 雅公工) 爽工) 爽工)		2023 年,郭雅参、丁爽出资入股恒众坤合。(1)2023 年 3 月,郭雅参以 18.88 万元受让恒众坤合 19.3350 万元财产份额(实缴出资额 18.4713 万元),出资款中 9.45 万元系丁爽实际出资,两人约定,郭雅参代丁爽投资持有恒众坤合 9.23565 万元财产份额;(2)2023 年 12 月,丁爽以 3.99 万元受让恒众坤合 3.69426 万元财产份额,出资款中 1.99 万元系郭雅参实际出资,两人约定,丁爽代郭雅参持有恒众坤合 1.84713 万元财产份额。	2024 年 10 月,郭雅参与丁爽签署《代持解除协议》,由郭雅参将持有的恒众坤合 7.38852万元财产份额转让给

持股平台	代持人	实际股东	代持形成情形	代持清理情况
	周国波(公司员工)	陈少鹏	2022 年 12 月,恒众坤合认购36.9916 万股。周国波作为恒众坤合有限合伙人出资43.10 万元,其中9.77 万元来源于朋友陈少鹏,为其代持恒众坤合9.7728 万元财产份额。	协议》,由周国波以7.01
兆莅恒	周国波(公司员工)	陈少鹏	2021 年 7 月, 兆莅恒认购发行人 146.4504 万股股份。周国波作为 兆莅恒有限合伙人出资 22.48 万元, 其中 7.01 万元来源于朋友陈少鹏, 为其代持兆莅恒 7.0125 万元财产份额。	的恒众坤合 9.7728 万 元财产份额,股权代持

发行人历史上存在的股权代持情形已经依法解除、股权代持各方之间不存在 关于股权归属方面的纠纷或潜在纠纷。除上述情况外,公司历史沿革中不存在其 他股权代持情形。截至本招股意向书签署日,公司股东不存在代持情况。

三、发行人成立以来重要事件(含报告期内重大资产重组)

报告期内,发行人未发生《上市公司重大资产重组管理办法》界定的重大资产重组。除本招股意向书已披露内容外,发行人自成立以来不存在其他对管理层、控制权、业务发展及经营业绩产生重大影响的重要事件。

(一) 发行人剥离原有业务

1、交易背景及原因

2019年12月,发行人将全资子公司苏州恒坤、厦门积能、深圳欣恒坤转让给恒坤投资,从合并报表范围内剥离。本次剥离前,发行人主营业务由集成电路领域关键材料业务板块和光电类产品业务板块两部分构成,具体情况如下:

序号	业务板块	公司名称	当时与公司关系	主营业务情况
1		香港恒坤	全资子公司	引进光刻材料、前驱体、电子特气及 其他半导体产品的销售
2	集成电路	上海楚坤	全资子公司	引进光刻材料、前驱体、电子特气及 其他湿电子化学品的销售
3	领域关键 材料业务 板块	翌光半导体	控股子公司	翌光半导体股权架构调整前,通过下 属全资子公司从事集成电路光刻胶及 前驱体的研发及国产化业务;股权架 构调整后无实际经营业务
4		泓坤微电子	翌光半导体的全 资子公司	拟进行集成电路关键材料原材料技术 研发,未实际经营

序号	业务板块	公司名称	当时与公司关系	主营业务情况
5		福建泓光	翌光半导体的全 资子公司	光刻材料等集成电路关键材料的研发、生产、销售
6		大连恒坤	翌光半导体的全 资子公司	前驱体等集成电路关键材料的研发、 生产、销售
7	光电类产	苏州恒坤	全资子公司	光电类产品的加工与销售
8	品业务板	深圳欣恒坤	全资子公司	光电类产品的加工与销售
9	 块	厦门积能	全资子公司	光电显示材料的销售

注: 翌光半导体于 2022 年 9 月 23 日注销

为了专注于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用,进一步将资源集中 于公司核心业务,提高管理效率,2019年12月,发行人通过转让从事光电类产 品业务的三家公司,将相关业务进行了剥离。

2、剥离所履行的相关程序

2019年12月8日,发行人召开2019年第八次临时股东大会,审议通过了《关于拟转让全资子公司深圳市欣恒坤科技有限公司100%股权》《关于拟转让全资子公司原门积份。公司苏州恒坤精密电子有限公司100%股权》《关于拟转让全资子公司厦门积能电子科技有限公司100%股权》等议案,同意发行人将持有的苏州恒坤、厦门积能、深圳欣恒坤100%股权转让给恒坤投资。鉴于本次股权转让涉及关联交易,关联方易荣坤及其控制主体回避了股东大会对相关内容的决策。

2019年12月8日,发行人与恒坤投资就上述股权转让事项分别签署了《股权转让协议》。

2019年12月,苏州恒坤、厦门积能、深圳欣恒坤分别召开股东会同意了上述股权转让事项,并办理完成了工商登记变更。

3、对价及定价依据

针对本次剥离涉及的 3 家公司,厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司分别出具了大学评估评报字[2019]820238 号、大学评估评报字[2019]820240 号以及大学评估评报字[2019]820239 号评估报告,具体情况如下:

序号	剥离标的	评估基准日	评估值(万元)
1	苏州恒坤 100%股权	2019.7.31	837.07
2	厦门积能 100%股权	2019.7.31	475.20

序号	剥离标的	评估基准日	评估值(万元)
3	深圳欣恒坤 100%股权	2019.7.31	923.74

经发行人与恒坤投资协商一致,最终以评估值作为股权转让对价,即恒坤投资分别以837.07万元、475.20万元、923.74万元价格受让苏州恒坤、厦门积能、深圳欣恒坤100%股权。

4、剥离对管理层、控制权、业务发展及经营业绩的影响

(1) 对管理层、控制权的影响

本次资产剥离未改变公司的股权结构,集成电路领域关键材料业务相关的主要管理人员仍在公司处任职,对发行人管理层和实际控制人无重大影响。

(2) 对业务发展及经营业绩的影响

本次资产剥离完成后,发行人将不再从事光电类产品等相关业务,有利于公司集中优势资源发展集成电路领域关键材料业务。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)针对剥离子公司出具的审计报告,截至2019年7月31日,剥离子公司的期末资产总额合计为98,373,190.79元,期末资产净额合计为19,337,279.43元,均未达到发行人当期经审计相应指标比例50%,不构成重大资产重组。

(二) 收购翌光半导体少数股东股权

1、交易背景及原因

翌光半导体原系由发行人于 2018 年 8 月参与设立且持有 65%股权的控股子公司,截至收购前,翌光半导体注册资本为 2,000 万元,其中发行人认缴 1,300 万元、杨波认缴 260 万元、张蕾认缴 240 万元、李湘江认缴 200 万元。

翌光半导体主要从事集成电路光刻胶及前驱体的研发及国产化,相继投资设立了福建泓光、大连恒坤、泓坤微电子等公司,建设有漳州、大连两个生产基地。基于扩展半导体业务的战略发展考虑,发行人于2021年发行股份收购了其余少数股东杨波、张蕾、李湘江持有的翌光半导体合计35%的股权。通过本次收购,翌光半导体成为发行人全资子公司。

2、收购所履行的相关程序

2020 年 12 月 2 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(容诚审字[2020]361Z0355 号),以 2020 年 6 月 30 日为审计基准日,翌光半导体的经审计净资产为 4,852,654.99 元。

2020年12月3日,厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具《厦门恒坤新材料科技股份有限公司拟股权收购涉及的翌光半导体(厦门)有限公司股东全部权益投资价值估值报告》(大学评估估值字[2020]820001号),以2020年6月30日为估值基准日,翌光半导体的股东全部权益的投资价值为33,022.12万元。在此基础上,经各方协商一致,确认最终目标公司估值为29,000万元,并以此确定少数股东持有的股权的对应收购价格。

2021 年 6 月 7 日,翌光半导体作出股东会决议,同意杨波、张蕾、李湘江 将其持有的全部股权转让给发行人。

2021年6月15日,公司召开2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产》《关于公司发行股份购买资产构成关联交易》等相关议案,同意发行36,909,091股股份收购杨波、张蕾、李湘江持有的翌光半导体合计35%的股权,并将本次收购翌光半导体的具体事宜全权授权董事会办理。

2021年6月15日,发行人分别与杨波、张蕾、李湘江签署《发行股份购买资产协议》,确认按照2.75元/股的价格,由发行人向杨波发行1,370.9091万股股份收购翌光半导体13%股权、向张蕾发行1,265.4545万股股份收购翌光半导体12%股权、向李湘江发行1,054.5455万股股份收购翌光半导体10%股权。

2021年6月21日,发行人取得了厦门市市场监督管理局核发的《营业执照》,就新发行股份事项完成了工商变更登记。

2021年7月7日,国家税务总局厦门市海沧区税务局分别向杨波、张蕾、李湘江出具了《非货币性资产投资分期缴纳个人所得税备案表》,同意前述自然人于2025年12月31日前缴纳完成本次股权置换产生的个人所得税。

综上,公司收购翌光半导体相关事宜已经董事会、股东大会审议通过,并聘请了专业评估机构对翌光半导体进行评估以作为收购价格的确定基础,依法办理了工商变更登记,收购程序合法合规。

3、本次收购对管理层、控制权、业务发展及经营业绩的影响

本次收购少数股权前后,翌光半导体均为发行人并表范围内的子公司。发行人收购少数股权后未新增业务,主营业务未发生变化,本次收购前后,公司的实际控制人、经营管理层均未发生变化。因此,本次收购对管理层、控制权、业务发展和经营业绩不存在重大影响。

(三) 收购翌光半导体后股权结构重组

发行人收购完成翌光半导体少数股东的股权后,通过翌光半导体间接持有大连恒坤、福建泓光及泓坤微电子 100%股权。基于优化公司管理架构,合理资源配置,同时提高运营管理效率之目的,发行人于 2021 年 8 月从翌光半导体处受让大连恒坤的 100%股权;于 2021 年 9 月从翌光半导体处受让福建泓光的 100%股权;于 2021 年 10 月从翌光半导体处受让泓坤微电子的 100%股权。股权结构重组完成后,发行人直接持有大连恒坤、福建泓光及泓坤微电子 100%股权。

本次变更事项在发行人合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围变化,不 会对发行人的财务状况和经营业绩产生不利影响,不存在损害发行人及股东利益 的情形。为完成本次股权调整,大连恒坤、福建泓光及泓坤微电子分别召开股东 会对股权转让事项作出决议,并经工商主管部门办理了工商变更登记。

四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况

(一)发行人在股转公司的挂牌情况

2014年12月15日,恒坤新材召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌有关事宜的议案》等与本次挂牌相关议案。

2015年4月24日,股转公司出具《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2015〕1435号),同意恒坤新材股票在股转公司挂牌。

2015年5月25日,恒坤新材股票在股转公司挂牌并公开转让,证券简称为"恒坤股份",证券代码为"832456",转让方式为协议转让。

(二)发行人在股转公司挂牌以来的股票交易变化情况

2015年5月25日,经股转公司同意,公司股票在新三板挂牌并以协议转让方式进行公开转让。

2018年1月15日,根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》的规定,公司股票由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。

除上述变动外,公司新三板挂牌期间股票交易方式未发生其他变动。

(三)发行人在股转公司终止挂牌情况

2021年1月12日、2021年1月27日,恒坤新材分别召开了第三届董事会第十五次会议及2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》等相关议案。

2021年5月19日,股转公司出具《同意厦门恒坤新材料科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统公告〔2021〕1439号),同意公司股票自2021年5月24日起终止在全国股转系统挂牌。

(四) 发行人在股转公司挂牌期间受到处罚的情况

公司在挂牌期间不存在受到股转系统处罚的情况。

(五) 招股意向书与新三板挂牌期间公司信息披露的差异情况说明

1、财务信息方面

公司挂牌期间的财务信息主要披露于《公开转让说明书》、半年度报告、年度报告等公告文件,因公司本次申请文件的报告期为2022年度、2023年度和2024年度,和发行人挂牌期间披露的财务数据会计期间不同,因此公司在股转系统挂牌期间财务信息披露与本次申请文件不存在差异。

2、非财务信息方面

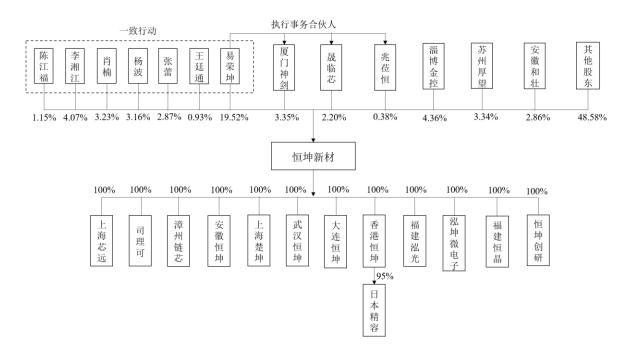
公司历史沿革中的股权代持及清理情况参见本招股意向书"第四节发行人基本情况"之"二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况"之"(四)发行人历史沿革中的股权代持情况"相关内容。

除上述情形外,公司在股转系统挂牌期间披露的非财务信息与本次发行申请 文件披露内容不存在实质性差异。

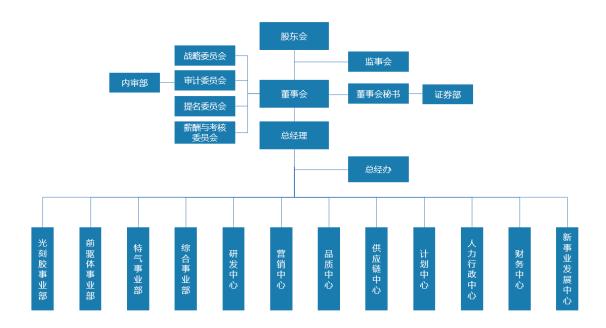
五、公司股权关系

(一) 发行人股权结构图

截至本招股意向书签署日,公司股权关系如下图所示:



(二) 发行人组织结构图



六、公司控股、参股公司及分公司情况

截至本招股意向书签署日,发行人拥有 12 家一级全资子公司、1 家二级控股子公司、5 家参股公司以及 1 家分公司。报告期各期,以各子公司中营业收入、净利润、总资产、净资产其中任一指标占公司合并报表相关指标的比例超过 5%的子公司认定为重要子公司,包括福建泓光、大连恒坤、上海楚坤、香港恒坤、安徽恒坤、翌光半导体,其中,翌光半导体报告期内已注销。相关主体具体情况如下:

(一)发行人重要子公司情况

1、福建泓光

 公司名称	福建泓光半导体材料和	有限公司			
成立日期	2019年1月7日				
注册资本	25,000 万元				
实收资本	25,000 万元				
法定代表人	肖楠				
注册地	福建省漳州高新区九海	胡镇林前村林前 773 号			
主要生产经营地		胡镇林前村林前 773 号			
经营范围	一般项目: 半导体分立器件制造; 电子专用材料研发; 电子专用材料制造; 集成电路制造; 专用化学产品制造(不含危险化学品); 工程和技术研究和试验发展; 货物进出口; 技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)				
主营业务情况	光刻材料等集成电路关键材料的研发、生产、销售				
在发行人业务板块中定 位	发行人光刻材料研发生	生产基地			
股东构成及控制情况	恒坤新材持股 100%				
	项目	2025年1-6月/2025 年6月30日	2024 年度/2024 年 12 月 31 日		
	总资产	114,361.90	87,663.30		
主要财务数据(万元)	净资产	41,932.06	37,154.27		
	营业收入	20,996.79	29,388.15		
	净利润	4,671.73	5,596.92		
	审计情况	审计情况			

2、大连恒坤

	大连恒坤新材料有限。			
成立日期	2018年5月29日			
注册资本	25,000 万元			
实收资本	25,000 万元			
 法定代表人	易荣坤			
	辽宁省大连金普新区村	公木岛化工园区松源街		
主要生产经营地	辽宁省大连金普新区村	公木岛化工园区松源街		
经营范围	许可项目:危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口;货物进出口;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);集成电路制造;工程和技术研究和试验发展;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)			
主营业务情况	前驱体材料等集成电路	格关键材料的研发、生	产、销售	
在发行人业务板块中定 位	发行人前驱体材料研究	发生产基地		
股东构成及控制情况	恒坤新材持股 100%		_	
	项目	2025年1-6月/2025 年6月30日	2024 年度/2024 年 12 月 31 日	
	总资产	49,192.78	46,205.97	
主要财务数据(万元)	净资产	12,804.19	14,190.73	
	营业收入	2,793.25	4,243.96	
	净利润	-1,408.11	-3,715.44	
	审计情况 经容诚会计师审计			

3、上海楚坤

公司名称	楚坤 (上海) 新材料科技有限公司
成立日期	2017年5月26日
注册资本	2,000 万元
实收资本	2,000 万元
法定代表人	肖忠根

注册地	上海市松江工业区茸江路 120 号 1 幢 C27 区				
主要生产经营地	上海市松江工业区茸江路 120 号 1 幢 C27 区				
经营范围	许可项目:危险化学品经营;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料及其制品、机电设备、电力设备、橡塑制品、电子产品、半导体产品的销售,商务信息咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)				
主营业务情况	引进光刻材料、前驱体、电子特气及其他湿电子化学品的采购和销售				
在发行人业务板块中定 位	负责引进产品的采购和销售				
股东构成及控制情况	恒坤新材持股 100%				
	项目	2025年1-6月/2025 年6月30日	2024 年度/2024 年 12 月 31 日		
	总资产	30,199.96	33,031.02		
主要财务数据(万元)	净资产 13,476.22 12,		12,063.88		
	营业收入	1,637.95	13,991.47		
	净利润 1,408.90 9,4				
	审计情况	经容诚会	计师审计		

4、香港恒坤

公司名称	恒坤精密工业香港有限公司				
成立日期	2013年6月11日				
股本 (港元)	558万				
实收资本 (港元)	558万				
注册地	Wanchai, Hong				
主要生产经营地	Room604,6/F, Easey commercialbuilding,253-261 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong				
主营业务	引进光刻材料、前驱体、电子特气及其他半导体产品的采购和销售				
在发行人业务板块中定 位	负责引进产品的采购和销售				
股东构成及控制情况	恒坤新材持股1	00%			
	项目	2025年1-6月/2025年6月 30日	2024年度/2024年12月31日		
主要财务数据(万元)	总资产	37,672.00	40,454.87		
	净资产	23,481.73	22,325.67		
	营业收入	1,918.45	4,445.08		

净利润	1,252.37	2,718.85
审计情况	经容诚会	计师审计

5、安徽恒坤

公司名称	安徽恒坤新材料科技有限公司				
成立日期	2020年4月8日				
注册资本	10,000 万元				
实收资本	10,000 万元				
法定代表人	王廷通				
注册地	安徽省合肥市新站区工	页王西路与颍州路交叉	口东南角		
主要生产经营地	安徽省合肥市新站区工	页王西路与颍州路交叉	口东南角		
经营范围	集成电路制造;电子半导体材料制造;材料科学研究服务;新材料技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);化工原料及产品(除危险品)批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
主营业务情况	光刻材料、前驱体材料等新产品的生产制造				
在发行人业务板块中定 位	负责各种集成电路关键材料的研发及产业化				
股东构成及控制情况	恒坤新材持股 100%				
	项目	2025年1-6月/2025 年6月30日	2024 年度/2024 年 12 月 31 日		
	总资产	55,538.67	42,170.64		
主要财务数据(万元)	净资产	4,830.62	6,079.97		
	营业收入	4.03	8.02		
	净利润	-1,252.58	-3,268.38		
	审计情况	经容诚会	计师审计		

(二) 发行人其他子公司及参股公司情况

截至本招股意向书签署日,发行人其他子公司及参股公司具体情况如下:

单位:万元、%

序号	公司名称	注册资本	实收资本	公司持股 比例	入股 时间	主营业务定位
1	泓坤微电 子	2,000.00	210.00	100.00	2018年 8月	集成电路关键材料原材料 技术研发,尚未投入实际生 产经营
2	武汉恒坤	2,000.00	40.00	100.00	2019年 6月	半导体研发技术服务
3	福建恒晶	1,200.00	1,200.00	100.00	2019年	集成电路关键材料的研发

序号	公司名称	注册资本	实收资本	公司持股 比例	入股 时间	主营业务定位
					11月	
4	漳州链芯	300.00	0.00	100.00	2023 年 4 月	尚未投入实际生产经营
5	司理可	10,000	1,995.00	100.00	2023年 11月	集成电路关键材料新产品 研发生产
6	上海芯远	500.00	1.00	100.00	2023 年 12 月	作为上海区域研发中心,吸收高端人才,向发行人及子公司输送技术
7	恒坤创研	5,000.00	0.00	100.00	2025年 9月	尚未投入实际生产经营
8	日本精容	1,000 万日元	1,000 万日元	95.00	2005年 2月	境外先进技术的研发合作 及市场拓展
9	祐尼三的	3,552.63	3,552.63	9.34	2016年 6月	从事 3D 玻璃冷弯贴合研发 及制造
10	湖北三维	11,600.00	11,500.00	4.31	2019年 6月	半导体工程化技术研发,三 维集成制造技术商业化应 用
11	大晶信息	25,000.50	25,000.50	6.67	2022 年 2 月	信息化学品(感光材料、试剂、原料)、涂料、化学生物医药原料的生产及销售,科研开发
12	长存产投	204,300.00	142,610.00	3.43	2023年 8月	私募股权投资基金管理、创 业投资基金管理服务
13	上海八亿时空	18,000.00	18,000.00	11.11	2023 年 11 月	技术服务开发,合成材料销售,电子专用材料研发及销售

注:上表中祐尼三的由发行人、关联方恒坤投资以及报告期内关联方勾陈合伙共同参与投资,恒坤投资持股 12.03%, 勾陈合伙持股 4.75%, 三方共同持股 26.13%, 无法形成对祐尼三的的实际控制。

发行人非重要子公司及参股公司的具体情况请见本招股意向书"第十二节 附件"之"十三、发行人非重要子公司及参股公司情况"。

(三)发行人分公司情况

公司名称	厦门恒坤新材料科技股份有限公司北京分公司
成立日期	2023年2月23日
负责人	易荣坤
注册地址	北京市大兴区庞各庄镇隆新大街 3 号 2 幢 2 层 213
主要生产经营地	北京市大兴区庞各庄镇隆新大街 3 号 2 幢 2 层 213
经营范围	一般项目:新材料技术推广服务;集成电路制造;工程和技术研究和试验发展;电子专用材料制造;专用化学产品制造(不含危险化学品); 化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用材料销售;机械设备销售;电子产品销售;货物进出口;企业管理咨询。(除依法须经批准

的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(四)发行人注销、转让子公司情况

报告期初至本招股意向书签署日,发行人不存在转让子公司的情况,存在注销子公司的情况,具体如下:

1、翌光半导体

翌光半导体注销前的基本情况如下:

公司名称	翌光半导体(厦门)有限公司
成立日期	2018年8月9日
注销日期	2022年9月23日
注册资本	2,000 万元
实收资本	2,000 万元
法定代表人	易荣坤
注册地	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路 99 号 1303 室之 883
经营范围	集成电路制造;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
主营业务情况	翌光半导体股权架构调整前,主要从事集成电路光刻胶及前驱体的 研发及国产化业务;股权架构调整后无实际经营业务。
股东构成及控制情况	注销前,恒坤新材持股 100%

注:发行人收购翌光半导体少数股东股权、收购翌光半导体后股权结构重组事项的基本情况参见本招股意向书"第四节发行人基本情况/三、发行人成立以来重要事件(含报告期内重大资产重组)"。

截至 2021 年 6 月,发行人持有翌光半导体 100%股权。因发行人投资架构发生调整,调整后翌光半导体无实际经营业务,发行人将其吸收合并。吸收合并完成后,发行人承接翌光半导体全部债权债务,履行的具体程序如下:

2022 年 7 月 26 日,发行人召开 2022 年第五次临时股东大会,同意发行人 吸收合并翌光半导体。

2022年8月3日,发行人作出解散翌光半导体的股东决定。

2022年8月4日,发行人及翌光半导体在海西晨报发布合并注销公告。

2022 年 8 月 16 日,国家税务总局厦门市海沧区税务局出具《清税证明》,确认翌光半导体所有税务事项已结清。

2022年9月23日,厦门市市场监督管理局出具《准予注销登记通知书》(登记内销字[2022]第2072022092350006号),准予翌光半导体注销登记。

翌光半导体注销后,其全部债权债务、相关资产均由公司承接。

2、晟明坤

晟明坤注销前的基本情况如下:

公司名称	晟明坤(厦门)材料科技有限公司
成立日期	2021年8月9日
注销日期	2024年8月9日
注册资本	1,000 万元
实收资本	0 万元
法定代表人	肖楠
注册地	厦门市海沧区山边路 389 号研发楼 108 室
经营范围	一般项目:科技中介服务;新材料技术推广服务;新材料技术研发; 集成电路制造;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务; 化工产品销售(不含许可类化工产品);技术进出口;货物进出口; 电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造。(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务情况	晟明坤设立时拟作为光刻材料及树脂材料的先导研发基地,自设立 后未投入实际经营。
股东构成及控制情况	注销前,恒坤新材持股70%

鉴于晟明坤设立后未实际经营,晟明坤申请办理了简易注销,通过企业信用信息系统公示注销情况。2024年4月15日,国家税务总局厦门市海沧区税务局出具的《清税证明》,确认晟明坤所有税务事项已结清;2024年8月9日,厦门市市场监督管理局出具《登记通知书》((厦)登销字[2024]第8002024080850003号),准予晟明坤注销登记。

翌光半导体及晟明坤在报告期内的存续期间不存在重大违法违规行为; 翌光半导体及晟明坤注销事宜,不构成控股股东、实际控制人的重大违法行为,不影响发行人董事、高级管理人员的任职资格。

七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

(一) 控股股东、实际控制人及其一致行动人

1、控股股东、实际控制人的基本情况

截至本招股意向书签署日,易荣坤直接持有公司 19.52%的股份表决权,并通过厦门神剑、晟临芯、兆莅恒间接控制公司 5.94%的股份表决权,另外通过与公司股东肖楠、杨波、张蕾、王廷通、陈江福、李湘江签订《一致行动协议书》控制公司 15.41%的股份表决权,合计控制的公司股份表决权比例为 40.87%,系公司控股股东、实际控制人。

易荣坤先生,1971年6月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。 1999年12月至2020年6月,任恒坤工贸执行董事兼总经理;2004年12月至2012年3月,任恒坤有限总经理;2012年3月至2014年1月,任恒坤有限监事; 2014年1月至今,任恒坤新材董事长;2017年2月至今,任恒坤新材总经理。

2、实际控制人的认定依据

发行人股权结构较为分散,除易荣坤外,其他任一单一股东持股比例均不超过 5%,易荣坤在发行人股东会行使表决权时具有优势地位;报告期内,易荣坤一直担任发行人董事长,其与一致行动人王廷通、肖楠共计占据董事会 3 席席位,其余均为外部董事(包括独立董事),报告期内,公司董事会中非独立董事半数以上均由易荣坤提名担任,易荣坤对董事会决议能够产生重大影响;易荣坤作为公司经营管理的核心决策者,报告期内一直担任发行人总经理,对公司的业务发展方向、战略布局、业务经营、公司治理、业务技术发展等重要事项均具有决定性影响。

综上所述,公司实际控制人为易荣坤,且最近二年未发生变更。

3、一致行动人

2020年7月,易荣坤与王廷通、肖楠签署《一致行动人协议》,各方同意在股东会、董事会提案、决策中以易荣坤的意见为准;张蕾、杨波于 2022年3月加入该协议。

2023年1月,为进一步规范一致行动关系,易荣坤与王廷通、肖楠、杨波、

张蕾重新签署了《一致行动协议书》,同意"易荣坤先生有权向一致行动人作出如何一致行动的明确指示,全体一致行动人必须按照易荣坤先生的指示行使股东/董事权利",协议有效期至协议签署后六年或至公司首次公开发行股票并上市满五年(到期日以二者日期孰晚日为准),且在到期后 30 日内各方未提出终止时自动续期三年。

2025年6月,为进一步保证发行人控制权的稳定性,易荣坤分别与李湘江、陈江福签署了《一致行动协议书》,李湘江、陈江福同意"易荣坤有权向一致行动人作出如何一致行动的明确指示,一致行动人必须按照易荣坤先生的指示行使股东权利"。陈江福在其持有发行人股份期间将始终作为易荣坤的一致行动人;李湘江自《一致行动协议书》签署后至公司首次公开发行股票并上市满三年期间为易荣坤的一致行动人,若到期日后30日内未以书面方式终止,则一致行动关系自动续期三年。

据此,王廷通、肖楠、张蕾、杨波以及陈江福、李湘江均系发行人实际控制人易荣坤的一致行动人。

(二) 控股股东和实际控制人持有发行人股份的质押或争议情况

截至本招股意向书签署日,公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的本公司股份均不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

(三)控股股东、实际控制人报告期内的重大违法违规情况

报告期内,本公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

(四)持有发行人5%以上股份的主要股东情况

截至本招股意向书签署日,除控股股东、实际控制人易荣坤外,不存在其他直接持有发行人 5%以上股份的股东。

八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况

截至本招股意向书签署日,发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

九、发行人协议控制架构的情况

截至本招股意向书签署日,发行人不存在协议控制架构。

十、发行人股本情况

(一) 本次发行前后的股本结构

截至本招股意向书签署日,公司总股本为 38,192.1660 万股,本次拟向社会公开发行 6,739.7940 万股人民币普通股,占发行后公司总股本的 15%,全部为公开发行新股。本次发行不存在股东公开发售股份的情形。

本次发行完成前后公司股本结构如下:

		发行	元前	发行后		
序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例(%)	持股数 (万股)	持股比例(%)	
1	易荣坤	7,456.2908	19.52	7,456.2908	16.59	
2	淄博金控(SS)	1,664.9088	4.36	1,664.9088	3.71	
3	李湘江	1,553.8255	4.07	1,553.8255	3.46	
4	厦门神剑	1,280.4000	3.35	1,280.4000	2.85	
5	苏州厚望	1,275.5000	3.34	1,275.5000	2.84	
6	肖楠	1,235.0000	3.23	1,235.0000	2.75	
7	杨波	1,205.9091	3.16	1,205.9091	2.68	
8	张蕾	1,096.5550	2.87	1,096.5550	2.44	
9	安徽和壮	1,090.9092	2.86	1,090.9092	2.43	
10	郭芳菲	980.0000	2.57	980.0000	2.18	
11	其他股东	19,352.8676	50.67	19,352.8676	43.07	
12	本次发行股份	-	-	6,739.7940	15.00	
	合计	38,192.1660	100.00	44,931.9600	100.00	

(二) 发行人前十名股东情况

截至本招股意向书签署日,公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例(%)
1	易荣坤	7,456.2908	19.52
2	淄博金控(SS)	1,664.9088	4.36

序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例(%)
3	李湘江	1,553.8255	4.07
4	厦门神剑	1,280.4000	3.35
5	苏州厚望	1,275.5000	3.34
6	肖楠	1,235.0000	3.23
7	杨波	1,205.9091	3.16
8	张蕾	1,096.5550	2.87
9	安徽和壮	1,090.9092	2.86
10	郭芳菲	980.0000	2.57
	合计	18,839.2984	49.33

(三) 本次发行前的前十名自然人股东及其在公司担任的职务

序号	股东名称	发行	前	在公司任职
冲 与	灰 不名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	任公可任职
1	易荣坤	7,456.29	19.52	董事长、总经理
2	李湘江	1,553.83	4.07	-
3	肖楠	1,235.00	3.23	董事、副总经理
4	杨波	1,205.91	3.16	新事业发展中心副总经理
5	张蕾	1,096.56	2.87	新事业发展中心副总经理
6	郭芳菲	980.00	2.57	-
7	周建华	500.00	1.31	-
8	陈江福	440.00	1.15	-
9	王廷通	354.00	0.93	董事、副总经理
10	黄耀林	280.00	0.73	-

(四)发行人国有股份或外资股份情况

1、国有股份情况

截至本招股意向书签署日,发行人股东深创投属于国有实际控制股东(标识为"CS"),淄博金控、漳州高新属于国有股东(标识为"SS"),除此以外,发行人其他股东均不属于国有股东("SS")或国有实际控制股东("CS")。深创投、淄博金控、漳州高新出具的相关说明或取得的批复情况如下:

(1) 深创投

截至本招股意向书签署日,深创投持有发行人 375.7574 万股股份,占发行人发行前总股本的 0.98%。根据深创投出具的《关于深圳市创新投资集团有限公司证券账户标识的说明》,深创投属于《上市公司国有股权监督管理办法》(国资委财政部证监会令第 36 号)第七十四条规定的"不符合本办法规定的国有股东标准,但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配其行为的境内外企业,证券账户标注为'CS',所持上市公司股权变动行为参照本办法管理"的对象,深创投的证券账户已经在中国证券登记结算有限责任公司标注为"CS"。

(2) 漳州高新

截至本招股意向书签署日,漳州高新持有发行人 214.4450 万股股份,占发行人发行前总股本的 0.56%,漳州高新属于参照《上市公司国有股权监督管理办法》(国资委财政部证监会令第 36 号)管理的国有股东。根据漳州高新技术产业开发区财政局 2023 年 10 月 26 日出具的《关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》,确认漳州高新的证券账户标注为"SS"。

(3) 淄博金控

截至本招股意向书签署日,淄博金控持有发行人 1,664.9088 万股股份,占发行人发行前总股本的 4.36%,淄博金控属于参照《上市公司国有股权监督管理办法》(国资委财政部证监会令第 36 号)管理的国有股东。根据淄博市财政局 2024年 6 月 17 日出具的《关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司国有股权认定的批复》,确认淄博金控的证券账户标注为"SS"。

(4) 发行人股本演变过程中国有股权管理情况

发行人股东漳州高新、淄博金控为国有独资/全资企业,属于《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委、财政部令第32号)认定的"国有及国有控股企业、国有实际控制企业"范围,其持有的发行人股份应当按照国有资产进行管理,具体情况如下:

事项	国有股权管理情况
2022年6月,漳州高新	根据《企业国有资产评估管理暂行办法》,国有企业收购非国有单
增资入股,发行人增资	位资产,应对相关资产进行评估并备案。漳州高新投资入股发行人
至 34,279.1715 万元	事项,已根据公司章程履行了内部决策程序,并提交漳州高新技术

事项	国有股权管理情况
	产业开发区管理委员会主任办公会议决策同意。
	对此,漳州高新技术产业开发区财政局于2023年8月14日出具了
	《确认函》,确认"漳州高新创投作为国有股东入股事项,已于投
	资入股前经上级主管部门会议研究讨论通过,合法合规。"
2022 年 11 月,发行人	根据《企业国有资产评估管理暂行办法》,发生非上市公司国有股
增资至 34,919.0715 万元	东股权比例变动的情形,应对相关资产进行评估并备案。两次增资
	均导致了漳州高新持有的股权被稀释。经核查,漳州高新未就两次
2022 年 12 月,发行人	增资事项履行对发行人资产评估并备案的程序。
增资至38,192.1660万元	漳州高新技术产业开发区财政局出具《确认函》,确认发行人"历
恒贝土 30,192.1000 /1/L	次国有股权变动清晰,截至本《确认函》出具之日,不存在国有资
	产管理方面的重大违法违规情形,不存在国有资产流失。"
2024年2月,淄博金控	淄博金控依据淄博市博山区人民法院作出的(2023)鲁 0304 执 600
依据生效的法院执行裁	号之三千二百九十号《执行裁定书》取得 1,404.9088 万股股份。此
定取得股份,并在两岸	次股权变动系淄博金控依据生效司法裁定取得发行人股份,且国有
股权交易中心办妥过户	股权变动已经淄博市财政局出具的《关于无偿划转厦门恒坤新材料
手续	科技股份有限公司 14,049,088 股股份的通知》同意。
2024年5月,淄博金控	淄博金控依据淄博市博山区人民法院作出的《执行裁定书》取得
依据生效的法院执行裁	共 260 万股股份。此次股权变动系淄博金控依据生效司法裁定取
定取得股份,并在两岸	得发行人股份,且国有股权变动已经淄博市财政局出具的《关于
股权交易中心办妥过户	无偿划转厦门恒坤新材料科技股份有限公司 260 万股股份至淄
手续	博市财金控股集团有限公司的通知》同意。

综上所述,发行人存在国有股东漳州高新入股后,因其他股东增资入股导致 漳州高新股权被动稀释未履行评估、备案程序的情况,发行人存在国有股权管理 方面的程序瑕疵。经漳州高新国有资产主管部门的确认,发行人历次国有股权变 动清晰,不存在国有资产管理方面的重大违法违规,不存在国有资产流失的情形。 据此,该瑕疵不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

2、外资股份情况

截至本招股意向书签署日、公司不存在外资股东。

(五)发行人股东的基金备案情况

截至本招股意向书签署日,公司共有 44 名机构股东。其中 13 名机构股东不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人,不需要按照前述规定办理私募投资基金备案手续或私募投资基金管理人登记手续,具体情况如下:

股东名称	机构股东数量	不需备案原因

股东名称	机构股东数量	不需备案原因
厦门神剑、晟临芯、晟临坤、 恒众坤合、兆莅恒	5	发行人员工持股平台
淄博金控、鑫恒舜、九州晟 德、漳州高新、赣州九派、 晟芯盈、铜陵垣涪、青岛中 胶	8	不存在以非公开方式向合格投资者募集资金或 聘请基金管理人进行投资管理的情形,亦不存 在担任私募基金管理人的情形、计划或安排
合计	13	-

截至本招股意向书签署日,除上述不需进行私募基金备案的机构股东外,公司其余 31 名机构股东均已在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案或私募基金管理人登记,具体情况如下:

序号	股东名称	备案 编号	备案时间	基金管理人名称	登记编号	登记时间
1	苏州厚望	SVQ434	2022-08-31	元禾厚望(苏州) 私募基金管理有 限公司	P1066725	2018-01-09
2	枣庄钧鑫	STY937	2022-08-02	成都钧鑫投资管 理有限公司	P1064659	2017-09-07
3	博润多	SVH372	2022-04-13	厦门博润资本投 资管理有限公司	P1068710	2018-07-17
4	新投春霖	SNF748	2020-12-14	中信建投资本管 理有限公司	GC2600011623	2015-10-20
5	浙港春霖	STQ721	2022-01-12	中信建投资本管 理有限公司	GC2600011623	2015-10-20
6	安徽和壮	SJJ005	2020-01-15	方正和生投资有 限责任公司	PT2600011619	2015-12-17
7	前海投资	SE8205	2016-04-27	前海方舟资产管 理有限公司	P1030546	2016-01-21
8	宜兴高易	SLZ584	2020-10-27	江苏高易创业投 资管理有限公司	P1072105	2021-06-24
9	江苏高易	-	-	-	P1072105	2021-06-24
10	创合鑫材	SNV429	2021-02-09	厦门创合鹭翔投 资管理有限公司	P1071657	2020-12-22
11	中原前海	SGE037	2019-04-01	前海方舟资产管 理有限公司	P1030546	2016-01-21
12	深创投	-	-	-	P1000284	2014-04-22
13	天津瑞武	SNF791	2020-12-04	天津瑞兴投资管 理有限公司	P1071086	2020-07-13
14	昇葆元启	STG334	2022-01-11	厦门昇葆筌真私 募基金管理有限 公司	P1071678	2020-12-28
15	天健周行	SVE938	2022-03-25	厦门蜜呆资产管 理合伙企业(有限 合伙)	P1060176	2016-11-22

序号	股东名称	备案 编号	备案时间	基金管理人名称	登记编号	登记时间
16	福州红土	SGQ402	2019-06-13	深创投红土私募 股权投资基金管 理(深圳)有限公 司	P1069346	2018-11-28
17	平阳启众	SVJ654	2022-03-29	杭州启势私募基 金管理有限公司	P1072560	2021-09-24
18	北京元培	SNY996	2021-03-12	方正和生投资有 限责任公司	PT2600011619	2015-12-17
19	龙岩昊嘉	SQQ979	2021-06-08	厦门吴嘉财富投 资管理有限公司	P1068059	2018-04-28
20	泉州华诺	SXU556	2022-12-08	共青城静平私募 基金管理有限公 司	P1074044	2022-09-29
21	安徽安华	SCJ944	2018-03-15	华安嘉业投资管 理有限公司	GC1900031600	2015-07-16
22	济宁弘科	STV487	2022-03-09	浙江弘颐资产管 理有限公司	P1068728	2018-07-25
23	重庆制造 业	STT807	2022-01-17	建信股权投资管 理有限责任公司	P1004749	2014-10-13
24	建信领航	SLA615	2020-09-22	建信股权投资管 理有限责任公司	P1004749	2014-10-13
25	湖北江城	SXW221	2022-12-16	湖北江城私募基 金管理有限公司	P1073162	2022-03-04
26	合肥穗禾	SVZ579	2022-07-26	农银资本管理有 限公司	P1068893	2018-08-27
27	中电基金	SJA992	2019-10-28	中电产融私募基 金管理有限公司	P1070141	2019-08-28
28	中化创新	STJ195	2022-01-18	中化创科私募基 金管理(天津)有 限公司	P1070145	2019-09-05
29	天健力丰	SSJ615	2021-09-01	厦门蜜呆资产管 理合伙企业(有限 合伙)	P1060176	2016-11-22
30	杭州嘉港	SABB53	2023-09-18	浙江海港产融投 资管理有限公司	P1060515	2016-12-09
31	成都交子	SZG481	2023-03-01	成都九颂繁星创 业投资有限公司	P1073193	2022-03-14

(六) 申报前十二个月发行人新增股东情况

1、申报前十二个月新增股东的持股数量及变化等情况

截至本招股意向书签署日,公司申报前十二个月新增股东情况如下:

序号	新增股东 名称/姓名	入股方式	取得股份时间(两岸股权中心登记时间)	持股数量 (股)	入股价格 (元/股)	定价依据	入股原因
1	杭州嘉港	股份受让	2023.12.25	800,000	11.0828	协商定价	看好公司发展
2	成都交子	股份受让	2023.12.29	480,000	10.7292	协商定价	有好公可及胶
3	淄博金控	司法划转	2024.2.27	14,049,088	-	-	执行法院裁定
3	佃 巴 亚 江	円伝刈科	2024.5.28	2,600,000	-	-	执行
4	吕文旭	股份受让	2024.10.16	1,381,041	12.3142	协商定价	看好公司发展
5	姚婉珠	股份受让	2024.10.16	1,380,000	12.3142	协商定价	1 1 1 1 1 八成

上表中,淄博金控系根据人民法院作出的生效裁定,取得原股东吕俊钦名下发行人股份合计 16,649,088 股,具体情况参见本招股意向书"第四节发行人基本情况/二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况/(三)报告期内股本、股东变化情况"相关内容。

根据中国证监会于 2021 年 2 月 5 日发布的《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》第九条的规定,淄博金控系因执行法院判决或仲裁裁决取得发行人股份的股东,在本次申报时向上海证券交易所申请豁免按照《监管指引》的要求进行股份锁定。除淄博金控外,杭州嘉港、成都交子、吕文旭、姚婉珠已承诺所持申报前 12 个月内新增股份自取得之日起 36 个月内不得转让。

公司不存在申报前6个月内从控股股东、实际控制人处受让股份的新增股东。

2、申报前十二个月新增股东的基本情况

公司 IPO 申报前十二个月新增股东的基本信息参见本招股意向书"第十二节 附件/二、申报前十二个月新增股东的基本情况"。

3、申报前十二个月新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人 员是否存在关联关系

除杭州嘉港的执行事务合伙人浙江海港产融投资管理有限公司同时担任浙港春霖普通合伙人外,公司申报前十二个月新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、申报前十二个月新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理 人员、经办人员是否存在关联关系,新增股东是否存在股份代持情形

除杭州嘉港的执行事务合伙人浙江海港产融投资管理有限公司同时担任浙港春霖普通合伙人外,公司申报前十二个月新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系,新增股东不存在股份代持的情形。

(七) 本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系情况

序号	股东名称	直接持股数量 (万股)	持股比例(%)	公司股东间的关联关系				
	易荣坤	7,456.29	19.52					
	厦门神剑	1,280.40	3.35					
	晟临芯	840.00	2.20	1、易荣坤担任厦门神剑、晟临芯、水芒恒的执行事条合体人。根据合金				
	兆莅恒	146.45	0.38	北莅恒的执行事务合伙人,根据合伙 协议能够对前述企业形成实际控制				
1	肖楠	1,235.00	3.23	协议能够对削还企业形成头际控制,				
1	杨波	1,205.91	3.16	2、易荣坤与肖楠、王廷通、张蕾、				
	张蕾	1,096.56	2.87	杨波、陈江福(系易荣坤的妻弟)、 李湘江签署了一致行动协议,构成一				
	王廷通	354.00	0.93	致行动关系				
	陈江福	440.00	1.15					
	李湘江	1,553.83	4.07					
	付端端	141.10	0.37	1、付端端为昇葆元启有限合伙人,				
2	杨小敏	60.00	0.16	其控制的厦门昇葆筌真私募基金管 理有限公司担任昇葆元启的执行事				
2	昇葆元启	343.11	0.90	务合伙人; 2、杨小敏为昇葆元启的有限合伙人				
	天健力丰	100.00	0.26					
3	天健周行	321.67	0.84	人均为厦门蜜呆资产管理合伙企业 (有限合伙)				
4	宜兴高易	727.00	1.90	江苏高易为宜兴高易的执行事务合				
	江苏高易	80.00	0.21	伙人				
	厦门神剑	1,280.40	3.35					
	晟临芯	840.00	2.20	1、陈志明为晟临芯的有限合伙人;				
	晟临坤	271.56	0.71	2、宋里千、王静、李婷婷为恒众坤 合的有限合伙人;				
	兆莅恒	146.45	0.38	3、陈志明、庄海华、黄丽恩为厦门				
5	恒众坤合	36.99	0.10	神剑的有限合伙人;				
	陈颖峥	80.00	0.21	4、陶懿宗、庄海华、肖忠根、赵明 海、毛鸿超为兆莅恒的有限合伙人;				
	陈志明	40.00	0.10	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一				
	庄海华	10.00	0.03	庄海华为晟临坤的普通合伙人				
	宋里千	40.00	0.10					

序号	股东名称	直接持股数量 (万股)	持股比例(%)	公司股东间的关联关系
	王静	40.00	0.10	
	李婷婷	20.00	0.05	
	黄丽恩	10.00	0.03	
	陶懿宗	40.00	0.10	
	肖忠根	69.00	0.18	
	赵明海	40.00	0.10	
	毛鸿超	32.00	0.08	
6	枣庄钧鑫	278.83	0.73	· 王彩缎为枣庄钧鑫的有限合伙人
	王彩缎	145.00	0.38	工形级内冬压均鍂的有限占恢入
	安徽和壮	1,090.91	2.86	1、安徽和壮、北京元培的执行事务
	北京元培	242.40	0.63	合伙人均为方正和生投资有限责任 公司;
7	铜陵垣涪	40.00	0.10	公司; 2、铜陵垣涪系方正和生投资有限责
	刘硕	48.00	0.13	任公司的员工跟投平台; 刘硕系方正 和生投资有限责任公司的员工,同时 系铜陵垣涪的有限合伙人
	深创投	375.76	0.98	1、深创投控制的企业担任福州红土
8	福州红土	290.91	0.76	的执行事务合伙人;
	前海投资	828.00	2.17	2、深创投为前海投资的有限合伙人
	前海投资	828.00	2.17	前海投资、中原前海的执行事务合伙
9	中原前海	517.45	1.35	人为前海方舟资产管理有限公司或 其控制的企业
	建信领航	406.04	1.06	
	重庆制造业	406.04	1.06	股权投资管理有限责任公司管理的
10	中化创新	471.00	1.23	私募基金; 2、建信领航持有重庆制造业、中化
	中电基金	406.04	1.06	创新、中电基金、博润多的财产份额,
	博润多	278.00	0.73	担任有限合伙人
11	中化创新	471.00	1.23	青岛中胶系中化创新管理人的员工
11	青岛中胶	16.24	0.04	跟投平台
	浙港春霖	536.11	1.40	1、浙港春霖、新投春霖的执行事务
	新投春霖	222.00	0.58	合伙人均为中信建投资本管理有限 公司;
12	杭州嘉港	80.00	0.21	2、浙港春霖的普通合伙人之一浙江 海港产融投资管理有限公司同时担 任杭州嘉港的执行事务合伙人

除上述情况外,本次发行前公司各股东之间不存在其他关联关系、一致行动 关系。

(八)公开发售股份对公司的控制权、治理结构及生产经营产生的影响

公司本次发行均为新股,不进行老股转让,预计本次发行完成后,公司控股

股东及实际控制人不会发生变化。本次发行不会对公司的控制权、治理结构及生产经营产生重大影响。

(九)本次发行前涉及的对赌协议及其解除情况

发行人在历次融资中,与相应投资方签订的不同版本的《增资合同》《<增资合同>之补充协议》《发行认购协议》《<发行认购协议>之补充协议》等交易文件中约定了多项股东特殊权利条款,主要包括股东的优先购买权和随售权、领售权、反稀释权、回购权、知情权、上市前的股权转让限制、公司治理、清算补偿权、最优惠条款等。前述特殊权利安排的清理情况如下:

序号	享受特殊权利主体	解除协议签订时间	解除情况
11. 3	深创投、中原前海、	冲你你你	WHAN IE OF
1	市海投资、安徽和 壮、深创投、福州红 土、宜兴高易、李凯、 漳州高新、昇葆元 启、创合鑫材、晟芯 盈、合肥穗禾	2023年2月、2024年6	原协议签订主体签署了终止协议,约定特殊权利条款自解除协议签订日终止并自始无效;确认不存在任何性质为对赌的条款被触发或被实际履行。
2	浙港春霖	2024年12月	原协议签订主体签署了终止协议,约定特殊权利条款自发行人通过辅导验收并取得验收报告之日起终止并自始无效,且不存在任何使之效力恢复的协议/条款。
3	博润多、苏州厚望、 建信领航、重庆制造 业、湖北江城、彭建 虎、中电基金	2024年7-12月	原协议签订主体签署了终止协议,约定特殊权利条款自发行人向中国证券监督管理委员会或证券交易所递交首次公开发行股票申请之日的前一日起终止自始无效;确认不存在任何性质为对赌的条款被触发或被实际履行。
4	中化创新		中化创新出具《回复函》,同意公司上市 申报被受理之日起易荣坤先生对其出具 的《承诺函》已经被撤回、注销,其中承 诺内容"自始无效"。
5	中化创新、青岛中胶	2024年9月	协议各方签署终止协议,特殊权利条款应 当自中化创新、青岛中胶之外的公司其他 股东就享有的各类特殊条款签署自始无 效的补充协议或书面确认文件且公司上 市申请被受理之日起终止,自始无效。
6	长兴虢实	2024年10月	长兴虢实已于2024年10月退出并签署《终止协议》,同意特殊权利条款应当自2024年10月16日起终止且自始无效;确认不存在任何性质为对赌的条款被触发或被实际履行。
7	资阳弘信创业投资 控股有限公司	2018年11月	资阳弘信创业投资控股有限公司已于 2018年11月退出并出具书面确认文件确 认"各方不存在违反约定的情形,本公司

序号	享受特殊权利主体	解除协议签订时间	解除情况	
			不就其中的任何约定与其他协议方存在 争议或潜在争议"。	
8	朱源勇、贾玉龙、吕 俊钦		吕俊钦已获得股权,特殊权利终止,后被司法机关罚没,不再持有公司股份。朱源勇、贾玉龙均已退股,并确认各方不存在纠纷或潜在纠纷。	

截至本招股意向书签署日,发行人及其控股股东、实际控制人与其他股东之间曾经约定有特殊权利安排,除发行人曾经基于《增资合同之补充协议》向深创投、福州红土承担股权回购义务且已于 2022 年 12 月终止并经各方确认自始无效外,不涉及其他发行人承担股份回购、现金补偿等具有对赌性质义务的情形。

经特殊权利条款的相关方确认,特殊权利条款已被终止或最晚将在本次发行 上市申请文件被上交所受理之日终止并自始无效。各方签署的上述特殊权利条款 终止文件合法、真实、有效,不会影响发行人股权清晰稳定。

十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

截至本招股意向书签署日,公司有7名董事、3名监事、5名高级管理人员和4名核心技术人员。发行人现任董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均为中国国籍,均无境外永久居留权。

(一) 董事

公司董事会由 7 名成员组成,其中包括 3 名独立董事,公司董事由股东会选举产生,每届任期三年,任期届满可连选连任;独立董事任期三年,独立董事连任不得超过两届。现任公司董事名单及简历如下:

序号	姓名	职务	本届任期	提名人
1	易荣坤	董事长、总经理	2022年12月-2025年12月	易荣坤
2	王廷通	董事、副总经理	2022年12月-2025年12月	易荣坤
3	肖楠	董事、副总经理	2022年12月-2025年12月	易荣坤
4	庄超颖	董事	2022年12月-2025年12月	易荣坤
5	邹友思	独立董事	2022年12月-2025年12月	董事会
6	苏小榕	独立董事	2022年12月-2025年12月	董事会
7	黄兴孪	独立董事	2022年12月-2025年12月	董事会

现任董事简历情况如下:

- 1、易荣坤先生的简历参见本招股意向书"第四节发行人基本情况"之"七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况"之"(一) 控股股东、实际控制人及其一致行动人"相关情况。
- 2、王廷通先生,1972年6月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。 1992年9月至1995年3月,于福清高山中学任教;1995年4月至1997年3月, 就读于日本京都教育大学计算机专业;1997年8月至2005年12月,任东京嘉 乐物产(进出口贸易)经理;2006年10月至2009年12月,任日本ASPEC驻 厦门代表处经理;2010年12月至2018年12月,任厦门积能总经理;2014年 6月至今,任恒坤新材副总经理;2017年1月至今,任恒坤新材董事。
- 3、肖楠先生,1982年11月生,中国国籍,北京大学电子与通信工程硕士, 无境外永久居留权。2004年7月至2010年4月,任中芯国际集成电路制造(北京)有限公司工程师;2010年5月至2013年7月,任英特尔半导体(大连)有限公司工艺工程师;2013年8月至2016年4月,任大连德豪光电科技有限公司倒装芯片工程部部长;2016年5月至2017年1月,任恒坤新材先进电子材料事业部总监;2017年1月至今,任恒坤新材董事、副总经理。
- 4、庄超颖先生,1974年1月生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。1999年1月至2003年11月,任戴尔(中国)有限公司系统集成部经理;2003年12月至2004年11月,任英特尔(中国)有限公司上海分公司技术市场经理;2004年12月至2006年11月,任戴尔(中国)有限公司产品市场经理;2007年1月至2007年12月,任中国平安保险(集团)股份有限公司区域发展部总经理;2008年1月至2012年5月,任戴尔(中国)有限公司亚太区技术支持运营管理负责人;2012年6月至2024年3月,任美银宝网络信息服务(上海)有限公司北美及亚太运营资源管理总监;2024年3月至今,任厦门北星博辉科技有限公司执行董事、总经理;2022年12月至今,任恒坤新材董事。
- 5、邹友思先生,1954 年 11 月生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。1980 年 2 月至 1986 年 12 月,任厦门大学化学系助教;1986 年 12 月至 1993 年 12 月,任厦门大学化学系讲师;1993 年 12 月至 1998 年 12 月,任厦门大学化学化工学院副教授、高分子教研室副主任;1998 年 12 月至今,任厦门大学化学化工学院教授,材料学院教授、研究员;2022 年 9 月至今,任恒坤新

材独立董事。

6、苏小榕先生,1973年2月生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。1995年10月至2001年7月,任福州市国家税务局科员;2001年7月至2003年2月,任福建浩辰律师事务所律师;2003年2月至2005年2月,任福建吴浩沛律师事务所律师;2005年2月至2010年7月,任福建浩辰律师事务所合伙人;2010年7月至今,任福建拓维律师事务所高级合伙人;2022年9月至今,任恒坤新材独立董事。

7、黄兴孪先生,1974年9月生,中国国籍,博士研究生学历,无境外永久居留权,会计专业人士。1995年8月至1995年11月,任福耀汽车玻璃股份有限公司技术员;1995年12月至1998年8月,任仙游县水务局技术员;2001年8月至今,历任厦门大学管理学院助理教授、讲师、副教授;2022年9月至今,任恒坤新材独立董事。

(二) 监事

公司监事会由 3 名成员组成,其中包括 1 名股东代表监事和 2 名职工代表监事。股东代表监事由股东会选举产生,职工代表监事由职工代表大会选举产生。每届监事任期为三年。现任公司监事名单及简历如下:

序号	姓名	职务	本届任期	提名人
1	庄海华	监事会主席	2022年12月-2025年12月	监事会
2	王玉琴	职工代表监事	2022年12月-2025年12月	职工代表大会
3	王艺缘	职工代表监事	2022年12月-2025年12月	职工代表大会

现任监事简历情况如下:

1、庄海华女士,1980年9月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。 2002年7月至2004年7月,任厦门永大橡塑五金工业有限公司研发助理;2004年8月至2007年7月,任苏州六和丰田叉车有限公司销售助理;2007年8月至2008年3月,任厦门华庆轻工制品有限公司研发助理;2008年4月至2014年3月,任恒坤有限销售助理;2014年4月至2018年8月,任恒坤新材销售助理;2018年9月至今,任恒坤新材项目专员;2014年1月至今,任恒坤新材监事会主席。

- 2、王玉琴女士,1979年9月生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。 2001年9月至2004年7月,任厦门厦新电子股份有限公司仓管;2004年9月至2012年4月,任恒坤有限采购经理;2012年7月至2018年9月,任厦门积能资材经理;2018年10月至今,任恒坤新材计划经理;2019年10月至今,任恒坤新材监事。
- 3、王艺缘女士,1985年6月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。 2007年7月至2011年10月,任三箭电子(厦门)有限公司品质/技术专员;2011年11月至2014年3月,任恒坤有限销售经理;2014年4月至2017年5月,任恒坤新材采购经理;2017年6月至2018年12月,任厦门积能项目经理;2019年1月至今,任恒坤新材采购经理;2020年4月至今,任恒坤新材监事。

(三) 高级管理人员

截至本招股意向书签署日,发行人高级管理人员如下:

序号	姓名	职务	任职期间
1	易荣坤	董事长、总经理	2023年1月至2026年1月
2	王廷通	董事、副总经理	2023年1月至2026年1月
3	肖楠	董事、副总经理	2023年1月至2026年1月
4	陈志明	财务总监	2023年1月至2026年1月
5	陈颖峥	董事会秘书	2023年1月至2026年1月

现任高级管理人员简历情况如下:

- 1、易荣坤先生的简历参见本招股意向书"第四节发行人基本情况"之"七、 持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况"之"(一)控股 股东、实际控制人及其一致行动人"相关情况。
- 2、王廷通先生的简历参见本招股意向书"第四节发行人基本情况"之"十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况"之"(一)董事"相关情况。
- 3、肖楠先生的简历参见本招股意向书"第四节发行人基本情况"之"十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况"之"(一)董事"相关情况。
 - 4、陈志明先生, 1973 年 11 月生, 中国国籍, 本科学历, 无境外永久居留

权。1995年7月至2007年5月,任厦门新凯复材科技有限公司财务课长;2007年7月至2008年3月,任厦门翔鹭化纤股份有限公司财务专员;2008年4月至2009年2月,任厦门通士达新材料有限公司财务经理;2009年3月至2010年4月,任厦门通士达有限公司财务经理;2010年5月至2013年8月,任厦门通士达新科技有限公司财务经理;2013年10月至2014年3月,任恒坤有限财务总监;2014年4月至今,任恒坤新材财务总监。

5、陈颖峥女士,1984年10月生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2009年10月至2015年5月,就职于世纪宝姿(厦门)实业有限公司,负责投资者关系事务工作;2015年7月至2017年10月,任创新互联(厦门)科技有限公司总经理助理;2017年11月至今,任恒坤新材董事长助理;2022年11月起至今,任恒坤新材董事会秘书。

(四)核心技术人员

公司综合考虑员工工作职责、工作年限、专业背景、参与研发项目情况、在 核心技术开发中所承担的角色与贡献程度、对公司核心技术发展有突出贡献、在 公司主要产品生产配方和工艺研发中具有重要作用等多方面因素,认定以下 4 名 核心技术人员,该等人员具体情况如下:

序号	姓名	职务
1	肖楠	董事、副总经理
2	宋里千	运营总监
3	王静	研发总监
4	毛鸿超	研发总监

其中,不担任公司董事、监事、高级管理人员的核心技术人员的简历如下:

1、宋里千先生,1985 年 7 月生,中国国籍,湘潭大学电子信息工程学士,无境外永久居留权。2007 年 7 月至 2010 年 10 月,任中芯国际集成电路制造(北京)有限公司光刻工艺工程师; 2010 年 11 月至 2013 年 12 月,任联华电子股份有限公司资深光刻工艺工程师; 2014 年 1 月至 2016 年 8 月,任株洲中车时代电气股份有限公司资深光刻工艺工程师; 2016 年 9 月至 2018 年 4 月,任力特半导体(无锡)有限公司晶圆代工外包运营经理; 2018 年 5 月至今,任恒坤新材运营总监。

- 2、王静女士,1984年10月生,中国国籍,中国科学院长春应用化学研究所有机化学博士,无境外永久居留权。2014年4月至2018年11月,任内蒙合成化工研究所高级工程师;2018年12月至今,历任恒坤新材资深研究员、研发总监。
- 3、毛鸿超先生,1984年8月生,中国国籍,中国科学院长春应用化学研究所有机化学博士,无境外永久居留权。2015年2月至2017年11月,任中国科学院长春应用化学研究所助理研究员;2017年12月至2019年1月,任美国伦斯勒理工学院博士后研究员;2019年2月至2020年3月,任美国凯斯西储大学博士后研究员;2020年7月至2020年12月,任中国船舶重工集团公司第七一八研究所工程师;2021年1月至今,历任恒坤新材高级工程师、研发总监。

(五)董事、监事及高级管理人员对于股票发行上市相关法律法规及其法 定义务责任的了解情况

上述公司董事、监事及高级管理人员均符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规规定的任职资格条件,由公司股东(大)会、职工代表大会和董事会依法定程序产生,不存在违反法律法规和公司章程规定的任职资格的情形。

中介机构通过集中授课、专业咨询等方式进行了辅导,帮助公司董事、监事、 高级管理人员了解首次公开发行股票并在科创板上市的有关法律、法规及规范性 文件的要求,协助公司按照相关要求进一步规范运作。公司董事、监事和高级管 理人员已了解股票发行上市相关法律法规,并知悉上市公司及董事、监事、高级 管理人员的法定义务和责任。

(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系

截至本招股意向书签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

(七)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年涉及行政处罚 等相关情况

截至招股意向书签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年内不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。

十二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与公司签订的协议及履行情况

发行人与除独立董事、外部董事之外的其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均已签订了《劳动合同》,对上述人员的忠诚义务和勤勉义务作了相关约定,明确了双方之间的权利和义务。同时,除独立董事、外部董事外,公司还与上述人员签署了保密协议、竞业禁止协议。除此之外,公司未与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员签订其他重大协议。截至本招股意向书签署日,上述合同和协议均得到了有效的执行。

十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年变动情况

(一) 董事变动情况

近两年内,公司董事的具体变动情况如下:

时间	人员	变动原因
2022年1月至2022年9月	易荣坤、肖楠、王廷通、廖泉文、 庞博	-
2022年9月至2022年12月	易荣坤、肖楠、王廷通、廖泉文、 庞博、邹友思、苏小榕、黄兴孪	新增邹友思、苏小榕、黄兴孪 为独立董事
2022年12月至今	易荣坤、肖楠、王廷通、庄超颖、 邹友思、苏小榕、黄兴孪	董事会提前换届选举,原董事 廖泉文因个人原因辞去董事 职务;股东前海投资、中原前 海的董事代表庞博因股东内 部安排辞去公司董事职务;原 2名董事辞职后由董事会提名 增补1名董事

2022年1月1日,公司董事会成员共5名,包括易荣坤、肖楠、王廷通、廖泉文、庞博。

2022 年 9 月 6 日,基于业务发展需要及优化公司治理的原因,发行人召开 2022 年第七次临时股东大会,决议同意选举邹友思、苏小榕、黄兴孪为公司第 三届董事会独立董事,董事会成员增加至 8 名。

2022年12月31日,公司董事会提前换届选举,发行人召开2022年第十三次临时股东大会选举第四届董事会成员,分别为易荣坤、肖楠、王廷通、庄超颖、邹友思、苏小榕、黄兴孪等7人,其中邹友思、苏小榕、黄兴孪为独立董事。原董事廖泉文因个人原因辞去董事职务;股东前海投资、中原前海的董事代表庞博

因股东内部安排辞去公司董事职务。

综上所述,自 2022 年 1 月 1 日至本招股意向书签署日,公司董事会成员累 计变动 6 名,其中包括因完善公司治理增加独立董事 3 名,原 2 名董事辞职后由 董事会重新提名董事补位 1 名,不存在发生重大不利变化的情况。

(二) 监事变动情况

近两年内,公司监事的具体变动情况如下:

时间	人员	变动原因	
2022年1月至2022年6月	庄海华、王玉琴、王艺缘、 宁大伟	-	
2022年6月至今	庄海华、王玉琴、王艺缘	安徽和壮的监事代表宁大伟因股 东内部安排辞去公司监事职务	

2022年1月1日,公司监事会成员为庄海华、王玉琴、王艺缘、宁大伟, 其中王玉琴、王艺缘为职工代表监事,庄海华为监事会主席,宁大伟系股东安徽 和壮委派监事。

2022年6月24日,安徽和壮的监事代表宁大伟因股东内部安排辞去公司监事职务。

2022年12月31日,因公司监事会提前换届选举,公司召开2022年第十三次临时股东大会选举第四届监事会成员,选举庄海华为公司监事会监事,任期三年。同日,公司召开职工代表大会,选举王玉琴、王艺缘为职工代表监事。2023年1月5日,公司召开第四届监事会第一次会议,选举庄海华为监事会主席。

综上所述,自 2022 年 1 月 1 日至本招股意向书签署日,公司监事累计变动 1 名,系公司投资人内部调整导致,不存在发生重大不利变化的情况。

(三)高级管理人员变动情况

近两年内,公司高级管理人员未发生变动。

(四)核心技术人员变动情况

截至本招股意向书签署日,公司核心技术人员共4名,分别为肖楠、宋里千、 王静、毛鸿超。近两年内,公司核心技术人员未发生变动。

(五) 近两年人员变动的结论性意见

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近2年内无重大不利变化,变动原因主要系公司进一步完善治理结构需要及投资人内部调整导致委派代表变动所致。发行人的核心管理团队、核心技术人员稳定,负责公司的战略、研发、生产、销售、财务等经营管理活动,并参与公司的经营决策。最近2年离任董事、监事不会对公司生产经营造成重大不利影响。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动均依法履行了《公司法》《公司章程》规定的程序,且该等变动未对公司的法人治理结构、经营政策的延续性产生重大不利影响。

十四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持有本 公司股份情况

(一) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接或间接持股情况

截至本招股意向书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有发行人股份的情况如下:

	职务		直接或间接	持股情况		合计持股比例(%)
姓名		直接持股数 量(股)	直接持股比例(%)	间接持股数 量(股)	间接持股比例(%)	
易荣坤	董事长、总经理	74,562,908	19.5231	10,159,020	2.6600	22.1831
王廷通	董事、副总经理	3,540,000	0.9269	-	-	0.9269
肖楠	董事、副总经理	12,350,000	3.2336	-	-	3.2336
庄海华	监事会主席	100,000	0.0262	398,000	0.1042	0.1304
王艺缘	监事	-	-	272,000	0.0712	0.0712
王玉琴	监事	-	-	344,000	0.0901	0.0901
陈志明	财务总监	400,000	0.1047	896,000	0.2346	0.3393
陈颖峥	董事会秘书	800,000	0.2095	-	-	0.2095
宋里千	运营总监	400,000	0.1047	110,000	0.0288	0.1335
王静	研发总监	400,000	0.1047	20,000	0.0052	0.1099
毛鸿超	研发总监	320,000	0.0838	30,000	0.0079	0.0917
	合计	92,872,908	24.3172	12,229,020	3.2020	27.5192

截至本招股意向书签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员

所持公司的股份不存在质押或冻结以及诉讼纠纷的情况。

(二)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的近亲属直接或间接持 股情况

截至本招股意向书签署日,公司董事长、总经理易荣坤配偶之弟陈江福直接持有公司 440 万股股份、配偶之妹夫张壬福通过厦门神剑间接持有公司 554.6693 万股股份;公司研发总监、核心技术人员毛鸿超配偶李禾禾通过恒众坤合间接持有公司 2,000 股股份。除此之外,公司不存在其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持股情况。

十五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的兼职情况

截至本招股意向书签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员除在发行人及其子公司以外担任董事、监事或高级管理人员的情况如下:

序号	姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务	与本公司的关系
			恒坤投资	监事	关联法人,公司实际控制人控制的其他企业
			晟临芯	执行事务合伙 人	公司员工持股平台
1	易荣坤	董事长、总 经理	厦门神剑	执行事务合伙 人	公司员工持股平台
			兆莅恒	执行事务合伙 人	公司员工持股平台
			厦门市翌光企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙 人	关联法人,公司实际控制人控制的其他企业
2	肖楠	董事、副总 经理	大晶信息	董事	公司参股公司
2	日刊		上海八亿时空	董事	公司参股公司
3	庄超颖	-tt-	厦门北星博辉科技有限公司	执行董事、总 经理	无
3	<u></u> 上	董事	厦门北星博辉科技有限公 司大连分公司	负责人	无
4	苏小榕	独立董事	福建拓维律师事务所	高级合伙人	无
4	が小竹	<u> </u>	顶点软件股份有限公司	独立董事	无
			厦门大学	副教授	无
5	黄兴孪	独立董事	福建侨龙应急装备股份有限 公司	独立董事	无
			三安光电股份有限公司	独立董事	无

序号	姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务	与本公司的关系
			厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	独立董事	无
6	邹友思	独立董事	厦门大学	教授、研究员	无
7	陈志明	财务总监	厦门市思明区日月荣光工艺 品店	经营者	无
8	庄海华	监事会 主席	晟临坤	执行事务合伙 人	公司员工持股平台

截至本招股意向书签署日,除上表所列兼职情况外,本公司董事、监事、高 级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职情况。

十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务 相关的对外投资情况

截至招股意向书签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人 员不存在与发行人及其业务相关的对外投资。

十七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的薪酬情况

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的薪酬由基本薪酬、绩效工资、奖金和津贴组成。工资根据其在公司担任的职务、承担的责任和实际履行情况确定,奖金以个人及公司业绩为基础确定。公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。董事、监事、高级管理人员的薪酬方案均按照《公司章程》等公司治理制度履行了相应的审议程序。公司给予独立董事适当的津贴,标准由股东会审议通过。

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬总额占公司利润总额的比例情况如下:

单位: 万元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
董监高及核心技术人员薪酬	396.98	1,073.61	822.56	846.53
利润总额	4,450.98	10,714.30	10,446.05	12,541.56
薪酬占利润总额比重	8.92%	10.02%	7.87%	6.75%

2024 年,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在公司领取报酬的情况如下:

序号	姓名	职位	税前薪酬/津贴(万元)	是否在关联企业领薪
1	易荣坤	董事长、总经理	109.83	否
2	王廷通	董事、副总经理	108.76	否
3	肖楠	董事、副总经理	207.65	否
4	庄超颖	董事	-	否
5	黄兴孪	独立董事	8.00	否
6	苏小榕	独立董事	8.00	否
7	邹友思	独立董事	8.00	否
8	庄海华	监事会主席	32.90	否
9	王玉琴	监事	40.41	否
10	王艺缘	监事	40.98	否
11	陈志明	财务总监	60.81	否
12	陈颖峥	董事会秘书	59.48	否
13	宋里千	运营总监	134.46	否
14	王静	研发总监	142.91	否
15	毛鸿超	研发总监	111.40	否
	1	合计	1,073.61	-

注:上表中税前薪酬/津贴包括税前应发薪酬(工资、奖金、津贴和补贴等)及公司承担的职工福利、社会保险、住房公积金等。

上述人员中,庄超颖为公司外部董事,不在公司领取薪酬;黄兴孪、苏小榕、邹友思仅在公司领取独立董事津贴,不享有其他福利待遇。除上述情况外,对于公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员,公司按照国家和地方的有关规定,依法为其办理养老、医疗等社会保险和住房公积金,不存在其它特殊待遇和退休金计划。

十八、发行人已经制定或实施的股权激励及执行情况

(一) 报告期内已经实施的股权激励情况

1、第一期股权激励

(1) 基本内容

2020年1月15日,公司召开2019年第十次临时股东大会,审议通过了《关

于厦门恒坤新材料科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》等相关议案。2020年4月13日,公司召开第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于确定"厦门恒坤新材料科技股份有限公司第一期股票期权激励计划"满足授予条件并确定期权授予日期》的议案,并与激励对象签署了《股份期权授予协议》。公司第一期股权激励计划和《股份期权授予协议》的基本内容如下:

基本要素	主要内容
标的股票来源	向激励对象定向发行公司普通股
标的股票数量	400万股。若在本激励计划公告当日至激励对象行权前,公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。
行权价格	8 元/股。在激励对象行权前,若公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股、派息等事项,未行权的股票期权的行权价格将做相应的调整。
行权时间安排	第一个行权期:自授予日起满 6 个月后的首个交易日至授予日起 12 个月内的最后一个交易日止,当期可行权比例 50%;第二个行权期:自授予日起满 12 个月后的首个交易日至授予日起 18 个月内的最后一个交易日止,当期可行权比例 50%。
有效期	本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过18个月。
授予日	2020年4月13日
服务期	协议生效之日起满3年
转让限制	公司成功 IPO 前,不以任何方式对外转让部分或全部股份,公司同意的情形除外;遵守证监会、沪深交易所关于股东限售、锁股的规定,积极配合目标公司上市辅导机构签署关于限售、锁股的相关文件和承诺。
回购条款	回购方:公司控股股东/实际控制人或其他由公司指定的第三方 (1)服务期未满,且未能充分遵守/违反第二条所载的承诺与保证或被动 离职的,回购方有权视情况决定是否回购所持有的标的股份。回购价=认 购标的股份的价格; (2)服务期未满,除前述情形外,拟转让全部或部分股份的(含主动离 职的情形),经公司同意后由回购方实施回购。回购价=认购标的股份的 价格×(1+10%×(持有天数/365))。未经公司同意,不得以任何方式转 让。 (3)服务期满至公司成功 IPO 前,于此期间内,拟转让部分或全部标的 股份的,取得公司书面同意后,各方可按照届时的市场价格协商交易。 回购方在同等条件下有优先受让权。 (4)尚未行权的,发生违反或不符合其在协议第二条所载的任何一项约 定、要求的,或乙方被动离职的,由公司无偿收回期权并注销。

注:《股份期权授予协议》中关于回购的约定,不够成发行人回购的义务。

(2) 激励对象

姓名	职务	期权数量(万份)	占授予总量比例
易荣坤	董事长、总经理	305	76.25%

姓名	职务	期权数量(万份)	占授予总量比例
宋增超	原副总经理	20	5.00%
宋里千	运营总监	10	2.50%
王静	研发总监	10	2.50%
陈颖峥	董事会秘书	10	2.50%
陈志明	财务总监	10	2.50%
其他3名员工	-	35	8.75%
合计		400	100.00%

注: 宋增超于 2021 年 2 月离职, 未参与股权激励后续行权

(3) 可行权条件

本激励计划在2020至2021年的两个会计年度中,对公司经营情况进行考核, 以达到考核目标作为激励对象当年度的可行权条件。

考虑公司主营业务、项目研发进展以及目前经营情况,分别选择公司二级子公司福建泓光半导体材料有限公司与大连恒坤新材料有限公司的经营考核指标作为本激励计划各期的公司层面行权条件。目标值的设定充分考虑公司未来战略的实现及股东对于公司的要求。

各行权期个人当期实际可行权额度=个人授予期权数量*当期可行权比例*公司经营系数*个人绩效系数

①公司经营考核要求

本次期权计划的公司经营情况达成条件为:

第一个行权期的行权条件:福建泓光半导体材料有限公司的光刻胶产品正式取得订单并对外销售。

第二个行权期的行权条件:大连恒坤新材料有限公司的前驱体产品正式取得订单并对外销售。

若每个行权期公司经营情况考核目标达成,则当期公司绩效系数为1,否则为0。

②个人业绩考核要求

本次期权激励对象的行权应以个人 2019 年度、2020 年度综合考核分别达到

要求作为前提。

不同激励对象由公司人事部门根据激励对象职务、公司考核规定等具体情况 分别确认考核方式,并根据考核结果确定年度考核等级。考核等级结果对应不同 个人绩效考核系数,具体如下表所示:

序号	考核等级	个人绩效系数
1	优秀、良好	100%
2	合格	70%
3	不合格	0%

激励对象考核当年不能行权的股票期权,由公司注销。

(4) 行权情况

2020年10月,公司以资本公积向全体股东每10股转增30股,标的股票数量相应由400万股调整为1,600万股,行权价格相应由8元/股调整为2元/股。

2021年6月8日,公司召开2021年第六次临时股东大会,审议通过了《公司首期股票期权激励第一个行权期延期》的议案,由于公司摘牌导致资本运作计划推后,拟将公司首期股票期权激励第一个行权期延期,延期时长不超过6个月。

2021年7月31日,公司召开2021年第十一次临时股东大会,审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及办理行权》的议案,同意发行不超过800万股股份用于对符合第一期期权激励计划行权条件的激励对象进行第一次行权,行权价格为2元/股。除部分激励对象因自公司离职不符合行权条件外,2021年9月,激励对象缴纳了全部认购款。

2021年12月30日,公司召开2021年第十七次临时股东大会,审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及办理行权》的议案,同意发行不超过800万股股份用于对符合第一期期权激励计划行权条件的激励对象进行第二次行权,行权价格为2元/股。除部分激励对象因自公司离职不符合行权条件外,2021年12月,激励对象缴纳了全部认购款。

2、第二期股权激励

(1) 基本内容

2021年6月22日,公司召开2021年第九次临时股东大会,审议通过了《关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司第二期股票期权激励》的议案。2021年8月31日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于确定"厦门恒坤新材料科技股份有限公司第二期股票期权激励计划"之授予日期及授予名单》的议案,并与激励对象签署了《合作协议》。

(2) 合作协议终止

2023 年 3 月,公司与激励对象签署了《终止合作协议》并与其协商解除劳动/劳务关系。根据《终止合作协议》约定:基于未来规划考虑,各方经协商一致后决定终止合作关系,自本协议签署之日起,已经订立的原协议不再继续履行,即原协议效力终止。双方承诺后续不就原协议履行再行提出任何主张,包括但不限于期权的行使、违约金/赔偿金的索偿。

3、第三期股权激励

(1) 基本内容

2021年7月8日,公司召开2021年第十次临时股东大会,审议通过了《关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司第三期股票期权激励计划》等相关议案。 2021年9月15日,公司召开2021年第十五次临时股东大会会议,审议通过了《关于确定"厦门恒坤新材料科技股份有限公司第三期股票期权激励计划"之授予日期及授予名单》的议案,并与激励对象签署了《股份期权授予协议》。公司第三期股权激励计划和《股份期权授予协议》的基本内容如下:

基本要素	主要内容
标的股票来源	向激励对象持股平台定向发行公司普通股
标的股票数量	1,476万股。若在本激励计划公告当日至激励对象行权前,公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。
行权价格	3.3 元/股。在激励对象行权前,若公司有资本公积金转增股本、派送股票 红利、缩股、派息等事项,未行权的股份期权的行权价格将做相应的调 整。
行权时间安排	第一个行权期: 自授予日起满 6 个月后的首个工作日至授予日起 7 个月内的最后一个工作日止,当期可行权比例 50%;第二个行权期: 自授予日起满 12 个月后的首个工作日至授予日起 13 个月内的最后一个工作日止,当期可行权比例 50%。
有效期	本激励计划有效期自股份期权授予之日起至激励对象获授的股份期权全部行权或注销之日止,最长不超过15个月。

基本要素	主要内容
授予日	2021年9月15日
服务期	协议生效之日起满3年
转让限制	公司成功 IPO 前,不以任何方式对外转让部分或全部股份,公司同意的情形除外。在公司成功 IPO 后遵守相关法律、法规、规范性文件及证监会、沪深交易所届时关于股东/董监高人员限售、锁股的规定。承诺公司成功 IPO 之日起三年内不减持。因权益分派等导致直接或间接持有的股份发生变化的,仍应遵守上述规定。
回购条款	回购方:公司控股股东/实际控制人或其他由公司指定的第三方 (1)在服务期满前或公司成功 IPO 前(二者孰晚),未能充分遵守/违 反第二条所载的承诺与保证或被动离职的,回购方有权视情况决定是否 回购所持有的标的股份。回购价=认购标的股份的价格; (2)在服务期满前或公司成功 IPO 前(二者孰晚),除前述情形外,拟 转让全部或部分股份的(含主动离职的情形),经公司同意后由回购方 实施回购。回购价=认购标的股份的价格×(1+10%×(持有天数/365))。 未经公司同意,不得以任何方式转让。 (3)尚未行权的,发生违反或不符合其在协议第二条所载的任何一项约 定、要求的,或乙方被动离职的,由公司无偿收回期权并注销。

注: 2022 年 11 月,发行人与参与行权的激励对象签署《补充协议》,约定"期权计划所载的回购条款自本协议生效之日终止"。

(2) 激励对象

姓名	职务	期权数量(万份)	占授予总量比例
易荣坤	董事长、总经理	700	47.43%
王廷通	副总经理	80	5.42%
陈颖峥	董事会秘书	80	5.42%
陈志明	财务总监	60	4.07%
毛鸿超	研发总监	40	2.71%
其他 39 名员工	-	516	34.96%
合计		1,476	100.00%

(3) 可行权条件

本激励计划在2021至2022年的两个会计年度中,对公司经营情况进行考核, 以达到考核目标作为激励对象当年度的可行权条件。

考虑公司主营业务、项目研发进展以及目前经营情况,选择光刻胶研发的经营考核指标作为本激励计划各期的公司层面行权条件。目标值的设定充分考虑公司未来战略的实现及股东对于公司的要求。

各行权期个人当期实际可行权额度=个人授予期权数量*当期可行权比例*公

司经营系数*个人绩效系数

①公司经营考核要求

本次期权计划的公司经营情况达成条件为:

第一个行权期的行权条件:福建泓光半导体材料有限公司的光刻胶产品低温 SOC 实现出货。

第二个行权期的行权条件:福建泓光半导体材料有限公司的光刻胶产品 ArF、BARC 实现出货。

若每个行权期公司经营情况考核目标达成,则当期公司绩效系数为1,否则为0。

②个人业绩考核要求

本次期权激励对象的行权应以个人 2021 年度、2022 年度综合考核分别达到 要求作为前提。

不同激励对象由公司人事部门根据激励对象职务、公司考核规定等具体情况 分别确认考核方式,并根据考核结果确定年度考核等级。考核等级结果对应不同 个人绩效考核系数,具体如下表所示:

序号	考核等级	个人绩效系数
1	优秀、良好	100%
2	合格	70%
3	不合格	0%

激励对象考核当年不能行权的股票期权,由公司注销。

(4) 行权情况

2022年3月22日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及办理行权》的议案,同意发行不超过738万股股份用于对符合第三期期权激励计划行权条件的激励对象进行第一次行权,行权价格为3.3元/股。除部分激励对象因自公司离职不符合行权条件外,2022年4月,激励对象缴纳了全部认购款。

2022年10月5日,公司召开2022年第九次临时股东大会,审议通过了《关

于公司第三期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及办理行权》的议案,同意发行不超过 738 万股股份用于对符合第三期期权激励计划行权条件的激励对象进行第二次行权,行权价格为 3.3 元/股。除部分激励对象因自公司离职不符合行权条件或放弃行权外,2022 年 10 月,激励对象缴纳了全部认购款。

4、第四期股权激励

2022 年 6 月 24 日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司第四期股票期权激励计划》等相关议案,并于2022 年 6 月 25 日与激励对象签署了《股份期权授予协议》。公司第四期股权激励计划和《股份期权授予协议》的基本内容如下:

基本要素	主要内容
———— 标的股票来源	公司实际控制人、控股股东转让其所持有的部分股份
标的股票数量	不超过 200 万股
行权价格	6 元/股
行权时间安排	直接授予
授予日	2022年6月24日
服务期	协议生效之日起满3年
转让限制	公司 IPO 成功上市交易前,不以任何方式对外转让部分或全部公司股份,但公司同意的情形除外;遵守证监会、沪深交易所关于股东限售、锁股的规定。
回购条款	(1) 在公司 IPO 申报前拟退出、甲方(实际控制人,下同)愿意回购,且不违反本协议第二条所载任何条件,该等情况下,拟转让标的股份的,则应按以下方式执行:回购价格=认购标的股份的价格×(1+10%×(持有天数/365))。 (2) 若违反或不符合其在本协议第二条所载的任何一项约定、要求的,或被任职的公司开除/解除劳动合同的,则甲方及公司有权随时取消乙方对标的股份的期权或认购权;若乙方已认购标的股份且已成为目标公司在册股东的,则甲方有权:按①本次认购价与②回购情形发生时公司之净资产对应的标的股份比例的价值,以二者中的孰低值无息回购全部标的股份。 (3) 若在服务期内,因其他非因激励对象过错的原因从公司离职的,则甲方有权以本次认购价加上同期银行贷款利率为回购价优先回购全部标的股份。

注: 2022 年 11 月,发行人与参与行权的激励对象签署《补充协议》,约定"期权计划所载的回购条款自本协议生效之日终止"。

(2) 激励对象

姓名	职务	股票数量(万份)	占授予总量比例

姓名	职务	股票数量(万份)	占授予总量比例
4名员工	-	124	100.00%
合计		124	100.00%

2022年6月28日,公司控股股东、实际控制人易荣坤与激励对象签署了《股权转让协议》。2022年6月和7月,全部激励对象支付了股权转让款。

5、其他股权激励

2021年7月,公司实际控制人易荣坤向陈颖峥转让其所持有的公司 40 万股股份,每股转让价格 0.55 元,构成股份支付。

6、员工持股平台

截至本招股意向书签署日,公司员工持股平台包括厦门神剑、晟临坤、晟临 芯、兆莅恒及恒众坤合,具体情况请见本招股意向书"第十二节 附件"之"十 四、员工持股平台"。

(二) 申报前制定、上市后实施的股票期权激励计划

1、第五期股权激励

(1) 基本内容

2023年3月13日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《公司第五期股票期权激励计划(草案)》等相关议案,并与激励对象签署了《股份期权授予协议》。公司第五期股权激励计划和《股份期权授予协议》的基本内容如下:

基本要素	主要内容
标的股票来源	向激励对象定向发行股票
标的股票数量	1,080 万股。
行权价格	9 元/股。综合考虑公司在本次期权计划之前最后一次定向增发的价格、所处行业、公司业绩、经营管理团队建设、公司成长性等多种因素的基础上,结合不低于最近一年经审计的净资产或评估值的要求确定。在激励对象行权前,若公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股、派息等事项,未行权的股份期权的行权价格将做相应的调整。
行权时间安排	第一个行权期: 自等待期届满后的首个交易日起至等待期届满 12 个月内的最后一个交易日当日止,当期可行权比例 50%; 第二个行权期: 自等待期届满 12 个月后的首个交易日起至有效期内最后一个交易日止,当期可行权比例 50%。

基本要素	主要内容		
有效期	本计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或回购注销之日止,最长不超过6年。		
授予日	2023年3月13日		
等待期	授予日起至以下两个日期孰晚: (1) 自授权日起 12 个月;及(2)公司股票完成上市公开发行之日。		
转让限制	在公司上市后因行权所获股票自行权日起三年内不得减持。禁售期限届满后,比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。		

(2) 激励对象

姓名	职务	期权数量(万份)	占授予总量比例
肖楠	董事、副总经理	500	46.30%
其他2名员工	-	580	53.70%
合计		1,080	100.00%

(3) 可行权条件

①公司层面业绩考核

考虑到激励对象承担的不同工作任务和岗位安排,公司针对激励对象制定了 差异化的行权条件。就特定行权期内的期权,激励对象在公司实现如下经营目标 的情形下方可行权:

激励对象	解锁期	业绩考核目标
	第一个	公司 2023 年光刻胶自产产品销售额达 1.8 亿元,并且前驱体自产销售
肖楠	行权期	额达 1000 万元。
日1用	第二个	公司 2024 年光刻胶自产产品销售额达 2.3 亿元,并且前驱体自产销售
	行权期	额达 2000 万元。
		第一项: A 产品形成销售额;
		第二项: B 产品形成销售额;
		第三项: C产品形成销售额;
	经营目 标	第四项: D产品量产准备完成。
		注: (1) 上述目标中提及的"销售额"系公司或其控股子公司与国
	171	内 8 和 12 英寸集成电路客户形成的交易金额; (2) 上述各项目标相
		互独立; (3)公司不对上述目标的达成顺序提出要求; (4)鉴于上
母子 1		述产品为本公司战略规划机密,公司将与激励对象另行签订补充协议
员工 1		进行明确约定。
	第一个	截止董事会审议行权条件之日,公司实现任一项经营目标,激励对象
	行权期	即可在第一个行权期内获授期权可全部行权。
		若(1)截止董事会审议行权条件之日,公司累计实现三项经营目
	 	标,激励对象可就第二个行权期内获授期权的 50%行权。
	第二个	若(2)截止董事会审议行权条件之日,公司累计实现"1.业绩目标"
	行权期	所列示的全部经营目标。实现该目标,期权授予对象可就第二个行
		权期内获授期权的 100%行权。

激励对象	解锁期	业绩考核目标		
		第二个行权期届满,未能行权的期权将自动失效,由公司注销。		
思丁 2	第一个行权期	截止董事会审议行权条件之日,公司实现光刻胶二期配方设备建成投产并且5款产品成功试产,激励对象即可在第一个行权期内获授期权可全部行权。		
员工 2 	第二个行权期	截止董事会审议行权条件之日,公司实现光刻胶二期树脂合成设备建成投产并且2款产品成功试产,激励对象即可在第二个行权期内获授期权可全部行权。		

若公司未满足上述业绩目标,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期 权均不得行权,由公司注销。

②个人层面业绩考核

本次期权激励对象的行权以行权时上一年度的综合考核达到要求作为前提。

不同激励对象由公司人事部门根据激励对象职务、公司考核规定等具体情况 分别确认考核方式,并根据考核结果确定年度考核等级。考核等级结果对应不同 个人绩效考核系数,具体如下表所示:

序号	考核等级	个人绩效系数
1	优秀、良好	100%
2	合格	70%
3	不合格	0%

激励对象考核当年不能行权的股份期权,由公司注销。

(4) 行权情况

根据《证券期货法律适用意见第 17 号》和公司第五期股权激励计划约定,激励对象需在授权日起 12 个月或公司股票完成上市公开发行之日孰晚后方可行权。截至本招股意向书签署日,行权时间尚未成就,激励对象尚未行权。

(三) 对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响

通过实施股权激励,公司建立健全了长效激励机制,充分调动了中、高级管理人员与骨干员工的工作积极性,提高了公司的凝聚力,增强了公司竞争力。结合公司实施的申报前制定、上市后实施的股票期权激励,公司树立了共同的企业经营发展目标,实现公司员工的个人收益、工作及绩效目标和未来几年股东、公司经营发展目标的统一,将有效推动公司落实中短期经营战略和业务发展策略,

提升公司持续经营能力。

公司授予股票或期权后,将在各期股权激励的等待期内分摊确认股份支付费用,每个会计年度将会增加因实施股权激励确认的费用,因股份支付会计处理确认的股权激励费用将对公司的净利润有一定程度影响。具体参见"(四)股权激励计划涉及股份支付费用的会计处理"相关内容。

公司报告期内已实施的股权激励计划和申报前制定、上市后实施的股票期权激励计划均不会导致公司实际控制人发生变化。

(四) 股权激励计划涉及股份支付费用的会计处理

1、权益工具公允价值的确定方法

公司选择"Black-Scholes"模型计算第一期、第三期和第五期股权激励计划中股票期权的公允价值。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《厦门恒坤新材料科技股份有限公司拟核实历次股票期权激励计划所涉及的股票期权公允价值项目评估咨询报告》(中企华评咨字(2024)第 4061 号),公司第一期、第三期和第五期股权激励计划中股票期权的公允价值分别为 1,717.28 万元、1,896.81 万元和 4,315.40 万元。

公司第四期股权激励授予股票数量 124.00 万元,转让价格 6 元/股,公允价值参考最近一次(2022 年 7 月)增资价格 9.3264 元/股,需确认股份支付费用总额 412.47 万元。

2021年7月,公司实际控制人易荣坤向陈颖峥转让其所持有的公司 40 万股股份,每股转让价格 0.55 元,公允价值参考最近一次(2021年7月)增资价格 4.125元/股,需确认股份支付费用总额 143.00 万元。

2、股权激励计划对各期经营业绩的影响

公司将各期股权激励对应的股份支付费用在等待期中进行分摊或在授予时一次性确认,并分别计入经常性损益或非经常性损益。报告期各期及以后期间分摊的股份支付费用如下表所示:

单位: 万元

股权激励计划	第一期	第三期	第四期	第五期	其他	合计

股权激励计划	第一期	第三期	第四期	第五期	其他	合计
2021年	543.81	131.22	-	-	143.00	818.03
2022年	543.81	485.19	68.75	-	-	1,097.74
2023年	135.95	365.17	137.49	975.10	1	1,613.71
2024年	-	388.65	137.49	1,170.12	-	1,696.26
2025年1-6月	-	201.45	68.75	585.06	-	855.26
2025年7-12月	-	201.45	-	585.06	-	786.51
2026年	-	100.72	-	682.05	-	782.77
2027 年	-	-	-	203.47	-	203.47
2028年	-	-	-	98.17	-	98.17
2029年	-	-	-	16.36	-	16.36

十九、发行人员工及其社会保障情况

(一) 员工人数及变化情况

报告期各期末,发行人员工人数如下表所示:

单位:人

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
员工人数	376	347	303	206

(二) 员工结构情况

截至2025年6月30日,公司员工结构如下:

单位: 人

项目	结构	人数	占员工总数比例
	生产人员	119	31.65%
	研发人员	73	19.41%
按专业划分	管理及运营人员	158	42.02%
	销售人员	26	6.91%
	合计	376	100.00%
	硕士及以上	49	13.03%
	本科	223	59.31%
受教育程度	大专	66	17.55%
	大专以下	38	10.11%
	合计	376	100.00%

项目	结构	人数	占员工总数比例	
	45 岁以上	32	8.51%	
	30-45 岁	202	53.72%	
按年龄划分	25-30 岁	113	30.05%	
	25 岁以下	29	7.71%	
	合计	376	100.00%	

(三)发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况

公司根据国家及所在地地方政府的有关规定,为员工办理了养老保险、医疗保险等社会保险,并按国家有关政策建立了住房公积金制度。公司鼓励员工缴纳社会保险,积极为其办理缴纳手续并履行缴纳义务。

报告期各期末,公司为员工缴纳社会保险及住房公积金情况如下:

单位:人

截止日	项目	员工 总数	缴纳 人数	委托第 三方缴 纳人数	新入职员工 因相关手续 正在办理中	原单位缴纳 尚未及时办 理账户转移	退休返 聘或劳 务合同 用工	外 籍 员工
2025.6.30	社会保险	376	371	1	1	1	4	-
	住房公 积金		369	1	1	1	4	2
2024.12.31	社会保 险	347	339	1	1	1	6	-
	住房公 积金		339	1	1	1	6	1
2023.12.31	社会保 险	303	293	1	3	1	6	-
	住房公 积金		292	1	3	1	6	1
2022.12.31	社会保 险	206	199	1	-	-	6	-
	住房公 积金		198	1	-	-	6	1

报告期内,因员工本人需求在实际居住地缴纳等原因,公司委托第三方机构为上述人员代缴社会保险、住房公积金。截至报告期末,公司已不存在通过第三方机构为员工缴纳社会保险、住房公积金的情形。

报告期内,公司存在部分员工未缴纳社会保险和住房公积金的情况,原因系: 1、新员工入职尚未办理完毕缴纳手续; 2、退休返聘人员无需缴纳; 3、发行人 为员工缴纳社会保险和住房公积金时,因上一用人单位未办理社会保险减员而导致未能缴纳; 4、部分人员与公司签订劳务合同,未缴纳社会保险及住房公积金,公司已为其购买商业保险,能够切实有效保障相关员工的合法权益; 5、公司 2 名外籍员工放弃缴纳住房公积金。

公司及其分公司所在地的社会保险及住房公积金主管部门针对存在在册员 工的公司已出具证明,确认发行人不存在因违反国家社会保险、劳动和社会保障 法律、行政法规而受到行政处罚的情形。

针对报告期内公司存在没有为部分员工缴纳社会保险费和住房公积金的情况,公司控股股东、实际控制人易荣坤做出如下承诺:

"发行人及子公司均已执行法律、法规及规范性文件所规定的社会保险制度和住房公积金制度,为公司员工缴存社会保险和住房公积金。如因国家有权部门要求或决定发行人及其子公司需为其员工补缴社保、住房公积金或因此而受到任何罚款或损失,相关费用和责任由本人全额承担、赔偿,本人将根据有权部门的要求及时予以缴纳。

如因此给发行人及其子公司带来损失,本人愿意向发行人及其子公司给予全额补偿。本人在承担前述补偿后,不会就该等费用向发行人及其子公司行使追索权。"

(四)劳务外包情况

报告期内,公司及其子公司将少量保安岗位进行外包,相关劳务外包人员主要承担保安等辅助性岗位工作,不涉及关键工序或关键技术。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东,均未在劳务外包单位中拥有任何权益,不存在关联关系或其他可能导致利益输送的关系。

第五节 业务与技术

一、发行人主营业务、主要产品及服务情况

(一) 主营业务基本情况

公司致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用,是境内少数具备 12 英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一,主要从事 光刻材料和前驱体材料的研发、生产和销售。

公司产品主要应用于先进 NAND、DRAM 存储芯片与 90nm 技术节点及以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节,系集成电路晶圆制造不可或缺的关键材料。报告期内,公司已量产供货产品包括 SOC、BARC、i-Line 光刻胶、KrF 光刻胶等光刻材料以及 TEOS 等前驱体材料,量产供货款数随着产品验证通过而持续提升。同时,公司持续开发新产品,包括 ArF 光刻胶、SiARC、Top Coating 等光刻材料和硅基、金属基前驱体材料均已进入客户验证流程,ArF 光刻胶已通过验证并小规模销售。截至报告期末,公司自产产品在研发、验证以及量供款数累计已超过百款。此外,在境内集成电路供应链安全需求增加背景下,公司依靠对集成电路晶圆制造各类工艺的专业理解与技术积累,引进销售进口光刻材料、前驱体材料、电子特气及其他湿电子化学品等集成电路关键材料,创新性地走出了一条"引进、消化、吸收、再创新"的发展路径。公司客户涵盖了多家中国境内领先的 12 英寸集成电路晶圆厂,已实现境外同类产品替代,打破 12 英寸集成电路关键材料国外垄断。

图:集成电路晶圆制造前道工艺流程示意图



-----前道工艺流程中公司自产产品应用领域

注:上述工艺流程顺序可根据实际工艺需求情形进行调整

公司成立于 2004 年,设立之初主要从事光电膜器件及视窗镜片产品的研发、 生产以及销售。自 2014 年起,公司推进筹划业务转型,并确定以集成电路领域 关键材料为业务转型战略方向。2017 年,公司引进的进口光刻材料与前驱体材 料陆续通过多家中国境内领先的 12 英寸集成电路晶圆厂验证,并实现常态化供应。2020 年以来,公司自产光刻材料与前驱体材料陆续通过多家客户验证并实现销售,并在 2022 年实现自产产品销售收入突破亿元大关。根据弗若斯特沙利文市场研究统计,在 12 英寸集成电路领域,公司自产光刻材料销售规模已排名境内同行前列,2023 年度,公司 SOC 与 BARC 销售规模均排名境内市场国产厂商第一位,在业内已具备较高知名度和影响力。

2020年开始,公司先后承接国家 02 科技重大专项子课题及国家发改委专项研究任务,并均已完成验收。2023年,公司新增承接多项国家多部委重要攻关任务。公司子公司福建泓光于 2020年被评为福建省集成电路光刻胶关键材料工程研究中心,并于后续相继被认定为国家级专精特新"小巨人"企业和重点"小巨人"企业,其"集成电路用旋涂碳光刻胶材料研发及产业化"项目先后获得工信部指导或主办的"创响福建"一等奖和"创客中国"三等奖。同时,公司在光刻材料与前驱体材料均有专利布局,截至报告期末,公司拥有专利 101 项,其中发明专利 43 项。

公司立足于集成电路关键材料领域,以实现集成电路关键材料国产化应用为己任,坚持为客户提供品质优良、安全可靠的产品及服务。经过多年研发与积累,公司已与多家中国境内领先的 12 英寸集成电路晶圆厂形成良好合作关系,所销售产品用于客户核心工艺制程,并获得了客户颁发的"价值创造奖"和"研发合作奖"。公司将持续加大对集成电路关键材料的研发投入,致力通过不断丰富产品品种与应用领域,巩固加强公司在集成电路关键材料领域的市场地位。

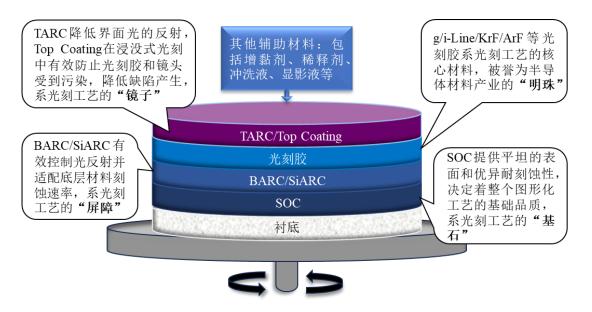
(二)公司主要产品及服务

1、自产产品

(1) 光刻材料

光刻材料主要应用于光刻工艺,光刻工艺系指利用光化学反应原理把事先制备在掩模板上的图形转印到一个衬底上的过程,是集成电路晶圆制造的一道关键工艺。报告期内,公司自产光刻材料中,SOC、BARC、KrF光刻胶、i-Line光刻胶等已有多款产品量产供货,ArF光刻胶、SiARC、Top Coating等已进入客户验证流程,ArF 浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售。公司光刻材料主要应用

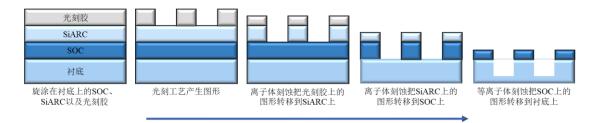
于 12 英寸集成电路晶圆制造光刻工艺环节,具体如下图所示:



① SOC (碳膜涂层)

SOC 主要成分是高碳含量的交联芳香结构聚合物,一般由聚酰胺酸树脂、交联剂和溶剂等混配而成,系一种有机涂层。在光刻工艺中,SOC 被称为光刻工艺的"基石",通常旋涂在衬底表面作为第一层材料,要求能够把衬底表面结构抹平,为后续材料旋涂提供基础。随着集成电路技术节点持续升级,要求光刻材料涂覆厚度越来越薄,以满足曝光分辨率的要求。但当胶膜薄到一定程度时,在后续刻蚀工艺过程中将无法抵挡高能等离子体引起的膜层损失,从而无法完成光掩模的图形转移。通过使用 SOC 可更好控制反射率,提升刻蚀持久性与纵横比,更好实现光刻胶上图形向衬底的刻蚀,同时,SOC 在完成光刻工艺显影后能够被除去,不会残留硅片表面影响品质。在光刻工艺中,一种被称为"三层结构"指光刻胶、SiARC 以及 SOC 三层光刻材料组合,这种结构既能有效地减少曝光时的反射光,又能提高刻蚀时选择比,已被广泛应用于先进 NAND、DRAM存储芯片与 45nm 技术节点以下逻辑芯片光刻工艺。基于工艺制程持续升级和精确图形传输需求,SOC 应用重要性持续提升,已被视为用以解决光刻过程中抗刻蚀与光反射的必备光刻材料之一。

图: SOC/SiARC/光刻胶三层结构的工艺流程图



SOC 作为集成电路制造高端技术节点制程中,图形化工艺的硬掩膜材料,以耐高温性、抗刻蚀性能、填隙能力和缺陷率等作为核心评估指标。公司 SOC 产品核心评估指标良好,能够满足先进 NAND、DRAM 存储芯片制造工艺、45nm 至 7nm 制程逻辑芯片制造工艺需求,具体说明如下表所示:

评估参数	公司产品技术水平
耐高温性	根据应用场景需求,可定向开发适用于不同温度区间的高低温 SOC 系列产品,可应用于 400℃~450℃工艺中。
抗刻蚀性能	通过精确调控碳含量以及树脂结构优化,可以获得在三层掩膜结构中理想的 刻蚀选择比,在达到光刻工艺窗口前提下,也满足蚀刻工艺的刻蚀需求。
填隙能力	最小可填隙尺寸能力达 20nm 以下。满足先进 NAND、DRAM 和逻辑芯片工艺需求。
缺陷率	单一金属离子浓度低于 1ppb, 粒径 0.3μm 以上颗粒度低于 5 个/ml。

② BARC (底部抗反射涂层)

BARC(底部抗反射涂层)是指涂布在光刻胶底部的涂层,一般由高分子树脂、热致产酸剂、表面活性剂以及溶剂等组成。在光刻工艺中,BARC通常涂覆于衬底、SOC和光刻胶之间,光刻工艺在曝光时光线透过光刻胶照射在衬底上,在光刻胶和衬底的界面处,光线会被反射,这些反射光和入射光会形成干涉,使得光强沿深度方向的分布不均匀,形成驻波效应。同时,有些衬底表面沉积有低介电常数材料,这些特殊材料会释放出对光刻胶尤其是应用化学放大技术的光刻胶有害的成分,破坏光刻胶性能。BARC具有较高的吸光系数,不溶于光刻胶溶剂,刻蚀速率要大于光刻胶,通过使用BARC,消除从衬底反射到光刻胶中的光,隔离衬底物质向光刻胶中扩散,降低由反射引起的驻波效应对光刻胶性能的影响。从 248nm 波长光刻胶即 KrF 光刻胶开始,BARC 被广泛应用,已被视为在先进NAND、DRAM 存储芯片与 90nm 以下技术节点逻辑芯片与光刻胶共同应用的必备光刻材料之一。

BARC 通常以光学常数、刻蚀速率以及兼容性作为核心评估参数, 公司

BARC 具备良好的光反射控制,可调节刻蚀速率,与光刻胶良好兼容,能够适配 浸没式光刻工艺以及 FinFET 工艺中特殊需求,具体技术水平说明如下表所示:

评估参数	公司产品技术水平
光学常数	通过调节树脂结构,可精确匹配衬底膜层对光学常数的要求,达到优秀反射 率控制,可达到界面反射率小于 0.5%。
刻蚀速率	适配快速刻蚀速率,刻蚀选择比大。
兼容性	与大多数光刻胶兼容性良好,已适配多款 KrF 光刻胶与 ArF 光刻胶,并能够满足光刻胶对于侧壁形貌要求。

报告期内,公司自产 SOC 与 BARC 销售收入占自产光刻材料销售收入的比例均超过 90%,系公司自产光刻材料主要销售品种。根据全球范围内集成电路晶圆制造通用工艺路线,随着境内集成电路先进制程快速发展,SOC 与 BARC 在集成电路晶圆制造的必需性与重要性日益显著,不仅如此,在境内集成电路产业缺少 EUV 光刻工艺的背景下,SOC、BARC 等光刻材料结合多重曝光技术和浸没式光刻技术的灵活运用是实现先进技术节点与工艺制程突破的关键解决方案。

截至报告期末,公司自产 SOC 与 BARC 已累计量产供货超过 50,000 加仑,量产供货产品款数合计超过 40 款,成功替换境外厂商同类产品,打破境外厂商垄断格局,在公司量产供货前,境内晶圆厂的 SOC、BARC 主要由境外厂商如信越化学、日本合成橡胶、日产化学以及 Brewer Science 等供应,公司系境内少数在 12 英寸集成电路领域实现 SOC、BARC 量产供货的企业之一。根据弗若斯特沙利文市场研究,2023 年度,公司 SOC 与 BARC 销售规模均已排名境内市场国产厂商第一位。与此同时,公司已实现适配浸没式光刻工艺 BARC 量产供货,全面助力境内集成电路先进制程的快速发展。

③ 光刻胶

光刻胶是一种光敏感的聚合物,是由聚合物树脂、光敏化合物、溶剂以及添加剂等成分组成的混合液。在集成电路晶圆制造过程中,光刻胶与其他光刻材料根据工艺先后旋涂于衬底上,通过曝光、显影、刻蚀等工艺流程,将掩模板上的图形转移至晶圆表面,从而实现细微图形加工。报告期内,公司量产供货光刻胶均系半导体光刻胶,应用于 12 英寸集成电路晶圆制造。半导体光刻胶根据曝光光源波长不同,可分为 g-Line(436nm)、i-Line(365nm)、KrF(248nm)、ArF(193nm)和 EUV(13.5nm)光刻胶。

光刻胶是光刻工艺核心材料,其性能和品质与芯片良率、可靠性及光刻生产成本密切相关。光刻胶性能指标包括分辨率、对比度、敏感度、粘度、粘附性、抗蚀性和表面张力等。报告期内,公司已实现销售的光刻胶包括 KrF 光刻胶、特殊应用 i-Line 负性光刻胶,ArF 浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售,并有多款光刻胶进入客户验证流程,具体情况如下表所示:

产品名称	产品技术特点
i-Line 光刻胶	曝光波长为 365nm,应用化学增幅技术可以大幅提高光刻胶敏感度,并保持较高的分辨率(<0.30um)。公司自产 i-Line 光刻胶系针对客户需求定制开发的创新型负性光刻胶产品,用于先进存储芯片生产。分辨率、对比度、粘附性及敏感度均系为客户工艺制程量身打造,体现公司自主研发能力。
KrF 光刻胶	曝光波长为 248nm,采用化学放大技术的光刻胶,结合分辨率增强技术,可进一步应用于 0.11μm 至 90nm 技术节点。公司自产 KrF 光刻胶可以满足厚度从数微米到 0.2μm 的应用需求。其中,高分辨率 KrF 光刻胶极限分辨率可达到 120nm,1:1 线条图形,在曝光宽容度为 10%的情况下焦深大于 0.3μm。
ArF 光刻胶	曝光波长为 193nm,采用化学放大技术,分为干式和浸没式光刻胶。其中,ArF 干式光刻胶可应用于 90nm 至 55nm 技术节点,ArF 浸没式光刻胶通过 浸没式光刻技术、邻近效应校正等分辨率增强技术,结合多重曝光技术,可应用于 45nm 至 7nm 技术节点。公司已针对 12 英寸集成电路晶圆制造开发数款 ArF 光刻胶在客户验证过程中,其中,ArF 浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售。

截至报告期末,公司自产 KrF 光刻胶和 i-Line 光刻胶已累计量产供货超过5,500 加仑,同时,除已批量供货产品外,公司已有超过10款 i-Line 光刻胶、KrF 光刻胶以及 ArF 光刻胶进入验证流程,部分产品已验证通过并小规模销售,预计将在未来实现对境外厂商同类产品替代。

④ 其他光刻材料

除上述光刻材料外,公司进入客户验证流程的光刻材料还包括 SiARC、Top Coating 以及其他光刻工艺配套试剂等。随着相关产品陆续验证通过,将进一步丰富公司量产供货的光刻材料产品品类与规模,提升公司核心竞争力。

基于集成电路制造中光刻工艺的重要性、复杂性以及精确性,光刻材料通常需根据客户具体需求进行定制化研发,并在通过客户验证后方可逐步使用。即使是同品类光刻材料产品,也需根据客户工艺需求、特点、指标、参数等进行配方调整,形成专属于某类客户或某个客户特定工艺环境下的具体产品。因此,光刻材料定制化特点促使公司必须充分理解和熟练掌握光刻材料的应用工艺,并融入到生产与研发过程中,以符合终端客户需求和市场发展趋势。

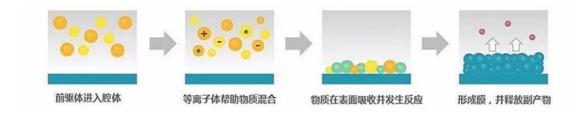
(2) 前驱体材料

在半导体领域,前驱体材料从化学性质方面系指携有目标元素,呈气态或易挥发液态或固态,且具备化学热稳定性,同时具备相应的反应活性或物理性能的一类物质,系薄膜沉积工艺的核心材料之一。前驱体材料在薄膜沉积工艺的气相沉积过程中形成符合半导体工艺要求的各类薄膜层,随着半导体技术节点持续突破,单位面积集成的电路规模不断扩大,芯片内部立体结构日趋复杂,所需薄膜层数越来越多,对薄膜的材料种类和性能参数均不断提出新的要求,前驱体的发展为半导体制造迈向更先进制程提供了保障。

报告期内,公司自产硅基前驱体材料以 TEOS 为主。公司子公司大连恒坤通过与 Soulbrain 合作,引进 TEOS 生产管理技术实现自产,产品纯度达到 9N (99.999999%)电子级别要求,未来将在客户端逐步置换公司自 Soulbrain 引进的 TEOS。

TEOS 系一种硅有机化合物材料,其化学式为 C₈H₂₀O₄Si,初级材料系由四 氯化硅和无水乙醇作用后经蒸馏而成。半导体用 TEOS 需在初级材料基础上进一步精馏,纯度要求达到 9N 电子级别。TEOS 主要用途系在薄膜沉积工艺的化学气相沉积工艺(CVD)过程中生成二氧化硅氧化薄膜,以阻挡污染物和杂质进入半导体器件,并产生导电层、绝缘层、反射层以及光刻层等,达到隔离不同电路、保护器件、减少光反射等效果,具体如下图所示:

图: 化学气相沉积工艺(CVD)示意图



除 TEOS 外,随着公司自主研发、生产运营以及质量控制经验逐步积累,公司已在开发其他硅基与金属基前驱体材料,已有超过 5 款前驱体材料在研发或验证过程中。

2、引进产品

报告期内,公司引进产品包括光刻材料、前驱体材料、电子特气及其他湿电

子化学品等。其中,前驱体材料、电子特气及其他湿电子化学品属于相对标准化的产品,公司根据客户需求,与境外供应商对接产品引进;光刻材料属于高度定制化产品,即在产品完成导入前,供应商并不存在无需改良调整即可直接销售的成熟产品。在引进过程中,公司需全面跟进客户送样测试、反馈改良以及产品调整等核心环节,并根据客户工艺制程情况,对产品配方改良、参数调整以及定制开发工作提出技术建议,与供应商合作定制光刻材料产品。定制光刻材料引进体现了公司在产品应用方面的核心技术与竞争实力。

报告期内,公司引进光刻材料相关产品均系替代美日厂商同类产品,满足了境内晶圆厂关键材料的替代需求,具体如下:

具体类别	主要客户	引进产品 供应商	替代产品供 应商	与报告期内公司自产产 品差异
BARC	客户 A1			
i-Line 光刻胶	客户 C	SKMP	东京应化、日 产化学以及	产品配方不同,应用于
KrF 光刻胶	客户 A1、客户 C	SKIVIP	美国杜邦等	不同的光刻层
ArF 光刻胶	客户 A1		7 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1	

(三)公司主营业务收入构成

报告期内,公司主营业务收入的构成情况如下:

单位:万元、%

75F LT	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自产产品	24,977.42	86.68	34,418.93	63.77	19,058.84	52.72	12,357.89	38.94
光刻材料	21,928.71	76.10	29,998.67	55.58	17,202.90	47.58	12,168.58	38.35
前驱体材料	3,048.70	10.58	4,420.26	8.19	1,855.93	5.13	189.31	0.60
引进产品	3,836.84	13.32	19,556.25	36.23	17,094.17	47.28	19,376.03	61.06
光刻材料	981.16	3.41	14,711.02	27.26	12,141.90	33.58	14,290.10	45.03
前驱体材料	1,065.70	3.70	1,828.08	3.39	2,449.56	6.78	3,556.56	11.21
电子特气	768.96	2.67	1,921.99	3.56	1,728.88	4.78	1,208.19	3.81
其他	1,021.00	3.54	1,095.17	2.03	773.83	2.14	321.18	1.01
主营业务收 入合计	28,814.25	100.00	53,975.18	100.00	36,153.01	100.00	31,733.92	100.00

(四)公司主要经营模式

1、采购模式

采购环节系公司日常运营、品质控制以及成本管理的重要环节。公司采购产品主要包括研发与生产所需原材料与辅料采购和引进产品采购等。公司由采购部负责对供应商进行整体管控,建立《合格供应商名单》;由研发部门协助建立规格标准,由采购部组织各相关部门对供应商的生产设备、生产能力、生产工艺等方面进行评审;由计划中心制定物料采购计划,确保物料计划符合需求;由质量部对供应商质量保证体系、HSF(无有害物质)符合性、环境管理等进行评审并动态监视。同时,公司制定了《采购管理程序》《供应商管理程序》《仓库出入库管理制度》等内部控制制度与标准工作程序对采购环节进行严格管控。

(1) 原材料与辅料等采购

公司根据客户订单情况与产品生产规划进行原材料备货,并提前规划备货周期。公司原材料与辅料采购流程主要如下:

A、新材料开发及确认阶段:需求部门提出采购申请,采购部门收到申请后,要求供应商提供符合采购申请相关资料,采购部门将相关资料提供给需求部门和研发部门确认相关参数是否符合要求。其中,针对需样品测试的原材料与辅料,由需求部门提出样品申请,采购部门要求供应商提供样品测试,需求部门进行测试后将结果反馈至采购部门,并最终确认是否符合需求。

- B、询价阶段:采购部与需求部门确认原材料与辅料符合采购申请要求后,要求供应商提供报价,根据价格审批流程确认后录入 ERP 系统。
- C、日常采购:由需求单位提出原材料与辅料编号申请交由计划中心,计划中心制定采购计划后,由采购员依照一种物料对应一个生产商的规则在 ERP 建立新的物料编号。工厂需求部门提交采购申请单,经审核通过后,由采购员下推采购订单,发送供应商进行签订。如供应商提出采购订单内容修改意见或要求使用供应商版本协议时,则需要经审批通过后才可以签订。
- D、原材料与辅料接收、验证以及入库:仓管员依据供应商"送货单"对来料进行确认标签、外观检查并点收数量,然后在 ERP 中做收货送检。质量部依据供应商"送货单"和"进料检验规范"对所送检的材料进行检验,符合质量及

HSF (无有害物质)要求后进行验收;发现不符合质量要求的,依照《不合格品控制程序》中原物料的控制流程进行处置。仓库对质量部检验合格的产品及时办理入库。

(2) 引进产品采购

公司引进产品采购包括光刻材料、前驱体材料、电子特气及其他湿电子化学品等采购。自相关产品完成客户送样、测试以及验证后,公司根据客户需求向供应商进行成品采购。采购过程中,由销售团队根据客户需求向计划中心提出产品申请,计划中心制定采购计划后,采购员依照一种产品对应一个生产商的规则在ERP建立新的产品料号。销售团队根据客户订单,在ERP系统提销售订单,同时下推采购申请单并走审批流程。采购员接到采购申请单后,下推采购订单,经过审批后,发送供应商签订。引进产品由境外供应商直接发货至客户仓库或指定地点,由客户或公司根据订单等文件办理清关等事宜。

2、生产模式

报告期内,公司子公司福建泓光与大连恒坤分别负责光刻材料与前驱体材料的生产工作。公司采用以销定产的生产模式。销售部门提前获得各客户各产品的年度或半年度需求预测和每月出货计划预测,确认正式订单并经销售部门负责人审核后,由计划中心负责制定出货计划及物料采购计划。生产部门根据出货计划要求,结合仓库库存情况和车间产能情况等制定生产排程,组织生产和安排出货,并根据需求储备安全库存,以确保产品交期稳定。

一方面,公司在产品研发阶段即投入大量资源与客户就产品技术、性能、品质要求、量产计划和需求规模等重要细节进行沟通,当产品样品性能通过客户验证后,通常还需经小批量、正式批量供货阶段来验证公司产品的生产技术能力与品质稳定性,客户也会在验证与小批量供货阶段对公司的产能及其原材料供应是否可满足其需求进行判断。因此,公司通常在产品验证阶段准备相关产品产能,同步对生产线是否可满足对应产品后续规模化生产进行测试。另一方面,产品开始供货后,客户通常按照其物料需求定期向公司推送采购需求,公司根据客户需求制定后续生产计划。

公司下游客户具有严格的供应商与产品准入机制,一旦公司产品通过验证并

批量供货,后续订单通常较为稳定且产量将随着客户需求提升逐步增长。公司已 熟练掌握光刻材料混配、纯化生产技术与前驱体材料合成、精馏提纯生产技术以 及各种检测分析能力,并搭建完善的品控管理体系,已通过境内主要晶圆厂严格 审核。报告期内,公司生产模式保持稳定,生产规模持续提升。

3、销售模式

公司产品销售均采用直销模式。按照公司与客户之间的结算模式不同,进一步分为普通销售模式和寄售模式。普通销售模式下,自产产品根据销售合同或订单约定,公司将商品发运至客户指定地点并取得客户签收单时实现销售;引进产品根据销售合同或订单约定的贸易条件,在控制权完成转移时实现销售。寄售模式下,公司根据销售合同或订单的约定将商品发运至客户指定地点,在客户实际领用时实现销售。

4、研发模式

公司已形成完善的研发体系,制定了《研发项目管理制度》《研发实验室安全管理制度》《产品品质先期策划程序》《知识产权管理手册》《保密控制程序》《研发费用管理规定》等内部控制制度,涵盖研发工作各环节,对公司日常研发进行管理。研发工作由研发中心统筹负责,项目实施方式主要以自主研发方式为主。公司研发模式分为项目立项阶段、方案设计阶段、样品制作阶段、用户试用阶段、小批量试产阶段以及量产阶段,具体如下图所示:

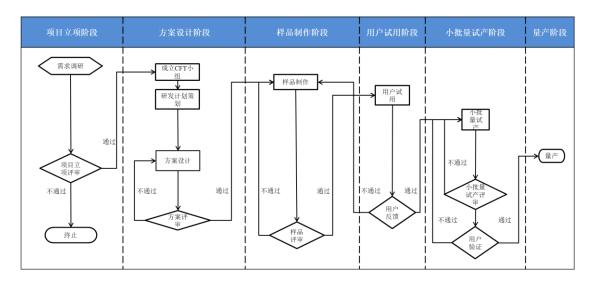


图: 研发模式流程图

公司研发模式主要系结合客户主要制程与研发方向需求,以产品线为基础,以国产化为主要研发方向,主要包括光刻材料与前驱体材料两个研发大类。目前,公司主要在研产品既包括客户现有技术节点下相关产品对应所需的材料,也包括客户在研发过程或规划中的产品对应所需的材料。公司在完成研发样品后即与客户沟通测试送样,并根据测试结果与客户需求对产品配方、参数以及指标进行调整,最终实现对不同客户不同类型产品销售。

5、公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和 影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

报告期内,公司主要经营模式保持稳定,未发生重大变化。公司目前的经营模式是结合行业情况、公司情况、主要产品以及市场供需等因素确定的,符合行业惯例与发展趋势。公司上游供应商主要系原材料、辅料、成品以及设备等供应商,下游客户主要系境内 12 英寸集成电路晶圆厂。

公司经营模式的关键影响因素主要在于产业政策的变化或推进、市场竞争情况变化、行业发展趋势、前沿产品技术的发展与应用等。未来,公司将积极巩固现有业务优势,把握市场、技术等方面的发展前瞻,实现市场竞争力的稳固与加强。

(五)公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况 况

自成立以来,公司主营业务、主要产品或服务以及主要经营模式演变主要分为3个阶段,具体情况如下:

1、2004年至2014年:传统业务构建经营基础,市场竞争促进转型战略

公司于 2004 年成立,成立之初以光电膜器件及视窗镜片产品的研发、生产以及销售为主营业务方向,具体产品包括 OCA 光学胶、视窗镜片以及光学防爆膜等,主要客户为境内外触摸屏与显示平板生产厂商。2014 年度,公司营业收入已突破 2 亿元。光电显示行业竞争日趋激烈让公司在日常经营过程中持续考虑业务转型方向,通过与境内外客户持续交流,公司逐步认识到半导体行业材料领域的市场空间与发展方向,并最终确定以集成电路关键材料为转型方向。

2、2015年至2019年:战略规划初见成效,销售先行提升研发信心

2015 年开始,公司即通过团队引进、渠道沟通以及资源积累等方式布局集成电路关键材料业务板块。公司对境内集成电路关键材料领域持续研究,意识到该领域已基本被境外厂商垄断,且境内晶圆厂正处于发展过程中,未来对关键材料需求将日益提升。同时,如关键材料持续被境外厂商垄断,势必影响境内集成电路行业长期发展。基于市场情况,公司确定如下发展战略:

- (1) 在集成电路晶圆制造方面,公司判断 6 英寸与 8 英寸硅基晶圆制造产业链已形成稳定竞争格局,而从技术发展与成本控制维度,12 英寸硅基晶圆制造将成为未来晶圆厂重要布局。因此,公司确定将客户维度首先锁定在12 英寸硅基晶圆制造领域,优先突破12 英寸集成电路晶圆制造关键材料。
- (2)在产品储备方面,由于集成电路关键材料细分领域众多,公司综合分析晶圆制造前道工艺与后道工艺各环节与自身经营研发团队优劣势,确定优先聚焦前道工艺环节,并将前道工艺中重要性较高的光刻材料与前驱体材料产品作为拟推进具体产品品种。
- (3)在供应链储备方面,公司充分评估自身资金实力与市场竞争格局,确定在发展初期以引进方式作为主要经营模式。公司通过引进方式,一方面快速落地实现客户准入,成为中国境内领先的12英寸集成电路晶圆厂的合格供应商;另一方面也为公司在技术研发、客户验证、产品改良以及品控管理等方面积累经验,为后续公司自主研发并建立工厂提供支撑。同时,引进产品销售也帮助公司取得了稳定的经营现金流,促进公司健康发展。
- 2017 年,公司引进光刻材料与前驱体材料陆续通过客户验证并实现销售,实现对中国境内领先的 12 英寸集成电路晶圆厂关键材料的常态化供应。随着公司成功进入集成电路晶圆制造产业链,公司进一步理解与分析行业现状、发展趋势以及市场机会,充分认识到关键材料国产化应用的重要性与紧迫性,将自主研发产品作为公司重要战略。2018 年,公司设立大连恒坤,启动大连前驱体材料工厂建设;2019 年,公司设立福建泓光,启动漳州光刻材料工厂建设。

3、2020年至今: 自主研发全面突破,行业地位日益稳固

2020年,福建泓光光刻材料工厂正式投产,当年完成 SOC 生产供货,成功

打破境外厂商垄断。同年,公司承担国家 02 科技重大专项子课题及国家发改委专项研究任务,相关项目已于 2023 年完成结题。2021 年,大连恒坤前驱体材料工厂正式投产,同年,公司子公司安徽恒坤明确发展规划,启动合肥关键材料工厂建设。自 2020 年起,公司陆续实现光刻材料与前驱体材料量产供货,自产产品得到市场充分认可。

截至报告期末,公司实现量产供货产品均系 12 英寸集成电路晶圆制造不可或缺的关键材料。2024 年度和 2025 年 1-6 月,公司自产产品销售规模分别为 34,418.93 万元和 24,977.42 万元,其中,光刻材料销售规模分别为 29,998.67 万元和 21,928.71 万元。根据弗若斯特沙利文市场研究统计,在 12 英寸集成电路领域,公司自产光刻材料销售规模已排名中国境内同行前列,2023 年度,公司 SOC 与 BARC 销售规模均排名境内市场国产厂商第一位,在业内已具备较高知名度和影响力。

(六)主要业务经营及核心技术产业化情况

报告期内,公司主营业务收入分别为 31,733.92 万元、36,153.01 万元、53,975.18 万元和 28,814.25 万元,整体呈现稳步增长趋势。其中,公司自产产品销售收入分别为 12,357.89 万元、19,058.84 万元、34,418.93 万元和 24,977.42 万元,2022 年至 2024 年复合增长率达 66.89%,公司自产销售规模快速增长,量产供货产品款数持续增加,体现公司自产产品的良好市场认可度。同时,公司引进产品销售收入分别为 19,376.03 万元、17,094.17 万元、19,556.25 万元和 3,836.84 万元,体现公司对集成电路工艺应用的专业理解。总体而言,公司核心技术产业化已取得突破,主营业务发展趋势与公司整体发展战略相匹配。

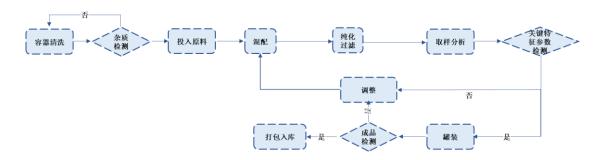
(七) 主要产品的生产工艺流程图

报告期内,公司主要从事光刻材料与前驱体材料的研发与生产。其中,光刻材料主要生产工艺为混配和纯化过滤,前驱体材料主要生产工艺为精馏。公司主要产品工艺流程图如下所示:

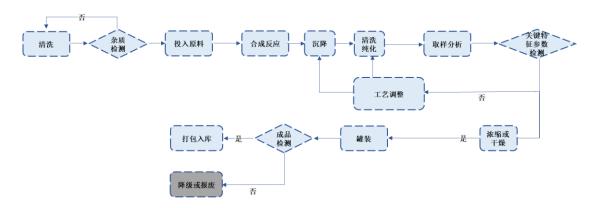
1、光刻材料生产工艺流程图

光刻材料生产过程中,混配和纯化过滤工艺是核心工艺,在初次混配和过滤完成后,需对材料进行关键特征参数检测,并根据检测结果确定是否需要进行调

整后再次混配。检测通过后,进行成品罐装,并在罐装完成后进行成品检测,检测合格后打包入库。公司光刻材料生产示意图如下所示:

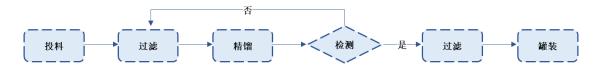


在熟练掌握光刻材料生产工艺基础上,公司已积极推进光刻材料核心原材料 树脂的合成工艺,致力在实现光刻材料国产化落地的同时,进一步解决光刻材料 核心原材料的国产化。公司树脂生产示意图如下所示:

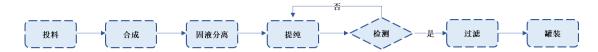


2、前驱体材料生产工艺流程图

前驱体材料生产过程中,精馏工艺是核心工艺。在精馏工艺方面,公司可以 实现对不同离子分次精馏,通过每次精馏后检测确认本次精馏是否实现颗粒、离 子以及杂质去除,最终实现产品参数满足客户要求。公司精馏工艺生产示意图如 下所示:



在熟练掌握精馏工艺基础上,公司已具备前驱体材料"固态、液态、气态" 多态合一的合成与分离生产工艺能力,为后续生产高纯度金属基前驱体材料提供 重要支撑。公司前驱体材料合成工艺生产示意图如下所示:



(八)公司具有代表性的业务数据

报告期内,公司具有代表性的业务数据包括客户、产能、产量、销量、产品销售单价、原材料采购单价等,相关业务数据的变动情况及原因请参见本节"三、发行人销售情况及主要客户"与"四、发行人采购情况及主要供应商"。

(九)公司符合产业政策和国家经济发展战略的情况

公司主要从事集成电路领域关键材料的研发与产业化应用,符合产业政策和国家经济发展战略,具体情况请参见本节"二、发行人所处行业基本情况及竞争状况"之"(一)所属行业及确定所属行业的依据"。

二、发行人所处行业基本情况及竞争状况

(一) 所属行业及确定所属行业的依据

公司主营业务为集成电路领域关键材料的研发与产业化应用,主要覆盖关键材料包括光刻材料与前驱体材料两大类,并根据客户需求引进包括电子特气等其他关键材料产品。

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)下属的电子专用材料制造(C3985)。根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》,公司属于新一代信息技术产业中的集成电路产业,具体为"1 新一代信息技术产业—1.3 电子核心产业—1.3.1 集成电路(集成电路材料)"。根据国家统计局《战略性新兴行业分类(2018)》,公司产品属于"3 新材料产业—3.3 先进石化化工新材料—3.3.6 专用化学品及材料制造(C3985 电子专用材料制造)"。根据国家统计局《新产业新业态新商业模式统计分类(2018)》,公司产品属于"020106 高储能和关键电子材料制造——3985 电子专用材料制造"。此外,根据工信部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录(2024 年版)》,公司产品属于关键战略材料,具体为"关键战略材料"之"三、先进半导体材料和新型显示材料"之"242 超高纯化学试剂"与"243 集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂"。

从相关目录分析,公司兼具"新一代信息技术"和"新材料"的产业属性,从公司产品主要应用领域、主要客户群体、承担重大科研专项等方面分析,公司"新一代信息技术"产业属性更为突出:一方面,公司销售产品主要应用于 12 英寸集成电路制造领域,报告期内主要客户等均系中国境内领先的 12 英寸集成电路晶圆厂;另一方面,公司先后承接并完成国家 02 科技重大专项子课题及国家发改委专项研究任务,打破境外厂商对集成电路关键材料垄断。

(二)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及对发行人经营发展的影响

1、行业主管部门和监管体制

公司主营业务属于新一代信息技术与新材料交叉领域,行业管理体制为国家 宏观调控和行业自律相结合方式。其中,行政主管部门系国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部,负责研究拟定产业发展战略、方针政策和总体规划,对行业整体发展方向进行宏观调控,指导并促进行业技术进步;行业监管部门包括国家应急管理部、国家市场监督管理总局以及国家生态环境部,负责安全生产政策和规划,指导协调全国安全生产工作,市场综合监督管理,建立健全环境保护基本制度,重大环境问题统筹协调和监督管理,环境污染防治的监督管理;行业协会系中国半导体行业协会与中国电子材料行业协会,负责行业自律、规范管理、协助制订标准、参与国际交流、提供决策支撑以及行业政策建议等。

根据法律法规,我国对集成电路关键材料包括光刻材料、前驱体材料等均实行严格监督管理机制,行业监管体系主要包括质量监督管理体系、安全生产监督管理体系、道路运输管理体系、环境保护管理体系等;行业监管制度包括安全生产许可制度、危险化学品生产许可制度、道路运输经营许可制度等。公司生产经营活动需遵守相关规章制度。

2、行业主要法律法规和政策

公司主营的关键材料包括光刻材料、前驱体材料等,均系国家重点扶持和发展行业以及战略性新兴产业中的新一代信息技术产业和新材料产业。截至报告期末,境内涉及集成电路及关键材料相关政策主要包括:

序号	名称	发布单位	发布时间	主要相关内容
1	《2024 年政府工作报告》	国务院	2024 年 3 月	实施制造业重点产业链高质量发展行动,着力补齐短板、拉长长板、锻造新板,增强产业链供应链韧性和竞争力。 大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。
2	《重点新材料首批 次应用示范指导目录(2024年版)》	工信部	2023 年 12 月	电子化工新材料部分列示超高纯化学试剂、集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂以及特种气体等,对"关键战略材料"进行鼓励与支持。
3	《产业结构调整指导目录》(2024年本)	国家发改委	2023 年 12 月	鼓励类项下信息产业项下的电子元器件 生产专用材料部分列示湿化学品、电子 特气、光刻胶等工艺与辅助材料。
4	《扩大内需战略规 划纲要(2022-2035 年)》		2022 年 12 月	深入推进国家战略性新兴产业集群发展,建设国家级战略性新兴产业基地。 全面提升信息技术产业核心竞争力,推 动人工智能、先进通信、集成电路、新 型显示、先进计算等技术创新和应用。
5	《原材料工业"三品"实施方案》	工信部、国资 委、国家市场 监督管理总 局、国家知识 产权局	2022 年 8 月	原材料品质提升工程,推进电子功能材料、电子工艺与辅助材料等设计制造技术研发和质量精确控制技术攻关; 开展高端半导体材料等新工艺标准制定。
6	《关于深入推进世 界一流大学和一流 学科建设的若干意 见》	教育部、财政 部、国家发改 委	2022 年 1 月	加快培养急需高层次人才。面向集成电路、人工智能、储能技术、数字经济等关键领域加强交叉学科人才培养。
7	《"十四五"数字经 济发展规划》	国务院	2021 年 12 月	瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域,发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势,提高数字技术基础研发能力。
8	《"十四五"国家知识产权保护和运用规划》	国务院	2021 年 10 月	要健全高质量创造支持政策,加强人工智能、量子信息、集成电路、基础软件等领域自主知识产权创造和储备。
9	《中华人民共和国 国民经济和社会发 展第十四个五年规 划和 2035 年远景目 标纲要》	全国人民代表大会	2021 年 3 月	明确指出集中优势资源攻关核心技术, 其中集成电路领域包括集成电路设计工 具、重点装备和高纯靶材,集成电路先 进工艺和 IGBT、MEMS 等特色工艺突 破,先进存储技术升级,碳化硅、氮化 镓等宽禁带半导体发展。
10	《关于支持集成电 路产业和软件产业 发展进口税收政策 的通知》	财政部、海关 总署、税务总 局	2021 年 3 月	提出制定享受免征进口关税的集成电路企业清单、免税进口商品清单、集成电路重大项目建议名单以及承建企业建议名单等一系列清单名录,制定可享受进口新设备进口环节增值税分期纳税的集成电路重大项目标准和享受分期纳税承建企业的条件。

序号	名称	发布单位	发布时间	主要相关内容
11	《关于促进集成电 路产业和软件产业 高质量发展企业所 得税政策的公告》	财政部、税务 总局、国家发 改委、工信部	2020 年 12 月	明确国家鼓励的集成电路生产、设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业的税收优惠政策。
12	《关于扩大战略性 新兴产业投资培育 壮大新增长点增长 极的指导意见》	国家发改委、 科技部、工信 部、财政部	2020 年 9 月	加快新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定,加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。
13	《新时期促进集成 电路产业和软件产 业高质量发展若干 政策》	国务院	2020 年 7 月	制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。
14	《战略性新兴产业分类(2018)》	国家统计局	2018年11 月	集成电路光刻材料与前驱体材料属于专用化学品及材料制造下电子专用材料制造,属于战略性新兴产业。
15	《新产业新业态新商业模式统计分类(2018)》	国家统计局	2018 年 8 月	关键电子材料制造属于新产业新业态新 商业模式。
16	《战略性新兴产业 重点产品和服务指 导目录(2016版)》	国家发改委	2017 年 1 月	将集成电路作为新一代信息技术产业列 入该目录。

3、近年来产业政策对公司经营发展的影响

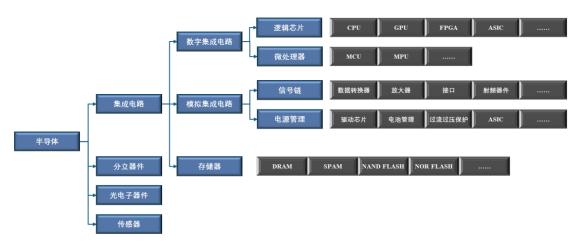
集成电路产业系国家科技发展水平核心体现。当前,境内集成电路仍然高度 依赖进口,供应链安全问题突出,不利于产业稳定健康发展。因此,国家层面已 高度关注集成电路产业发展,出台各类鼓励性与支持性政策持续扶持集成电路产 业。近年来,国家层面发布一系列支持政策与重点产业目录,从发展方向指引、 税收优惠等方面为集成电路产业整体发展营造了良好政策和制度环境,有效加速 半导体关键设备、关键材料等国产化进程。

公司从事的集成电路关键材料领域属于国家鼓励产业,是战略性新兴产业重点发展方向。报告期内,公司所属行业的行业政策未发生不利变化,未对公司日常经营、准入门槛、技术研发以及运营模式等涉及持续经营能力方面产生不利影响。

(三) 行业发展情况及发展趋势

1、集成电路行业发展概况及发展趋势

半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体行业是现代经济社会发展先导性产业,是电子信息产业的基础支撑。根据世界半导体贸易统计协会统计,2023年,全球半导体市场规模为5,198.2亿美元,同比下降10.9%。半导体产品主要分为集成电路、分立器件、光电子器件及传感器四类。其中集成电路在半导体产品中占比超过80%,总体行业附加值最大。



集成电路行业是信息技术产业核心和国民经济信息化基础,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,是国家创新驱动发展战略的重点发展领域。集成电路简称 IC(Integrated Circuit),是指通过一系列特定加工工艺,将晶体管、二极管等有源器件和电阻器、电容器等无源器件,按照一定电路互联,"集成"在半导体晶片上,随后封装在一个外壳内,执行特定功能的电路或系统。按照产品种类划分,集成电路可进一步细分为承担计算功能的逻辑芯片、承担存储功能的存储芯片、承担传输与能源供给功能的模拟芯片以及将运算、存储等功能集成于一个芯片之上的微控制单元四个主要品类。其中存储芯片是集成电路占比最大的品类,约占 35%。

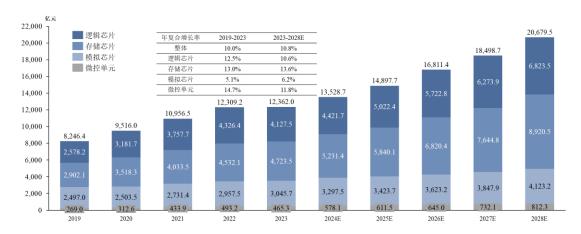


图: 境内 2019-2028 年集成电路产品市场规模预测分析

来源: Frost & Sullivan

按照产业链环节划分,集成电路可以分为设计、制造、封装和测试环节。目前,境内集成电路发展仍以集成电路设计为主,销售额占比不断增加。根据中国半导体行业协会统计及弗若斯特沙利文市场调研,2023 年境内集成电路产业销售额为12,362.0 亿元,同比增长0.4%,其中设计业、制造业、封装测试业分别占比45.0%、30.0%、25.0%,集成电路制造占比逐渐升高,预计未来中国集成电路产业市场规模将继续保持增长态势,2028 年境内集成电路行业市场规模将达到20,679.5 亿元。

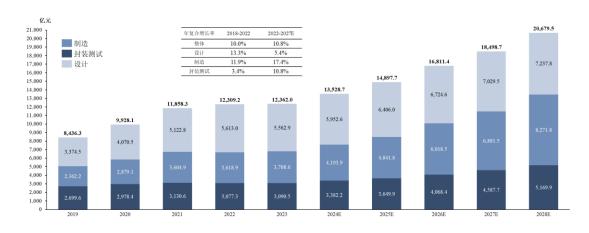
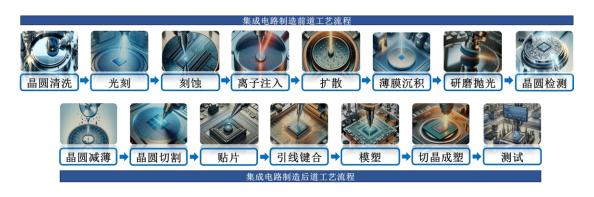


图: 境内 2019-2028 年集成电路按产业链市场规模分析

来源: SEMI、CEMIA、Frost & Sullivan

在全球集成电路产业中,受到摩尔定律驱动,技术节点向 5nm 和 3nm 演化, 集成电路设计和制造成本不断上升,导致设计和制造比重在整体产业结构中不断 上升。晶圆制造是指晶圆生产商根据设计版图进行掩模制作,形成模版,在晶圆 上批量制造集成电路,通过多次重复运用光刻、掺杂、沉积等工艺,最终在晶圆 上实现高集成度的复杂电路。晶圆生产后通常要进行晶圆测试,检测晶圆的电路功能和性能。晶圆制造工艺流程中,光刻工艺系利用光化学反应原理把事先制备在掩模板上的图形转印到一个衬底上的过程,其定义了集成电路尺寸,难度最大,耗时最长,芯片在生产过程中一般需要进行 20-90 次光刻,是晶圆制造工艺中关键一环,薄膜沉积工艺系利用含有薄膜元素的一种或几种气相化合物或单质,通过气相沉积方式在衬底表面形成薄膜的过程,其对提高集成电路性能、可靠性和寿命至关重要。晶圆制造前道工艺与后道工艺流程图概览如下所示:

图: 晶圆制造工艺流程图概览



注: 上述工艺流程顺序可根据实际工艺需求情形进行调整

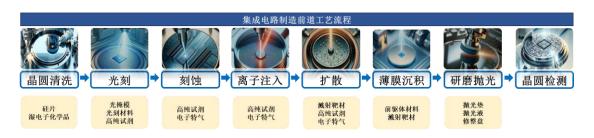
境内集成电路得益于成熟制程自主可控性逐渐提高及晶圆制造厂商更加专注先进制程的市场开拓和制造生产,技术节点在 14-90nm 范围的晶圆产能增长明显。根据 SEMI 数据,2017-2020年,全球范围内投产半导体晶圆厂为 62 座,其中 26 座设于境内地区,占全球总数的 42%。同时,2021年末,根据全球范围内半导体制造商的新增产能建设计划,预计新建晶圆厂每月可生产多达 260 万片晶圆 (等效 8 英寸计算)。2021-2023年,境内新建半导体晶圆厂达 20 座,远超名列第二的美洲地区和第三的欧洲及中东地区。根据弗若斯特沙利文预测,到 2025年,境内 12 英寸晶圆产能有望达每月 240 万片,位列全球第一。

2、集成电路关键材料发展概况及发展趋势

材料和设备是集成电路产业基石,是推动集成电路技术创新的引擎。集成电路关键材料处于整个产业链上游环节,对产业发展起着重要支撑作用,具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期长等特点。集成电路关键材料细分品类众多,可以分为前道工艺晶圆制造材料和后道工艺封装材料。

前道工艺晶圆制造材料包含硅片、掩模板、光刻材料、前驱体材料、电子特气、研磨抛光材料、湿电子化学品、高纯试剂、溅射靶材等。在晶圆制造过程中,硅晶圆环节会用到硅片;清洗环节会用到湿电子化学品;光刻中涂胶环节会用到光刻材料,曝光环节会用到掩模板;显影、去胶环节均会用到高纯试剂;刻蚀环节会用到高纯试剂、电子特气;薄膜沉积环节会用到前驱体材料和靶材;研磨抛光环节会用到抛光液和抛光垫等。晶圆制造前道工艺流程和所需关键材料具体如下所示:

图: 晶圆制造前道工艺流程和所需关键材料图例



注: 上述工艺流程顺序可根据实际工艺需求情形进行调整

随着境内集成电路产业持续发展,结合国家战略推动关键材料国产化,带动关键材料市场规模逐年增长。根据弗若斯特沙利文统计及预测,境内集成电路关键材料市场规模总体从 2019 年 664.7 亿元增长到 2023 年 1,139.3 亿元,年复合增长率为 14.4%,预计 2028 年市场规模为 2,589.6 亿元。同时,基于晶圆制造技术节点不断升级及境内集成电路先进制程日趋成熟,光刻材料、前驱体材料以及靶材等制造材料用量均持续提升,预计前道工艺对应制造材料增长幅度将高于后道工艺封测材料增长幅度,预计 2028 年制造材料市场规模为 1,853.8 亿元,占关键材料市场规模比例超过 70%。



图: 境内 2019-2028 年集成电路关键材料行业市场规模分析

来源: Frost & Sullivan

制造材料中,硅片、光刻材料、掩模板、电子特气占比较高。以 2023 年为例,硅片市场在晶圆制造材料市场中占比为 33.1%,位列第 1 位,光刻材料、掩模板、电子特气分别位列第 2、3、4 位,占比分别为 15.3%,13.2%,13.2%。抛光材料、前驱体材料、湿电子化学品、溅射靶材等材料占比均在 2%-7%之间。同时,各大类材料又包括几十种甚至上百种具体产品,细分子行业多达上百个,关键材料产业呈现种类繁多、细分市场相对较为分散的特点。

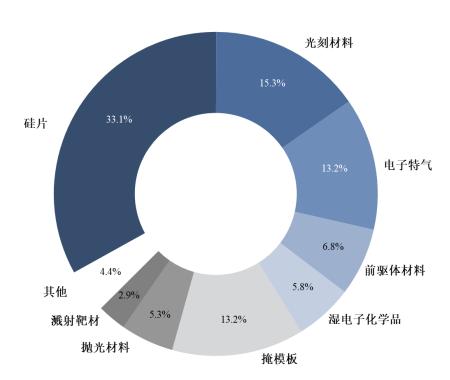


图: 2023 年境内集成电路制造材料分类占比

来源: Frost & Sullivan

3、光刻材料发展概况及发展趋势

光刻材料主要包括 SOC(Spin On Carbon)、ARC(Anti-reflective Coating)、 光刻胶、Top Coating、稀释剂、冲洗液、显影液等,系光刻工艺中重要材料之一, 决定着晶圆工艺图形的精密程度与产品良率。光刻工艺定义了集成电路产品的尺寸,是集成电路制造工艺中的关键一环,光刻工艺难度最大,耗时最长,芯片在 生产过程中一般需要进行 20 至 90 次光刻。同时,光刻材料贯穿整个光刻工艺, 集成电路生产制造过程中,光刻材料成本约占集成电路制造材料成本的 13%-15%, 光刻工艺成本约占晶圆制造工艺的 1/3,耗时占晶圆制造工艺的 40%-50%。

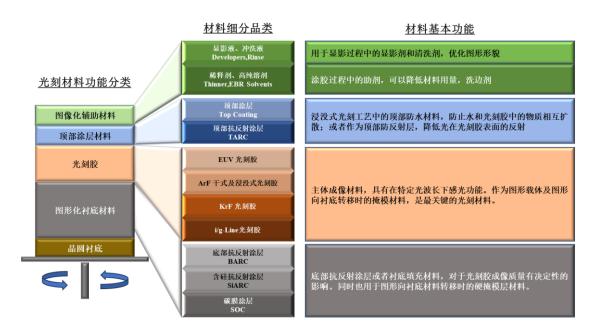


图: 光刻材料分类示意图

光刻材料市场需求与集成电路工艺发展紧密相关。一方面,随着晶圆制造工艺制程逐渐缩小,先进制程中光刻工艺曝光次数显著增加。尤其是境内缺失 EUV 相关技术的背景下,多重曝光技术与浸没式光刻技术已被广泛应用以提升技术节点,相应曝光材料用量随之提升,对光刻材料需求保持增长;另一方面,存储芯片中闪存芯片推进 3D NAND、内存芯片技术节点持续升级、逻辑芯片转向FinFET 结构等都对光刻材料提出新要求,促使光刻材料持续演进。存储芯片与逻辑芯片合计市场规模占集成电路市场规模超过 60%,相应产品技术演变推动光刻材料技术不断进步,需求保持上升。

在存储芯片方面,持续提升读写速度和存储容量系各类存储芯片主要发展方

向。其中,DRAM 制程工艺已在使用 DUV 技术与多重曝光技术,特别是技术节点进入 20nm 以下之后,制造难度大幅提升,DRAM 芯片厂商对工艺定义从具体线宽转变为在制程范围内技术迭代来提高存储密度; NAND 芯片制程工艺从 2D 架构转向 3D 堆叠架构,以更多堆叠层数来得到更大存储容量,要求光刻材料满足多次台阶刻蚀和深层结构刻蚀要求。在技术实现基础上,存储芯片容量提升对应制造工艺过程中的光刻次数与层数持续增加,对应光刻材料市场需求也将快速增长。

在逻辑芯片方面,一方面,为了在现有技术范围内尽可能提高技术节点,晶圆厂引入浸没式光刻技术和多重曝光技术,Top Coating 作为与 ArF 浸没式光刻胶配套使用的光刻材料得以广泛应用。同时,多重曝光技术使浸没式光刻技术在原有半周期极限分辨率仅能满足 28nm 技术节点背景下,通过多重曝光能够应用于 14nm、10nm 甚至 7nm 技术节点,而在多重曝光技术下,对光刻材料的分辨率、线条边缘粗糙度和光敏性均提出更高要求;另一方面,高数值孔径光刻机应用和 FinFET 器件工艺导致光刻工艺复杂性显著增加,除需要改善分辨率外,光刻材料还需应对 FinFET 器件不平整的三维衬底结构在平坦化和抗反射方面的需求。多重曝光技术与 FinFET 器件工艺持续推动光刻材料技术进化,并同步带动光刻材料市场需求提升。

除了来自集成电路前道工艺方面的技术挑战与市场需求外,后道封装工艺中, 先进封装再布线层、穿透硅通孔、堆叠封装、凸块制作等技术应用也推动光刻材料进一步发展:如再布线层和铜凸块制作需要高对比度厚膜光刻胶;特定穿透硅通孔需要高深宽比和高分辨率的负性光刻胶,并需同时满足形貌、厚度、涂布均匀性、对比度、高黏度等多维度参数要求;集成电路小型化和多功能化推动芯片布线和封装技术持续创新,在制造封装基板、薄膜和其他先进封装组件中,光敏聚酰亚胺已成为金属线和单元芯片之间应用最多的绝缘介质材料。

境内光刻材料起步较晚,前期发展较为缓慢。随着国家科技重大专项支持和集成电路产业快速成长的带动下,境内光刻材料企业开始持续研发投入,光刻材料整体研发与制备水平得到提升,但在先进制程领域,境外光刻材料厂商仍然占据较高市场份额。伴随境内晶圆制造产能与良率不断提升,上下游行业快速发展,并结合光刻材料国产化战略持续深化,境内光刻材料市场本土供应量增速有望高

于全球平均水平。根据弗若斯特沙利文市场研究,境内光刻材料整体市场规模从 2019 年 53.7 亿元增长至 2023 年 121.9 亿元,年复合增长率达 22.7%,并将于 2028 年增长至 319.2 亿元,年复合增长率达 21.2%。

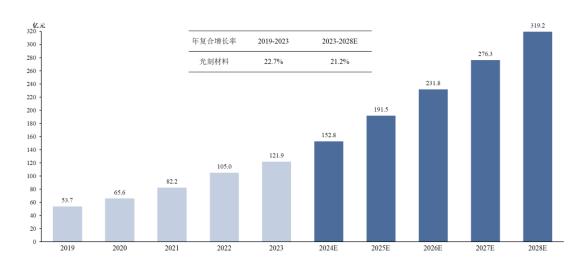


图: 境内 2019-2028 年光刻材料市场规模分析

来源: Frost & Sullivan

(1) SOC 系晶圆制造光刻工艺必备光刻材料之一

SOC 主要包括用于存储芯片生产为主的高温 SOC 与用于逻辑芯片生产为主的低温 SOC, 广泛应用于先进 NAND、DRAM 存储芯片与 45nm 技术节点以下逻辑芯片光刻工艺。SOC 系光刻工艺衬底上旋涂的第一层材料, 有效解决光刻过程中的平坦度、刻蚀持久性以及抗反射能力问题,同时,SOC 系"三层结构"的核心材料之一,随着 FinFET 器件技术广泛应用,"三层结构"已开始取代"两层结构",SOC 已属于晶圆制造光刻工艺必备关键光刻材料。

SOC 发展趋势主要系基于晶圆制造光刻工艺的持续升级与优化。一方面,由于 SOC 材料特性,使其同时具备较好抗反射能力与优良刻蚀持久性与纵横比,并能够在光刻工艺后被除去。因此,在晶圆制造工艺日趋复杂的发展趋势下,对 SOC 使用量将成倍提升;另一方面,"三层结构"对提高图形解析度与保真度方面均效果显著,且在工艺异常时可通过返工工艺避免晶圆报废,能够一定程度弥补境内 EUV 光刻工艺缺失的技术短板,促进境内晶圆制造工艺与关键材料国产化的发展,相应推动 SOC 规模进一步增长;与此同时,随着境内先进 NAND、DRAM 存储芯片如多层堆叠的 3D NAND 和 18nm 及以下的 DRAM 等 SOC 使用

量较高产品的生产技术日趋成熟,产能产量日益提升,对 SOC 需求和使用量将持续扩大。

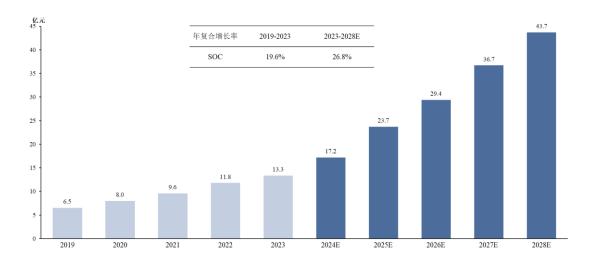


图: 境内 2019-2028 年 SOC 市场规模分析

来源: Frost & Sullivan

根据弗若斯特沙利文市场研究,境内 SOC 市场规模呈现持续上升趋势,从 2019 年 6.5 亿元增长至 2023 年 13.3 亿元,年复合增长率达 19.6%,预计 2028 年境内 SOC 市场规模将增长至 43.7 亿元,年复合增长率为 26.8%。因此,预计 2023 年至 2028 年,境内 SOC 年复合增长率将高于光刻材料整体年复合增长率, SOC 在光刻材料中占比将日益提升。

(2) 抗反射涂层配套光刻胶成熟应用于晶圆制造光刻工艺

抗反射涂层根据涂覆位置不同主要分为位于衬底与光刻胶之间的 BARC 与位于光刻胶顶部的 TARC。在光刻工艺过程中,抗反射涂层在旋涂光刻胶前后均需要使用,主要作用系消除入射光在光刻胶与衬底界面、光刻胶与空气界面产生的反射,降低由反射引起的驻波效应对光刻胶性能的影响,已成为配套光刻胶成熟应用的关键光刻材料。

随着集成电路集成度日益提升,对应线宽尺寸与薄膜厚度均提出更高要求,相应需要更大比例抗反射涂层配合光刻胶使用,因此,随着光刻技术演进,光刻层数增加,抗反射涂层使用规模将同步增加。与此同时,技术节点不断缩小致使不同光刻材料之间化学相互作用日益明显,需对 BARC 工艺和特性持续优化以提供最佳光刻材料轮廓和工艺窗口,满足特定应用和产品需求。根据弗若斯特沙

利文市场研究,境内抗反射涂层市场规模从 2019 年 10.3 亿元增长至 2023 年 29.4 亿元,年复合增长率达 29.9%。预计 2028 年境内抗反射涂层市场规模将增长至 96.9 亿元,年复合增长率为 26.9%。

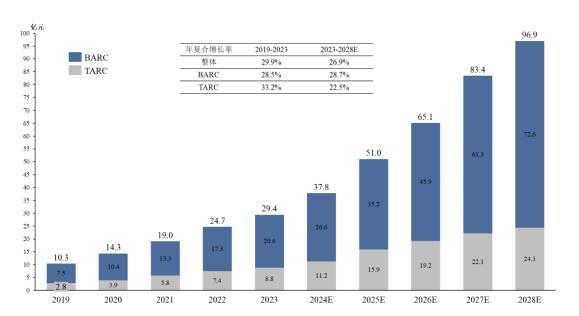


图: 境内 2019-2028 年抗反射涂层市场规模分析

来源: Frost & Sullivan

BARC 占抗反射涂层市场规模超过 70%。按照应用场景及搭配光刻胶类别,BARC 可进一步分为 i-Line BARC、KrF BARC、ArF BARC 以及 iArF BARC 等类型。BARC 市场需求与对应光刻胶用量密切相关,随着境内 12 英寸集成电路晶圆制造产能持续提升,工艺制程逐步升级,预计 KrF 光刻胶与 ArF 浸没式光刻胶市场规模将进一步提升,对应 KrF BARC与 iArF BARC 市场规模同步增长。

BARC 材料细分领域众多,其中,SiARC 涂覆位置与 BARC 相似但分子结构与其他 BARC 有较大差异,在先进 NAND、DRAM 存储芯片与 40nm 技术节点以下逻辑芯片的关键层被广泛使用。如在 40nm 技术节点,光刻胶厚度一般仅为 100nm 左右,该厚度已无法有效阻挡反应离子刻蚀,在图形被完全刻蚀到衬底之前,光刻胶已经大量消耗,SiARC 由于含硅特性,在离子刻蚀时可提供较高的刻蚀选择性。在"三层结构"中,SiARC 涂覆于 SOC 上,共同解决光刻工艺过程中的刻蚀性能、间隙填充、平坦化性能以及反射率等问题。现阶段,"三层结构"在集成电路晶圆制造过程中已广泛应用,SiARC 需求随着境内晶圆厂量产能力提升而持续增长。

根据弗若斯特沙利文市场研究,在 12 英寸集成电路领域,全球范围内生产 SOC 与抗反射涂层的企业主要有日本合成橡胶、信越化学、美国杜邦、Brewer Science、德国默克、PIBOND等。公司 SOC 与 BARC 均已实现稳定量产供货,2024年度,公司 SOC 销售规模达 23,236.34万元,预计境内市占率超过 10%。除公司量产供货外,境内集成电路晶圆厂 SOC 与 BARC 仍然主要通过进口方式采购。因此,随着关键材料国产化战略进一步深化落实,SOC 与 BARC 应用规模与市场需求快速提升,将带动公司 SOC 与 BARC 销售规模同步增长。

(3) 光刻胶系光刻工艺核心材料

光刻胶按照化学反应和显影原理可分为正性光刻胶和负性光刻胶,按照应用领域划分可分为 PCB 光刻胶、LCD 光刻胶以及半导体光刻胶。其中,半导体光刻胶技术壁垒最高,LCD 光刻胶次之,PCB 光刻胶技术壁垒最低。半导体光刻胶根据曝光光源波长可进一步分为 g-Line 光刻胶、i-Line 光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 光刻胶以及 EUV 光刻胶等。光刻胶应用于晶圆制造工艺的光刻环节,作为核心材料决定了工艺图形的精密程度和产品良率,多年来一直保持稳定持续增长。

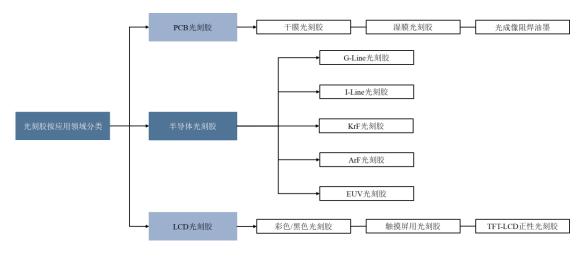


图: 光刻胶按应用领域分类图

来源: Frost & Sullivan

根据弗若斯特沙利文市场研究,境内半导体光刻胶市场规模从 2019 年 27.8 亿元增长至 2023 年 64.2 亿元,年复合增长率达 23.3%,预计 2028 年境内半导体光刻胶市场规模将达到 150.3 亿元,年复合增长率 18.5%,高于全球半导体光刻胶市场规模增速。在细分市场中,i-Line 光刻胶、KrF 光刻胶与 ArF 光刻胶系境内 12 英寸集成电路晶圆制造主要应用光刻胶,随着境内 12 英寸晶圆产能持续提

升,先进应用和技术节点持续提升,光刻技术如浸没式光刻技术和多重曝光技术逐步应用以及光刻胶性能稳步升级,KrF 光刻胶与 ArF 光刻胶对应市场规模从2019年14.7亿元增长至2023年36.7亿元,预计2028年市场规模将达到106.9亿元,占境内半导体光刻胶市场份额将达71.12%。

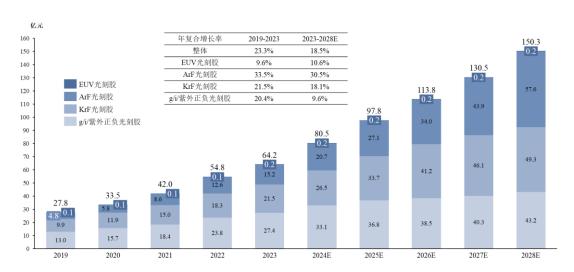


图: 境内 2019-2028 年半导体光刻胶市场规模分析

来源: Frost & Sullivan

技术节点持续升级将推动光刻胶应用规模的稳步提升。在逻辑芯片光刻工艺中,随着技术节点不断微缩,ArF 浸没式光刻应用将大幅增长,从 40nm 的少量应用增至 7nm 工艺可超过 35 层; KrF 光刻一直是 65nm 至 28nm 甚至是 16nm 工艺应用最多的光刻工艺,光刻层数为 25 至 30 层; i-Line 光刻在 130nm 至 90nm 工艺中的应用层数为 20 层左右,超过总光刻层数 50%; 在 3D NAND 存储芯片光刻工艺中,随着堆叠技术快速提升工艺层数,促使光刻层数对应增加,KrF 光刻作为 3D NAND 应用最广泛的光刻工艺,光刻层数持续增加; 在 DRAM 工艺中,18nm 以下技术节点时,KrF 光刻层数超过 50%,ArF 和 ArF 浸没式光刻层数各占约 25%。

浸没式光刻技术与多重曝光技术在推动集成电路光刻工艺发展方面发挥重要作用,并带动光刻次数持续提升,对应光刻胶使用需求稳步增长。浸没式光刻技术利用液体的高折射率来提高光刻工艺的分辨率,进一步提升光刻技术可应用技术节点;多重曝光技术的核心是把一层光刻的图形拆分到两个或多个掩模上,用多次光刻和刻蚀来实现原来一层设计的图形。在多重曝光技术中,双重曝光已经被广泛应用于22nm、20nm、16nm和14nm技术节点;三重或多重曝光技术将

被用于 7nm 节点工艺。在境内 EUV 光刻技术取得突破前,只有依靠浸没式光刻技术结合多重曝光技术来实现技术节点之间的收缩。与此同时,多重曝光技术虽然是在浸没式光刻技术基础上发展起来的,但它适用于包括 EUV 在内任何波长的光刻技术,在 7nm 技术节点以下,即使 EUV 光刻技术也无法满足技术节点对分辨率要求,多重曝光技术在 EUV 光刻工艺下仍将持续应用。

(4) 光刻材料原材料研发已取得进展

中国境内光刻材料早期发展较为缓慢,致使光刻材料原材料的开发缺乏动力和目标,间接导致现阶段中国境内光刻材料原材料仍然大部分依赖进口。随着光刻材料国产化持续推进,光刻材料原材料如光敏剂、树脂、溶剂等已具备市场发展空间,相关研发工作已取得进展,在基本有机合成方面积累一定技术沉淀,需重点突破在大批量生产过程中如何控制原材料的金属杂质和颗粒尺寸及含量,使其可满足集成电路工艺对金属杂质和颗粒的严苛要求。未来,随着光刻材料原材料国产化取得突破,将促进光刻材料国产化应用进一步落地。

根据弗若斯特沙利文市场研究,在 12 英寸集成电路晶圆制造领域,全球范围内生产半导体光刻胶的企业主要有日本合成橡胶、信越化学、东京应化、富士胶片、美国杜邦等。境内企业除恒坤新材已实现 i-Line 光刻胶与 KrF 光刻胶量产供货外,包括南大光电、北京科华、上海新阳、瑞红苏州等也有半导体光刻胶产品在验证或量产供货过程中。2024 年度,公司 i-Line 光刻胶销售规模达 715.19万元,KrF 光刻胶销售规模达 1,352.31 万元,相较境内整体市场规模而言,仍具备广阔成长空间。

总体而言,境内半导体光刻胶在国产化应用方面已取得一定突破,但仍有长足发展空间。根据弗若斯特沙利文市场研究,KrF光刻胶国产化率 1-2%左右,ArF光刻胶国产化率不足 1%,i-Line光刻胶国产化率 10%左右。随着境内材料企业的光刻胶持续通过验证,预计未来光刻胶国产化比例将进一步提升,境内光刻胶企业的市场空间将得以扩大。

4、前驱体材料发展概况及发展趋势

前驱体材料在集成电路制造领域占据重要位置,系集成电路技术发展的关键材料之一。前驱体材料主要应用于集成电路晶圆制造前道工艺中的薄膜沉积工艺,

在气相沉积过程中形成符合集成电路制造要求的各类薄膜层。薄膜沉积工艺可分为物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD)以及原子层气相沉积(ALD)等,随着集成电路工艺制程持续突破,单位面积集成的电路规模不断扩大,芯片内部立体结构日趋复杂,所需薄膜层数越来越多,对薄膜的材料种类和性能参数均不断提出新要求,前驱体材料发展为集成电路制造向更先进制程发展提供核心保障。

前驱体材料根据形成薄膜材料属性划分,可以分为硅基前驱体与金属基前驱体;根据集成电路晶圆制造工序功能划分,可以分为 High-K 前驱体和 Low-K 前驱体, K 即介电常数,用于衡量一种材料存储电荷的能力, High-K 前驱体用于 High-K 金属栅极 (HKMG) 薄膜沉积工艺的 High-K 介质层; Low-K 前驱体用于 集成电路后端布线工序 BEOL 中金属连线之间的绝缘介质。前驱体根据不同分类 标准划分如下表所示:

分类标准	产品类型	产品举例	主要用途
按形成薄 膜材料属 性划分	硅基前驱 体	TEOS、HCDS、BDEAS 等	用于氧化硅和氮化硅等硅基薄膜 沉积
	金属基前 驱体	TMA、四氯化钛、四氯化铪等	用于各类金属化合物薄膜沉积
按集成电 路晶圆制 造工序划 分		三甲基硅烷(3MS)、四甲基硅 烷等(4MS)	用于集成电路后端布线工序 BEOL 中金属连线之间的绝缘介质,大部 分属于硅基前驱体
	High-K 前 驱体	四氯化铪、四氯化锆	用于 High-K 金属栅极(HKMG) 薄膜沉积工艺的 High-K 介质层, 大部分属于金属基前驱体

前驱体材料市场需求一方面随着集成电路晶圆产能扩张而快速增长,另一方面也随着工艺制程技术迭代促使单位用量稳步提升。根据弗若斯特沙利文市场研究,境内前驱体材料从 2019 年 24.2 亿元增长至 2023 年 54.4 亿元,年复合增长率为 22.4%,并将于 2028 年达到 179.9 亿元。年复合增长率为 27.0%。其中,硅基前驱体从 2023 年 25.6 亿元增长至 2028 年 72.6 亿元,年复合增长率为 23.2%,金属基前驱体从 2023 年约 26.9 亿元增长至 2028 年约 103.4 亿元,年复合增长率为 30.9%。

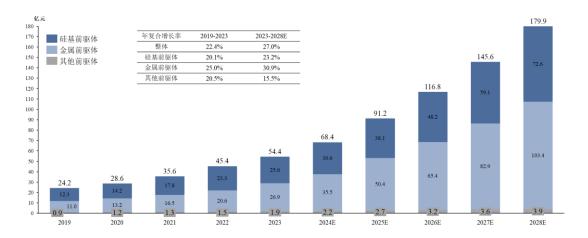


图: 境内 2019-2028 年不同前驱体材料市场规模分析

来源: Frost & Sullivan

在逻辑芯片方面,逻辑芯片以微缩技术节点来提升芯片的集成度,使用多重曝光技术将多次通过刻蚀和薄膜沉积的工艺组合来完成微观结构加工。同时,随着技术节点微缩,一方面低电阻率铜结合低介电常数绝缘材料的集成方案将逐渐取代铝作为互连材料,以改善互连线性能,降低延迟;另一方面金属栅电路技术开始广泛应用,带动金属基前驱体用量提升。同时,FinFET 技术对外延和 ALD需求明显增加,推动更多外延工艺相关前驱体需求;多重曝光技术需要更多工艺步骤、更多沉积和刻蚀工序,从而增加 CVD 和 ALD 工艺相关前驱体材料的用量。总体而言,逻辑芯片多步骤均运用多种前驱体材料改善性能,且技术节点越先进,品种越多,对应用量和单价均将提高。

在存储芯片方面,DRAM 与逻辑芯片的技术发展路线类似,以微缩技术节点提高存储密度。同时,增大电容器表面积、增大介电常数以及降低介电材料的厚度是改善电容器存储性能的主要途径,而随着技术节点微缩,电容的深宽与倍数增加,需要单位价值量更高的 High-K 前驱体材料降低高深宽比刻蚀产生的各种缺陷; 3D NAND 的技术发展路线主要通过增加立体硅层的方式,既能提高单位面积存储密度,增加容量,又能改善存储单元性能,控制成本。在此背景下,薄膜沉积与刻蚀工艺的技术要求显著提升。在 3D 结构中,需要进行几十层甚至上百层薄膜堆叠材料的生长,随着堆叠层数逐渐增加,前驱体材料单位用量将翻倍增长。

(1) 硅基前驱体市场规模保持稳步增长

硅基前驱体主要用于生产氧化硅、氮化硅薄膜,用来辅助存储、逻辑芯片制造光刻工艺中微影技术的实现。同时,氧化硅和氮化硅前驱体能够保护集成电路栅极的电气性能。比较典型的硅基前驱体包括TEOS(正硅酸乙酯)、HCDS(六氯乙硅烷)、BDEAS(双(二乙氨基)硅烷)等。硅基前驱体的发展趋势与集成电路产能提升紧密相关。

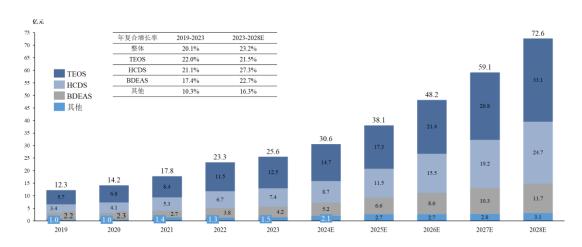


图: 境内 2019-2028 年硅基前驱体市场规模分析

来源: Frost & Sullivan

(2) 金属基前驱体在先进制程应用规模有望快速提升

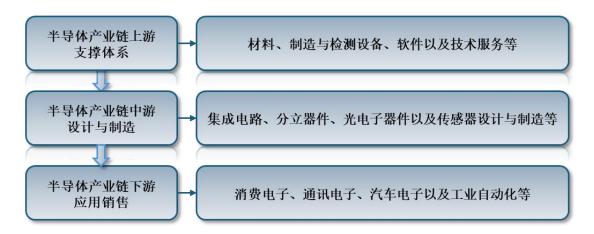
从 20 世纪 70 年代开始,二氧化硅一直是主流的氧化层材料。随着半导体整体行业快速发展,单个芯片上的晶体管数量持续增加,单个晶体管体积持续缩小,发展到 21 世纪,氧化层厚度已薄至 1.2nm。然而,二氧化硅材料的氧化层极限厚度为 1.5nm,二氧化硅介电常数低,低于该厚度会出现隧穿现象,导致漏电,且漏电现象随着厚度减小呈现指数增长,如当晶体管技术节点缩小至 90nm 时,氧化层厚度仅有 1.2nm,栅极漏电密度达到 100A/cm²,该级别漏电在大部分应用中已无法接受。同时,当氧化层降低至 2nm 以下时,伴随退火处理温度升高,会出现硼扩散现象,从而对产品性能带来影响。但是,晶体管尺寸缩小后,需要更高电容来产生所需驱动电流。由于电容与栅层厚度成反比,前驱体材料作为栅介质材料其厚度必须降低。

在此背景下, High-K 前驱体材料由于具有更高的介电常数, 使得材料在氧化层厚度与二氧化硅相同前提下具有更高的物理厚度, 从而降低栅漏电流密度。

根据弗若斯特沙利文市场研究, High-K 金属栅极介电质可使漏电减少 10 倍左右, 使功耗也能得到很好控制, 理论性能可提升 20%左右。因此, 随着集成电路技术 节点缩小, High-K 前驱体材料市场规模将持续提升。

(四)发行人所处行业在产业链中的地位和作用,与上、下游行业关联性

公司及其产品所属行业在半导体产业链属于上游支撑体系,半导体产业链整体示意图如下图所示:



1、发行人所属行业在产业链中的地位和作用

半导体产业链由上游支撑体系、中游设计与制造以及下游应用销售组成。公司销售的集成电路关键材料系处于整体产业链上游,系半导体产业链上游支撑体系的重要组成部分。公司销售的光刻材料、前驱体材料、电子特气以及其他湿电子化学品直接影响产业链中游产品制造的性能、良率以及成本,系影响整体产业链升级的关键因素之一。

2、上游行业对发行人所处行业的影响

公司自产产品上游行业系各类材料的原材料厂商,由于中国境内集成电路关键材料早期发展较为缓慢,导致现阶段集成电路关键材料原材料仍然大部分依赖进口。公司已在积极布局上游原材料产业化落地,通过技术转让与自主研发相结合方式逐步实现上游原材料国产化,进一步完善整体产业链自主可控。公司引进产品上游行业系境外各类材料厂商,公司与相关供应商已有长期合作历史,供应链体系稳定,公司的日常采购需求均可得到合理满足。

3、下游行业对发行人所处行业的影响

公司下游行业为集成电路晶圆制造行业,下游行业的扩张需求及工艺升级都将促使关键材料行业的技术升级与规模提升。近年来,中国境内集成电路产业发展迅速,逻辑芯片与存储芯片一方面市场需求稳步提升,促使晶圆制造厂商产能持续扩大,另一方面技术规格持续升级,推动晶圆厂国产化进程全面加速。整体分析,集成电路晶圆制造长期扩展趋势明显,将带动公司所处行业同步快速增长。

(五) 行业发展面临的机遇和挑战

1、行业发展面临的机遇

(1) 国家政策扶持为集成电路关键材料企业稳步发展奠定基础

当前,境内集成电路关键材料产业仍然高度依赖进口,供应链安全问题较为 突出,不利于行业稳定发展,国产化应用刻不容缓。因此,国家高度重视集成电 路关键材料产业可持续发展,陆续出台一系列政策与规划,从发展指引、股权投 资、专项支持、研发补助以及税收优惠等方面均为集成电路关键材料产业建立了 优良可靠的发展环境,推动产业"强长板、补短板、上规模、上水平"。在此背 景下,预计境内关键材料产业将迎来长期高质量发展,对应行业内企业将迎来良 好发展机遇。

(2) 产业技术升级为关键材料企业提供市场机遇

随着境内集成电路产业快速发展,晶圆制造产业技术持续升级,包括大尺寸与薄片化硅片、多重曝光技术、FinFET 结构工艺、闪存堆栈工艺等已在晶圆制造过程中广泛应用。在晶圆制造产业技术升级过程中,对材料和设备的性能要求和应用需求均显著提升,一方面要求行业内企业持续提升自主研发能力与创新能力,巩固核心竞争力;另一方面有利于相关企业进一步拓展下游应用和市场空间,迎来良好市场机遇。

(3) 集成电路产业持续发展有效提升光刻材料企业定位

成熟光刻技术除需要光刻材料满足分辨率、抗刻蚀性的要求之外,更重要系需要将光刻材料与晶圆制造技术整合,通过精确控制获得高品质图形质量。因此,每一层光刻材料都离不开光刻材料企业与晶圆制造厂商的密切合作。此外,随着

集成电路技术快速发展,一方面,工艺线宽不断缩小,对光刻材料分辨率要求不断提高;另一方面,差异化制造工艺需要光刻材料企业与晶圆制造厂商通力合作实现定制产品持续开发,形成相互扶持,长期稳定的合作关系。现阶段,中国境内光刻材料产业技术发展滞后于晶圆制造工艺技术的需求,处于追赶并替代国际先进光刻材料企业的过程中,晶圆制造厂商为保证工艺生产安全,通常要求中国境内光刻材料与现有工艺中已应用的境外产品工艺参数完全一致,无形中增加了光刻材料的开发难度。未来,随着现有应用与产品替代逐步实现,新应用与产品开发需求将显著增长,具备自主可控研发技术的光刻材料企业与晶圆制造厂商战略合作模式将有所改变,光刻材料企业在集成电路产业的定位将进一步提升。

2、行业发展面临的挑战

(1) 行业国产化率仍然处于较低水平,国产化战略任重道远

近年度,境内集成电路产业发展迅速,部分关键材料已逐步实现国产化应用,但整体国产化水平仍然较低。尤其在中高端领域,根据弗若斯特沙利文市场研究,在 12 英寸集成电路领域,i-Line 光刻胶、SOC 国产化率 10%左右,BARC、KrF 光刻胶国产化率 1-2%左右,ArF 光刻胶国产化率不足 1%,EUV 光刻胶完全由国外厂商垄断。集成电路关键材料研发与验证周期均较长,且从验证到客户导入最终实现批量供货还需较长时间,集成电路关键材料国产化战略任重道远。

(2) 行业升级迭代对企业基础研究能力和资金投入实力的挑战

集成电路产业属于技术密集型与资金密集型行业,普遍具备较高的技术门槛与资金门槛,需要参与企业具备良好的基础研究和资金实力。聚焦到材料细分领域,一方面,关键材料涉足领域较广,需要参与企业具备对数学、物理学、化学以及逻辑学等基础科学的深厚研究,对材料特性、反应原理、工艺技术等细节充分理解,以形成适配半导体行业快速迭代升级的研发能力和技术体系;另一方面,关键材料投资规模较大,需要参与企业在产能建设、技术研发、运营控制等层面均保持稳定且持续的资金投入,以紧跟半导体行业升级迭代与变革创新的需要。

因此,随着集成电路产业持续发展,基础研究能力和资金投入实力将决定参与企业的构筑壁垒能力、市场开拓维度以及核心竞争价值,并最终决定企业的发展空间和竞争格局。

3、行业周期性特征

公司所处的集成电路关键材料行业属于半导体产业链上游。短期分析,半导体材料将阶段性受到宏观经济周期性波动和终端需求下降等行业影响而有所波动。长期来看,半导体产业已成为支撑国民经济持续健康发展的支柱产业,且日渐成为国家竞争中的焦点领域。国家各级层面已投入大量资源或出台相关政策支持半导体产业链蓬勃发展,半导体材料作为国产化的重要领域,整体处于长周期波动上行阶段。

(六) 行业壁垒

1、技术壁垒

集成电路关键材料是多学科结合的综合研究成果,且细分产品种类众多,要求参与企业拥有跨领域的知识储备和生产技术。国际领先的关键材料企业通常都具备数十年的研发经验与成果积累,已构建完善的知识体系、技术架构以及生产工艺,产品种类已实现层次化和多元化,涵盖多个应用领域。因此,对于行业新进企业而言,需具备优秀的技术研发能力,首先追赶头部企业成熟产品,其次满足客户个性化需求,最终凭借持续研发创新巩固技术壁垒,实现可持续发展。

2、客户与供应链壁垒

集成电路关键材料下游客户主要系晶圆制造厂商,相关客户对供应商及所供应产品通常将进行严格的认证、验证、考核以及跟踪流程,整体耗费周期较长。以光刻胶为例,由于光刻胶品质会直接影响芯片性能与良率等重要指标,试错成本高,客户验证需要经过PRS(性能验证)、STR(小批量试产)、MSTR(批量试产)以及Release(通过验证)四个阶段,验证周期可达2年左右。产品一旦通过验证并批量供货后,就会形成相对稳定的合作关系。客户如更换供应商需谨慎评估并综合考虑更换成本,包括所需耗费时间、现有生产影响以及新增验证成本等。因此,关键材料企业如某款产品通过客户验证并批量供货后,该款产品短期内较难被替换。新进企业只有在研发水平、生产能力、品质控制、供应价格以及售后服务等方面均显著超过现有供应商,才有可能获得客户验证机会推进导入产品。

与此同时,集成电路关键材料自主可控难题不仅体现在材料本身,整体供应

链也处于依赖进口状态。供应链自主可控关系到关键材料企业的量产供货能力和持续研发能力,系关键材料企业可持续发展的重要支撑。因此,已实现供应链自主可控,尤其是关键原材料国产化的关键材料企业将在市场竞争中形成有效供应链壁垒。

3、人才壁垒

集成电路关键材料具备较高技术含量,是高技术人员高度聚集的产业。产业内企业在研发、生产以及销售等日常运营环节均需要专业背景深厚,从业经验丰富的高层次技术人才参与。全球范围内,美国和日本在关键材料领域已有多年沉淀,在日常培训、技术学习、科研体系等方面均已形成较为完善且可持续的输出机制,人才储备充足。中国境内集成电路关键材料整体起步较晚,在人才培养方面存在滞后,导致整体专业人员匮乏,构成新进入企业的竞争壁垒。

4、资金壁垒

集成电路关键材料研发和产业化是一项高投入、重资产、长周期的系统性工程。一方面,企业从工厂与实验室建造,生产与检测设备购置,到产品自主研发与验证测试,最终批量生产和持续品质管控,各环节均需要持续资金投入;另一方面,产业不断技术创新促使材料和设备持续升级,企业需要拥有良好的资金实力以保持对产品研发和产业化的投资力度,提升研发与生产水平以满足行业发展需要。因此,对于产业新进入企业,发展各阶段所需要的资金储备构成了产业竞争壁垒。

(七)发行人市场地位和行业竞争格局

1、发行人市场地位及技术水平

公司主营业务为集成电路领域关键材料的研发与产业化应用,已实现自产关键材料包括 SOC、BARC、KrF 光刻胶、i-Line 光刻胶等光刻材料和 TEOS 等前驱体材料,并有多款关键材料已进入客户验证流程,截至报告期末,公司自产产品在研发、验证以及量供款数累计已超过百款。公司主营业务产品属于集成电路光刻环节必备关键材料,体现硬科技实力,实现高水平科技自立自强,符合国家战略方向。2024 年度,公司自产光刻材料销售规模 29,998.67 万元,其中,SOC销售规模 23,236.34 万元,预计境内市占率已超过 10%。公司已成为境内主要的

集成电路光刻材料供应商,已实现对境内主流 12 英寸集成电路晶圆厂的广泛覆盖,预计将在未来国产化应用过程中持续占有较高市场份额。

公司技术研发实力能够匹配国家战略需要和行业发展要求。一方面,公司持续承接国家各类重大专项,在前期承接国家 02 科技重大专项子课题及国家发改委专项研究任务并已完成验收基础上,2023 年末新增联合承接国家多部委重要攻关任务,通过行业领先的研发能力为中国境内集成电路实现全产业链自主可控提供关键支持;另一方面,公司通过自主研发能力助力境内集成电路产业快速发展,配合境内晶圆厂在突破 128 层以上 3D NAND 闪存芯片、18nm 以下 DRAM芯片以及 14nm 以下逻辑芯片等国外重点技术封锁领域提供光刻材料技术解决方案。

公司自产产品相关核心技术具备技术先进性,产品填补国内空白,打破国外垄断,保障境内集成电路关键材料的供应链安全。目前,公司自产产品已在多家中国境内领先的 12 英寸集成电路晶圆厂实现销售,实现了对日产化学、信越化学、美国杜邦、德国默克、日本合成橡胶、东京应化等境外厂商同类产品替代。

2、行业竞争格局及主要竞争对手

(1) 行业竞争格局

现阶段,境内光刻材料与前驱体材料仍然系由境外厂商占据主要市场份额,境内关键材料企业虽然已有突破,但是尚未在先进技术节点形成大规模国产化的局面。以公司自产光刻材料为例,根据弗若斯特沙利文市场研究,在 12 英寸集成电路领域,i-Line 光刻胶、SOC 国产化率 10%左右,BARC、KrF 光刻胶国产化率 1-2%左右,ArF 光刻胶国产化率不足 1%。在未来一定时期内,境内关键材料企业仍将以国产化应用为主要突破方向。公司 SOC、BARC、KrF 光刻胶以及 i-Line 光刻胶均已实现量产供货,从国产化进程分析,公司已在同行业竞争中占得先机。

根据弗若斯特沙利文市场研究统计,2023 年度境内集成电路晶圆制造前十大厂商晶圆年产量合计已超过1,400万片,占境内集成电路晶圆制造总产量超过90%,集聚效应显著。前十大晶圆厂中,多家已成为公司客户,其中,报告期内,公司自产产品在部分客户累计销售规模已突破亿元。公司客户已基本涵盖境内主

流晶圆厂,且对部分客户已形成稳定持续的销售规模。

(2) 发行人与行业内主要企业的比较情况

公司定位为专注于集成电路关键材料产业化应用,以 12 英寸集成电路晶圆制造所需光刻材料与前驱体材料国产化应用为主要突破方向,销售产品主要包括光刻材料、前驱体材料、电子特气及其他湿电子化学品。现阶段,在该领域,公司产品主要系替代境外厂商同类产品,因此,公司的主要竞争对手系境外厂商,以美国与日本关键材料厂商为主。这类企业具有先发优势,长期处于垄断地位,且始终保持对先进技术节点的产品供应。整体对比而言,公司与境外行业龙头在营收利润规模与尖端技术层面仍然存在一定代差。

集成电路关键材料多样化程度较高,产品性能在不同应用场景存在较大差异。公司产品实现替代的前提条件,一方面是产品能够满足客户技术节点和工艺制程要求,另一方面是产品性能与参数要持平甚至优于客户原有采购产品。公司现有产品在技术与指标已达到境外厂商同类产品同等水平,同时,部分产品在研发阶段即系结合客户工艺量身定制,最终表现已优于境外厂商同类产品。公司已与境内行业领先客户建立长期合作关系,随着集成电路技术持续升级,公司将获得广泛技术积累,产品维度将进一步扩充,并与客户实现共同成长,追赶甚至超越境外厂商技术水平。

与境内 A 股上市公司相比,境内 A 股上市公司凭借良好背景、持续投入以及技术积累也已在光刻材料与前驱体材料取得一定突破,与公司主营业务产品存在类似的公司包括北京科华、艾森股份、南大光电、上海新阳、瑞红苏州等。公司是境内少数实现光刻材料与前驱体材料量产供货企业之一,根据弗若斯特沙利文市场研究,2023 年度,公司 SOC 与 BARC 销售规模均已排名境内市场国产厂商第一位。

公司关键数据和指标比较参见本招股意向书"第六节 财务会计信息与管理 层分析"之"十、经营成果分析"、"十一、资产质量分析"及"十二、偿债能力、 流动性与持续经营能力分析"等相关内容。

(3) 行业内主要企业情况

截至报告期末,公司自产产品已实现或正在尝试替代的境外厂商包括美国杜

邦、日本合成橡胶、信越化学、Brewer Science、东京应化、富士胶片、日产化学以及德国默克等。公司同行业内主要企业情况如下表所示:

公司名称	基本情况	主要产品	关键指标
美国杜邦	美国杜邦系由陶氏化学与杜邦 于 2015 年合并再于 2019 年分 拆的一家以科研为基础的全球 性企业,是半导体领域电镀液 及光刻材料重要的海外供应商 之一。	包括化工、材料、膜产品等在内的综合业务范围,并包括光刻材料、封装材料及解决方案。	2024 年 营 业 收 入 123.86 亿美元,净利润 7.03 亿美元,总资产 366.36 亿美元。
日本合成橡胶	日本合成橡胶成立于 1957 年, 总部位于日本东京,致力于光 刻材料和其它周边材料、研磨 液等材料开发、制造和销售, 为半导体光刻材料的重要海外 供应商之一。	包括用于离子注入、栅极和配线工艺图案光刻胶,用于 CMP 工艺研磨液和清洗剂,以及用于封装各个工艺流程的临时键合材料、厚膜加工用光刻胶和感光性绝缘膜材料等。	2023 年 3 月末至 2024 年 3 月末营业收入 404,631 百万日元,净 利润-5,551 百万日元, 总资产 771,355 百万日元。
信越化学	信越化学成立于 1926 年,为日本最大的化工企业,也是最早向海外扩张的日本化工企业。 1998 年,信越化学实现光刻胶产品的商用化,在 PVC、半导体硅等多个领域处于国际龙头地位。	从原料聚合物合成到 化合进行一体化生产, 光刻胶产品涵盖 i-Line 光刻胶、KrF 光刻胶、 ArF 光刻胶、EUV 光 刻胶。	2024年3月末至2025年3月末营业收入2,561,249百万日元,净利润534,021百万日元,总资产5,636,601百万日元。
Brewer Science	制程的一家全球科技领导品	产品可实现先进光刻技术、薄晶圆处理技术、3D整合,以及化学和机械设备保护及纳米科技型产品的实际应用。	未公开披露数据。
东京应化	东京应化成立于 1940 年,先后 开发出半导体用正型胶和负型 胶,一直走在半导体微加工技术的前列。2006 年,东京应化 率先投资开始研发 ArF 浸没光刻胶所需技术,并在世界光刻胶市场上保持了领先地位。 2019 年,东京应化系开启面向10nm 以下制程工艺 EUV 光刻胶研发的先发企业之一。	涵盖多种类型的光刻胶,如橡胶型负性光刻胶、g-Line 光刻胶、i-Line 光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 光刻胶、ArF 光刻胶、EUV 光刻胶以及电子光束光刻胶等。	2024 年营业收入 200,966 百万日元,净 利润 22,683 百万日元, 总资产 281,930 百万日 元。
富士胶片	富士胶片成立于 2006 年,继承了富士写真胶片株式会社事业。长期以来,富士胶片都是照相机胶卷和相关冲印化学产品的世界龙头。凭借由照片冲印业务积累下来的光学,化学	包括负胶与电子束胶,i-Line 光刻胶,KrF 光刻胶,ArF 光刻胶、ArF 没没式光刻胶等产品,以及显影液,溶剂,剥离液等光刻材料等。	2024年3月末至2025年3月末营业收入3,195,828百万日元, 净利润260,951百万日元,总资产5,249,908百万日元。

公司名称	基本情况	主要产品	关键指标
	与信息技术方面的丰富经验, 成功在医疗,影像艺术,光学 设备和高性能材料等领域成为 全球领导者。光刻胶是富士胶 片半导体材料产品门类中重要 的组成部分。		
日产化学	日产化学成立于 1887 年,是一家总部位于日本东京的综合型化工企业,其业务涵盖了无机化学、药物化学、通用化学等多重化工产业,包括农药、功能材料、农业化学、药学以及贸易等领域。	司拥有 Brewer Science 光刻用抗反射涂层生 产许可,可制造和销售	2024年3月末至2025年3月末营业收入251,365百万日元,净利润43,043百万日元,总资产330,763百万日元。
德国默克	德国默克成立于 1668 年,总部位于德国达姆施塔特市,主要致力于创新型制药、生命科学以及前沿功能材料技术。德国默克重点关注特种化学品和功能性材料。在国内显示面板光刻材料市场占有 65%以上的市场份额,为光刻材料重要海外供应商之一	晶和用于芯片制造的	2024 年 营 业 收 入 211.56 亿欧元,净利润 27.77 亿欧元,总资产 515.67 亿欧元。
形程新材 (北京科华)	形程新材成立于 2008 年,是一家化工材料制造和服务商。形程新材子公司北京科华成立于2004 年,是一家产品覆盖 KrF光刻胶、i-Line 光刻胶、g-Line光刻胶、紫外宽谱光刻胶及配套试剂的供应商与服务商。	包括 KrF 深紫外光刻 胶、i/g-Line 正性光刻 胶等。	2024 年半导体光刻胶业务实现营业收入3.03 亿元,同比增长50.43%。北京科华2024 年末总资产 2.61亿元。
艾森股份	艾森股份成立于 2010 年,主要 围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工 艺环节,形成了电镀液及配套 试剂、光刻胶及配套试剂两大 产品板块布局,产品广泛应用 于集成电路、新型电子元件及 显示面板等行业。	包括电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂、光刻胶及配套试剂 及其他电子化学品等。	2024 年半导体行业实现营业收入 4.08 亿元, 其中,电镀液及配套试剂 1.96 亿元,光刻胶及配套试剂 0.95 亿元。 2024 年末总资产 12.44 亿元。
南大光电	南大光电成立于 2000 年,是一家专业从事先进电子材料即高纯金属有机化合物(MO源)的研发、生产和销售的高新技术企业。对关键技术拥有完全自主知识产权,亦是全球 MO源领导供应商之一。	分为先进前驱体材料、 电子特气和光刻胶及 配套材料三个板块。其 中,先进前驱体板块包 括 MO 源和半导体的 短体,电子特气包插 电子特气和含氟配 子特气,光刻胶及配套 材料包括 ArF 光刻胶 等。	2024年营业收入 23.52 亿元,其中,前驱体材料 5.78 亿元,特气产品 15.06 亿元,净利润 2.71 亿元。2024 年末总资产 64.90 亿元。
上海新阳	上海新阳成立于 2004 年,专业 从事半导体行业所需电子化学	分为晶圆制造及先进 封装用电镀液及添加	

	Γ		
公司名称	基本情况	主要产品	关键指标
	品及配套设备的研发设计、生	剂系列产品、晶圆制造	2024年末总资产 58.61
	产制造和销售服务,致力于为	用清洗液、蚀刻液系列	亿元。
	用户提供化学材料、配套设备、	产品、集成电路制造用	
	应用工艺和现场服务一体化的	高端光刻胶产品系列、	
	整体解决方案。	晶圆制造用化学机械	
		研磨液、半导体封装用	
		电子化学材料、氟碳涂	
		料产品系列等。	
		包括应用于半导体制	
		造及先进封装领域的	
	飞凯材料成立于 2002 年,从光		2024 年半导体材料销
飞凯材料	通信领域紫外固化材料逐步拓		售收入 6.83 亿元。2024
4001311	展至集成电路制造、屏幕显示		年末总资产 65.84 亿
	和医药中间体领域。	用于集成电路传统封	元。
		装领域的锡球、环氧塑	
		封料等。	
		包括半导体光刻胶、显	
	晶瑞电材成立于2001年,是一	示面板光刻胶等,其中	
	家集研发、生产和销售于一体	半导体光刻胶包括紫	2024 年光刻胶销售收
晶瑞电材 (瑞红苏州)	的科技型新材料公司。晶瑞电	外宽谱光刻胶、g线光	入 1.98 亿元。瑞红苏
	材子公司瑞红苏州成立于	刻胶、i 线光刻胶、KrF	州 2024 年末总资产
	1993年,是一家专注于光刻胶	光刻胶等,显示面板光	16.71 亿元。
	及其配套试剂研发、生产及销	刻胶包括触摸屏光刻	. , -
	售等业务的高新技术企业。	胶、TFT-LCD 光刻胶	
		等。	

资料来源:各家公司公开披露信息

(八) 发行人的竞争优势与劣势

1、公司的竞争优势

(1) 技术与产品优势

公司根据境外集成电路先进制程的发展历程,从中国境内企业并未充分涉足的光刻材料如 SOC、BARC 等在先进制程广泛应用的产品切入,快速实现替代与量产供货,填补国内空白。公司承接国家 02 科技重大专项子课题及国家发改委专项研究任务,均已完成结题。在光刻材料方面,公司进一步向 i-Line 光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 光刻胶、SiARC、Top Coating 等产品延伸,其中 i-Line 光刻胶与 KrF 光刻胶已实现销售,ArF 光刻胶、SiARC、Top Coating 均已进入客户验证流程,ArF 浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售。在前驱体材料方面,公司自产 TEOS 已在客户 A1 实现销售,并已通过客户 C、客户 D 验证,且自主研发的金属基前驱体材料已进入客户验证流程。截至报告期末,公司已取得专利授权

101 项,其中发明专利 43 项。公司已取得的相关专利均系与公司主营业务相关的知识产权储备,保障了公司在集成电路关键材料领域的技术及产品优势。

(2) 国产化优势

现阶段,境内集成电路晶圆制造所需的关键材料包括光刻材料、前驱体材料等仍然依赖进口,市场份额主要掌握在少数几家如美国杜邦、信越化学、日本合成橡胶、东京应化、日产化学、富士胶片等美国和日本材料企业手中。在中美贸易摩擦长期存在的背景下,集成电路关键材料国产化应用已成为国家重要战略。报告期内,公司自产产品已经达到美国和日本同类产品同等水平并在境内晶圆厂实现销售。公司作为境内领先的集成电路关键材料服务商之一,主要服务于境内集成电路晶圆厂,客户需求响应更加及时,运输时间短,运输成本低,相比同类进口产品有明显的服务和价格优势。

(3) 客户资源优势

公司客户主要系 12 英寸集成电路晶圆厂,对各类关键材料供应商的产品质量和供货能力十分重视,关键材料供应均需严格验证,且通常需经较长验证周期方可进入供货阶段。报告期内,公司产品已在多家中国境内领先的 12 英寸集成电路晶圆厂实现销售,积累了众多优质客户资源,确保公司在后续产品导入和验证过程中的先发优势。

(4) 团队优势

经过多年的发展,公司聚集了一支高学历、高素质、富有开拓进取和创新精神的研发队伍及具有丰富行业经验的生产技术专家和销售服务专家。截至报告期末,公司共有员工 376 名。公司核心技术团队既包括曾任职于境内主流晶圆厂的光刻工艺技术专家,还包括拥有材料专业背景和博士学历的高级技术人才,在集成电路材料行业积累了数年的丰富经验和先进技术。公司高素质的员工队伍为维持竞争优势提供了保证。

2、公司的竞争劣势

(1) 融资渠道亟待扩展

集成电路行业属于资金密集型行业。对于材料公司而言,在工厂建设与研发

投入方面均需要持续投入大量资金。公司为保持市场核心竞争力,必须维持较大规模的研发投入与工厂建设,并为优质人才提供有竞争力的薪酬、丰富产品类型以应对客户多样化需求等。目前,公司在福建漳州、辽宁大连以及安徽合肥均已有工厂落地,对公司的融资渠道和资源调配等形成挑战。公司的资金主要依赖于股东投入和自有资金积累,融资手段有限,公司亟需拓展融资渠道,增强资金实力,进一步提高公司竞争力和盈利能力。

三、发行人销售情况及主要客户

(一) 主要产品的生产和销售情况

1、主要产品的产能、产量及销量情况

报告期内,公司自产的主要产品包括 SOC、BARC、KrF 光刻胶、i-Line 光刻胶和 TEOS 前驱体材料,各产品的产能、产量、销量如下表所示:

产品		2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
•	产能 (加仑)	13,464	26,928	25,208	24,888
	产量 (加仑)	11,260	15,462	7,818	5,194
SOC	销量(加仑)	11,177	14,391	7,293	5,751
	产能利用率	83.63%	57.42%	31.01%	20.87%
	产销率	99.26%	93.07%	93.28%	110.72%
	产能 (加仑)	11,148	20,796	10,156	8,376
	产量 (加仑)	4,186	4,457	1,956	793
BARC	销量(加仑)	3,107	4,264	1,644	646
	产能利用率	37.55%	21.43%	19.26%	9.47%
	产销率	74.22%	95.67%	84.05%	81.46%
	产能 (加仑)	4,545	12,465	5,640	4,950
	产量 (加仑)	1,901	2,188	1,056	78
KrF 光刻胶	销量(加仑)	1,950	2,385	760	77
3 43.17,00	产能利用率	41.83%	17.55%	18.72%	1.58%
	产销率	102.58%	109.00%	71.97%	98.72%
	产能 (加仑)	2,850	600	600	600
i-Line 光刻胶	产量 (加仑)	413	280	145	28
	销量 (加仑)	213	239	116	26

产品	项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
	产能利用率	14.49%	46.67%	24.17%	4.67%
	产销率	51.57%	85.36%	80.00%	92.86%
	产能 (千克)	720,000	840,000	720,000	720,000
	产量(千克)	260,961	390,359	189,359	12,070
TEOS	销量 (千克)	238,305	324,585	132,710	8,405
	产能利用率	36.24%	46.47%	26.30%	1.68%
	产销率	91.32%	83.15%	70.08%	69.64%

注: 2025 年起,一条年产能 4,500 加仑的 1000L 产线完成改造,由 KrF 光刻胶改为 i-Line 光刻胶, KrF 光刻胶的产能相应减少。

2、主营业务收入按产品分类

报告期内,公司主营业务收入按照产品类别分类情况如下:

单位:万元,%

项目	2025年	1-6月	2024 출	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	
自产产品	24,977.42	86.68	34,418.93	63.77	19,058.84	52.72	12,357.89	38.94	
光刻材料	21,928.71	76.10	29,998.67	55.58	17,202.90	47.58	12,168.58	38.35	
前驱体材料	3,048.70	10.58	4,420.26	8.19	1,855.93	5.13	189.31	0.60	
引进产品	3,836.84	13.32	19,556.25	36.23	17,094.17	47.28	19,376.03	61.06	
光刻材料	981.16	3.41	14,711.02	27.26	12,141.90	33.58	14,290.10	45.03	
前驱体材料	1,065.70	3.70	1,828.08	3.39	2,449.56	6.78	3,556.56	11.21	
电子特气	768.96	2.67	1,921.99	3.56	1,728.88	4.78	1,208.19	3.81	
其他	1,021.00	3.54	1,095.17	2.03	773.83	2.14	321.18	1.01	
主营业务收 入合计	28,814.25	100.00	53,975.18	100.00	36,153.01	100.00	31,733.92	100.00	

报告期内,公司主营业务产品包括自产产品和引进产品。其中,自产产品销售收入分别为 12,357.89 万元、19,058.84 万元、34,418.93 万元和 24,977.42 万元,占主营业务收入的比例分别为 38.94%、52.72%、63.77%和 86.68%,收入规模和占比逐年上升。

3、主营业务收入按区域分类

报告期内,公司主营业务收入按区域划分的情况如下:

单位:万元,%

区域	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
<u> </u>	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华中	16,395.96	56.90	35,156.07	65.13	24,373.31	67.42	22,968.05	72.38
华东	7,090.86	24.61	10,907.09	20.21	5,471.45	15.13	2,487.85	7.84
华北	3,332.02	11.56	4,738.39	8.78	2,927.98	8.10	1,913.18	6.03
东北	1,864.09	6.47	3,028.81	5.61	3,316.45	9.17	4,307.83	13.57
华南	131.31	0.46	144.82	0.27	63.82	0.18	49.04	0.15
西南	-	-	-	-	-	-	7.96	0.03
主营业务收 入合计	28,814.25	100.00	53,975.18	100.00	36,153.01	100.00	31,733.92	100.00

报告期内,公司客户主要位于华中、华东、华北以及东北等区域。报告期内, 上述区域销售收入占比合计分别为 99.82%、99.82%、99.73%和 99.54%。由于境 内 12 英寸集成电路晶圆厂主要建设于上述区域,因此,公司在上述区域的销售 占比较高。

(二)报告期内发行人前五大客户情况

报告期内,公司对前五大客户销售情况如下:

单位:万元、%

年份	序号	客户名称	客户类型	收入金额	占主营业务收入比例
	1	客户 A	存储芯片制造	15,890.19	55.15
	2	客户 B	存储芯片制造	8,494.90	29.48
2025年	3	客户 C	存储芯片制造	1,779.97	6.18
1-6 月	4	客户 E	逻辑芯片制造	835.41	2.90
	5	客户 H	逻辑芯片制造	483.54	1.68
		合计	-	27,484.02	95.38
	1	客户 A	存储芯片制造	34,583.06	64.07
	2	客户 B	存储芯片制造	12,478.94	23.12
2024 年度	3	客户 C	存储芯片制造	2,961.37	5.49
2024 平及	4	客户 D	逻辑芯片制造	1,220.12	2.26
	5	客户 E	逻辑芯片制造	1,218.57	2.26
		合计	-	52,462.07	97.20
2023 年度	1	客户 A	存储芯片制造	24,029.16	66.47

年份	序号	客户名称	客户类型	收入金额	占主营业务收入比例
	2	客户 B	存储芯片制造	6,858.82	18.97
	3	客户 C	存储芯片制造	3,308.90	9.15
	4	客户 D	逻辑芯片制造	782.05	2.16
	5	客户 E	逻辑芯片制造	423.64	1.17
		合计	-	35,402.57	97.92
	1	客户 A	存储芯片制造	22,960.05	72.35
	2	客户 C	存储芯片制造	4,307.83	13.57
2022 左座	3	客户 B	存储芯片制造	3,832.59	12.08
2022 年度	4	客户 E	逻辑芯片制造	304.83	0.96
	5	客户 F	存储芯片制造	82.08	0.26
		合计	-	31,487.39	99.22

注: 受同一控制的客户已合并计算销售额。

公司产品主要应用于集成电路领域,报告期内,公司客户集中度较高,主要是系由于下游晶圆制造行业集中度较高所致,主要客户中,客户A、客户B、客户C均系知名存储芯片制造厂商,客户D、客户E等均系知名逻辑芯片生产厂商。根据弗若斯特沙利文统计,客户A、客户B、客户C、客户D以及客户E均系 2023 年境内产能前十大晶圆厂。

报告期内,公司与上述客户之间不存在关联关系。公司不存在董事、监事、 高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东在 前五名客户占有权益的情况。

四、发行人采购情况及主要供应商

(一)发行人采购情况

1、主要原辅料(含包装物)采购情况

报告期内,公司采购主要分为原材料、辅料、包装物及引进产品等。对于自产产品,公司为满足生产需求,对外采购包括树脂、添加剂、溶剂等原材料以及滤芯、容器、化学试剂等其他辅料耗材等;对于引进产品,公司根据客户需求向境外供应商采购光刻材料、前驱体材料、电子特气及其他湿电子化学品等产成品。

报告期各期,公司原辅料(含包装物)采购总额分别为 8,097.20 万元、

17,568.87 万元、25,723.87 万元和 18,746.82 万元,主要采购内容及其占比情况具体如下:

单位:万元、%

采购内容	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
不购的谷	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原辅料	18,181.19	96.98	25,276.72	98.26	17,307.77	98.51	7,934.89	98.00
包装物	565.64	3.02	447.16	1.74	261.10	1.49	162.31	2.00
合计	18,746.82	100.00	25,723.87	100.00	17,568.87	100.00	8,097.20	100.00

2、报告期内主要原辅料采购价格变动情况

报告期内,假设 2022 年采购价格指数为 100.00,后续各期采购价格指数以 2022 年采购价格指数为基数进行计算的主要品类原材料采购价格指数如下:

采购项目	2025年 1-6月	2024年 度	2023年 度	2022 年 度	价格变动原因
SOC 所用树脂	99.98	107.15	109.26	100.00	2023 年受到外币汇率波动的影响,采购均价上升;2024年以来,公司与供应商协商降价,采购均价略有降低。
TEOS 原材料	110.52	115.69	109.96	100.00	因受到不同批次采购价格波动及 上游材料价格变化的影响, TEOS 原材料价格总体呈现上涨趋势。
滤芯 ionfilter20"	107.68	103.69	99.96	100.00	供应商由于成本原因调整价格, 公司对该滤芯的采购价格存在波 动。

(二)报告期内发行人前五大原辅料(含包装物)供应商情况

报告期内,公司向前五大原辅料(含包装物)供应商采购情况如下:

单位:万元、%

年份	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占采购总额 比例
	1	供应商 A	树脂、环己酮、活性剂等	10,866.32	57.96
	2	供应商 B	滤芯等	1,930.28	10.30
2025 年 1-6	3	供应商 C	树脂、PGMEA、化学助剂 等	1,413.16	7.54
月	4	供应商 F	TEOS (原材料)	949.70	5.07
	5	供应商 K	加仑瓶	525.66	2.80
		合计	-	15,685.12	83.67

年份	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占采购总额 比例
	1	供应商 A	树脂、环己酮、活性剂等	13,256.09	51.53
	2	供应商 F	TEOS (原材料)	2,211.16	8.60
2024	3	供应商 B	滤芯等	1,541.69	5.99
年度	4	供应商 C	树脂、PGMEA、化学助剂 等	1,517.77	5.90
	5	供应商 D	滤芯等	879.11	3.42
		合计	-	19,405.82	75.44
	1	供应商 A	树脂、环己酮、活性剂等	7,030.32	40.02
	2	供应商 C	树脂、PGMEA、化学助剂 等	2,587.23	14.73
2023	3	供应商 F	TEOS (原材料)	1,695.01	9.65
年度	4	供应商 B	滤芯等	1,021.69	5.82
	5	供应商 D	滤芯等	842.37	4.79
		合计	-	13,256.09 2,211.16 1,541.69 1,517.77 879.11 19,405.82 7,030.32 2,587.23 1,695.01 1,021.69	75.00
	1	供应商 A	树脂、环己酮、活性剂等	4,214.11	52.04
	2	供应商 C	PGMEA、化学助剂等	1,192.86	14.73
2022	3	供应商 F	TEOS (原材料)	233.88	2.89
年度	4	上海韵申新能源科技 有限公司	阀门等	226.05	2.79
	5	供应商 D	滤芯等	204.50	2.53
		合计	-	6,071.39	74.98

注: 受同一控制的供应商已合并计算采购额。

报告期内,随着公司自产业务持续增长,公司原材料采购金额逐年增加。基于集成电路关键材料的技术要求和品控要求,并结合现阶段境内集成电路关键材料供应链现状,公司主要原材料仍然通过境外供应商供应。公司已持续完善供应链布局,不存在严重依赖少数供应商的情况。公司与上述供应商之间不存在关联关系。公司不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东在前五名供应商占有权益的情况。

(三) 能源采购情况

报告期内,公司能源采购情况如下:

	采购项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
	耗用量 (度)	10,843,002.00	20,441,148.00	12,641,802.00	7,397,258.00
电	单价 (元/度)	0.67	0.61	0.62	0.62
	采购金额 (元)	7,127,869.90	12,470,328.68	7,852,471.07	4,618,330.76
	耗用量 (吨)	2,477.00	3,137.00	2,620.00	1,893.00
蒸汽	单价(元/吨)	348.62	345.29	348.62	348.62
	采购金额 (元)	863,541.30	1,083,174.32	913,394.51	659,944.95

公司生产经营所用的能源主要为电、蒸汽,随着公司生产规模的扩大,能源耗用量整体呈现上升趋势。

五、主要固定资产及无形资产

(一) 主要固定资产情况

1、固定资产构成情况

公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备及仓储设备、运输工具、电子设备及其他。截至报告期末,公司的固定资产情况如下:

单位: 万元

项目	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	48,429.81	3,400.82	1	45,028.99	92.98%
机器设备及仓储设备	43,871.95	13,750.36	403.47	29,718.11	67.74%
运输工具	358.22	195.66	-	162.56	45.38%
电子设备及其他	749.33	352.28	-	397.05	52.99%
合计	93,409.31	17,699.12	403.47	75,306.71	80.62%

其中,主要机器设备包括光刻机、涂胶显影机、缺陷扫描仪、配方罐等生产 及检测设备。

2、房屋建筑物及租赁

(1) 房屋建筑物

截至报告期末,公司拥有 28 处已办理产权证书的不动产权,具体情况参见本招股意向书"第十二节 附件"之"九、公司不动产权情况"。

截至报告期末,公司未办妥产权证书的房屋及建筑物情况如下:

项目	账面原值 (万元)	账面价值 (万元)	未办妥产权证书 的原因	预计办结产权证 书时间
安徽合肥工厂	21,517.30	21,006.27	正在办理中	2025年
大连维修车间及 变配电所	473.50	473.50	正在办理中	2026年

(2) 房屋租赁情况

截至本招股意向书签署日,公司经营涉及仓储租赁服务情况具体如下:

序号	公司	服务方	位置	面积	合作期限
1	上海 楚坤	上海振义企 业发展有限 公司	上海市浦东新区高翔 环路 155 号	以实际对账为准, 最低 50 m ² 起租	2024.07.01-2026.06.30
2	大连 恒坤	武汉恒基达 鑫国际化工 仓储有限公 司	武汉市武汉化学工业 区化工五路1号	以实际对账为准, 最低 60 m ² 起租	2024.02.01-2026.01.31

截至本招股意向书签署日,除仓储场地外,公司基于生产和运营需要共计承租 4 处物业,具体情况如下表所示:

单位: m²

序号	承租 方	出租方	租赁房屋	租赁 面积	租赁期限	用途
1	恒坤 新材	大连悦成跨 境电商大厦 有限公司	大连市经济技术开 发区哈尔滨路 16-2 号 1-6 层水晶 SOHO 大厦 A211 室	160.00	2025.08.31-2026.08.30	办公
2	福建泓光	漳州高新区 圆创商业运 营管理有限 公司	龙海市九湖林前村 九湖工业园-一栋 层钢结构厂房、一 4层宿舍办公楼、 4层宿舍办公楼、 作、动力间、 作、动力间、 相关 所水池及相关 属设施	4,711.00	2024.05.01-2027.04.30	厂房、办公、宿舍
3	上海楚坤	蒋家林	上海市松江区茸悦 路 228 号 1209/1210 室	99.19	2025.03.01-2027.02.28	办公

公司租赁上述房产均已获得不动产权证,房屋租赁合同均未办理租赁备案手续,根据《中华人民共和国民法典》第706条规定,未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的不影响合同效力;上述房屋租赁合同未将登记备案约定为房屋租赁合同的生效要件,因此,未办理登记备案不会影响上述租赁合同

的法律效力,该事项不会对公司本次发行上市构成重大法律障碍。

(二) 主要无形资产情况

截至报告期末,公司无形资产主要为土地使用权、非专利技术、专利技术等, 具体情况如下:

单位: 万元

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	6,491.97	440.19	1	6,051.79
非专利技术	2,677.99	729.01	-	1,948.98
专利技术	300.00	68.14	-	231.86
计算机软件	157.56	112.38	-	45.18
合计	9,627.52	1,349.71	-	8,277.81

1、土地使用权

截至报告期末,公司拥有 28 处不动产权,均已办理不动产权证,对应土地使用权具体情况参见本招股意向书"第十二节 附件"之"九、公司不动产权情况"。

2、专利和非专利技术

截至报告期末,公司拥有 43 项发明专利、58 项实用新型专利,具体情况参见本招股意向书"第十二节 附件"之"十、公司专利情况"。

截至报告期末,公司非专利技术主要系公司从 Soulbrain 获得 TEOS 生产管理技术授权。2018年8月,公司与 Soulbrain 签订《PRODUCTION TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENT》,约定授予公司独家许可,在境内建造、设置和运营工厂,制造、使用以及销售 TEOS。

3、商标

截至报告期末,公司拥有 29 项注册商标,具体情况参见本招股意向书"第十二节 附件"之"十一、公司商标情况"。

4、软件著作权

截至报告期末,发行人及其子公司拥有1项软件著作权,具体情况如下:

著作权人	登记号	软件名称	登记批准 日期	取得方式	他项权利
恒坤新材	2024SR1549254	HK 信息管理系统 V1.0	2024.10.17	原始取得	无

(三)公司拥有的特许经营权的情况

截至本招股意向书签署日,本公司不涉及特许经营情况。

(四) 主要业务资质情况

截至本招股意向书签署日,公司已就所从事业务取得如下主要资格/资质证书:

序号	公司	资质证书	核发机关/备案机关	证书编号	有效期至
1		危险化学品经营许可 证	厦门市海沧区应急 管理局	闽厦海危化经字【2024】 000058 号	2027.4.2
2		危险化学品登记证	福建危险化学品登记注册中心、应急管理部化学品登记中心	35022500072	2028.4.23
3		固定污染源登记回执	全国排污许可证管 理信息平台	91350200769253672B001 W	2030.5.18
4		中华人民共和国海关 报关单位注册登记证 书	厦门海沧海关	海关注册编码: 3502967 193	长期
5		质量管理体系认证证 书(ISO9001: 2015)		CN20/30801.00	2026.5.6
6		质量管理体系认证证 书(ISO9001: 2015)	通标标准技术服务 有限公司	CN20/30801.01	2026.5.6
7	恒坤 新材	职业健康安全管理体 系认证证书(ISO450 01: 2018)	通标标准技术服务 有限公司	CN22/00000538	2028.4.18
8		职业健康安全管理体 系认证证书(ISO450 01: 2018)	通标标准技术服务有限公司	CN22/00000538.01	2028.4.18
9		IECQ 有害物质过程 控制管理体系认证 (I ECQ QC080000: 201 7)	通标标准技术服务有限公司	IECQ-HSGSCN21.0008	2027.1.14
10		知识产权管理体系认证证书(GB/T29490-2013)	中规(北京)认证有限公司	18124IP0591R1M	2027.12.15
11		环境管理体系认证(I SO14001: 2015)	通标标准技术服务 有限公司	CN21/30050.00	2027.1.11
12		环境管理体系认证(I SO14001: 2015)	通标标准技术服务 有限公司	CN21/30050.01	2027.1.11

序号	公司	资质证书	核发机关/备案机关	证书编号	有效期至
13		城镇污水排入排水管 网许可证	厦门市海沧区住建 和交通局	厦排证字第HC2400093X 号	2029.9.19
14		城镇污水排入排水管 网许可证	厦门市海沧区建设 与交通局	厦排证字第HC2300296X 号	2028.11.19
15		高新技术企业证书	福建省科学技术厅、 福建省财政厅、国家 税务总局福建省税 务局	GR202435001559	2027.12.4
16		排污许可证	漳州市生态环境局 高新技术产业开发 区分局	91350603MA32E4UE780 01W	2028.12.12
17		危险化学品登记证	福建省危险化学品 登记注册中心	35062300032	2026.6.3
18		安全生产许可证	福建省应急管理厅	(闽) WH 安许证字【20 20】000004(换)号	2026.4.20
19		安全生产标准化证书	漳州高新技术产业 开发区管委会应急 管理局	ZGAQBWH III 2023000 02	2026.3.30
20		城镇污水排入排水管 网许可证	漳州高新技术产业 开发区管委会建设 局	漳高建污字第[2023]023 号	2028.11.7
21	- } □ 7-13-	中华人民共和国海关 报关单位注册登记证 书	漳州海关	海关注册编码: 3506969 0AF	长期
22	福建泓光	质量管理体系认证证 书(ISO9001: 2015)	通标标准技术服务 有限公司	CN20/30801.00	2026.5.6
23		质量管理体系认证证 书(ISO9001: 2015)	通标标准技术服务 有限公司	CN20/30801.02	2026.5.6
24		职业健康安全管理体 系认证证书(ISO450 01: 2018)	通标标准技术服务 有限公司	CN22/00000538	2028.4.18
25		职业健康安全管理体 系认证证书(ISO450 01: 2018)	通标标准技术服务 有限公司	CN22/00000538.02	2028.4.18
26		IECQ 有害物质过程 控制管理体系认证 (I ECQ QC080000: 201 7)	通标标准技术服务 有限公司	IECQ-H SGSCN 21.000 8-01	2027.1.14
27		知识产权管理体系认证证书(GB/T29490- 2013)	中规(北京)认证有限公司	18124IP0591R1M-1	2027.12.15
28		环境管理体系认证 (I SO14001:2015)	通标标准技术服务 有限公司	CN21/30050.00	2027.1.11
29		环境管理体系认证(I SO14001:2015)	通标标准技术服务 有限公司	CN21/30050.02	2027.1.11
30	大连 恒坤	高新技术企业证书	大连市科学技术局、 大连市财政局、国家 税务总局大连市税		2025.12.14

序号	公司	资质证书	核发机关/备案机关	证书编号	有效期至
			务局		
31		安全生产许可证	辽宁省应急管理厅	(辽) WH 安许证字【20 24】1598 号	2027.2.5
32		危险化学品登记证	辽宁省安全生产服 务中心、应急管理部 化学品登记中心	21022300048	2026.7.8
33		固定污染源排污登记 回执	全国排污许可证管 理信息平台	91210213MA0XTF9B3M 001W	2029.3.7
34		中华人民共和国海关 报关单位注册登记证 书	大连港湾海关	海关注册编码: 2102969 9J6 检验检疫备案号: 211940 0431	长期
35		质量管理体系认证证 书(ISO9001: 2015)	通标标准技术服务 有限公司	CN21/10481	2027.3.15
36		环境管理体系认证(I SO14001: 2015)	通标标准技术服务 有限公司	CN22/00000038	2028.3.9
37		职业健康安全管理体 系认证证书(ISO450 01: 2018)	通标标准技术服务 有限公司	CN25/00001208	2028.2.27
38		排污许可证	大连市生态环境局	91210213MA0XTF9B3M 001W	2029.8.1
39		两化融合管理体系评 定证书	北京赛西科技发展 有限责任公司	101	2026.12.15
39		危险化学品经营许可 证	上海市松江应急管 理局	沪(松)应急管危经许【2 023】206305	2026.12.24
40	上海楚坤	危险化学品登记证	上海市化学品登记 注册办公室&应急 管理部化学品登记 中心	31012501386	2028.07.29
41		海关进出口货物收发 货人备案回执	上海松江综合保税 区 A 区	海关编码: 3118660023 检验检疫备案号: 31006 98847	长期
42	福建 恒晶	海关进出口货物收发 货人备案回执	漳州海关	海关编码: 35069606RZ 检验检疫备案号: 39535 00054	长期
43	泓坤 微电	中华人民共和国海关 报关单位注册登记证 书	海沧海关	海关注册编码: 3502167 ATN	长期
44	子	出入境检验检疫报检 企业备案表	厦门海关	390110006	-
45	武汉恒坤	海关进出口货物收发 货人备案回执	武昌海关	海关注册编码: 4201360 0HE 检验检疫备案号: 42552 00049	长期
46	安徽	海关进出口货物收发 货人备案回执	庐州海关	海关注册编码: 3401960 0C7	长期
47	恒坤	排污许可证	合肥市生态环境局	91340100MA2UM4XY7 B001U	2029.12.12

序号	公司	资质证书	核发机关/备案机关	证书编号	有效期至
48	福建 司理 可	海关进出口货物收发 货人备案回执	漳州海关	海关注册编码: 3506960 A03	长期
49	漳州 链芯	危险化学品经营许可 证	漳州高新技术产业 开发区管委会应急 管理局	闽漳高危经【2024】000 1号	2027.5.30

六、发行人核心技术及研发情况

(一) 公司的核心技术情况

公司专注于集成电路关键材料的研发与产业化应用,核心技术均系围绕关键材料的研发和生产展开,并进一步延伸至对关键材料上游原材料的技术储备。公司主营业务产品中,光刻材料属于配方型精细化学品,前驱体材料属于高纯化学试剂,在产品研发过程中需要对客户工艺制程与应用需求充分理解,并根据不同客户情况对产品进行改良调整;在产品生产过程中需要对产品品质与量产能力全面管控,确保产品品质与生产规模持续满足客户使用需求。

近年来,境内集成电路产业保持蓬勃发展,随着国家战略与行业政策多方位 扶持,集成电路产业国产化进程加速。境内晶圆厂在先进制程的研发创新能力、 生产制造能力以及市场开拓能力均不断提升。在境内晶圆厂研发创新与生产制造 过程中,需要与关键材料与关键设备企业紧密合作,并要求相关企业一方面具备 持续研发和自主创新能力,另一方面具备规模生产和品控管理能力。公司承担国 家 02 科技重大专项子课题与国家发改委专项研究任务系公司持续研发和自主创 新能力的良好体现,公司累计超过 55,000 加仑的自产光刻材料销售规模系公司 规模生产和品控管理的有效佐证。截至报告期末,公司自产产品在研发、验证以 及量供款数累计已超过百款。公司与境内多家中国境内领先的 12 英寸集成电路 晶圆厂均已形成稳定合作机制,为前述晶圆厂升级工艺制程提供国产化关键材料 技术支撑,为境内集成电路产业发展作出重要贡献。

总体而言,公司作为半导体制造关键材料企业,在配方研发、生产能力、品质管控以及产品应用等方面形成核心技术积累,帮助公司在半导体行业树立行业壁垒,持续稳固核心竞争能力。

截至报告期末,公司拥有关键核心技术情况、技术来源、技术所处阶段等具

体情况如下表所示:

序号	核心技术名称	核心技术描述	核心技 术所处 阶段	核心技术来源
1	光刻材料配方开发技术	技术用于光刻材料配方开发与改良,在产品研发阶段与验证阶段均发挥核心作用。 光刻材料属于配方型精细化学品,定制化程度高,细微比例的配比变化、含量调整或组合改良都会对光刻材料的功能与性能产生重大影响。配方开发技术系公司研发光刻材料的基础核心技术。	成熟应 用	自主研 发
2	光刻图形改善与应用优化 技术	技术用于光刻材料在客户验证过程中的分析与优化。技术基础系基于对集成电路光刻工艺的专业理解与经验积累,形成对光刻工艺过程中图形和成像的分析能力。该技术与光刻材料配方开发技术相结合后共同实现光刻材料的持续研发和产品导入。同时,在引进模式下,该技术为公司前期顺利导入中国境外关键材料厂商的光刻材料提供技术支撑。	成熟应用	自主研发
3	碳膜涂层(SOC)生产管 理技术	用于 12 英寸集成电路晶圆制造用 SOC 规模生产与品质管控的技术。	部分成 熟应用	自主研 发
4	抗反射涂层(ARC)生产 管理技术	用于 12 英寸集成电路晶圆制造用 BARC、TARC 以及 SiARC 等抗反射涂层规模生产与品质管控的技术。	部分成 熟应用	自主研发
5	i-Line 光刻胶生产管理技术	用于 12 英寸集成电路晶圆制造用 i-Line 光刻胶及相关感光类材料规模生产与品质管控的技术。	部分成 熟应用	自主研发
6	KrF 光刻胶生产管理技术	用于 12 英寸集成电路晶圆制造用 KrF 光 刻胶规模生产与品质管控的技术。	部分成 熟应用	自主研 发
7	ArF 光刻胶生产管理技术	用于 12 英寸集成电路晶圆制造用 ArF 光 刻胶和 ArF 浸没式光刻胶的技术。	研发中	自主研 发
8	光刻工艺化学试剂生产管 理技术	用于 12 英寸集成电路晶圆制造用旋涂介电层、Top Coating 等化学试剂规模生产与品质管控的技术。	研发中	自主研 发/技术 转让
9	树脂制造工艺技术	树脂系光刻材料核心成份,直接影响光刻 材料的光学性能、分辨率、蚀刻性能等重 要参数。该技术对应自产各类光刻材料的 树脂原材料,涵盖树脂合成方法、金属离 子去除技术以及添加剂适配等细分技术。 通过掌握树脂制造相关技术,公司可实现 对光刻材料核心原材料的自主可控。	部分成 熟应用	自主研 发/技术 转让
10	硅基前驱体材料生产管理 技术	用于 TEOS 等硅基前驱体材料规模生产与 品质管控的技术。	部分成 熟应用	技术授 权/自主 研发
11	金属基前驱体材料生产管 理技术	用于四氯化铪等金属基前驱体材料规模 生产与品质管控的技术。	研发中	自主研 发

过去半个多世纪,全球范围集成电路产业发展一直遵循摩尔定律。在摩尔定

律技术基础上,只要光刻工艺精度不断提高,元器件密度会相应提高,工艺制程或技术节点也将持续缩小。以逻辑芯片为例,从 1995 年 350nm 面世以来,集成电路产业每过 18 个月至 24 个月即会研发形成新的技术节点,到 2023 年,全球范围内已有晶圆厂实现逻辑芯片 3nm 技术节点量产。在全球集成电路产业发展过程中,对于关键材料包括光刻材料、前驱体材料以及电子特气等一直保持需求增长态势。境内集成电路产业起步较晚,公司所掌握核心技术及对应产品处于境内集成电路关键材料领先地位,已覆盖 128 层及以上 3D NAND、18nm 及以下DRAM 存储芯片以及 7-90nm 技术节点逻辑芯片,系当前境内集成电路产业主要布局范围。公司将通过自主研发助力境内集成电路产业不断升级迭代,追赶世界先进水平,实现高水平科技自立自强。

(二)公司技术先进性及具体表征

公司已成熟应用或部分成熟应用核心技术先进性表征如下表所示:

序号	核心技术名称	核心技术先进性及具体表征
1	光刻材料配方 开发技术	相关技术已支持研发完成超过 90 款用于 12 英寸集成电路晶圆制造 光刻材料配方,且多款光刻材料实现量产供应或通过客户验证。光刻材料属于配方型精细化学品中高难度级别,且属于定制化产品,不同客户在不同工艺使用的光刻材料通常存在差异,需对配方进行适时调整,公司配方开发技术帮助公司产品能够持续匹配客户多样 化需求。
2	光刻图形改善 与应用优化技 术	
3	碳膜涂层生产管理技术	1、技术实现高温产品可应用于 400℃~450℃,单一金属离子浓度低于 1ppb,粒径 0.3μm 以上颗粒度低于 5 个/ml,最小可填隙尺寸能力达 20nm 以下; 2、技术可精确调控碳含量以及树脂结构优化,并提供刻蚀选择比; 3、SOC 已通过多名客户验证并实现销售,系中国境内极少数 SOC量产供货企业之一,成功替代国际竞品,截至报告期末,累计稳定供货量超过 40,000 加仑。
4	抗反射涂层生 产管理技术	1、技术精确匹配衬底膜层对光学常数要求,实现材料表面处反射率小于 0.5%; 能够适配快速刻蚀速率,并满足光刻胶侧壁形貌要求。2、BARC 已通过多名客户验证并实现销售,系中国境内少数实现BARC 量产供货企业,成功替代国际竞品,截至报告期末,累计稳定供货量超过 9,500 加仑。
5	i-Line 光刻胶生 产管理技术	1、根据客户需求定制适配 12 英寸集成电路晶圆制造光刻工艺的创新负性 i-Line 光刻胶,分辨率、对比度、粘附性及敏感度均系为客户定制开发。 2、i-Line 光刻胶已通过客户验证并实现销售,截至报告期末,累计

序号	核心技术名称	核心技术先进性及具体表征
		稳定供货量超过 500 加仑。
6	KrF 光刻胶生产 管理技术	1、技术可实现厚度从数微米到 0.2μm,极限分辨率可达到 120nm, 1:1 线条图形,在曝光宽容度为 10%的情况下焦深大于 0.3μm。 2、KrF 光刻胶已通过客户验证并实现销售,成功替代国际竞品,截至报告期末,累计稳定供货量超过 5,000 加仑。
7	树脂制造工艺 技术	实现不同种类树脂稳定合成,是光刻材料自主研发重要支撑;在含碳量、厚度、单体比例、分子量以及一致性等方面均满足光刻材料要求;合成树脂满足单一金属离子含量小于 1ppb,总金属离子小于 5ppb 技术指标要求。
8	硅基前驱体材 料生产管理技 术	

(三)公司核心技术在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况

公司核心技术是公司通过持续积累并自主创新而形成的技术成果,在主营业务及产品或服务中得到广泛应用。一方面,公司自研相关核心技术助力公司自产销售规模持续增长,最近三年,公司自产销售收入分别为 12,357.89 万元、19,058.84 万元和 34,418.93 万元,复合增长率 66.89%,增长迅速;另一方面,公司光刻图形改善与应用优化技术帮助公司在前期通过引进模式成功向客户导入进口定制光刻材料,报告期内,公司引进光刻材料销售收入分别为 14,290.10 万元、12,141.90 万元、14,711.02 万元和 981.16 万元,系公司主营业务收入重要组成部分。

报告期内,公司利用核心技术自产产品收入及占比具体情况如下:

单位: 万元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
核心技术收入	24,977.42	34,418.93	19,058.84	12,357.89
主营业务收入	28,814.25	53,975.18	36,153.01	31,733.92
占主营业务收入比重	86.68%	63.77%	52.72%	38.94%

(四)核心技术取得专利情况或其他技术保护措施

1、核心技术取得专利情况

公司充分认识到知识产权在企业经营中的重要作用与核心价值,持续保护核心技术。针对核心技术对应的工艺优化、技术迭代以及产品创新等,公司积极申

请相关知识产权。截至报告期末,公司已取得 101 项授权专利,其中发明专利 43 项,具体情况请参见"第十二节 附件"之"十、公司专利情况"。

2、其他技术保护措施

(1) 公司已制定完善的内部控制制度强化技术保护

公司已制定《保密控制程序》《记录控制程序》《内部审核控制程序》《文件控制程序》《知识产权管理规范》《知识产权获取控制程序》《知识产权实施、许可、转让控制程序》等全方位对公司核心技术涉及的专利或非专利技术成果、内部技术秘密以及相关数据资料等进行管理。

公司对主要生产经营场所均设定涉密区域并实施专门管制,对相关人员出入权限进行设置并对信息安全防护管控,有效保护与隔离涉密信息。公司建立完善的文件与记录机密等级机制,对涉密信息设定不同保密等级,对公司日常经营过程中数据或资料均进行标记,严格规定查看或使用权限。同时,公司注重信息安全建设,对OA、ERP、财务管理等核心系统均设置严格准入权限。

(2) 日常培训与行为限制

公司对员工定期进行专项培训,通过集中会议、课程培训等形式,持续提升员工技术保护意识。同时,为防范核心技术泄露,公司与核心人员均签订了保密协议和竞业禁止协议,约定了研发成果归属、保密义务、竞业限制义务等。

(3) 激励制度

公司积极鼓励员工投入研发创新活动,促进公司核心技术持续提升。公司已制定《绩效管理制度》《研发激励制度》《知识产权管理规范》《专利奖励办法》等制度,对于研发活动或项目以奖金方式对相关人员进行奖励。此外,公司还通过股权激励计划对相关技术人员进行有效激励,具体请参见本招股意向书"第四节发行人基本情况"之"十八、发行人已经制定或实施的股权激励及执行情况"。

(五)公司科研实力和成果情况

1、公司获得的重要奖项

截至报告期末,公司及子公司获得的主要奖项荣誉情况如下:

- 序 号	荣誉名称	荣誉主体	颁发单位	时间
1	2024 年度福建省数字经济核心产业"瞪羚"创新企业	福建泓光	福建省数字福建建 设领导小组办公室	2024 年
2	福建省工业龙头培育企业	福建泓光	福建省工信厅	2024年
3	重点"小巨人"企业	福建泓光	国家工信部	2024年
4	福建省制造业单项冠军企业	福建泓光	福建省工信厅	2023年
5	国家专精特新小巨人企业	福建泓光	国家工信部	2023年
6	福建省科技小巨人企业	福建泓光	福建省科技厅	2023 年
7	福建省瞪羚企业	福建泓光	福建省数字福建建 设领导小组办公室	2023 年
8	国家知识产权优势企业	福建泓光	国家知识产权局	2023年
9	龙江杯"优秀奖"	福建泓光	福建省工业和信息 化厅	2021年
10	创响福建中小企业创新创业大赛 福建省总决赛一等奖	福建泓光	福建省工信厅	2020年
11	创客中国中小企业创新创业大赛 全国总决赛三等奖	福建泓光	创客中国大赛	2020年
12	福建省集成电路光刻胶关键材料 工程研究中心	福建泓光	福建省发改委	2020年
13	第七届"创客中国"中小企业创新 创业大赛 500 强	大连恒坤	国家工信部	2022 年
14	第八届大连市创新创业大赛新材 料成长组二等奖	大连恒坤	大连市科技局	2022 年
15	第十一届中国创新创业大赛(成长 组)优秀企业	大连恒坤	中国创新创业大赛 组委会办公室	2022 年
16	辽宁省数字化车间	大连恒坤	辽宁省工信厅	2023年
17	辽宁省专精特新中小企业	大连恒坤	辽宁省工信厅	2025年
18	辽宁省瞪羚企业	大连恒坤	辽宁省科学技术厅	2025年
19	厦门市科学技术进步奖三等奖	恒坤新材	厦门市人民政府	2025年
20	先进制造业倍增计划企业	恒坤新材	厦门市工信局	2023年
21	福建省企业技术中心	恒坤新材	福建省工信厅	2023年
22	价值创造奖	恒坤新材	客户 A1	2023年
23	研发合作奖	恒坤新材	客户 B2	2023年
24	国家知识产权优势企业	恒坤新材	国家知识产权局	2023年
25	第七批省级新型研发机构	恒坤新材	福建省科学技术厅	2022 年
26	厦门市未来产业骨干企业	恒坤新材	厦门市科技局	2021年

2、公司承担或参与的国家部委重大科研项目

序号	项目名称	项目状态
1	国家 02 科技重大专项子课题	己验收
2	国家专项研究任务	己验收
3	材料攻关项目 A	进行中
4	材料攻关项目B	进行中
5	材料攻关项目 C	进行中

上述国家专项中,国家 02 科技重大专项子课题和国家专项研究任务均已结题并通过主管部门验收,对应产品已实现销售,成功助力集成电路国产化战略。

(六)公司项目研发及进展情况

截至报告期末,公司正在从事的研发项目及进展情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	所处阶段	拟达到的目标	行业技术水平比较情况	研发状态说明	报告期内研发投入情况
1	碳膜涂层 系列研发 项目	部分产品已实现 量产供货,部分在 研发和客户验证 中	根据工艺需求不同,广泛应用于逻辑芯片和存储芯片生产。在研或在验证产品均已明确对标产品及境外厂商,目标实现替代。SOC 系公司核心产品之一。	产品参数与性能达到或优于对标境外厂商产品,处于行业领先水平。	共计 18 款产品, 其中 7 款已结项	1,227.02
2	抗反射涂 层系列研 发项目	部分产品已实现 量产供货,部分在 研发和客户验证 中		产品参数与性能达到或 优于对标境外厂商产 品,处于行业领先水平。	共计 45 款产品, 其中 14 款已结 项	6,117.06
3	KrF 光刻 胶系列研 发项目	部分产品已实现 量产供货,部分在 研发和客户验证 中	根据工艺需求不同,广泛应用于逻辑芯片与存储芯片生产。在研或在验证产品均已明确对标产品及境外厂商,目标实现替代。KrF 光刻胶系公司核心产品之一。	产品参数与性能达到或 优于对标境外厂商产品,处于行业领先水平。	共计 29 款产品, 其中 3 款已结项	5,805.99
4	ArF 光刻 胶系列研 发项目		项目子产品包括 ArF 光刻胶与 ArF 浸没式光刻胶等。根据工艺需求不同,广泛应用于逻辑芯片与存储芯片生产。在研或在验证产品均已明确对标产品及境外厂商,目标实现替代。	产品参数与性能达到或优于对标境外厂商产品,处于行业领先水平。	共计7款产品, 均未结项	2,114.82
5	i-Line 光 刻胶系列 研发项目	部分产品已实现 量产供货,部分在 研发和客户验证 中	i-Line 负性光刻胶及相关感光类光刻材料,广泛应用	部分产品系配合客户创 新研发,处于行业领先 水平。	共计6款产品, 其中2款已结项	1,353.27
6		研发中,部分在客户验证中.	项目子产品包括光刻工艺相关化学试剂如旋涂介电层(SOD)、Top Coating等,适用于正负显影,广泛应用于逻辑芯片与存储芯片生产。在研或在验证产品均已明确对标产品及境外厂商,目标实现替代。	产品参数与性能达到或 优于对标境外厂商产品,处于行业领先水平。	共计8款产品, 其中1款已结项	1,492.71
7	光刻材料 原材料系 列研发项	研发中	项目系公司光刻材料原材料之一的树脂,在技术转让基础上进一步研发,目标实现树脂国产化应用。	树脂预计参数与性能达 到或优于现有采购产 品,境内尚未实现树脂	共计2款原料, 均未结项	570.68

序号	项目名称	所处阶段	拟达到的目标	行业技术水平比较情况	研发状态说明	报告期内研 发投入情况
	目			国产化,原材料技术处 于行业领先水平。		
8			项目子产品包括 TEOS 等硅基前驱体材料,纯度、杂质与金属离子浓度均达到集成电路要求,在研产品已明确对标产品及境外厂商,目标实现替代。TEOS 系公司核心产品之一。	产品参数与性能达到或 优于对标境外厂商产 品,处于行业领先水平。	共计6款产品, 其中1款已结项	974.61
9	金属基前 驱体系列 研发项目	研发中,部分在客户验证中	项目子产品包括各类金属基前驱体材料,纯度、杂质与金属离子浓度均达到集成电路要求,在研或在验证产品已明确对标产品及境外厂商,目标实现替代。	产品参数与性能达到或 优于对标境外厂商产 品,处于行业领先水平。	共计8款产品, 均未结项	2,933.41
10	磷/硼基 前驱体材 料系列研 发项目	研发中	项目为磷酸三乙酯、三乙基硼烷等,纯度、杂质与金属离子浓度均达到集成电路要求,在研产品已明确对标产品及境外厂商,目标实现替代。		共计2款,均未 结项	72.34

注: 研发状态说明系自报告期以来,截至报告期末公司产品款数状态,报告期前已结项产品未列示。

(七)公司报告期内的研发投入情况

报告期内,公司研发项目持续推进,对应研发投入规模不断提升,研发投入占营业收入占比均在10%以上,具体情况如下:

单位:万元、%

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
研发投入	4,160.43	8,860.85	5,366.27	4,274.36
营业收入	29,433.73	54,793.88	36,770.78	32,176.52
占比	14.13	16.17	14.59	13.28

(八) 公司合作研发情况

报告期内,公司以自主研发为主,委托研发和合作研发为辅开展研发活动。 其中,涉及委托研发和合作研发情况如下表所示:

序号	単位	合作研发 内容	主要合同 情况	签署日期	金额	研究成果及其权属、收益 约定	技术保密措施
1	供应商 G	SOC 和 i-Line 光 刻胶树脂 技术及相 关服务	技术开发 (委托)	2023 年 11 月	初始技术开发费 400 万美元, 变动开发费不超过 200 万美元	本合同产生的技术所有 权和知识产权归公司 (及公司授权第三方) 独家所有,无需附加任 何条件。变动开发费以 提成方式支付,金额为 销售额(不含税)的 10%。	本合同有效期内 及之后 10 年内, 双方应履行协议 下保密义务。
2	山东大学	光刻胶及 周 质 及 提 升 为 法	技术服务	2020年 11月	100 万元	在本项目独立 果妇和独立 果妇和知识方科记程,对于一个人,方成权自己,是是一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	除经对者法,不是是一个人,不是一个人,这一个一个一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一个一点,这一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一个一点,这一点,这一点,这一点,这一点,这一点,这一点,这一点,这一点,这一点,这
3	上海八亿 时空	树脂产品合作开发	合作研发	2023 年 9 月	不适用	本项目中由双方因履行本协议产生的技术成果、知识产权及其申请权及处分权利、收益等与该技术成果、知识产权相关的权利按照《中华人民共和国民法典》的相关规定归双方共同所有。	本的他双息或而露光方式的他双息或而露光的性况,除他须未同以不放然的,我们就是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,

序号	单位	合作研发 内容	主要合同情况	签署日期	金额	研究成果及其权属、收益 约定	技术保密措施
序号 4	厦门大学			签署日期 2024 年 11 月	金额 750 万元		技术保密措施 任何 接不因形使使何方人触雇接已信或保密措施 。
						进结果享有优先的受让/被许可权。	

(九)公司核心技术人员及研发人员情况

1、研发中心组织架构及研发人员情况

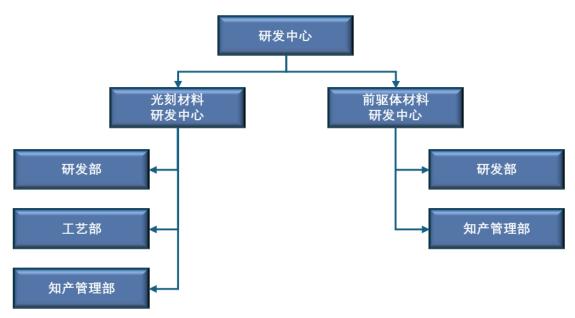
公司以研发创新为核心驱动力,在长期技术摸索过程中形成了研发创新与生产验证相结合的研发生产体系,具备快速、高效、安全以及可持续的研发成果转化能力。

(1) 研发组织架构

公司设立研发中心统筹公司研发活动。公司研发中心配合公司发展战略,建立研发中心人才培养及建设体系,健全研发中心管理及制度建设。公司研发中心制定研究开发计划,一方面开发满足客户需求的关键材料,另一方面研究储备具有应用前景的新技术。同时,研发中心负责管理公司知识产权规划,落实专利申请与技术保密工作。

研发中心下设光刻材料与前驱体材料两个分支中心,分别负责光刻材料与前驱体材料的开发工作。研发中心与营销中心、品质中心以及生产工厂保持日常紧密沟通,跟进产品验证过程中涉及对产品配方或工艺改良调整。公司光刻材料研

发中心与前驱体材料研发中心下设具体研发工作部门,公司研发组织架构如下所示:



序号	部门	工作职责
1	光刻材料 研发中心	统筹光刻材料相关研发工作
2	前驱体材 料研发中 心	统筹前驱体材料相关研发工作
3	研发部	(1) 依据市场及客户需求提出并负责研发新产品; (2) 对新产品进行技术上可行性调研并形成研究报告; (3) 制定新产品的开发方案及开发计划; (4) 执行开发计划,及时处理实验中遇到的各类问题。根据客户试用反 馈对产品进行改进,完成研发到量产的开发过程。执行新产品项目开发 总结; (5) 收集与公司行业等相关领域最新技术信息; (6) 协助申请政府科技类奖项,撰写技术方案材料。
4	工艺部(应 用工艺组)	(1)负责研发开发样品工艺测试与评估,汇总工艺相关数据,并进行数据分析; (2)负责量测样品生产监控与技术确认,保证生产产品良品率; (3)负责新产品导入与流程改善; (4)负责相关设备验收与调试,完成日常点检与稳定性监控; (5)参与工艺相关体系文件编写与 SOP 修正; (6)参与客诉异常排查与分析,负责工艺模块相应技术调查; (7)负责专案项目推进。
5	知产管理部	(1)依公司发展战略提出专利撰写方向,布局预开发产品的专利技术;(2)撰写并申请相关技术产品的新专利;(3)维护目前拥有的专利;(4)撰写需在技术杂志发表的相关技术文章;(5)建立技术保密体系,建立专利侵权等风险预警机制。

(2) 研发人员情况

报告期内,公司研发人员主要系专职从事研发活动的员工,通过外部招聘与内部培养结合方式逐步组建而成,相关人员均具备丰富的研发经验和技术能力。此外,公司将当期研发工时占比超过50%的非全时研发人员认定为研发人员,报告期各期末非全时研发人员分别1名、0名、3名、1名。

报告期各期末,公司研发人员数量、占比、学历分布情况如下表所示:

单位:人

				1 12. / (
项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
博士	5	3	3	3
硕士	16	14	11	10
本科	46	35	29	22
本科以下	6	2	2	1
合计	73	54	45	36
 员工总人数	376	347	303	206
研发人员数量占比	19.41%	15.56%	14.85%	17.48%

截至报告期末,公司研发人员共73名,占员工总人数的比例为19.41%。其中,硕士及以上学历19人,占研发人员比例为26.03%。

2、核心技术人员情况

公司核心技术人员共计 4 名,均系对集成电路或化工材料方面拥有深刻理解并具备多年技术专业经验,上述核心技术人员的简历参见本招股意向书"第四节发行人基本情况"之"十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况"之"(四)核心技术人员"。报告期内,公司核心技术人员构成均未发生变化。

上述核心技术人员的重要科研成果以及对公司研发活动的贡献情况如下:

姓名	核心技术人员的重要科研成果、对公司研发活动的贡献
肖楠	从事集成电路晶圆制造技术相关工作接近 20 年,积累丰富行业经验。主要贡献如下: (1) 统筹构建公司现有产品结构和业务架构:一方面,通过专业光刻工艺经验促成 引进产品导入客户并稳定销售;另一方面,统筹光刻材料工厂与前驱体工厂的筹建、 设计、建设与投产,建立专业品质管理体系,实现光刻材料与前驱体材料自产产品 导入客户并稳定销售。(2) 主持光刻材料生产工艺研发与前驱体材料生产工艺应用。 截至报告期末,参与研发已授权发明专利 27 项。
宋里	从事集成电路晶圆制造技术相关工作超过 15 年。主要贡献包括:作为光刻材料工厂
	负责人全面负责并参与工厂包括筹建、设计、建设、投产以及运营等各项工作,保

姓名	核心技术人员的重要科研成果、对公司研发活动的贡献
	证工厂稳定运营;全面负责并参与光刻材料生产工艺研发工作。截至报告期末,参与研发已授权发明专利17项。
王静	中国科学院长春应用化学研究所博士研究生学历,从事化工材料方面研究或工作超过 15 年,主要贡献包括: 搭建并管理公司光刻材料研发团队,主持公司光刻材料配方与原材料开发,陆续完成 SOC、BARC、i-Line 光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 光刻胶等配方开发工作。截至报告期末,参与研发已授权发明专利 35 项。
毛鸿超	中国科学院长春应用化学研究所博士研究生学历,从事化工材料方面研究或工作接近 15 年,主要贡献如下:参与 BARC 配方开发工作并实现量产供货。搭建公司前驱体材料研发团队,主持前驱体材料生产工艺研发工作。截至报告期末,参与研发已授权发明专利 23 项。

3、公司对核心技术人员实施的约束激励措施

公司已建立完善的技术创新激励体系,相继制定《绩效管理制度》《研发激励制度》《专利奖励办法》《知识产权维护控制程序》等内部制度并已有效运行。同时,公司已通过股权激励形式对核心技术人员进行有效激励。此外,公司与核心技术人员签订了保密协议、竞业禁止协议,对保密内容、有效期、核心技术人员在任职期间及离职后保密职责、离职后从事相关行业等事项进行严格规范。

(十)公司的技术创新机制、技术储备及技术创新的安排

1、公司的技术创新机制及安排

公司从事集成电路领域关键材料的研发与产业化应用,本质上属于制造业,需要针对关键材料的配方及生产工艺进行持续研发和技术创新,一方面拓展产品维度与应用场景,另一方面提高产品稳定性与可靠性。关键材料研发通常需要具备丰富行业经验的研发人员和长期稳定的研发投入,为保证公司在集成电路关键材料领域的市场地位,公司需时刻跟进行业趋势与市场方向,并采取了一系列措施保证自身核心竞争力,具体情况如下:

(1) 健全高效的研发体系

公司将研发积累与技术创新作为可持续发展的核心基础,在研发中心下构建 光刻材料和前驱体材料两大研发分支组织,覆盖 12 英寸集成电路晶圆制造前道 工艺涉及的光刻材料与前驱体两大产品体系。公司研发遵循行业发展逻辑、客户 工艺需求以及产业自主可控原则,由研发中心承担研发任务,并分配至两大研发 分支组织下各类研发小组负责。各研发小组根据研发项目需要,组成由研发工程 师、工艺工程师、分析工程师、专利工程师、技术员等骨干力量构成的专业团队。 公司对研发项目实施专项管理,制定了《研发项目管理制度》《研发实验室 安全管理制度》《知识产权管理规范》《研发激励制度》《保密控制程序》等研发 相关的管理制度,为研发工作提供制度支撑。

(2) 全面多元的人才政策

公司一直秉持"汇聚人才,培养人才,人才优先"的经营方针,持续加强研发团队建设,并对研发团队的人员选拔制定严格标准。一方面,公司通过外部招聘方式对研发岗位专项招聘,对基本素质、学历背景、工作经验等提出严格要求,保证新增研发人员的研发能力和专业能力,另一方面,公司通过内部选拔或推荐机制,经由公司人员推荐或部门评估选拔,有意向且能力适配者可进入研发部门。与此同时,公司通过建立人力资源优化、推荐培训交流等政策持续提升现有研发人员的技术创新能力,并通过鼓励研发人员参加专业展览、技术论坛以及学术会议等形式,促使研发人员加强领域研讨,实现学术融合,持续掌握行业动态和发展趋势,有效提升现有研发人员的研发驱动力和创新能力。

(3) 切实落地的激励政策

在激励机制方面,公司充分调动研发人员积极性,提供行业内具备竞争力的 岗位职级、薪酬体系和晋升体系,并建立绩效奖金制度。同时,公司对核心技术 人员及优秀研发骨干实施股权激励,分享公司成长硕果。

2、技术储备

公司技术储备围绕 12 英寸集成电路晶圆制造所需关键材料,覆盖 128 层及以上 3D NAND、18nm 及以下 DRAM 存储芯片以及 7-90nm 技术节点逻辑芯片等境内集成电路产业主要布局产品,重点就光刻材料与前驱体两大体系持续进行研发创新,不断夯实公司在相关领域的领先地位。同时,公司与下游晶圆厂客户战略合作,以行业发展和客户需求为导向,积极配合客户工艺制程发展规划,研发与布局集成电路关键制程所需的关键材料,并形成各类核心技术持续积累。

境内集成电路产业虽起步较晚,但发展迅速,逻辑和存储两大细分领域均已有企业取得实质性突破,对公司关键材料技术储备提出更高要求。公司聚焦 12 英寸集成电路工艺,在稳定掌握现有已量产关键材料产品基础上,已储备或开发包括但不限于 ArF 光刻胶、SiARC、Top Coating、硅基和金属基前驱体材料等关

键材料技术,持续完善公司光刻材料和前驱体材料品类与维度。

七、安全生产及环境保护情况

(一) 公司环境保护情况

公司高度重视环境保护工作,在研发、采购、生产、回收等环节均秉持环境保护理念。公司拥有完备的污染治理设施和符合国际安全规格的厂房,建设项目严格执行安全职业健康、环保"三同时"规定,并确保投入足额的安全环保费用,安全环保设备设施均符合相关法律法规要求。公司漳州工厂与大连工厂主要环境污染物、处理设备以及处理能力情况如下表所示:

序号	污染类型	主要污染物	处置方式
1	废水	生产废水、生活 污水	生产废水经厂内污水处理设施处理后、生活污水经 化粪池预处理后一起经市政污水管网排入污水处理 厂进一步处理
2	废气	有机废气	收集后经活性炭处理装置净化(或经过尾气处理塔的多面球吸附后,再经过两道喷淋处理)后,通过排气筒排放
3	固废	固废	厂内按规范建设危险废物暂存场所,危险废物收集 后委托有资质单位处置。生活垃圾分类收集后,由 环卫部门统一清运
4	噪声	噪声	选用低噪声设备,高噪声设备采取减振隔声措施

公司与第三方危废处理公司签订了危险废物处理处置合同,将生产过程中的 危险废物交由其处置。第三方危废处理公司按照国家有关规定和标准对公司的污染物进行安全处置,公司不存在违规排放污染物的情形。

报告期内,发行人环境保护相关支出如下表所示:

单位:万元

项目	2025年1-6月 2024年度		2023 年度	2022 年度
环保相关支出	75.36	159.56	81.63	91.91

报告期内,公司环保相关支出主要为环保设施支出、环评相关费用以及危废处置费用。报告期内,公司环保投入及成本费用与公司生产经营所产生的污染相匹配。

(二)公司安全生产情况

公司子公司福建泓光和大连恒坤均取得安全生产许可证,已组织建立较为完

善的安全生产管理制度体系,制定了《安全生产责任制》《安全活动管理制度》《安全检查和隐患排查制度》等规章制度并已有效执行。

报告期内,公司在生产经营过程中未发生过安全生产违法违规行为,不存在 因违反安全生产方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

八、发行人境外经营情况

报告期内,公司子公司香港恒坤负责引进业务,通过向境外供应商采购产品并向境内客户进行销售,公司子公司日本精容尚未有实质业务开展。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节披露或引用的财务会计信息,非经特别说明,均引自公司经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告。本节的财务会计数据及有关的分析说明反映了公司报告期内经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表及附注的主要内容,公司提醒投资者关注本招股意向书所附财务报表和审计报告全文,以获取更详尽的财务资料。

公司根据自身所处的行业和经济环境等因素、公司所处的发展阶段以及业务性质等,运用重要性概念从性质和金额两方面判断财务会计信息相关事项对公司财务报表的影响。在判断相关事项性质的重要性时,公司主要考虑相关事项在性质上是否属于日常经营活动、是否可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策;在判断相关事项金额的重要性时,基于公司业务规模,盈利状况以及大多数财务报表使用者最为关注的财务指标等方面的考虑,公司选取了利润总额为基准确定重要性水平,并以利润总额的5%作为公司重要性水平判断标准。

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
流动资产:				
货币资金	552,423,095.43	290,897,496.97	235,081,339.07	522,609,809.54
交易性金融资产	346,328.00	1	-	105,311,433.27
应收账款	99,142,079.82	113,856,471.31	89,588,819.48	48,740,979.95
预付款项	32,945,913.79	6,233,077.08	5,559,234.77	4,031,778.35
其他应收款	44,228,449.50	101,032,437.73	75,112,886.08	57,108,192.89
其中: 应收股利	-	1	-	-
存货	194,539,554.85	158,684,397.15	121,009,996.89	46,461,013.60
一年内到期的非流动 资产	387,057,448.62	107,443,449.87	ı	-
其他流动资产	75,754,765.19	96,743,559.09	60,030,007.45	73,274,352.10
流动资产合计	1,386,437,635.20	874,890,889.20	586,382,283.74	857,537,559.70
非流动资产:				

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
长期股权投资	31,272,681.46	34,912,111.55	39,080,176.85	19,200,055.91
其他权益工具投资	6,676,572.42	6,250,754.33	6,116,200.09	5,874,235.57
其他非流动金融资产	49,671,029.99	49,942,421.26	20,934,897.38	-
投资性房地产	46,964,812.61	48,468,201.89	51,535,340.80	9,086,176.33
固定资产	753,067,103.44	772,295,656.33	439,599,606.55	287,937,719.61
在建工程	402,543,135.95	344,539,020.89	389,307,143.12	161,274,825.35
使用权资产	5,160,804.72	2,312,180.72	3,263,683.32	5,958,758.89
无形资产	82,778,073.59	84,444,693.89	72,629,124.38	75,472,300.72
长期待摊费用	6,799,878.94	8,441,497.78	11,827,907.55	15,660,100.76
递延所得税资产	64,907,496.92	55,440,129.69	30,328,343.10	17,996,720.98
其他非流动资产	101,227,335.51	363,428,787.35	440,081,323.20	176,897,544.30
非流动资产合计	1,551,068,925.55	1,770,475,455.68	1,504,703,746.34	775,358,438.42
资产总计	2,937,506,560.75	2,645,366,344.88	2,091,086,030.08	1,632,895,998.12
流动负债:				
短期借款	581,027,143.20	400,853,910.30	182,950,429.85	101,407,689.85
交易性金融负债	205,882.63	-	1	675,750.00
应付票据	16,389,554.11	9,930,250.00	-	-
应付账款	193,203,631.73	205,585,717.35	175,100,867.19	100,984,020.97
预收款项	115,252.78	408,709.09	92,369.60	-
合同负债	8,070,941.91	10,853,230.72	8,659,779.62	1,130,176.94
应付职工薪酬	29,019,615.83	44,980,662.94	28,796,232.28	19,813,415.47
应交税费	8,761,084.02	11,142,625.61	15,676,555.31	9,953,895.53
其他应付款	12,036,589.14	54,046,347.42	50,492,105.06	40,145,142.46
一年内到期的非流动 负债	42,071,531.39	25,465,666.33	10,400,825.15	3,698,379.54
其他流动负债	-	-	528,538.70	1,320,550.00
流动负债合计	890,901,226.74	763,267,119.76	472,697,702.76	279,129,020.76
非流动负债:				
长期借款	205,643,085.99	210,464,726.88	156,354,032.30	-
租赁负债	1,538,445.64	605,601.30	814,359.71	2,645,543.70
递延收益	284,504,826.66	166,299,778.40	73,861,277.86	74,791,119.66
递延所得税负债	3,307,403.70	3,841,800.75	5,673,153.81	5,786,842.39
非流动负债合计	494,993,761.99	381,211,907.33	236,702,823.68	83,223,505.75

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
负债合计	1,385,894,988.73	1,144,479,027.09	709,400,526.44	362,352,526.51
股东权益:				
股本	381,921,660.00	381,921,660.00	381,921,660.00	381,921,660.00
资本公积	787,332,623.20	778,780,066.54	761,819,271.56	748,212,696.12
其他综合收益	11,153,433.05	11,682,308.25	8,403,906.52	5,769,381.25
专项储备	7,309,804.51	6,206,008.83	4,104,083.26	2,139,538.96
盈余公积	5,102,850.12	5,102,850.12	3,869,568.94	2,793,754.90
未分配利润	358,788,600.92	317,188,198.57	221,502,249.26	132,728,809.34
归属于母公司股东权 益合计	1,551,608,971.80	1,500,881,092.31	1,381,620,739.54	1,273,565,840.57
少数股东权益	2,600.22	6,225.48	64,764.10	-3,022,368.96
股东权益合计	1,551,611,572.02	1,500,887,317.79	1,381,685,503.64	1,270,543,471.61
负债和股东权益总计	2,937,506,560.75	2,645,366,344.88	2,091,086,030.08	1,632,895,998.12

(二)合并利润表

单位:元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	294,337,252.67	547,938,785.55	367,707,802.87	321,765,219.56
其中: 营业收入	294,337,252.67	547,938,785.55	367,707,802.87	321,765,219.56
二、营业总成本	269,689,089.16	448,288,665.03	280,578,081.69	208,125,267.79
其中: 营业成本	171,759,029.92	252,919,284.98	138,835,557.28	88,152,558.05
税金及附加	2,872,321.47	4,052,725.48	2,174,805.42	1,840,936.18
销售费用	15,296,455.39	34,068,039.02	34,129,614.91	29,812,647.06
管理费用	42,414,213.93	81,335,751.93	65,765,114.62	50,715,873.66
研发费用	41,604,299.35	88,608,477.19	53,662,735.12	42,743,560.98
财务费用	-4,257,230.90	-12,695,613.57	-13,989,745.66	-5,140,308.14
其中: 利息费用	5,835,801.22	9,220,404.67	3,018,705.29	3,947,800.88
利息收入	11,801,768.70	21,290,313.65	16,933,658.94	2,071,680.91
加: 其他收益	23,326,485.09	20,944,665.08	17,886,530.53	19,189,050.11
投资收益(损失以"一" 号填列)	-3,639,430.09	-3,859,690.83	2,321,311.46	625,391.27
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	-3,639,430.09	-3,433,437.98	-766,144.52	-1,281,916.77
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)	-130,945.90	1,007,523.88	33,186.84	-214,387.36

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
信用减值损失(损失以"一"号填列)	417,050.89	-544,985.99	-974,134.97	-292,477.75
资产减值损失(损失以 "一"号填列)	-4,338,706.89	-6,183,023.67	-1,438,935.63	-9,424,201.32
资产处置收益(损失以 "-"号填列)	4,633,490.04	45,750.45	-313,974.10	15,985.07
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	44,916,106.65	111,060,359.44	104,643,705.31	123,539,311.79
加:营业外收入	10,910.08	59,579.50	68,807.40	2,595,445.20
减:营业外支出	417,242.92	3,976,983.75	252,041.49	719,110.37
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	44,509,773.81	107,142,955.19	104,460,471.22	125,415,646.62
减: 所得税费用	2,913,360.16	10,231,891.08	14,697,860.06	25,687,368.78
五、净利润(净亏损以 "一"号填列)	41,596,413.65	96,911,064.11	89,762,611.16	99,728,277.84
归属于母公司所有者的净 利润	41,600,402.35	96,919,230.49	89,849,253.96	100,903,009.55
少数股东损益	-3,988.70	-8,166.38	-86,642.80	-1,174,731.71
六、其他综合收益的税后 净额	-528,511.76	3,277,303.29	2,631,480.50	8,158,514.48
归属于母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-528,875.20	3,278,401.73	2,634,525.27	8,156,574.15
归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额	363.44	-1,098.44	-3,044.77	1,940.33
七、综合收益总额	41,067,901.89	100,188,367.40	92,394,091.66	107,886,792.32
归属于母公司所有者的综 合收益总额	41,071,527.15	100,197,632.22	92,483,779.23	109,059,583.70
归属于少数股东的综合收 益总额	-3,625.26	-9,264.82	-89,687.57	-1,172,791.38
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.11	0.25	0.24	0.30
(二)稀释每股收益	0.11	0.25	0.23	0.30

(三) 合并现金流量表

单位:元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务 收到的现金	341,018,902.70	578,668,721.80	365,489,784.53	325,318,306.16
收到的税费返还	18,911,847.02	13,463,738.98	24,644,513.23	27,524,440.50
收到其他与经营活动	363,446,977.74	591,162,614.12	408,557,028.35	467,184,575.45

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
有关的现金				
经营活动现金流入小 计	723,377,727.46	1,183,295,074.90	798,691,326.11	820,027,322.11
购买商品、接受劳务 支付的现金	236,637,183.09	296,034,944.20	230,216,909.44	106,044,015.75
支付给职工以及为职 工支付的现金	60,162,389.87	84,395,322.35	63,717,684.10	45,593,772.75
支付的各项税费	18,070,933.68	45,358,521.69	30,518,333.49	29,684,626.94
支付其他与经营活动 有关的现金	217,224,222.71	565,918,685.01	386,274,196.57	489,370,573.47
经营活动现金流出小 计	532,094,729.35	991,707,473.25	710,727,123.60	670,692,988.91
经营活动产生的现金 流量净额	191,282,998.11	191,587,601.65	87,964,202.51	149,334,333.20
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	40,000,000.00	53,956,934.50	522,242,674.41	634,995,500.00
取得投资收益收到的 现金	5,486,130.97	1,141,389.21	2,787,267.38	6,300,687.88
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	8,129,144.00	-	555,225.30	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	-	734,120.81	-	-
收到其他与投资活动 有关的现金	-	-	68,000,000.00	75,166.59
投资活动现金流入小 计	53,615,274.97	55,832,444.52	593,585,167.09	641,371,354.47
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	122,388,028.88	409,272,898.76	368,604,404.85	271,370,515.31
投资支付的现金	157,311,668.66	62,008,045.94	763,290,538.76	788,310,792.08
支付其他与投资活动 有关的现金	-	-	-	68,000,000.00
投资活动现金流出小 计	279,699,697.54	471,280,944.70	1,131,894,943.61	1,127,681,307.39
投资活动产生的现金 流量净额	-226,084,422.57	-415,448,500.18	-538,309,776.52	-486,309,952.92
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	643,072,726.31
取得借款收到的现金	546,196,102.62	732,182,079.42	361,052,953.97	218,687,940.67
收到其他与筹资活动 有关的现金	35,650,850.00	85,245,170.30	49,497,677.73	30,000,000.00

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
筹资活动现金流入小 计	581,846,952.62	817,427,249.72	410,550,631.70	891,760,666.98
偿还债务支付的现金	354,459,227.12	444,327,017.54	116,132,220.99	213,539,334.98
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	8,350,161.99	10,647,391.31	3,199,557.17	3,108,232.16
支付其他与筹资活动 有关的现金	12,842,992.90	105,637,930.95	28,077,186.81	80,794,808.14
筹资活动现金流出小 计	375,652,382.01	560,612,339.80	147,408,964.97	297,442,375.28
筹资活动产生的现金 流量净额	206,194,570.61	256,814,909.92	263,141,666.73	594,318,291.70
四、汇率变动对现金 及现金等价物的影响	-2,923,478.74	4,494,166.59	919,286.53	2,086,281.78
五、现金及现金等价 物净增加额	168,469,667.41	37,448,177.98	-186,284,620.75	259,428,953.76
加:期初现金及现金 等价物余额	247,292,016.49	209,843,838.51	396,128,459.26	136,699,505.50
六、期末现金及现金 等价物余额	415,761,683.90	247,292,016.49	209,843,838.51	396,128,459.26

二、审计意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司报告期内的财务报表进行了审计,认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度、2022 年度的经营成果和现金流量,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(容诚审字[2025]510Z0197 号审计报告)。

三、关键审计事项

(一) 收入确认

相关会计期间: 2025年1-6月、2024年度、2023年度、2022年度。

1、事项描述

2025年1-6月、2024年度、2023年度、2022年度,恒坤新材公司合并报表所列示的销售商品收入金额分别为人民币29,433.73万元、54,793.88万元、36,770.78万元、32,176.52万元。由于收入是关键业绩指标,可能存在管理层为了达到特定目标或舞弊虚增收入确认的固有风险;因此会计师将收入确认识别为

关键审计事项。

2、审计应对

针对销售商品收入确认,会计师实施的审计程序包括但不限于以下:

- (1)了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其 是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
- (2) 检查框架协议与订单合同,识别与商品或服务控制权转移相关的合同 条款及条件,评价收入确认政策是否符合相关会计准则的规定:
- (3) 实施函证程序,向申报期内主要客户进行函证,函证内容包括各期销售交易额、往来余额、收款与开票金额、以及实物返货事项;对于未回函的客户执行替代程序;
 - (4) 对申报期内主要客户实施现场走访程序;
- (5) 对收入的真实性实施核查程序,选取样本检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同或订单、报关单、货运单、客户签收单、寄售结算单、销售发票以及收款流水等原始单据;
 - (6) 执行销售收入截止性测试,评价收入是否确认在恰当的会计期间;
- (7)对营业收入及毛利率按产品、月度、主要客户等实施综合分析程序, 识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因。

(二)固定资产及在建工程确认

相关会计期间: 2025年1-6月、2024年度、2023年度、2022年度。

1、事项描述

截至 2025 年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日,合并财务报表中固定资产和在建工程账面价值合计分别 115,561.02 万元、111,683.47 万元、82,890.67 万元、44,921.25 万元,占资产总额比例分别 为 39.34%、42.22%、39.64%、27.51%。由于固定资产及在建工程的账面价值金 额重大,对财务报表的影响较大,因此会计师将固定资产及在建工程的确认识别 为关键审计事项。

2、审计应对

- (1)了解和评价管理层与固定资产、在建工程相关的内部控制设计的合理性,并测试了关键控制执行的有效性;
- (2)了解并评价固定资产及在建工程的会计政策,获取固定资产明细表及 在建工程明细表,并与总账核对是否一致;
- (3)抽样检查本期新增的工程成本,检查与之相关的工程合同,并将实际付款的金额核对至发票和付款凭证;通过抽样检查本期新增的固定资产,核对合同、发票、验收单等支持性文件;
- (4) 实地检查固定资产及在建工程,并实施监盘程序,以了解固定资产状态及在建工程进度;
- (5) 获取固定资产累计折旧明细表,按照固定资产折旧方法对其折旧进行 重新计算,复核累计折旧金额计提的准确性;
- (6) 检查预付工程款,结合函证程序复核期末余额的准确性,实地观察工程施工进度及设备到货安装情况,确定资产入账的准确性和完整性;
- (7)结合应付账款函证,向主要工程及设备供应商函证本期采购金额,开票金额,付款金额和主要合同内容;
- (8)检查与固定资产及在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当 列报。

四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况

(一) 财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则及 其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。此外, 公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财 务报告的一般规定(2023 年修订)》披露有关财务信息。

2、持续经营

公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响公司持续经营能力的事项,公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

(二)合并财务报表范围及变化情况

2022年9月23日,公司完成翌光半导体(厦门)有限公司注销手续。翌光半导体(厦门)有限公司的全部资产、负债及权益由公司承接。

2022 年 11 月 21 日,公司之子公司恒坤精密工业香港有限公司与康文兵、陶峥、村田诚签署《精容株式会社股权转让协议》,协议约定康文兵将其持有的精容株式会社的 80%股权转让给香港恒坤,2022 年 12 月 20 日支付了股权转让款,并实际取得了对精容株式会社的控制权。

2023年4月13日,公司通过投资新设的方式成立漳州链芯半导体有限公司,公司自2023年起将其纳入合并范围。

2023年11月29日,公司通过投资新设的方式成立福建司理可新材料有限公司,公司自2023年起将其纳入合并范围。

2023年12月6日,公司通过投资新设的方式成立上海芯远精材新材料有限公司,公司自2023年起将其纳入合并范围。

2024年8月9日,子公司晟明坤(厦门)材料科技有限公司注销。

报告期纳入合并财务报表范围的子公司的情况如下:

子公司名称	主要经	注册	业务性质	持股比例	(%)	取得方式
丁公刊石柳	营地	地	业 分 任从	直接	间接	以待 刀入
恒坤精密工业香港有 限公司	中国香港	中国 香港	集成电路材料的 销售	100.00	_	出资设立
楚坤(上海)新材料科 技有限公司	上海	上海	集成电路材料的 销售	100.00	_	出资设立
精容株式会社	日本	日本	集成电路材料的 销售	_	95.00	非同一控制 下企业合并
漳州链芯半导体有限 公司	漳州	漳州	集成电路材料的 销售	100.00	_	出资设立
大连恒坤新材料有限 公司	大连	大连	集成电路材料的 制造与销售	100.00	1	出资设立
福建泓光半导体材料 有限公司	漳州	漳州	集成电路材料的 制造与销售	100.00	_	出资设立

子公司名称	主要经	注册	业务性质	持股比例	(%)	取得方式
丁公刊名称	营地 地	地	业务任从	直接	间接	以行 刀八
泓坤微电子(厦门)有 限公司	厦门	厦门	集成电路材料的 制造与销售	100.00		出资设立
武汉恒坤新材料科技 有限公司	武汉	武汉	集成电路材料的 制造与销售	100.00	l	出资设立
安徽恒坤新材料科技 有限公司	合肥	合肥	集成电路材料的 制造与销售	100.00	ı	出资设立
福建恒晶新材料科技 有限公司	漳州	漳州	集成电路材料的 研发	100.00	-	出资设立
晟明坤(厦门)材料科 技有限公司	厦门	厦门	集成电路材料的 研发	70.00	_	出资设立
福建司理可新材料有 限公司	漳州	漳州	集成电路材料的 制造与销售	100.00	_	出资设立
上海芯远精材新材料 有限公司	上海	上海	集成电路材料的 研发	100.00	_	出资设立

五、重要会计政策和会计估计

公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

(一) 收入确认原则和计量方法

1、一般原则

收入是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义 务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务, 按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时,如果存在可变对价,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中

如果存在重大融资成分,公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销,对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

- ①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;
- ②客户能够控制公司履约过程中在建的商品:
- ③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法(或产出法)确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,公司会考虑下列迹象:

- ①公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;
- ②公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有了该商品的法定所有权:
 - ③公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;
- ④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;
 - ⑤客户已接受该商品。
 - A. 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售,公司在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债或其他流动负债;同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,即应收退货成本,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。

B. 客户未行使的合同权利

公司向客户预收销售商品或服务款项的,首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。当公司预收款项无需退回,且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时,公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入;否则,公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时,才将上述负债的相关余额转为收入。

C. 主要责任人与代理人

公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时公司的身份是主要责任人还是代理人。公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,公司是主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入。否则,公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

在引进产品销售业务中,公司分别与供应商及客户签订合同,但不是合同的首要义务人,实际为代理人。因此,公司对该类业务以净额法确认收入,相关款项往来作为代收代付款进行会计处理,形成的债权债务分别在其他应收款、其他应付款列报。

2、具体方法

公司收入确认的具体方法如下:

① 商品销售合同

公司与客户之间的销售商品合同,属于在某一时点履行的履约义务。

A. 普通销售模式

普通销售模式下,公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬,相关产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。区分自产产品与引进产品销售下的收入确认具体方法:

自产产品销售在货物交付客户并经其签收后视同控制权转移,公司在取得客户签收单时确认收入。

引进产品销售按照国际通行的贸易条件所规定的控制权转移的时点确认收入。其中: CIF下,公司在报关并取得报关单时确认收入; DDP和 DAP下,公司在货物送达客户指定地点并取得客户签收单时确认收入。

B.寄售模式

产品在客户从寄售仓领用公司产品时视同控制权转移,公司定期与客户确认 领用数量和库存数量并形成结算单,产品销售收入金额已确定,且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量,公司根据客户确认的结算单确认收入。

② 租赁合同

公司为客户提供的租赁业务,属于在某一时间段内履行的履约义务,按照时段法确认收入。在租赁期内各个期间,公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

(二) 金融工具

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

当公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- ②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,应当终止原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款规定,在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日,是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2、金融资产的分类与计量

公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非公司改变管理金融资产的业务模式,在此情形下,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相 关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不 考虑重大融资成分的应收票据及应收账款,公司则按照收入准则定义的交易价格 进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类:

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标:该金融资产的合同条款

规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允 价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损 失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。

3、金融负债的分类与计量

公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。但公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益,当该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指,当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款 偿付债务时,要求公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保 合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认 金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后,对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外,金融负债与权益工具按照下列原则进行区分:

①如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的,还是

完全或部分地基于除公司自身权益工具的市场价格以外变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

4、衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量,并以其公 允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价 值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目 影响损益时转出计入当期损益之外,衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失, 直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如主合同为金融资产的,混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产,且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

5、金融工具减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生

的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自 初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收账款、其他应收款,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个 存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收账款确定组合的依据如下:

应收账款组合 1	账龄组合
应收账款组合 2	应收合并范围内关联方款项

对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以

及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下:

其他应收款组合 1	应收利息
其他应收款组合 2	应收股利
其他应收款组合 3	账龄组合
其他应收款组合 4	应收合并范围内关联方款项

对于划分为组合的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

公司基于账龄确认信用风险特征组合的预期信用损失计算方法:

账 龄	应收账款(%)	其他应收款(%)
1年以内(含1年)		
其中: 6个月以内	1.00	1.00、5.00
6-12 月	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	100.00	100.00
5年以上	100.00	100.00

说明:其他应收款账龄在6个月以内的计提比例存在1%和5%,其中1%的计提组合系公司引进产品销售业务执行净额法确认收入政策下,形成的代收代付款项;5%的计提组合系其他往来款项。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率,以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括:

- A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;
- B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;
- C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
 - E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;
- F.借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;
 - G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
 - H.合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

根据金融工具的性质,公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用 风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,公司可基于共同信用风 险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下,如果逾期超过 30 日,公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天,但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未 来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用 减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违 约或逾期等;债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人 在任何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组; 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;以大幅折扣购买或源 生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

6、金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形:

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方:

B.将金融资产整体或部分转移给另一方,但保留收取金融资产现金流量的合

同权利,并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,但放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时,根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方, 且没有额外条件对此项出售加以限制的,则公司已放弃对该金融资产的控制。

公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时,注重金融资产 转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

A. 所转移金融资产的账面价值;

B.因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产视同继续 确认金融资产的一部分)之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将 下列两项金额的差额计入当期损益:

A.终止确认部分在终止确认目的账面价值;

B.终止确认部分的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,且未放弃对该金融资产控制的,应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度,是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,应当继续确认 所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间,企业应当继续确认该金融资产产生的收入(或利得)和该金融负债产生的费用(或损失)。

7、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

8、金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本节"(三)公允价值计量"。

(三) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收 到或者转移一项负债所需支付的价格。

公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值,不存在主要市场的,公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场,是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场;最有利市场,是指在考虑交易费用和运输费用后,能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债,公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生 经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生 经济利益的能力。

① 估值技术

公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值 技术,使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。公司使用与其中一种 或多种估值技术相一致的方法计量公允价值,使用多种估值技术计量公允价值的, 考虑各估值结果的合理性, 选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

公司在估值技术的应用中,优先使用相关可观察输入值,只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。可观察输入值,是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值,是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次,并首先使用第一层次输入值,其次使用第二层次输入值,最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(四) 存货

1、存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品、在途物资等。

2、发出存货的计价方法

公司存货发出时采用加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

公司存货采用永续盘存制,每年至少盘点一次,盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

4、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

- ①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
- ②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。
 - ③公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额 予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损 益。

5、周转材料的摊销方法

- ①低值易耗品摊销方法: 在领用时采用一次转销法。
- ②包装物的摊销方法: 在领用时采用一次转销法。

(五) 固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

1、确认条件

固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

2、各类固定资产的折旧方法

公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧,按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下:

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备及仓储设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4-5	5.00	19.00-23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

对于已经计提减值准备的固定资产,在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了,公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命。

(六) 在建工程

- 1、在建工程以立项项目分类核算。
- 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

公司各类别在建工程具体转固标准和时点:

类 别	转固标准和时点
房屋及建筑物	(1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工; (2) 建造工程在达到预定设计要求, 经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收; (3) 经消防、国土、规划等外部部门验收; (4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的, 自达到预定可使用状态之日起, 据工程实际造价按预估价值转入固定资产。
需安装调试的机器 设备	(1)相关设备及其他配套设施已安装完毕; (2)设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行; (3)生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品; (4)设备经过资产管理人员和使用人员验收。

(七) 无形资产

1、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

2、无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权	20年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
非专利技术	15年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了,公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产,公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果重新复核后仍为不确定的,于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产,公司在取得时确定其使用寿命,在使用寿命内采用直线法系统合理摊销,摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产,还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产,其残值视为零,但下列情况除外:有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息,并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定 的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

3、研发支出归集范围

公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出,包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、测试化验加工费等。

4、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段,无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时,才能确认为无形资产:

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- C.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
 - E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,公司将发生的研发支出全部计入 当期损益。

(八) 股份支付

1、股份支付的种类

公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。②对于授予职工的股票期权,在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权,公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等 后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工 具的最佳估计。

4、股份支付计划实施的会计处理

(1) 以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以公司承担负债的 公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日 和结算日对负债的公允价值重新计量,将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的 股份支付,在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础, 按公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负 债。

(2) 以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的 以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具 数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入 成本或费用和资本公积。

5、股份支付计划修改的会计处理

公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;若修改增加了所授予权益工具的数量,则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

6、股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),公司:

- ①将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额;
- ②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理,回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用。

公司如果回购其职工已可行权的权益工具,冲减企业的所有者权益;回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期损益。

(九) 重要会计判断和估计

公司根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下:

1、金融资产的分类

公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式,考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时,存在以下主要判断:本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动;利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如,提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息,以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

2、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

3、未上市的权益投资的公允价值

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前 折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求公司估计预期未来现金流量和折 现率,因此具有不确定性。在有限情况下,如果用以确定公允价值的信息不足, 或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值 的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(十) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则解释第15号》

2021年12月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)(以下简称"解释15号"),"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行,"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"(以下简称"试运行销售的会计处理规定")和"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。执行解释15号的相关规定对公司报告期内财务报表无重大影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号), 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,公司于2022年1月1日执行解释16号的该项规定,对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2021年1月1日)至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易,公司按照解释16号的规定进行调整;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"、方容自公布之日起施行。执行解释16号的相关规定对公司报告期内财务报表无重大影响。

(3) 执行《企业会计准则解释第 17 号》

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对公司报告期内财务报表无重大影响。

(4) 保证类质保费用重分类

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》,规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期内,公司无重大会计估计变更。

六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚专字[2025]510Z0446 号《非经常性损益的鉴证报告》,公司报告期内非经常性损益的情况如下表所示:

单位:万元

项目	2025年 1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值 准备的冲销部分	421.80	-66.20	-35.14	0.57
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	908.47	696.19	798.42	1,069.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益	-13.09	23.22	33.34	-21.44
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	35.21	278.73	190.73
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	0.21
因立即授予且没有明确约定服务期等限制条 件或职工自愿放弃行权一次性确认的股份支 付费用	-	-	-	-119.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.91	-320.96	-14.58	188.45
非经常性损益总额	1,318.09	367.46	1,060.76	1,308.03

项目	2025年 1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
减: 非经常性损益的所得税影响数	232.03	105.83	228.61	321.26
非经常性损益净额	1,086.07	261.63	832.15	986.77
减: 归属于少数股东的非经常性损益净额	-	0.07	-	0.00
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	1,086.07	261.56	832.15	986.77

报告期内,归属于公司普通股股东的非经常性损益净额分别为986.77万元、832.15万元、261.56万元和1,086.07万元,主要系取得的政府补助。报告期内,公司归属于公司普通股股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东净利润的比例分别为9.78%、9.26%、2.70%和26.11%,公司对非经常性损益不存在重大依赖。

七、主要税种及税收政策

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率		
增值税	应税收入	5%, 6%, 9%, 13%		
房产税	从价计征,按房产税原值扣除 30%后的余值	从价计税: 1.20%		
<i>万)</i> 亿	从租计征, 按租金收入	从租计价: 12.00%		
城镇土地使用税	以实际占用的土地面积计缴	3.20 元/m²、4.00 元/m² 5.00 元/m²、6.00 元/m²		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%		
教育费附加	应纳流转税额	3%		
地方教育附加	应纳流转税额	2%		
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%		

公司及子公司存在不同企业所得税税率的情况:

	所得税税率						
约优主	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度			
厦门恒坤新材料科技股份有限公司	25%	25%	25%	25%			
楚坤(上海)新材料科技有限公司	25%	25%	25%	25%			
福建泓光半导体材料有限公司	15%	15%	15%	15%			
大连恒坤新材料有限公司	15%	15%	15%	15%			
福建恒晶新材料科技有限公司	20%	20%	20%	20%			

研书 子体 <i>标</i>		所得税和	 说率	
纳税主体名称	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
泓坤微电子(厦门)有限公司	20%	20%	20%	20%
翌光半导体(厦门)有限公司	不适用	不适用	不适用	20%
安徽恒坤新材料科技有限公司	25%	25%	25%	20%
武汉恒坤新材料科技有限公司	20%	20%	20%	20%
晟明坤 (厦门) 材料科技有限公司	不适用	20%	20%	20%
恒坤精密工业香港有限公司	16.50%	16.50%	16.50%	16.50%
精容株式会社	15%	15%	15%	15%
漳州链芯半导体有限公司	20%	20%	20%	不适用
福建司理可新材料有限公司	20%	20%	20%	不适用
上海芯远精材新材料有限公司	20%	20%	20%	不适用

翌光半导体(厦门)有限公司于 2022 年注销,精容株式会社于 2022 年通过非同一控制下收购纳入合并报表,漳州链芯半导体有限公司、福建司理可新材料有限公司、上海芯远精材新材料有限公司于 2023 年新设,晟明坤(厦门)材料科技有限公司于 2024 年注销。

(二) 税收优惠

1、企业所得税

(1) 高新技术企业税收优惠

2021年12月15日,公司之子公司福建泓光半导体材料有限公司取得福建省科学技术厅、福建省财政厅和国家税务总局福建省税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202135002549,有效期三年);2024年12月4日,福建泓光半导体材料有限公司再次取得福建省科学技术厅、福建省财政厅和国家税务总局福建省税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202435001559,有效期三年)。故2021年至2026年福建泓光半导体材料有限公司适用高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

2022 年 12 月 14 日,公司之子公司大连恒坤新材料有限公司取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅和国家税务总局辽宁省税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202221200623,有效期三年)。故 2022 年至 2024 年大连

恒坤新材料有限公司适用高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。大连恒坤新材料有限公司已于 2025 年 6 月 16 日提交高新技术企业资格复审,由于大连恒坤新材料有限公司持续符合高新技术企业的认定条件,预计高新技术企业证书续期不存在障碍。

根据《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76号)规定,自 2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。公司之子公司福建泓光半导体材料有限公司、大连恒坤新材料有限公司符合高新技术企业资格,尚未弥补完的亏损准予结转以后年度10年。

(2) 集成电路企业两免三减半税收优惠

根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财税〔2020〕45 号〕规定,对国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。公司之子公司福建泓光半导体材料有限公司享受两免三减半政策,自 2023 年度开始获利,于 2023 年度、2024 年度享受免征企业所得税,于 2025 年度至 2027 年度享受减按 12.5%征收企业所得税。

(3) 小微企业税收优惠

根据财政部、税务总局 2021 年 4 月 2 日联合颁发的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号),自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。

根据财政部、税务总局 2022 年 3 月 14 日联合颁发的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号),自 2022年1月1日至 2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万

元但不超过 300 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳 企业所得税。

根据财政部、税务总局 2023 年 3 月 26 日联合颁发的《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号),自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、税务总局 2023 年 8 月 2 日联合颁发的《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号),对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

2022 年度享受小微企业税收优惠的公司:福建恒晶新材料科技有限公司、 泓坤微电子(厦门)有限公司、翌光半导体(厦门)有限公司、武汉恒坤新材料 科技有限公司、晟明坤(厦门)材料科技有限公司。

2023 年度享受小微企业税收优惠的公司:福建恒晶新材料科技有限公司、 泓坤微电子(厦门)有限公司、武汉恒坤新材料科技有限公司、晟明坤(厦门) 材料科技有限公司、漳州链芯半导体有限公司、福建司理可新材料有限公司、上 海芯远精材新材料有限公司。

2024 年度享受小微企业税收优惠的公司:福建恒晶新材料科技有限公司、 泓坤微电子(厦门)有限公司、武汉恒坤新材料科技有限公司、晟明坤(厦门) 材料科技有限公司、漳州链芯半导体有限公司、福建司理可新材料有限公司、上 海芯远精材新材料有限公司。

2025年1-6月享受小微企业税收优惠的公司:福建恒晶新材料科技有限公司、 泓坤微电子(厦门)有限公司、武汉恒坤新材料科技有限公司、漳州链芯半导体 有限公司、福建司理可新材料有限公司、上海芯远精材新材料有限公司。

2、增值税

根据《财政部 税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》(财税(2023)17号)规定,自2023年1月1日至2027年12月31日,允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业(以下称集成电路企业),按照当期可

抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。公司及子公司福建泓光半导体材料有限公司享受进项税额加计抵减政策。

八、分部信息

报告期内,公司按产品类别、地区分布的分部信息,参见本招股意向书"第六节 财务会计信息与管理层分析"之"十、经营成果分析"之"(一)营业收入分析"之"2、主营业务收入构成及变动分析"。

九、主要财务指标

(一) 主要财务指标

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
流动比率 (倍)	1.56	1.15	1.24	3.07
速动比率 (倍)	1.34	0.94	0.98	2.91
资产负债率	47.18%	43.26%	33.92%	22.19%
归属于公司股东的每股净资产 (元/股)	4.06	3.93	3.62	3.33
项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
应收账款周转率(次/年)	5.47	5.33	5.26	8.14
存货周转率(次/年)	1.86	1.74	1.57	2.03
息税折旧摊销前利润 (万元)	8,948.01	18,017.11	15,496.39	17,071.84
利息保障倍数 (倍)	15.33	19.54	51.33	43.24
归属于母公司股东的净利润(万元)	4,160.04	9,691.92	8,984.93	10,090.30
归属于母公司股东扣除非经常 性损益后的净利润(万元)	3,073.97	9,430.36	8,152.78	9,103.53
研发投入占营业收入的比例(%)	14.13	16.17	14.59	13.28
每股经营活动产生的现金流量 (元/股)	0.50	0.50	0.23	0.39
每股净现金流量(元/股)	0.44	0.10	-0.49	0.68

- 注: 上述财务指标的计算公式如下:
- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
- 4、归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计额/期末普通股份总数
- 5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 6、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧费+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- 8、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息费用

- 9、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
- 10、每股经营活动产生的现金流量=经营活动现金流量净额/期末总股本
- 11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股份总数

(二)净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订),报告期内发行人的净资产收益率和每股收益如下:

		加权平均净资产	每股	每股收益			
项目 	报告期间	报告期间 收益率(%)		稀释每股收益 (元/股)			
	2025年1-6月	2.73	0.11	0.11			
归属于公司普通股股 东的净利润	2024 年度	6.78	0.25	0.25			
	2023 年度	6.78	0.24	0.23			
	2022 年度	14.72	0.30	0.30			
	2025年1-6月	2.02	0.08	0.08			
扣除非经常性损益后	2024 年度	6.59	0.25	0.24			
归属于公司普通股股 东的净利润	2023 年度	6.15	0.21	0.21			
	2022 年度	13.28	0.28	0.28			

- 注:每股收益和净资产收益率的计算公式为:
- 1、加权平均净资产收益率的计算公式如下:

加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中: P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M0 为报告期月份数; Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的,计算加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从报告期期初起进行加权;计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时,被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权;计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

2、基本每股收益可参照如下公式计算:

基本每股收益=P0÷S

 $S=S0+S1+Si\times Mi+M0-Sj\times Mj+M0-Sk$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益可参照如下公式计算:

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si\times Mi+M0-Sj\times Mj+M0-Sk+$ 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

十、经营成果分析

报告期内,公司经营成果主要项目变动情况如下:

单位:万元,%

项目 —	2025年1-6月		2024年	度	2023 年度 2022 年度			度
	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅
营业收入	29,433.73	23.74	54,793.88	49.01	36,770.78	14.28	32,176.52	127.93
营业毛利	12,257.82	-5.62	29,501.95	28.90	22,887.22	-2.03	23,361.27	138.32
营业利润	4,491.61	-16.02	11,106.04	6.13	10,464.37	-15.30	12,353.93	317.94
利润总额	4,450.98	-16.72	10,714.30	2.57	10,446.05	-16.71	12,541.56	313.78
净利润	4,159.64	-5.68	9,691.11	7.96	8,976.26	-9.99	9,972.83	275.42

2022 年,随着下游客户需求的增长及公司自产规模的扩大,公司营业收入和净利润较上年度同比快速增长。2023 年,公司自产业务收入仍保持增长,但受下游终端消费市场周期性影响,部分客户对引进光刻材料和前驱体需求下降,公司整体营业收入增速有所下降,营业毛利与上年度基本持平。同时,随着公司自产业务的不断扩张和研发投入持续增加,公司销售、管理及研发费用合计较上年度增加了 3,028.54 万元,导致公司当期净利润较上年度有所下降。2024 年,公司自产业务收入进一步增长,营业收入和净利润均较上年度同比增长。

2025年1-6月,公司营业收入较上年同期增长23.74%,主要系公司自产业务收入大幅增加10,506.36万元,增幅达72.60%,完全抵消了因部分引进产品合作终止对引进业务收入的影响。2025年1-6月,公司利润总额、净利润较上年同期分别减少893.76万元、250.28万元,降幅分别为16.72%、5.68%,主要原因系:(1)受部分引进产品合作终止的影响,公司引进业务毛利有所下降,但同时公司自产业务毛利大幅增加4,179.72万元,增幅达102.45%,较大程度上抵消了引进业务毛利下降的影响,整体毛利金额小幅下降5.62%;(2)一方面公司积极推进自产产品的开发,研发投入保持持续增长;另一方面安徽工厂已具备逐步投

入运营的条件,相关长期资产陆续完成转固,致使 2025 年折旧费用及日常经营费用有所增加;而前述研发和资产投入短期内尚未产生效益,故导致公司利润总额出现阶段性下滑。长期来看,随着新产品的不断导入,以及安徽工厂正式量产后产能陆续释放,将有助于提升公司未来持续经营能力。

(一) 营业收入分析

1、营业收入构成及变动分析

报告期内,公司营业收入构成如下:

单位:万元,%

	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	28,814.25	97.90	53,975.18	98.51	36,153.01	98.32	31,733.92	98.62
其他业务收入	619.47	2.10	818.70	1.49	617.77	1.68	442.60	1.38
营业收入合计	29,433.73	100.00	54,793.88	100.00	36,770.78	100.00	32,176.52	100.00

报告期内,公司主营业务突出,各期主营业务收入占营业收入的比例均在95%以上,其他业务收入主要为租金收入等,收入发生额及占比均较小。

2、主营业务收入构成及变动分析

(1) 按产品分类分析

报告期内,公司主营业务收入按照产品类别分类情况如下:

单位:万元,%

项目	2025年	1-6月	2024 출	F度	2023 年度		2022 年度	
坝日	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自产产品	24,977.42	86.68	34,418.93	63.77	19,058.84	52.72	12,357.89	38.94
光刻材料	21,928.71	76.10	29,998.67	55.58	17,202.90	47.58	12,168.58	38.35
前驱体材料	3,048.70	10.58	4,420.26	8.19	1,855.93	5.13	189.31	0.60
引进产品	3,836.84	13.32	19,556.25	36.23	17,094.17	47.28	19,376.03	61.06
光刻材料	981.16	3.41	14,711.02	27.26	12,141.90	33.58	14,290.10	45.03
前驱体材料	1,065.70	3.70	1,828.08	3.39	2,449.56	6.78	3,556.56	11.21
电子特气	768.96	2.67	1,921.99	3.56	1,728.88	4.78	1,208.19	3.81
其他	1,021.00	3.54	1,095.17	2.03	773.83	2.14	321.18	1.01

项目 2025年1-6月		1-6月	2024 출	F度	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收 入合计	28,814.25	100.00	53,975.18	100.00	36,153.01	100.00	31,733.92	100.00

报告期内,公司主营业务产品包括自产产品和引进产品。其中,自产产品销售收入分别为 12,357.89 万元、19,058.84 万元、34,418.93 万元和 24,977.42 万元,占主营业务收入的比例分别为 38.94%、52.72%、63.77%和 86.68%,收入规模和占比逐年上升。

①自产产品

报告期内,公司自产产品包括 SOC、BARC、i-Line 光刻胶、KrF 光刻胶等 光刻材料和硅基前驱体材料、金属基前驱体材料等前驱体材料,各产品具体占比 及变动情况分析如下:

A、光刻材料

单位:万元,%

项目	2025年	1-6月	2024 年	度	2023 출	F 度	2022 年	度
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
SOC	16,495.34	75.22	23,236.34	77.46	14,473.48	84.13	11,258.71	92.52
BARC	3,487.53	15.90	4,603.55	15.35	1,913.61	11.12	774.86	6.37
i-Line 光刻胶	624.44	2.85	715.19	2.38	354.87	2.06	91.00	0.75
KrF 光刻胶	1,235.52	5.63	1,352.31	4.51	458.30	2.66	44.02	0.36
ArF 光刻胶	49.58	0.23	44.02	0.15	-	-	-	-
其他	36.30	0.17	47.25	0.16	2.64	0.02	-	-
合计	21,928.71	100.00	29,998.67	100.00	17,202.90	100.00	12,168.58	100.00

报告期内,公司自产光刻材料中 SOC 收入金额分别为 11,258.71 万元、14,473.48 万元、23,236.34 万元和 16,495.34 万元,占各期自产光刻材料收入的比例均超过 75%; BARC 于 2021 年实现销售、i-Line 光刻胶、KrF 光刻胶于 2022年实现销售,并均实现快速增长。

报告期内,公司 SOC 收入金额分别同比增长了 201.72%、28.55%、60.54% 和 61.27%,持续增长,主要是由于:(1)公司 SOC 种类不断丰富,各期实现规模销售的产品数量持续增加;(2)公司持续推进 SOC 在其他晶圆厂的验证工作,

新增多家境内知名客户; (3)公司 SOC 随着主要客户业务规模的扩大及供应链安全措施的推进,其对公司 SOC 的需求大幅增加。

2021年,公司BARC开始实现销售。报告期内,公司BARC种类不断丰富,原客户需求较 2021年明显增加,同时公司不断拓展新的客户,使得公司当期BARC收入分别较上年同期同比大幅增长了1,135.23%、146.96%、140.57%和104.51%。

2022年,公司 i-Line 光刻胶、KrF 光刻胶开始实现销售,分别实现销售收入 91.00万元和 44.02万元。2023年,随着客户需求的增长,公司 i-Line 光刻胶、KrF 光刻胶分别实现销售收入 354.87万元和 458.30万元,较上年度同比增长 289.97%和 941.12%。2024年度,客户需求进一步增长,公司 i-Line 光刻胶、KrF 光刻胶分别实现销售收入 715.19万元和 1,352.31万元,较上年度同比增长 101.53% 和 195.07%。2025年 1-6月,公司 i-Line 光刻胶、KrF 光刻胶分别实现销售收入 624.44万元和 1,235.52万元,较上年同期同比增长 133.70%和 134.64%。

2024年,公司 ArF 光刻胶开始取得部分收费订单,当期实现销售收入 44.02万元。2025年 1-6月,公司 ArF 光刻胶实现销售收入 49.58万元,已超过去年全年水平。

B、前驱体材料

单位:万元,%

项目	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
硅基前驱体	3,048.70	100.00	4,420.26	100.00	1,843.81	99.35	148.90	78.65
金属基前驱体	-	-	-	-	11.33	0.61	36.61	19.34
其他	-	-	-	-	0.80	0.04	3.81	2.01
合计	3,048.70	100.00	4,420.26	100.00	1,855.93	100.00	189.31	100.00

报告期内,公司自产前驱体材料收入金额分别为189.31万元、1,855.93万元、4,420.26万元和3,048.70万元。公司自主生产的TEOS陆续实现销售,收入规模保持较快增长趋势。

②引进产品

报告期内,公司引进产品包括 KrF 光刻胶、BARC、ArF 光刻胶、i-Line 光

刻胶等光刻材料,硅基前驱体、金属基前驱体等前驱体材料和电子特气及其他湿化学品产品,各产品具体占比及变动情况分析如下:

A、光刻材料

单位:万元,%

项目 -	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
KrF 光刻胶	902.68	92.00	12,912.28	87.77	10,409.54	85.73	12,010.23	84.05
BARC	1	-	1,049.13	7.13	952.01	7.84	1,572.40	11.00
ArF 光刻胶	-	-	663.64	4.51	664.32	5.47	648.80	4.54
i-Line 光刻胶	78.48	8.00	85.96	0.58	116.03	0.96	58.67	0.41
合计	981.16	100.00	14,711.02	100.00	12,141.90	100.00	14,290.10	100.00

报告期内,公司引进光刻材料以 KrF 光刻胶为主,其收入金额分别为12,010.23 万元、10,409.54 万元、12,912.28 万元和 902.68 万元,占各期引进光刻材料收入的比例均超过 80%。

2022年,公司引进光刻材料产品收入金额同比增长了128.28%,其中各类产品收入规模均保持大幅增长,主要是由于公司引进光刻材料产品主要客户随着业务规模的扩大及供应链安全措施的推进,其对公司相关产品的需求大幅增加。2023年,公司引进光刻材料产品收入金额同比下降了15.03%,主要是受下游终端消费市场周期性影响,部分客户对引进 KrF 光刻胶和 BARC 的采购量有所下降。2024年度,下游终端消费市场有所回温,引进光刻材料产品收入金额有所上升。2025年1-6月,引进光刻材料产品收入大幅下滑,主要系自2025年起,公司与SKMP之间终止了销售给客户A1的光刻材料产品合作。

B、前驱体材料

单位:万元,%

项目	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
硅基前驱体	1,050.83	98.60	1,794.17	98.15	2,411.64	98.45	3,474.75	97.70
金属基前驱体	14.87	1.40	33.90	1.85	37.91	1.55	81.81	2.30
合计	1,065.70	100.00	1,828.08	100.00	2,449.56	100.00	3,556.56	100.00

报告期内,公司引进前驱体材料主要为硅基前驱体,其收入金额分别为

3,474.75 万元、2,411.64 万元、1,794.17 万元和 1,050.83 万元,占各期引进前驱体材料收入的比例均超过 97%。

2022年,公司引进前驱体材料收入金额同比增长了 37.76%,随着主要客户业务规模的扩大,需求大幅增加。2023年,公司引进前驱体类产品收入金额同比下降了 31.13%,主要是受下游终端消费市场周期性影响,部分客户对引进前驱体的需求有所下降,且原引进 TEOS 已逐步切换成公司自产 TEOS。2024年度,随着公司自产 TEOS 替代持续推进,公司引进前驱体材料销售规模进一步减少。

C、电子特气及其他

单位:万元,%

福日	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子特气	768.96	42.96	1,921.99	63.70	1,728.88	69.08	1,208.19	79.00
其他	1,021.00	57.04	1,095.17	36.30	773.83	30.92	321.18	21.00
合计	1,789.97	100.00	3,017.16	100.00	2,502.71	100.00	1,529.37	100.00

报告期内,公司引进电子特气收入金额分别为1,208.19万元、1,728.88万元、1,921.99万元和768.96万元。2022年,公司引进电子特气收入金额同比增长了46.66%,主要客户随其业务规模的扩大,需求有所增加。2023年,公司引进电子特气收入金额同比增长了43.10%,主要是由于当期对客户D收入规模有所增长。2024年度,公司引进电子特气收入金额同比增长11.17%,收入规模随着下游市场需求增加而增长。

(2) 按销售模式分析

报告期内,公司主营业务收入按销售模式分类的情况如下:

单位:万元,%

项目	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度		
坝日	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	
普通销售	24,375.82	84.60	47,013.58	87.10	30,624.35	84.71	14,623.58	46.08	
寄售模式	4,438.43	15.40	6,961.60	12.90	5,528.66	15.29	17,110.34	53.92	
主营业务收 入合计	28,814.25	100.00	53,975.18	100.00	36,153.01	100.00	31,733.92	100.00	

报告期内,公司销售模式包括寄售模式和普通销售模式。其中,寄售模式收

入金额分别为 17,110.34 万元、5,528.66 万元、6,961.60 万元和 4,438.43 万元,占各期主营业务收入的比例分别为 53.92%、15.29%、12.90%和 15.40%。

2022 年,公司寄售模式和普通销售模式收入金额均保持增长,但普通销售模式收入占比大幅提升,主要是由于:2022 年 4 月开始,经与客户 A1 协商一致,将自主和引进光刻材料产品销售模式由寄售模式变更为普通销售模式。2023 年和 2024 年,公司向客户 A1 销售的自主和引进光刻材料产品均采用普通销售模式,普通销售模式收入占比进一步上升。

(3) 按区域分析

报告期内,公司主营业务收入按区域划分的情况如下:

单位:万元,%

区域	2025年	1-6月	2024 출	2024 年度		度	2022 年	度
<u> </u>	金额	出出	金额	出占	金额	占比	金额	占比
华中	16,395.96	56.90	35,156.07	65.13	24,373.31	67.42	22,968.05	72.38
华东	7,090.86	24.61	10,907.09	20.21	5,471.45	15.13	2,487.85	7.84
华北	3,332.02	11.56	4,738.39	8.78	2,927.98	8.10	1,913.18	6.03
东北	1,864.09	6.47	3,028.81	5.61	3,316.45	9.17	4,307.83	13.57
华南	131.31	0.46	144.82	0.27	63.82	0.18	49.04	0.15
西南	-	-	-	-	-	-	7.96	0.03
主营业务收 入合计	28,814.25	100.00	53,975.18	100.00	36,153.01	100.00	31,733.92	100.00

报告期内,公司客户主要位于华中、华东、华北以及东北等区域。报告期内, 上述区域销售收入占比合计分别为 99.82%、99.82%、99.73%和 99.54%。由于境 内 12 英寸集成电路晶圆厂主要建设于上述区域,因此,公司在上述区域的销售 占比较高。

(4) 按季度分析

报告期内,公司主营业务收入按季度划分的情况如下:

单位:万元,%

项目	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	14,822.11	51.44	9,993.96	18.52	7,695.29	21.29	5,834.97	18.39

项目	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第二季度	13,992.15	48.56	13,475.32	24.97	7,182.45	19.87	7,651.50	24.11
第三季度	-	-	15,074.29	27.93	10,179.05	28.16	10,660.00	33.59
第四季度	-	-	15,431.61	28.59	11,096.21	30.69	7,587.45	23.91
主营业务收 入合计	28,814.25	100.00	53,975.18	100.00	36,153.01	100.00	31,733.92	100.00

报告期内,公司营业收入不具有明显的季节性。公司收入变动主要与下游客户需求相关,而主要客户营业收入不具有明显的季节性。2022 年第三季度,公司收入占比有所上升,主要是由于 2022 年下半年客户 A1 光刻材料产品销售模式由寄售模式转变为普通销售,且其备货增加,当期确认收入金额较高。

(二) 营业成本分析

1、营业成本构成及变动分析

报告期内,公司营业成本构成如下:

单位:万元,%

福日	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	16,928.92	98.56	24,773.41	97.95	13,589.38	97.88	8,650.50	98.13
其他业务成本	246.99	1.44	518.51	2.05	294.18	2.12	164.76	1.87
营业成本合计	17,175.90	100.00	25,291.93	100.00	13,883.56	100.00	8,815.26	100.00

报告期内,公司主营业务成本占营业成本的比例均在 95%以上,与营业收入 构成一致。

2、主营业务成本构成及变动分析

(1) 主营业务成本分产品类别分析

报告期内,公司主营业务成本按照产品类别分类情况如下:

单位:万元,%

项目	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
グロ	金额	叶 宋	金额	占	金额	占比	金额	占比
自产产品	16,718.03	98.75	24,448.08	98.69	13,286.77	97.77	8,215.37	94.97
光刻材料	13,962.69	82.48	19,958.89	80.57	11,061.39	81.40	7,402.12	85.57

项目	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
前驱体材料	2,755.34	16.28	4,489.19	18.12	2,225.38	16.38	813.25	9.40
引进产品	210.89	1.25	325.33	1.31	302.61	2.23	435.13	5.03
光刻材料	11.83	0.07	20.45	0.08	25.66	0.19	36.05	0.42
前驱体材料	81.31	0.48	136.64	0.55	133.65	0.98	279.37	3.23
电子特气	18.62	0.11	34.50	0.14	54.87	0.40	54.28	0.63
其他	99.14	0.59	133.75	0.54	88.44	0.65	65.42	0.76
主营业务成 本合计	16,928.92	100.00	24,773.41	100.00	13,589.38	100.00	8,650.50	100.00

报告期内,公司主营业务成本主要为自产产品成本。公司引进产品采用净额 法确认收入,成本均为运输费,金额及占比较小。

(2) 主营业务成本的明细构成分析

报告期内,公司自产产品主营业务成本的明细构成具体如下:

单位:万元,%

项目	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	12,093.50	72.34	15,665.76	64.08	7,981.07	60.07	4,621.53	56.25
直接人工	624.56	3.74	1,018.38	4.17	573.07	4.31	332.89	4.05
制造费用	3,806.62	22.77	7,471.70	30.56	4,562.45	34.34	3,179.67	38.70
运输费	193.35	1.16	292.25	1.20	170.19	1.28	81.27	0.99
小计	16,718.03	100.00	24,448.08	100.00	13,286.77	100.00	8,215.37	100.00

报告期内,公司自产产品营业成本构成包括直接材料、直接人工、制造费用和运输费,其中制造费用主要包括间接材料、间接人工、折旧摊销、水电费等。报告期各期,随着公司自产产品产量的上升,直接材料占比呈上升趋势,制造费用占比则呈下降趋势,直接人工占比保持相对稳定。

(三)毛利及毛利率分析

1、毛利构成及变动分析

报告期内,公司毛利构成情况如下:

单位:万元,%

项目	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务 毛利	11,885.34	96.96	29,201.77	98.98	22,563.63	98.59	23,083.42	98.81
其他业务 毛利	372.49	3.04	300.18	1.02	323.59	1.41	277.84	1.19
合计	12,257.82	100.00	29,501.95	100.00	22,887.22	100.00	23,361.27	100.00

报告期内,公司主营业务毛利分别为 23,083.42 万元、22,563.63 万元、29,201.77 万元和 11,885.34 万元,占毛利总额的比例分别为 98.81%、98.59%、98.98%和 96.96%,是公司毛利的主要来源。

2、主营业务毛利构成及变动分析

(1) 主营业务毛利构成情况

报告期内,公司主营业务毛利按照产品类别分类情况如下:

单位:万元,%

项目	2025年	1-6月	2024 年度		2023 年度		2022 年	度
沙口	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自产产品	8,259.39	69.49	9,970.85	34.14	5,772.07	25.58	4,142.52	17.95
光刻材料	7,966.02	67.02	10,039.78	34.38	6,141.52	27.22	4,766.46	20.65
前驱体材料	293.36	2.47	-68.93	-0.24	-369.45	-1.64	-623.94	-2.70
引进产品	3,625.95	30.51	19,230.92	65.86	16,791.56	74.42	18,940.90	82.05
光刻材料	969.34	8.16	14,690.57	50.31	12,116.24	53.70	14,254.05	61.75
前驱体材料	984.40	8.28	1,691.44	5.79	2,315.91	10.26	3,277.19	14.20
电子特气	750.35	6.31	1,887.48	6.46	1,674.01	7.42	1,153.91	5.00
其他	921.87	7.76	961.43	3.29	685.40	3.04	255.76	1.11
主营业务毛 利合计	11,885.34	100.00	29,201.77	100.00	22,563.63	100.00	23,083.42	100.00

报告期内,公司自产产品实现毛利分别为 4,142.52 万元、5,772.07 万元、9,970.85 万元和 8,259.39 万元,占主营业务毛利的比例分别为 17.95%、25.58%、34.14%和 69.49%,随着公司自产产品收入规模的增长,毛利贡献亦随之上升。

(2) 主营业务毛利率变动分析

报告期内,公司主营业务毛利率变动情况如下:

单位: %

	2025年1-6月		2024	年度	2023 年度		2022	年度
项目	毛利率	变动百 分点	毛利率	变动百 分点	毛利率	变动百 分点	毛利率	变动百 分点
自产产品	33.07	4.10	28.97	-1.32	30.29	-3.24	33.52	31.78
光刻材料	36.33	2.86	33.47	-2.23	35.70	-3.47	39.17	30.72
前驱体材料	9.62	11.18	-1.56	18.35	-19.91	309.68	-329.59	315.17
引进产品	94.50	-3.83	98.34	0.11	98.23	0.48	97.75	1.16
合计	41.25	-12.85	54.10	-8.31	62.41	-10.33	72.74	2.91

2022 年,公司自产产品毛利率随着收入的增长,规模效应逐步显现,毛利率大幅提升,2023 年和2024 年略有下降,2025 年 1-6 月有所回升;引进产品毛利率报告期内相对稳定。

①自产产品

A、光刻材料

报告期内,公司自产光刻材料毛利率分别为 39.17%、35.70%、33.47%和 36.33%,2022 年随着收入规模的扩大,单位成本明显降低,毛利率快速上升;2023 年和 2024 年,由于产品结构变化及与客户协商降价的原因,毛利率小幅下降。2025 年 1-6 月,公司自产光刻材料收入规模大幅增长,产能利用率提升导致单位成本下降,毛利率有所回升。

B、前驱体材料

报告期内,公司自产前驱体材料毛利率分别为-329.59%、-19.91%、-1.56%和 9.62%。2022年,公司产线仍处于产能爬坡阶段,收入规模较小,因此单位成本较高,毛利率为负。2023年以来,随着产量的增长,单位成本逐年降低,毛利率不断提升。2025年 1-6 月,随着自产前驱体材料产量的进一步提升,毛利率已由负转正。

②引讲产品

报告期内,公司引进产品采用净额法确认收入,成本均为运输费,各期毛利率均超过90%。

3、综合毛利率同行业比较分析

报告期内,公司与同行业上市公司可比业务毛利率对比情况如下:

ゴルハヨ	عاد المالية المالية المالية ا		分业务毛利	率(%)	
可比公司	可比业务	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
彤程新材	自产电子材料	未披露	29.80	26.32	25.07
(北京科华)	综合毛利率	25.20	24.84	23.68	23.99
晶瑞电材	光刻胶及配套试剂	32.11	28.22	34.21	40.88
(瑞红苏州)	综合毛利率	32.09	19.23	23.61	22.42
艾森股份	光刻胶及配套试剂	未披露	22.21	28.27	23.67
又称双切	综合毛利率	26.53	26.42	27.18	23.33
上海新阳	电子化学材料	45.90	46.19	44.85	37.65
上传机阳	综合毛利率	40.75	39.29	35.16	31.35
	电子特气	35.30	39.95	46.13	48.88
南大光电	MO 源产品	50.37	48.61	39.90	40.10
	综合毛利率	38.75	41.16	43.16	45.34
小	半导体材料	37.94	35.59	37.98	36.21
飞凯材料	综合毛利率	36.10	35.06	34.46	38.92
平均	可比业务	40.32	35.80	36.81	36.07
干坳	综合毛利率	33.24	31.00	31.21	30.89
	自产产品	33.07	28.97	30.29	33.52
	其中:光刻材料	36.33	33.47	35.70	39.17
公司	前驱体	9.62	-1.56	-19.91	-329.59
	引进产品	94.50	98.34	98.23	97.75
	综合毛利率	41.25	53.84	62.24	72.60

注:可比上市公司相关数据均取自于公开披露的定期报告或招股意向书,其中晶瑞电材光刻胶及配套试剂毛利率取自其控股子公司瑞红苏州定期报告。

报告期内,发行人自产光刻材料毛利率分别为 39.17%、35.70%、33.47%和 36.33%,处于可比公司可比业务毛利率的中间水平,与平均水平接近。报告期内,由于公司自产前驱体材料尚处于产能爬坡阶段,产能利用率较低,单位产品分摊的固定成本较高,毛利率分别为-329.59%、-19.91%、-1.56%和 9.62%,拉低了公司自产产品的整体毛利率,导致公司自产产品毛利率低于可比公司可比业务毛利率平均值。报告期内,公司引进产品采用净额法确认收入,毛利率较高,与同行

业可比公司不具有可比性。

(四)期间费用分析

报告期内,公司期间费用及其占营业收入比例情况如下:

单位:万元,%

	2025年1-6月		2024 소		2023 4	年度	2022 4	年度
项目	金额	占营业 收入比 例	金额	占营业 收入比 例	金额	占营业 收入比 例	金额	占营业 收入比 例
销售费用	1,529.65	5.20	3,406.80	6.22	3,412.96	9.28	2,981.26	9.27
管理费用	4,241.42	14.41	8,133.58	14.84	6,576.51	17.89	5,071.59	15.76
研发费用	4,160.43	14.13	8,860.85	16.17	5,366.27	14.59	4,274.36	13.28
财务费用	-425.72	-1.45	-1,269.56	-2.32	-1,398.97	-3.80	-514.03	-1.60
合计	9,505.77	32.30	19,131.67	34.92	13,956.77	37.96	11,813.18	36.71

报告期内,公司期间费用金额分别为 11,813.18 万元、13,956.77 万元、19,131.67 万元和 9,505.77 万元,占同期营业收入的比例分别为 36.71%、37.96%、34.92%和 32.30%。报告期内,公司期间费用变动与营业收入变动趋势基本一致。

1、销售费用

(1) 销售费用构成

报告期内,公司销售费用具体构成如下:

单位:万元,%

项目	2025年	1-6月	2024 年度		2023 年度		2022	2022 年度	
沙 日	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	
职工薪酬	601.56	39.33	1,438.33	42.22	1,226.81	35.95	1,190.47	39.93	
折旧与摊销	424.29	27.74	838.80	24.62	773.10	22.65	550.25	18.46	
保险费	25.19	1.65	128.76	3.78	299.82	8.78	276.81	9.29	
运输费	107.20	7.01	179.54	5.27	211.66	6.20	298.57	10.01	
业务招待费	66.50	4.35	182.59	5.36	179.07	5.25	185.07	6.21	
样品费	34.49	2.25	138.73	4.07	157.36	4.61	84.93	2.85	
股份支付	69.93	4.57	135.75	3.98	155.16	4.55	134.81	4.52	
维修费	70.55	4.61	117.85	3.46	110.06	3.22	126.34	4.24	
差旅费	69.29	4.53	128.62	3.78	152.74	4.48	59.75	2.00	

项目	2025年1-6月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
仓储费	34.82	2.28	70.01	2.05	84.23	2.47	43.80	1.47
其他	25.82	1.69	47.83	1.40	62.93	1.84	30.46	1.02
合计	1,529.65	100.00	3,406.80	100.00	3,412.96	100.00	2,981.26	100.00

报告期内,公司销售费用金额分别为 2,981.26 万元、3,412.96 万元、3,406.80 万元和 1,529.65 万元,占营业收入的比例分别为 9.27%、9.28%、6.22%和 5.20%。报告期内,随着公司加大市场开拓力度,销售费用随之增长。2023 年度,公司销售费用较上一年有所增加,其中主要系折旧与摊销费用、维修费、样品费及差旅费等增长所致。

公司销售费用主要由职工薪酬、折旧与摊销、保险费、运输费、业务招待费等构成。公司主要销售费用的构成或变化情况如下:

①职工薪酬

报告期各期,公司计入销售费用的职工薪酬分别为 1,190.47 万元、1,226.81 万元 1,438.33 万元和 601.56 万元,占当期销售费用的比例分别为 39.93%、35.95%、42.22%和 39.33%,是公司销售费用最主要的构成部分。公司销售费用中的职工薪酬主要系公司销售人员的工资、奖金、社保和公积金等。报告期内,公司计入销售费用的职工薪酬不断增加,主要系公司业务快速增长,经营规模持续扩张,公司销售人员数量及薪酬福利上涨所致。

②折旧与摊销

报告期各期,公司销售费用中的折旧与摊销分别为 550.25 万元、773.10 万元、838.80 万元和 424.29 万元,占当期销售费用的比例分别为 18.46%、22.65%、24.62%和 27.74%。公司销售费用中的折旧与摊销支出主要是公司销售产品所用钢瓶折旧费用及由公司销售部门承担的固定资产折旧费用等。

③保险费

报告期各期,公司计入销售费用的保险费分别为 276.81 万元、299.82 万元、128.76 万元和 25.19 万元,占当期销售费用的比例分别为 9.29%、8.78%、3.78%和 1.65%。保险费主要为公司购买重点新材料首批次应用保险、产品责任险以及

相关商业险种所支付的费用。

④运输费

报告期各期,公司计入销售费用的运输费分别为 298.57 万元、211.66 万元、179.54 万元和 107.20 万元,占当期销售费用的比例分别为 10.01%、6.20%、5.27% 和 7.01%。运输费主要为公司销售引进前驱体材料后不定期从客户处运回钢瓶并运往境外供应商所发生的运费。2023 年和 2024 年,公司引进前驱体材料销量下降,销售费用中的运输费有所下降。

⑤业务招待费

报告期各期,公司计入销售费用的业务招待费分别为 185.07 万元、179.07 万元、182.59 万元和 66.50 万元,各期业务招待费支出保持相对稳定,占当期销售费用的比例分别为 6.21%、5.25%、5.36%和 4.35%。

此外,2023年公司销售费用中样品费及差旅费同比增加较多,主要系:(1) 2023年,公司重点布局自产产品销售,送样较2022年有所增加;(2)差旅费增加主要系2023年销售人员较2022年增加了差旅频次与新产品市场开拓力度所致。

(2) 同行业上市公司对比情况

报告期内,公司销售费用率与同行业上市公司对比如下:

			销售费用率(%)							
证券简称	证券代码	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度					
	603650.SH	3.39	3.43	3.14	2.91					
艾森股份	688720.SH	6.26	5.91	5.59	5.54					
上海新阳	300236.SZ	4.92	4.51	4.49	3.45					
南大光电	300346.SZ	2.76	3.33	4.08	4.41					
飞凯材料	300398.SZ	5.31	5.55	4.97	4.57					
晶瑞电材	300655.SZ	2.13	2.34	2.18	1.64					
平均	匀值	4.13	4.18	4.08	3.75					
本么		5.20	6.22	9.28	9.27					

注: 同行业可比上市公司相关指标取自其定期报告或招股书。

如上表所示,由于部分可比上市公司产品类型较为丰富且公司业务规模效应尚未体现,销售费用率高于同行业可比上市公司平均水平;随着公司业务规模的

增长,公司销售费用率整体呈下降趋势。

2、管理费用

(1) 管理费用构成

报告期内,公司管理费用具体构成如下:

单位:万元,%

项目	2025年	1-6月	2024	年度	2023 年度		2022 4	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	1,907.77	44.98	4,284.89	52.68	3,396.20	51.64	2,267.88	44.72
股份支付	513.73	12.11	1,017.32	12.51	999.50	15.20	931.73	18.37
折旧与摊销	1,041.77	24.56	818.51	10.06	559.02	8.50	509.53	10.05
办公费	303.27	7.15	338.59	4.16	331.71	5.04	271.60	5.36
业务招待费	127.54	3.01	392.34	4.82	335.12	5.10	321.16	6.33
中介服务费用	114.22	2.69	754.42	9.28	491.21	7.47	294.74	5.81
差旅费	83.71	1.97	187.75	2.31	171.84	2.61	68.46	1.35
内部抵消不可抵扣 进项税	16.10	0.38	28.38	0.35	29.58	0.45	265.95	5.24
其他	133.32	3.14	311.37	3.83	262.32	3.99	140.53	2.77
合计	4,241.42	100.00	8,133.58	100.00	6,576.51	100.00	5,071.59	100.00

报告期内,公司管理费用的金额分别为 5,071.59 万元、6,576.51 万元、8,133.58 万元和 4,241.42 万元,占营业收入的比例分别为 15.76%、17.89%、14.84%和 14.41%。公司管理费用主要由职工薪酬、股份支付、折旧与摊销、中介服务费用、业务招待费、办公费等构成。公司主要管理费用的构成或变化情况如下:

①职工薪酬

报告期各期,公司计入管理费用的职工薪酬分别为 2,267.88 万元、3,396.20 万元、4,284.89 万元和 1,907.77 万元,占管理费用的比例分别为 44.72%、51.64%、52.68%和 44.98%。报告期内,公司计入管理费用的职工薪酬整体呈增长趋势,主要系公司业务快速增长,经营规模持续扩张,公司管理人员数量及薪酬福利上涨所致。

②股份支付

报告期各期,公司计入管理费用的股份支付金额分别为931.73万元、999.50

万元、1,017.32 万元和 513.73 万元,占管理费用的比例分别为 18.37%、15.20%、12.51%和 12.11%,主要系公司实施员工股权激励计划计提的股份支付费用。

③折旧与摊销

报告期各期,公司计入管理费用的折旧与摊销分别为 509.53 万元、559.02 万元、818.51 万元和 1,041.77 万元,占管理费用的比例分别为 10.05%、8.50%、10.06%和 24.56%,报告期内管理费用中的折旧与摊销整体呈增长趋势,主要系由房屋建筑物、办公设备等折旧形成。

④办公费

报告期各期,公司计入管理费用的办公费分别为 271.60 万元、331.71 万元、338.59 万元和 303.27 万元,占管理费用的比例分别为 5.36%、5.04%、4.16%和7.15%,主要系公司日常办公所需的水电费、办公用品费等。

⑤业务招待费

报告期各期,公司计入管理费用的业务招待费分别为 321.16 万元、335.12 万元、392.34 万元和 127.54 万元,占管理费用的比例分别为 6.33%、5.10%、4.82% 和 3.01%,与公司业务规模增长相匹配。

⑥中介服务费用

报告期各期,公司计入管理费用的中介服务费用分别为 294.74 万元、491.21 万元、754.42 万元和 114.22 万元,占管理费用的比例分别为 5.81%、7.47%、9.28% 和 2.69%,主要系公司日常及 IPO 过程中聘请中介机构发生的审计费、评估费、咨询服务费等。

(2) 同行业上市公司对比情况

报告期内,公司管理费用率与同行业上市公司对比如下:

证券简称	证券代码	管理费用率(%)							
此分則你	ME分1(14号	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度				
彤程新材	603650.SH	5.53	5.62	5.90	6.78				
艾森股份	688720.SH	5.01	5.72	5.67	5.76				
上海新阳	300236.SZ	7.57	7.94	7.64	6.87				

证券简称	证券代码	管理费用率(%)							
近分 间你	正分1(1円	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度				
南大光电	300346.SZ	8.42	9.14	11.90	14.40				
飞凯材料	300398.SZ	8.90	9.30	11.10	8.51				
晶瑞电材	300655.SZ	7.44	8.10	7.37	6.18				
平均值		7.14	7.64	8.26	8.08				
本公司		14.41	14.84	17.89	15.76				

注: 同行业可比上市公司相关指标取自其定期报告或招股书。

如上表所示,由于部分可比上市公司产品类型较为丰富且公司业务规模效应 尚未体现,管理费用率高于同行业可比上市公司平均水平。

3、研发费用

(1) 研发费用构成

报告期内,公司研发费用具体构成如下:

单位:万元,%

16 日	2025 年	1-6月	2024	2024 年度		年度	2022 출	F度
项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料费	1,572.26	37.79	3,306.80	37.32	1,483.40	27.64	1,168.02	27.33
职工薪酬	1,224.57	29.43	3,285.42	37.08	1,938.40	36.12	1,574.52	36.84
折旧与摊销	704.98	16.94	1,170.41	13.21	971.81	18.11	1,000.77	23.41
股份支付	268.20	6.45	536.41	6.05	452.27	8.43	24.40	0.57
燃料动力费	67.64	1.63	180.09	2.03	110.99	2.07	82.96	1.94
测试化验加工费	59.48	1.43	148.62	1.68	160.64	2.99	190.66	4.46
其他费用	263.30	6.33	233.10	2.63	248.77	4.64	233.02	5.45
合计	4,160.43	100.00	8,860.85	100.00	5,366.27	100.00	4,274.36	100.00

报告期各期,公司研发费用金额分别为 4,274.36 万元、5,366.27 万元、8,860.85 万元和 4,160.43 万元,占同期营业收入的比例分别为 13.28%、14.59%、16.17% 和 14.13%。

报告期内,公司不存在研发费用资本化的情形。公司研发费用主要由职工薪酬、材料费、折旧与摊销等构成。公司主要研发费用的构成或变化情况如下:

①材料费

报告期各期,公司研发费用中的材料费分别为 1,168.02 万元、1,483.40 万元 3,306.80 万元和 1,572.26 万元,研发材料投入呈现增长趋势,主要系公司持续加大自产产品的开发力度,相关材料领用及试验耗材增加所致。

②职工薪酬

报告期各期,公司研发费用中的职工薪酬分别为 1,574.52 万元、1,938.40 万元、3,285.42 万元和 1,224.57 万元。为持续提升产品的核心竞争力,报告期内,公司持续加大研发投入,不断加强研发队伍建设,因此报告期内的研发人员数量和薪酬有所增长。

③折旧与摊销

报告期各期,公司研发费用中的折旧与摊销分别为 1,000.77 万元、971.81 万元、1,170.41 万元和 704.98 万元,主要系公司加大研发设备投入,对应的折旧费用总体呈现增长趋势。

报告期内,公司研发费用按研发项目投入情况如下:

单位: 万元

项目名称	2025年 1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度	进度
碳膜涂层系列研发项目	224.79	498.85	193.94	309.44	进行中
抗反射涂层系列研发项目	787.59	1,738.74	1,712.80	1,877.93	进行中
KrF 光刻胶系列研发项目	1,037.01	2,444.74	1,411.11	913.13	进行中
ArF 光刻胶系列研发项目	362.55	910.09	740.01	102.17	进行中
i-Line 光刻胶系列研发项目	225.42	470.57	393.88	263.40	进行中
光刻工艺化学试剂系列研发项目	251.69	606.12	419.27	215.63	进行中
光刻材料原材料系列研发项目	403.08	167.60	-	-	进行中
硅基前驱体材料系列研发项目	342.58	142.36	138.07	351.60	进行中
金属前驱体材料系列研发项目	506.65	1,865.32	320.37	241.07	进行中
磷基前驱体材料系列研发项目	9.36	13.22	31.43	-	进行中
硼基前驱体材料系列研发项目	9.71	3.23	5.39	-	进行中
合计	4,160.43	8,860.85	5,366.27	4,274.36	-

(2) 同行业上市公司对比情况

报告期内,公司研发费用率与同行业上市公司对比如下:

证券简称	证券代码	研发费用率(%)			
此分則你	ME分1(1号	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
彤程新材	603650.SH	7.10	6.62	6.11	6.33
艾森股份	688720.SH	10.87	10.62	9.08	7.32
上海新阳	300236.SZ	13.58	14.92	12.27	10.36
南大光电	300346.SZ	7.28	9.06	11.42	11.13
飞凯材料	300398.SZ	6.21	6.23	6.94	6.32
晶瑞电材	300655.SZ	5.02	6.91	5.47	3.99
平均	匀值	8.34	9.06	8.55	7.58
本么	公司	14.13	16.17	14.59	13.28

注: 同行业可比上市公司相关指标取自其定期报告或招股书。

如上表所示,公司研发费用率高于同行业可比上市公司平均水平主要系:一方面,报告期内公司不断加大产品研发投入;另一方面,部分同行业上市公司产品类型较多,而公司则以光刻材料和前驱体材料收入为主,收入和研发的匹配性较强,故研发费用率高于行业平均值。

4、财务费用

报告期内,公司财务费用具体构成如下:

单位:万元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
利息支出	600.36	1,127.31	349.66	394.78
其中: 租赁负债利息支出	2.96	9.29	17.18	19.73
减: 利息资本化	16.78	205.27	47.78	-
减: 利息收入	1,180.18	2,129.03	1,693.37	207.17
利息净支出	-596.60	-1,206.99	-1,391.50	187.61
汇兑损失	666.81	559.24	1,040.80	454.85
减: 汇兑收益	526.28	676.19	1,086.53	1,177.14
汇兑净损失	140.53	-116.94	-45.72	-722.29
银行手续费	30.34	54.37	38.24	20.64
合计	-425.72	-1,269.56	-1,398.97	-514.03

报告期内,公司财务费用分别为-514.03 万元、-1,398.97 万元、-1,269.56 万元和-425.72 万元,主要系公司日常经营中的银行借款产生的利息支出,由货币资金、列报于其他非流动资产和一年内到期的非流动资产的长期定期存款产生的

利息收入以及汇兑损益。2022年,公司汇兑损益波动主要系受到汇率波动的影响。2023年和2024年,公司定期存款较以前年度增多,利息收入有所增加。

(五) 其他影响经营成果的项目分析

1、税金及附加

报告期内,公司税金及附加构成情况如下:

单位:万元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
房产税	214.44	248.22	98.02	94.09
印花税	34.35	90.47	68.52	51.38
城镇土地使用税	36.19	62.97	49.92	36.51
城市维护建设税	0.38	0.84	0.55	1.08
教育费附加	0.15	0.36	0.24	0.40
地方教育附加	0.10	0.24	0.16	0.27
其他税金	1.61	2.17	0.06	0.37
合计	287.23	405.27	217.48	184.09

报告期内,公司的税金及附加金额分别为 184.09 万元、217.48 万元、405.27 万元和 287.23 万元,主要包括房产税、印花税和城镇土地使用税等。报告期内,公司税金及附加金额呈现逐年上升趋势,主要系随着公司业务规模持续上升,计提相应的税金及附加也随之增加。

2、其他收益

报告期内,公司其他收益构成情况如下:

单位: 万元

项目	2025年 1-6月	2024年 度	2023 年 度	2022 年 度
一、计入其他收益的政府补助	1,439.26	1,624.18	1,676.20	1,911.72
其中: 与递延收益相关的政府补助(资产相关)	530.79	927.99	877.78	842.53
直接计入当期损益的政府补助	908.47	696.19	798.42	1,069.19
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	893.39	470.29	112.45	7.18
其中: 个税扣缴税款手续费	16.41	10.94	73.33	7.18
进项税加计扣除	876.98	459.35	39.13	-
合计	2,332.65	2,094.47	1,788.65	1,918.91

报告期内,公司其他收益分别为 1,918.91 万元、1,788.65 万元、2,094.47 万元和 2,332.65 万元,主要由政府补助和进项税加计扣除构成。

报告期各期,公司计入递延收益的政府补助分摊计入当期损益的情况如下:

单位: 万元

		一 	员益的金额		平世: 万九
项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度	备注
国家 02 科技重大专项子课题	200.60	401.21	401.21	401.21	与资产相关
大连前驱体项目投资补助	36.92	73.85	73.85	73.85	与资产相关
国家专项研究任务	72.80	145.60	145.60	145.60	与资产相关
重大技术装备补助	69.55	139.09	139.09	139.09	与资产相关
厦门干式 Arf Barc 量产应用开发	19.80	35.82	27.16	7.48	与资产相关
大连 2021 新建重点项目补助	15.40	30.80	30.80	30.80	与资产相关
2021 年省产业领军团队补助	13.73	27.47	18.74	7.50	与资产相关
"雏鹰计划"青年拔尖人才支持资金	4.05	5.76	0.86	-	与资产相关
研发设备补助	1.74	3.49	3.49	-	与资产相关
无尘车间装修补助	-	27.75	37.00	37.00	与资产相关
材料攻关项目C	50.73	0.50	-	-	与资产相关
材料攻关项目 A	14.62	15.74	-	-	与资产相关
福建省工程研究中心补助	25.00	16.67	-	-	与资产相关
材料攻关项目B	2.00	2.33	-	-	与资产相关
2024 年度省级新型研发机构设备后补助项目	3.84	1.92	-	-	与资产相关
合计	530.79	927.99	877.78	842.53	

报告期各期,公司直接计入其他收益的政府补助情况如下:

单位:万元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
进项税加计扣除	876.98	459.35	39.13	-
政府扶持资金	397.48	339.13	365.00	35.00
中小企业补助	285.00	-	-	-
扶持奖励	200.00	-	-	-
第七批省级制造业单项冠军 奖励资金	-	50.00	-	-
科技计划项目补助	5.00	57.75	20.00	30.00

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
知识产权补助	-	30.50	25.00	7.70
创新驱动补助	18.34	87.08	-	-
个税扣缴税款手续费	16.41	10.94	73.33	7.18
科技保险补贴	-	12.93	-	-
增产增效奖励	-	22.46	-	5.00
人才补助	-	44.59	200.03	153.99
集成电路专项补助	-	1	36.10	-
新增新上规模工业企业政策 奖励	-	-	-	25.00
进口关税免税退回	-	-	-	90.19
支持企业增营收奖励	-	-	7.56	-
研发费用补助	-	-	-	112.19
促项目扩投资奖励	-	1	-	15.50
漳州市企业技术中心奖励资 金	-	-	10.00	-
科技成果转化补助	-	-	-	12.90
重点新材料首批次应用补贴	-	-	-	527.00
厦门市"专精特新"中小企业 认定奖励	-	-	-	10.00
租金补助	-	-	-	6.00
专精特新小巨人奖励	-		70.00	-
跨越发展增产奖励	-	-	18.83	-
创新创业大赛奖金	-	-	18.30	-
普惠金融发展示范区奖补资 金	-	-	-	20.65
数字经济产业发展若干措施 奖励资金	-	25.00	-	-
其他	2.65	26.76	27.60	18.06
合计	1,801.86	1,166.48	910.87	1,076.38

3、投资收益

报告期内,公司投资收益情况如下:

单位:万元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-363.94	-343.34	-76.61	-128.19
外汇衍生产品	-	-77.53	30.02	_

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
理财产品收益	-	35.21	278.73	190.73
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-0.31	-	-
合计	-363.94	-385.97	232.13	62.54

报告期内,公司投资收益金额分别为 62.54 万元、232.13 万元、-385.97 万元和-363.94万元,主要由权益法核算的长期股权投资收益、外汇衍生产品和银行理财的投资收益构成。

4、公允价值变动收益

单位: 万元

产生公允价值变动收益的来源	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
交易性金融资产	34.63	-	-57.75	46.14
其中:外汇衍生产品的公允价值变动	34.63	-	-	-
银行理财产品的公允价值变动	-	-	-57.75	46.14
交易性金融负债	-20.59	-	67.58	-67.58
其中:外汇衍生产品的公允价值变动	-20.59	-	67.58	-67.58
其他非流动金融资产	-27.14	100.75	-6.51	-
合计	-13.09	100.75	3.32	-21.44

报告期内,公司公允价值变动收益分别为-21.44万元、3.32万元、100.75万元和-13.09万元,主要系公司银行理财产品、外汇衍生产品及其他非流动金融资产公允价值变动所致。

5、信用减值损失

报告期内,公司信用减值损失情况如下:

单位: 万元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
其他应收款坏账损失	26.79	-29.53	-56.14	-3.99
应收账款坏账损失	14.92	-24.97	-41.27	-25.26
合计	41.71	-54.50	-97.41	-29.25

报告期内,公司信用减值损失分别为-29.25 万元、-97.41 万元、-54.50 万元和 41.71 万元,主要系公司根据应收款项减值计提政策对应收账款和其他应收款计提相应的坏账损失。

6、资产减值损失

报告期内,公司资产减值损失情况如下:

单位:万元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
存货跌价损失	-433.87	-618.30	-64.40	-610.70
固定资产减值损失		-	-79.49	-331.72
合计	-433.87	-618.30	-143.89	-942.42

报告期内,公司资产减值损失金额分别为-942.42 万元、-143.89 万元、-618.30 万元和-433.87 万元,系公司计提的存货跌价损失和固定资产减值损失。2022-2023 年度,公司分别计提固定资产减值损失 331.72 万元及 79.49 万元,主要原因系参考可回收金额,对安徽恒坤闲置钢瓶计提减值。

7、资产处置收益

单位:万元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
处置未划分为持有待售的固定资 产、在建工程、生产性生物资产 及无形资产的处置利得或损失	463.35	4.58	-31.40	1.60
其中:固定资产	463.35	4.58	-31.40	1.60
合计	463.35	4.58	-31.40	1.60

报告期内,公司资产处置收益分别为 1.60 万元、-31.40 万元、4.58 万元和 463.35 万元。2023 年,资产处置损失主要系安徽恒坤处置固定资产形成。2025 年 1-6 月,资产处置收益主要系福建泓光因购置了更高性能的设备而处置个别二 手设备。

8、营业外收入

单位:万元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
保险理赔	-	-	-	256.17
其他	1.09	5.96	6.88	3.37
合计	1.09	5.96	6.88	259.54

报告期内,公司营业外收入分别为 259.54 万元、6.88 万元、5.96 万元和 1.09 万元,主要由保险理赔等构成。

9、营业外支出

报告期内,公司营业外支出构成如下表所示:

单位:万元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
罚款及滞纳金	0.03	5.45	20.17	27.79
公益性捐赠支出		-	-	9.74
非流动资产毁损报废损失	41.55	70.78	3.74	1.03
赞助费		-	-	22.29
其他	0.14	321.47	1.29	11.07
合计	41.72	397.70	25.20	71.91

报告期内,公司营业外支出分别为 71.91 万元、25.20 万元、397.70 万元和 41.72 万元。2024 年其他金额较大系因子公司福建司理可新材料有限公司所购置 土地未能用于既定用途,累计已投入的工程支出 318.88 万元转入营业外支出。

10、所得税费用

报告期内,公司所得税费用构成如下表所示:

单位: 万元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
当期所得税费用	1,290.07	3,723.85	2,723.17	2,712.83
递延所得税费用	-998.74	-2,700.66	-1,253.38	-144.09
合计	291.34	1,023.19	1,469.79	2,568.74

报告期内,公司所得税费用由当期所得税费用和递延所得税费用构成。报告期内,随着公司业务持续扩展,收入及利润规模增长,使得公司当期所得税费不断上升。2023-2024年,主要受到递延所得税费用的影响,公司所得税费用较 2022年度有所下降。

(六)发行人缴纳税额情况

1、报告期内发行人主要税种纳税情况

(1) 增值税

单位:万元

期间	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2022 年度	-2,058.59	-1,234.52	-2,439.59	-853.52
2023 年度	-853.52	-3,655.36	-2,321.78	-2,187.10
2024 年度	-2,187.10	-3,582.89	-1,285.26	-4,484.74
2025年1-6月	-4,484.74	-1,424.34	-1,884.13	-4,024.95

(2) 企业所得税

单位: 万元

期间	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2022 年度	676.90	2,745.83	2,591.61	831.11
2023 年度	831.11	2,190.29	2,077.09	944.31
2024 年度	944.31	3,730.69	3,728.37	946.63
2025年1-6月	946.63	1,288.78	1,561.77	673.63

2、报告期内重大税收政策的变化与税收优惠及对发行人的影响

报告期内,公司税收政策、税收优惠情况参见本招股意向书"第六节财务会计信息与管理层分析"之"七、主要税种及税收政策"中的相关内容。报告期内,公司适用的税收政策稳定,未发生重大不利变化,亦不存在面临即将实施的重大税收政策调整的情况。

十一、资产质量分析

(一) 资产构成及变动情况分析

报告期各期末,公司的资产结构如下:

单位:万元,%

项目	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	138,643.76	47.20	87,489.09	33.07	58,638.23	28.04	85,753.76	52.52
非流动资产	155,106.89	52.80	177,047.55	66.93	150,470.37	71.96	77,535.84	47.48
资产合计	293,750.66	100.00	264,536.63	100.00	209,108.60	100.00	163,289.60	100.00

从资产规模来看,报告期各期末,公司的资产总额分别为 163,289.60 万元、209,108.60 万元、264,536.63 万元和 293,750.66 万元,随着公司业务规模扩大及引入投资者增资等因素,公司资产整体规模快速增加。

从资产结构来看,报告期各期末,公司流动资产占资产总额的比例分别为52.52%、28.04%、33.07%和47.20%,主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款和存货。2022年末,公司流动资产占比增加较大,主要是系2022年度公司业务规模扩大、股权激励行权及引入新一轮股权融资,导致公司存货和货币资金等项目增加,从而使得流动资产规模扩大。同时,为了满足生产和经营的需要,公司不断加大在长期资产方面的投资;报告期各期末,非流动资产占资产总额的比例分别为47.48%、71.96%、66.93%和52.80%,主要包括固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产。2023年末,公司的流动资产占比显著降低,主要系公司持续推进项目建设,在建工程、固定资产等非流动资产比显著降低,主要系公司持续推进项目建设,在建工程、固定资产等非流动资产,快速增长。2025年6月末,流动资产占比有所增长,主要系部分长期定期存款转为一年内到期的非流动资产所致。

(二)流动资产构成及变动分析

报告期各期末,公司流动资产结构如下表所示:

单位:万元,%

项目	2025.6	.30	2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	55,242.31	39.84	29,089.75	33.25	23,508.13	40.09	52,260.98	60.94
交易性金融资产	34.63	0.02	-	-	-	-	10,531.14	12.28
应收账款	9,914.21	7.15	11,385.65	13.01	8,958.88	15.28	4,874.10	5.68
预付款项	3,294.59	2.38	623.31	0.71	555.92	0.95	403.18	0.47
其他应收款	4,422.84	3.19	10,103.24	11.55	7,511.29	12.81	5,710.82	6.66
存货	19,453.96	14.03	15,868.44	18.14	12,101.00	20.64	4,646.10	5.42
一年内到期的非 流动资产	38,705.74	27.92	10,744.34	12.28	-	-	-	-
其他流动资产	7,575.48	5.46	9,674.36	11.06	6,003.00	10.24	7,327.44	8.54
流动资产合计	138,643.76	100.00	87,489.09	100.00	58,638.23	100.00	85,753.76	100.00

报告期各期末,公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款和存货构成,上述五项合计占公司流动资产的比例分别为 90.99%、88.81%、75.95%和 64.24%。

1、货币资金

报告期各期末,公司货币资金具体情况如下:

单位:万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
库存现金	0.31	-	0.07	-
银行存款	41,719.60	25,009.35	21,090.86	48,912.84
其中: 定期存款应收利息	143.75	197.24	106.54	-
其他货币资金	13,522.40	4,080.40	2,417.21	3,348.14
合计	55,242.31	29,089.75	23,508.13	52,260.98
其中: 存放在境外的款项总额	16,796.14	9,757.18	11,466.94	419.64

报告期各期末,公司货币资金分别为 52,260.98 万元、23,508.13 万元、29,089.75 万元和 55,242.31 万元,主要由银行存款和其他货币资金构成,其中其他货币资金为公司的银行承兑汇票保证金、保函保证金等。2023 年末,公司货币资金较 2022 年末减少 28,752.85 万元,主要系 2023 年公司持续投入包括漳州二期、安徽一期工程在内的厂房及设备购置,当年投资活动产生的现金流量净流出额较上年大幅增长。2024 年末,公司货币资金较 2023 年末增长 5,581.62 万元,主要系当年收到多项材料攻关项目政府补助所致。2025 年 6 月末,公司货币资金较 2024 年末增长 26,152.56 万元,主要系公司根据经营需要借入短期银行借款及客户回款所致。

报告期各期末,公司存放在境外的款项总额分别为 419.64 万元、11,466.94 万元、9,757.18 万元和 16,796.14 万元,占当期货币资金的比重分别为 0.80%、48.78%、33.54%和 30.40%,主要系境外子公司香港恒坤的货币资金。

2、交易性金融资产

报告期各期末,公司交易性金融资产具体情况如下:

单位:万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	34.63	-	-	10,531.14
其中:外汇衍生产品	34.63	•	•	-
银行理财产品	-	-	-	10,531.14

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
合计	34.63	-	-	10,531.14

报告期各期末,公司交易性金融资产分别为 10,531.14 万元、0 万元、0 万元 和 34.63 万元,主要为公司购买的银行理财产品。

3、应收账款

报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 4,874.10 万元、8,958.88 万元、11,385.65 万元和 9,914.21 万元,占总资产的比例分别为 2.98%、4.28%、4.30%和 3.38%,金额整体呈现增长趋势。报告期各期末,公司应收账款分析如下:

(1) 应收账款余额变动情况

单位:万元,%

项目	2025.6.30/ 2025年1-6月	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度
应收账款账面余额	10,014.46	11,501.12	9,049.38	4,923.33
营业收入	29,433.73	54,793.88	36,770.78	32,176.52
应收账款余额占营业收入比例	34.02	20.99	24.61	15.30

报告期各期末,公司应收账款账面余额分别为 4,923.33 万元、9,049.38 万元、11,501.12 万元和 10,014.46 万元,整体呈现增长趋势,主要系随着公司报告期内业务规模的不断增长,应收账款规模随之增加。报告期内,公司应收账款余额占当期营业收入比例分别为 15.30%、24.61%、20.99%和 34.02%,其中 2024 年度应收账款余额占营业收入比例较 2023 年度下降 3.62 个百分点,主要系 2024 年度公司营业收入增长较快所致。

(2) 应收账款分类情况

公司将应收账款区分为按单项计提坏账准备和按组合计提坏账准备,具体如下:

单位:万元,%

2025.6.30							
	账面余	坏账准备					
项目	金额	比例	金额	计提 比例	账面价值		
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-		

按组合计提坏账准备	10,014.46	100.00	100.25	1.00	9,914.21			
组合 1.账龄组合	10,014.46	100.00	100.25	1.00	9,914.21			
合计	10,014.46	100.00	100.25	1.00	9,914.21			
	2024.12.31							
	账面余	:额	坏账	佳备				
项目	金额	比例	金额	计提 比例	账面价值			
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-			
按组合计提坏账准备	11,501.12	100.00	115.47	1.00	11,385.65			
组合 1.账龄组合	11,501.12	100.00	115.47	1.00	11,385.65			
合计	11,501.12	100.00	115.47	1.00	11,385.65			
2023.12.31								
	账面余	坏账准备						
项目	金额	比例	金额	计提 比例	账面价值			
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-			
按组合计提坏账准备	9,049.38	100.00	90.50	1.00	8,958.88			
组合 1.账龄组合	9,049.38	100.00	90.50	1.00	8,958.88			
合计	9,049.38	100.00	90.50	1.00	8,958.88			
	2022.12.31							
	账面余	额	坏账	住备				
项目	金额	比例	金额	计提 比例	账面价值			
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-			
按组合计提坏账准备	4,923.33	100.00	49.23	1.00	4,874.10			
组合 1.账龄组合	4,923.33	100.00	49.23	1.00	4,874.10			
合计	4,923.33	100.00	49.23	1.00	4,874.10			

(3) 应收账款账龄情况

①应收账款坏账计提情况

报告期各期末,公司应收账款的账龄分布和坏账计提情况如下:

单位:万元,%

2025.6.30								
组合	账龄	账面余额	占比	坏账准备	计提比例	账面价值		
组合 1.账	6 个月以内	10,011.80	99.97	100.12	1.00	9,911.68		

龄组合	6 12 U	2.66	0.02	0.12	5 .00	2.52					
以 ≥T □	6-12 月	2.66	0.03	0.13	5.00	2.52					
	小计	10,014.46	100.00	100.25	1.00	9,914.21					
	2024.12.31										
组合	账龄	账面余额	占比	坏账准备	计提比例	账面价值					
	6 个月以内	11,489.95	99.90	114.90	1.00	11,375.05					
组合 1.账	6-12 月	10.97	0.10	0.55	5.00	10.42					
龄组合	1-2 年	0.20	0.00	0.02	10.00	0.18					
	小计	11,501.12	100.00	115.47	1.00	11,385.65					
	2023.12.31										
组合	账龄	账面余额	占比	坏账准备	计提比例	账面价值					
	6 个月以内	9,049.18	100.00	90.49	1.00	8,958.69					
组合 1.账 龄组合	6-12 月	0.20	0.00	0.01	5.00	0.19					
N/AL	小计	9,049.38	100.00	90.50	1.00	8,958.88					
		2	2022.12.3	1							
组合	账龄	账面余额	占比	坏账准备	计提比例	账面价值					
组合 1.账	6 个月以内	4,923.33	100.00	49.23	1.00	4,874.10					
龄组合	小计	4,923.33	100.00	49.23	1.00	4,874.10					

报告期各期末,公司账龄在6个月以内应收账款比例较高,公司应收账款质量较好。

②同行业可比上市公司坏账计提比例

报告期内,公司同行业可比上市公司坏账计提比例情况如下表:

单位: %

上市公司	账龄	2025年1-6月 计提比例	2024 年度计 提比例	2023 年度计 提比例	2022 年度计 提比例
	6个月以内	0.23	0.33	0.35	0.25
	7-12 个月	5.00	3.08	3.56	3.26
彤程新材	1-2 年	10.00	10.00	10.00	10.00
	2-3 年	50.00	50.00	49.96	50.00
	3年以上	100.00	100.00	95.29	100.00
	1年以内	未披露	5.00	5.00	5.00
艾森股份	1-2 年	未披露	10.00	10.00	10.00
	2-3 年	未披露	30.00	30.00	30.00

上市公司	账龄	2025年1-6月 计提比例	2024 年度计 提比例	2023 年度计 提比例	2022 年度计 提比例
	3-4 年	未披露	50.00	50.00	50.00
	4-5 年	未披露	80.00	80.00	80.00
	5年以上	未披露	100.00	100.00	100.00
	1年以内	5.00	5.12	5.00	5.00
	1-2 年	10.00	10.00	10.00	10.00
上海新阳	2-3 年	30.00	30.00	30.79	30.00
工场划切	3-4 年	50.00	50.00	50.00	50.00
	4-5 年	80.00	80.00	80.00	80.00
	5年以上	100.00	100.00	100.00	100.00
	未逾期	1.00	1.00	1.00	1.00
	逾期1个月	8.11	8.12	8.32	8.35
克 士	逾期 2-4 个月	15.01	15.02	15.55	15.12
用八儿电	逾期 5-12 个月	25.00	25.00	25.00	25.00
	逾期 13-24 个月	50.00	50.00	50.00	50.00
	逾期 24 个月以上	100.00	100.00	100.00	100.00
飞凯材料	6个月以内	1.00	1.00	1.00	1.00
	7-12 个月	5.00	5.00	5.00	5.00
	1-2 年	25.00	25.00	25.00	25.00
	2-3 年	50.00	50.00	50.00	50.00
	3年以上	100.00	100.00	100.00	100.00
	6个月以内	未披露	1.00	1.00	1.00
	7-12 个月	未披露	5.00	5.00	5.00
日华由林	1-2 年	未披露	10.00	10.00	10.00
田州也初	2-3 年	未披露	20.00	20.00	20.00
	3-4 年	未披露	50.00	50.00	50.00
未逾期 逾期1个月 逾期2-4个月 逾期5-12个月 逾期13-24个月 逾期13-24个月 逾期24个月以上 6个月以内 7-12个月 1-2年 2-3年 3年以上 6个月以内 7-12个月 1-2个月 1-2年 2-3年	未披露	100.00	100.00	100.00	
	6个月以内	1.00	1.00	1.00	1.00
	7-12 个月	5.00	5.00	5.00	5.00
八司	1-2 年	10.00	10.00	10.00	10.00
公司	2-3 年	20.00	20.00	20.00	20.00
	3-4 年	50.00	50.00	50.00	50.00
	4年以上	100.00	100.00	100.00	100.00

注: 同行业可比上市公司相关指标取自其定期报告或招股书

经对比,公司应收账款坏账计提比例与晶瑞电材一致,且公司账龄1年以内 应收账款坏账计提比例与同行业可比上市公司相比不存在重大差异。因此,公司 应收账款坏账计提政策具有合理性。

(4) 应收账款前五名情况

报告期各期末,公司应收账款金额前五名客户欠款情况如下:

单位:万元,%

	<u> </u>									
	2025.6.30									
序号	单位名称	应收账款 余额	占应收账 款余额的 比例	坏账准备						
1	客户 A1	5,430.18	54.22	54.30						
2	客户 B3	1,358.06	13.56	13.58						
3	客户 B4	994.30	9.93	9.94						
4	客户 B2	874.63	8.73	8.75						
5	客户 H	276.44	2.76	2.76						
	合计	8,933.61	89.20	89.34						
	2024.12.31									
序号	单位名称	应收账款 余额	占应收账 款余额的 比例	坏账准备						
1	客户 A1	7,656.78	66.57	76.57						
2	客户 B4	1,388.96	12.08	13.89						
3	客户 B3	817.00	7.10	8.17						
4	客户 C2	742.01	6.45	7.42						
5	客户 D	175.90	1.53	1.76						
	合计	10,780.65	93.73	107.81						
	2023.12.31									
序号	单位名称	应收账款 余额	占应收账 款余额的 比例	坏账准备						
1	客户 A1	5,370.05	59.34	53.70						
2	客户 B2	1,329.44	14.69	13.29						
3	客户 B3	1,158.98	12.81	11.59						
4	客户 C2	494.61	5.47	4.95						

5	客户 B4	213.39	2.36	2.13
	合计	8,566.48	94.67	85.66
	2022.12.31			
序号	单位名称	应收账款 余额	占应收账 款余额的 比例	坏账准备
1	客户 A1	2,984.58	60.62	29.85
2	客户 B3	869.96	17.67	8.70
3	客户 C2	476.94	9.69	4.77
4	客户 B2	408.38	8.29	4.08
5	客户 A2	61.50	1.25	0.61
	合计	4,801.36	97.52	48.01

报告期各期末,公司应收账款余额前五名客户中,不存在持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

4、预付款项

(1) 预付账款账龄情况

单位:万元,%

2025.6.30		5.30	2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
账龄	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,284.44	99.69	609.57	97.80	533.35	95.94	380.87	94.47
1至2年	0.16	0.00	0.50	0.08	12.77	2.30	1.06	0.26
2至3年	0.11	0.00	3.44	0.55	1	-	21.25	5.27
3年以上	9.89	0.30	9.80	1.57	9.80	1.76	1	-
合计	3,294.59	100.00	623.31	100.00	555.92	100.00	403.18	100.00

报告期各期末,公司预付账款账龄主要在1年以内,占比分别为94.47%、95.94%、97.80%和99.69%。

(2) 预付账款前五名情况

单位:万元,%

	2025.6.30								
序号	单位名称	预付账款余额	占预付账款余额的 比例						
1	上海誉经国际贸易有限公司	1,176.00	35.69						

2	上海西博新材料科技有限公司	793.19	24.08
3	供应商 F	425.20	12.91
4	上海赫夫生物科技有限公司	359.40	10.91
5	供应商 K	69.12	2.10
	合计	2,822.91	85.68
	2024.12.31		
序号	单位名称	预付账款余额	占预付账款余额的 比例
1	厦门大学	250.00	40.11
2	国网辽宁省电力有限公司大连供电公司	34.93	5.60
3	世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司	29.38	4.71
4	供应商 F	29.28	4.70
5	国网福建省电力有限公司漳州供电公司	26.96	4.33
	合计	370.55	59.45
	2023.12.31		
序号	单位名称	预付账款余额	占预付账款余额的 比例
序号 1	単位名称 供应商 F	预付账款余额 237.00	
			比例
1	供应商 F	237.00	比例 42.63
1 2	供应商 F 供应商 E	237.00	比例 42.63 15.42
1 2 3	供应商 F 供应商 E NISSO SHOJI CO.,LTD	237.00 85.75 31.98	比例 42.63 15.42 5.75
1 2 3 4	供应商 F 供应商 E NISSO SHOJI CO.,LTD 上海镒乾电子科技有限公司	237.00 85.75 31.98 27.00	比例 42.63 15.42 5.75 4.86
1 2 3 4	供应商 F 供应商 E NISSO SHOJI CO.,LTD 上海镒乾电子科技有限公司 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司	237.00 85.75 31.98 27.00 23.96	比例 42.63 15.42 5.75 4.86 4.31
1 2 3 4	供应商 F 供应商 E NISSO SHOJI CO.,LTD 上海镒乾电子科技有限公司 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 合计	237.00 85.75 31.98 27.00 23.96	比例 42.63 15.42 5.75 4.86 4.31
1 2 3 4 5	供应商 F 供应商 E NISSO SHOJI CO.,LTD 上海镒乾电子科技有限公司 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 合计 2022.12.31	237.00 85.75 31.98 27.00 23.96 405.68	比例 42.63 15.42 5.75 4.86 4.31 72.97
1 2 3 4 5	供应商 F 供应商 E NISSO SHOJI CO.,LTD 上海镒乾电子科技有限公司 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 合计 2022.12.31	237.00 85.75 31.98 27.00 23.96 405.68	比例 42.63 15.42 5.75 4.86 4.31 72.97 占预付账款余额的
1 2 3 4 5	供应商 F 供应商 E NISSO SHOJI CO.,LTD 上海镒乾电子科技有限公司 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 合计 2022.12.31 单位名称 供应商 A	237.00 85.75 31.98 27.00 23.96 405.68 预付账款余额	比例 42.63 15.42 5.75 4.86 4.31 72.97 占预付账款余额的 比例 36.33
1 2 3 4 5 序号 1 2	供应商 F供应商 ENISSO SHOJI CO.,LTD上海镒乾电子科技有限公司国网辽宁省电力有限公司大连供电公司合计2022.12.31单位名称供应商 A供应商 F	237.00 85.75 31.98 27.00 23.96 405.68 预付账款余额 146.48 85.10	比例 42.63 15.42 5.75 4.86 4.31 72.97 占预付账款余额的 比例 36.33 21.11
1 2 3 4 5	供应商 F供应商 ENISSO SHOJI CO.,LTD上海镒乾电子科技有限公司国网辽宁省电力有限公司大连供电公司合计2022.12.31单位名称供应商 A供应商 F昆山探途电子科技有限公司	237.00 85.75 31.98 27.00 23.96 405.68 预付账款余额 146.48 85.10 37.80	比例 42.63 15.42 5.75 4.86 4.31 72.97 占预付账款余额的 比例 36.33 21.11 9.38

报告期各期末,公司预付账款余额前五名中,不存在持有本公司 5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

5、其他应收款

报告期各期末,公司其他应收款构成的具体明细如下:

单位:万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
其他应收款	4,422.84	10,103.24	7,511.29	5,710.82
小计	4,422.84	10,103.24	7,511.29	5,710.82

(1) 其他应收款分类情况

报告期各期末,公司其他应收款的情况如下:

单位:万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
代收代付款项	4,284.05	9,864.49	6,747.38	5,589.74
保证金及押金	223.30	362.37	854.57	146.14
员工代扣代缴	-	27.21	22.35	21.31
其他往来款	49.70	11.99	21.11	34.07
备用金	8.20	6.35	3.50	3.07
合并范围外关联往来	-	0.01	2.03	-
其他应收款余额	4,565.25	10,272.43	7,650.94	5,794.33
减: 坏账准备	142.40	169.19	139.65	83.51
其他应收款账面价值	4,422.84	10,103.24	7,511.29	5,710.82

报告期各期末,公司其他应收款账面价值分别为 5,710.82 万元、7,511.29 万元、10,103.24 万元和 4,422.84 万元,占各期末流动资产的比例分别为 6.66%、12.81%、11.55%和 3.19%,主要为公司在开展引进产品销售业务中,按照净额法确认收入政策下所形成的代收代付款项。

(2) 其他应收款账龄分布情况

报告期各期末,公司其他应收款账面余额按账龄分布情况如下:

单位:万元,%

账龄	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,366.01	95.64	10,074.90	98.08	7,546.95	98.64	5,680.53	98.04
1至2年	106.93	2.34	105.18	1.02	13.20	0.17	95.61	1.65

账龄	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
2至3年	8.72	0.19	9.40	0.09	73.78	0.96	1.95	0.03
3至4年	1.14	0.02	70.66	0.69	1.78	0.02	6.24	0.11
4至5年	71.66	1.57	1.49	0.01	5.24	0.07	10.01	0.17
5 年以上	10.81	0.24	10.81	0.11	10.01	0.13	-	-
小计	4,565.25	100.00	10,272.43	100.00	7,650.94	100.00	5,794.33	100.00
减: 坏账准备	142.40	3.12	169.19	1.65	139.65	1.83	83.51	1.44
合计	4,422.84	96.88	10,103.24	98.35	7,511.29	98.17	5,710.82	98.56

报告期各期末,公司其他应收款主要为代收代付款项,部分保证金及押金随着合作的持续账龄有所延长。

(3) 其他应收款前五名情况

报告期各期末,公司其他应收款的前五名情况如下:

单位:万元,%

	2025.6.30										
序号	单位名称	性质	其他应收款 余额	占比	坏账准备						
1	香港佑凯电子有限公司	代收代付款	1,526.93	33.45	15.27						
2	客户 C2	代收代付款	865.29	18.95	8.65						
3	客户 B4	代收代付款	359.34	7.87	3.59						
4	客户 B3	代收代付款	259.34	5.68	2.59						
5	客户 B2	代收代付款	163.32	3.58	1.63						
	合计		3,174.22	69.53	31.74						
	2	024.12.31									
序号	单位名称	性质	其他应收款 余额	占比	坏账准备						
1	客户 A1	代收代付款	3,821.09	37.20	38.21						
2	客户 C2	代收代付款	2,850.78	27.75	28.51						
3	香港佑凯电子有限公司	代收代付款	1,518.56	14.78	15.19						
4	绿色光束光电技术(中国)有限公司	代收代付款	826.38	8.04	8.26						
5	Soulbrain Co,.Ltd.	代收代付款	230.73	2.25	2.31						
	合计		9,247.54	90.02	92.48						

	2023.12.31													
序号	单位名称	性质	其他应收款 余额	占比	坏账准备									
1	客户 A1	代收代付款	3,363.13	43.96	33.63									
2	客户 C2	代收代付款	2,676.31	34.98	26.76									
3	漳州高新技术产业开发区财政局	用地履约保 证金	490.00	6.40	24.50									
4	客户 B2	代收代付款	257.58	3.37	2.58									
5	漳州高新技术产业开发区经济发展 服务中心	建设履约保 证金	168.00	2.20	18.90									
	合计		6,955.02	90.91	106.37									
	2	022.12.31			2022.12.31									
序														
号	单位名称	性质	其他应收款 余额	占比	坏账准备									
	单位名称 客户 A1	性质 代收代付款		占比 57.84	坏账准备 33.51									
号	, – , , ,		余额											
号 1	客户 A1	代收代付款	余额 3,351.22	57.84	33.51									
号 1 2	客户 A1 客户 C2	代收代付款 代收代付款 代收代付款 及代垫运费	余额 3,351.22 1,839.54	57.84 31.75	33.51									
日 1 2 3	客户 A1 客户 C2 KANTO DENKA KOGYO CO., LTD.	代收代付款 代收代付款 代收代付款 及代垫运费款	余额 3,351.22 1,839.54 146.13	57.84 31.75 2.52	33.51 18.40 2.80									

报告期各期末,公司其他应收款余额前五名中,不存在持有本公司 5%以上 (含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

6、存货

报告期各期末,公司存货情况具体如下:

单位:万元,%

福口	2025.6.30								
项目	账面余额	存货跌价准备	存货跌价准备占比	账面价值					
原材料	16,993.58	792.78	4.67	16,200.80					
库存商品	1,760.05	44.04	2.50	1,716.01					
发出商品	601.46	-	-	601.46					
半成品	558.72	52.29	9.36	506.44					
在产品	429.25	-	-	429.25					
合计	20,343.07	889.11	4.37	19,453.96					

		2024.	12.31	
项目	账面余额	存货跌价准备	存货跌价准备占比	账面价值
原材料	13,334.12	580.47	4.35	12,753.66
库存商品	1,698.50	46.36	2.73	1,652.13
发出商品	451.69	-	-	451.69
半成品	473.02	41.56	8.79	431.46
在产品	579.50	-	-	579.50
合计	16,536.83	668.39	4.04	15,868.44
16 H		2023.	12.31	
项目	账面余额	存货跌价准备	存货跌价准备占比	账面价值
原材料	10,460.48	242.33	2.32	10,218.15
库存商品	1,446.92	108.08	7.47	1,338.83
发出商品	244.19	30.57	12.52	213.63
半成品	320.04	-	-	320.04
在产品	10.35	-	-	10.35
合计	12,481.98	380.98	3.05	12,101.00
项目		2022.	12.31	
坝口	账面余额	存货跌价准备	存货跌价准备占比	账面价值
原材料	4,521.93	266.15	5.89	4,255.78
库存商品	189.98	69.00	36.32	120.98
发出商品	260.18	167.55	64.40	92.63
半成品	168.05	-	-	168.05
在产品	8.66		-	8.66
合计	5,148.81	502.70	9.76	4,646.10

报告期各期末,公司存货主要为原材料、发出商品、库存商品、在途物资等。 报告期各期末,公司存货账面价值分别为 4,646.10 万元、12,101.00 万元、15,868.44 万元和 19,453.96 万元,占各期末流动资产的比例分别为 5.42%、20.64%、18.14% 和 14.03%,随着公司经营规模的扩大,报告期内存货金额总体呈上升趋势,存货余额与公司经营规模较为匹配。

(1) 存货余额变动分析

报告期内公司存货账面价值持续增长,主要原因系:公司下游客户主要为中国境内领先的晶圆厂,报告期内下游客户的需求稳步增长,订单增长情况良好,

公司积极备货,库存商品、原材料等金额相应增长。

(2) 存货跌价计提情况

公司的存货采用成本与可变现净值孰低的原则进行计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为502.70万元、380.98万元、668.39万元和889.11万元,公司的存货跌价准备计提比例分别为9.76%、3.05%、4.04%和4.37%,2022年的存货跌价准备计提比例较高,主要系前期公司自产前驱体产量较低,承担了较多的固定成本,导致其单位成本较高,公司根据产品实际销售情况,计提了相应的跌价准备。公司存货减值测试方法符合企业会计准则的规定和公司行业特点,存货跌价准备计提充分。

7、其他流动资产

报告期各期末,公司其他流动资产情况如下:

单位: 万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
增值税负数余额重分类	4,025.02	4,485.14	2,204.28	853.70
引进产品	2,915.74	4,729.22	3,482.14	6,417.30
发行相关中介费用	634.72	460.00	-	-
预缴所得税	-	-	316.58	-
应收退货成本	-	-	-	56.43
合计	7,575.48	9,674.36	6,003.00	7,327.44

报告期各期末,公司其他流动资产金额分别为7,327.44万元、6,003.00万元、9,674.36万元和7,575.48万元,占流动资产比例分别为8.54%、10.24%、11.06%和5.46%,主要为待抵扣增值税和尚未实现销售的引进产品。

8、一年内到期的非流动资产

截至 2025 年 6 月 30 日,公司一年内到期的非流动资产 38,705.74 万元,为一年内到期的长期定期存款。

(三) 非流动资产构成及变动分析

报告期各期末,公司非流动资产结构如下表所示:

单位:万元,%

	2025 (20	2024 12	21	2022 12	21	2022 1	
项目	2025.6.	30	2024.12	31	2023.12	.31	2022.1	12.31
· A H	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期股权 投资	3,127.27	2.02	3,491.21	1.97	3,908.02	2.60	1,920.01	2.48
其他权益 工具投资	667.66	0.43	625.08	0.35	611.62	0.41	587.42	0.76
其他非流 动金融资 产	4,967.10	3.20	4,994.24	2.82	2,093.49	1.39	-	-
投资性房 地产	4,696.48	3.03	4,846.82	2.74	5,153.53	3.42	908.62	1.17
固定资产	75,306.71	48.55	77,229.57	43.62	43,959.96	29.22	28,793.77	37.14
在建工程	40,254.31	25.95	34,453.90	19.46	38,930.71	25.87	16,127.48	20.80
使用权资 产	516.08	0.33	231.22	0.13	326.37	0.22	595.88	0.77
无形资产	8,277.81	5.34	8,444.47	4.77	7,262.91	4.83	7,547.23	9.73
长期待摊 费用	679.99	0.44	844.15	0.48	1,182.79	0.79	1,566.01	2.02
递延所得 税资产	6,490.75	4.18	5,544.01	3.13	3,032.83	2.02	1,799.67	2.32
其他非流 动资产	10,122.73	6.53	36,342.88	20.53	44,008.13	29.25	17,689.75	22.81
非流动资 产合计	155,106.89	100.00	177,047.55	100.00	150,470.37	100.00	77,535.84	100.00

报告期各期末,公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产构成,上述四项合计占公司非流动资产的比例分别为 90.48%、89.16%、88.38%和 86.37%。

1、长期股权投资

单位:万元

被投资单位	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
上海八亿时空	1,533.15	1,765.52	2,024.27	-
大晶信息	1,594.12	1,725.69	1,810.35	1,846.73
恒星电子	-	-	73.40	73.28
合计	3,127.27	3,491.21	3,908.02	1,920.01

报告期各期末,公司长期股权投资账面价值分别为 1,920.01 万元、3,908.02 万元、3,491.21 万元和 3,127.27 万元,公司对长期股权投资采用权益法核算,并根据其当期利润确认对应投资收益,导致长期股权投资账面价值相应变动。湖北

恒星电子材料有限公司于2024年7月3日注销。

2021年7月,公司战略投资大晶信息2,000万元,持股10%,大晶信息系上市公司久日新材控股子公司,主要从事信息化学品(感光材料、试剂、原料)、涂料、化学生物医药原料的研发、生产及销售,公司通过与大晶信息合作共同搭建光刻胶关键原材料及其他电子化学材料的平台,以推动我国各类光刻胶原材料国产化进程。2023年11月,公司向上海八亿时空投资2,000万元,上海八亿时空是上市公司八亿时空设立的高端电子材料研发测试平台,主要从事技术服务开发,合成材料销售,电子专用材料研发及销售。

2、其他权益工具投资

单位: 万元

被投资单位	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
湖北三维	667.66	625.08	611.62	587.42
合计	667.66	625.08	611.62	587.42

报告期各期末,公司其他权益工具投资账面价值分别为 587.42 万元、611.62 万元、625.08 万元和 667.66 万元。2019 年 6 月,公司与多家半导体行业内公司共同设立湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司,以获取技术、拓展客户、渠道等为目的,有利于进一步完善公司在半导体行业全产业链的业务布局,公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,并计入其他权益工具投资核算。

3、其他非流动金融资产

单位: 万元

被投资单位	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
长存产投	4,967.10	4,994.24	2,093.49	-
合计	4,967.10	4,994.24	2,093.49	-

报告期各期末,公司其他非流动金融资产账面价值分别为 0 万元、2,093.49 万元、4,994.24 万元和 4,967.10 万元。2023 年 8 月,公司与多家专业机构共同投资设立长存产业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙),主要聚焦投资于存储芯片产业链上下游的优质股权投资项目,截至 2025 年 6 月末,公司认购出资额7,000 万元,累计实缴 4,900 万元。

4、投资性房地产

报告期各期末,公司的投资性房地产构成情况如下:

单位: 万元

项目	项目 2025.6.30		2023.12.31	2022.12.31	
一、账面原值合计	6,482.26	6,482.26	6,488.20	2,148.45	
房屋及建筑物	6,197.72	6,197.72	6,203.66	1,863.91	
土地使用权	284.54	284.54	284.54	284.54	
二、累计折旧合计	1,785.78	1,635.44	1,334.66	1,239.83	
房屋及建筑物	1,675.68	1,528.20	1,233.14	1,144.03	
土地使用权	110.10	107.24	101.52	95.80	
三、账面价值合计	4,696.48	4,846.82	5,153.53	908.62	
房屋及建筑物	4,522.04	4,669.52	4,970.52	719.88	
土地使用权	174.44	177.30	183.02	188.74	

报告期各期末,公司投资性房地产账面价值分别为908.62万元、5,153.53万元、4,846.82万元和4,696.48万元,主要为公司将东孚房产部分闲置楼层对外出租,并采用成本模式进行计量。2023年,投资性房地产增加主要系由于东孚二期房产完成竣工验收并转入投资性房地产,用于对外租赁。

5、固定资产

(1) 固定资产构成及变动情况

报告期各期末,公司的固定资产构成情况如下:

单位: 万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31	
一、账面原值合计	93,409.31	92,193.55	54,075.36	35,478.76	
房屋及建筑物	48,429.81	47,827.81	18,585.96	7,275.07	
机器设备及仓储设备	43,871.95	43,408.73	34,944.71	27,833.95	
运输工具	358.22	358.22	235.60	113.50	
电子设备及其他	749.33	598.79	309.09	256.24	
二、累计折旧合计	17,699.12	14,560.51	9,711.92	6,353.27	
房屋及建筑物	3,400.82	2,262.49	1,222.20	832.81	
机器设备及仓储设备	13,750.36	11,840.79	8,164.68	5,294.79	
运输工具	195.66	166.60	121.77	75.06	

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
电子设备及其他	352.28	290.63	203.27	150.61
三、减值准备合计	403.47	403.47	403.47	331.72
房屋及建筑物		-		-
机器设备及仓储设备	403.47	403.47	403.47	331.72
运输工具	1	1	-	-
电子设备及其他	1	1	-	-
四、账面价值合计	75,306.71	77,229.57	43,959.96	28,793.77
房屋及建筑物	45,028.99	45,565.33	17,363.76	6,442.26
机器设备及仓储设备	29,718.11	31,164.47	26,376.55	22,207.45
运输工具	162.56	191.62	113.83	38.44
电子设备及其他	397.05	308.16	105.82	105.63

报告期各期末,公司固定资产账面价值分别为 28,793.77 万元、43,959.96 万元、77,229.57 万元和 75,306.71 万元,占各期末非流动资产总额的比例分别为 37.14%、29.22%、43.62%和 48.55%。2023 年末和 2024 年末,公司固定资产同比持续增长,主要系漳州二期工程、安徽一期工程、大连二期工程陆续转固;同时,为持续推进光刻材料产业化,公司购置一批价值较高包括光刻机在内的经营所需设备,导致当年固定资产大幅增长。

报告期各期末,公司固定资产整体状况良好,除一批钢瓶因长期闲置而计提减值准备外,不存在其他减值情况。

(2) 固定资产折旧年限与同行业可比公司比较情况

报告期内,公司固定资产折旧年限与同行业上市公司对比情况如下:

单位: 年

项目	公司	彤程新材	艾森股份	上海新阳	南大光电	飞凯材料	晶瑞电材
房屋及建 筑物	20	20-30	20	5-30	20	20	16-20
机器设备 及仓储设 备	5-10	10-15	5-10	5-10	5-10	5-10	3-20
运输工具	4-5	4-5	5	4-5	8-10	5-10	4-5
电子设备 及其他	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5

注:同行业可比公司未披露"电子设备及其他"类别,此处采用"电子设备"、"其他设备"、"办公设备及其他"、"研发及电子设备"类别的数据作为替代;同行业可比公司未披露

"机器设备"类别,此处采用"生产设备"类别的数据作为替代。

经对比,公司固定资产折旧计提政策与可比上市公司同类资产计提政策不存 在显著差异。

6、在建工程

报告期各期末,公司在建工程情况如下:

单位: 万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
生产线建设	29,859.50	28,311.69	20,311.99	1,254.42
基建工程	6,193.34	5,340.79	16,883.09	12,391.12
待安装调试设备	4,201.48	801.43	1,735.63	2,481.94
合计	40,254.31	34,453.90	38,930.71	16,127.48

报告期各期末,公司在建工程余额分别为 16,127.48 万元、38,930.71 万元、34,453.90 万元和 40,254.31 万元,占各期非流动资产总额的比例分别为 20.80%、25.87%、19.46%和 25.95%。

2023 年,公司在安徽一期工程、大连二期工程厂房建设以及漳州二期、大连二期产线投入较高金额,导致 2023 年期末在建工程余额较 2022 年末增长 141.39%。2024 年,安徽一期工程、大连二期工程陆续转固,在建工程余额较上年末有所下降。2025 年 6 月末,公司持续购置设备,在建工程余额较上年末有所增加。

报告期内,公司在建工程均处于正常建设期。公司在建工程建设进度与建设支出相匹配。报告期各期末,公司在建工程不存在减值情况。

7、使用权资产

单位:万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31	
一、账面原值合计	1,809.81	1,385.55	1,209.10	1,154.33	
房屋及建筑物	1,809.81	1,385.55	1,209.10	1,154.33	
二、累计折旧合计	1,293.73	1,154.33	882.73	558.45	
房屋及建筑物	1,293.73	1,154.33	882.73	558.45	
三、账面价值合计	516.08	231.22	326.37	595.88	

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31	
房屋及建筑物	516.08	231.22	326.37	595.88	

报告期各期末,公司使用权资产账面价值金额为 595.88 万元、326.37 万元、231.22 万元和 516.08 万元,主要系公司租赁的办公室及厂房。

8、无形资产

单位:万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
一、账面原值合计	9,627.52	9,627.52	8,117.18	8,095.78
土地使用权	6,491.97	6,491.97	4,981.63	4,981.63
非专利技术	2,677.99	2,677.99	2,677.99	2,677.99
专利技术	300.00	300.00	300.00	300.00
计算机软件	157.56	157.56	157.56	136.17
二、累计摊销合计	1,349.71	1,183.05	854.26	548.55
土地使用权	440.19	375.26	250.44	151.05
非专利技术	729.01	639.74	461.21	282.68
专利技术	68.14	59.76	43.00	26.25
计算机软件	112.38	108.30	99.62	88.57
三、账面价值合计	8,277.81	8,444.47	7,262.91	7,547.23
土地使用权	6,051.79	6,116.71	4,731.19	4,830.57
非专利技术	1,948.98	2,038.24	2,216.78	2,395.31
专利技术	231.86	240.24	257.00	273.75
计算机软件	45.18	49.27	57.95	47.60

报告期各期末,公司无形资产账面价值分别为 7,547.23 万元、7,262.91 万元、8,444.47 万元和 8,277.81 万元,主要由土地使用权和非专利技术构成。其中,非专利技术为 TEOS 生产管理技术。

报告期各期末,公司无形资产不存在减值情况。

9、长期待摊费用

报告期各期末,公司的长期待摊费用构成情况如下:

单位:万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
装修改造	679.99	844.15	1,182.79	1,566.01
合计	679.99	844.15	1,182.79	1,566.01

报告期各期末,公司长期待摊费用账面价值分别为 1,566.01 万元、1,182.79 万元、844.15 万元和 679.99 万元,主要系报告期内公司产生的厂房及办公场地装修改造费用,并在受益期内按照直线法摊销。

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 报告期各期末,公司未经抵销的递延所得税资产具体情况如下:

单位:万元

	1 12. 7370							
	2025	.6.30	2024.	12.31	2023.	12.31	2022.12.31	
项目	可抵扣暂 时性差异	递延所得 税资产	可抵扣暂 时性差异	递延所得 税资产	可抵扣暂 时性差异	递延所得 税资产	可抵扣暂 时性差异	递延所得 税资产
可抵扣亏损	29,216.99	5,493.11	24,441.79	4,568.92	11,528.86	1,952.56	7,249.57	1,115.63
预提费用	2,007.22	405.02	2,490.53	513.08	2,881.19	629.82	1,749.95	383.77
递延收益	1,424.58	356.15	1,424.58	356.15	1,460.29	365.07	1,415.48	353.87
资产减值准备	1,288.43	153.57	1,157.98	165.49	870.57	177.45	920.53	179.46
信用减值准备	232.85	42.18	274.86	55.58	193.39	41.55	132.74	28.91
租赁负债税会 差异	483.46	110.33	231.53	36.82	405.73	101.43	634.39	140.76
公允价值变动 收益	27.14	6.78	-	-	6.51	1.63	67.58	16.89
预计售后支出	-	-	-	-	52.85	13.21	6.60	1.65
内部交易未实 现损益	281.91	44.99	-	-	-	-	-	-
合计	34,962.57	6,612.14	30,021.27	5,696.04	17,399.38	3,282.73	12,176.85	2,220.95

报告期各期末,公司递延所得税资产金额分别为 2,220.95 万元、3,282.73 万元、5,696.04 万元和 6,612.14 万元。报告期内,公司递延所得税资产主要系公司可抵扣亏损、递延收益、预提费用等征税收入和未弥补亏损等导致资产账面价值与其在所属纳税主体的计税基础产生的暂时性差异所致。

(2) 报告期各期末,公司未经抵销的递延所得税负债具体情况如下:

单位:万元

	2025	.6.30	2024.	12.31	2023.	12.31	2022.	12.31
项目	应纳税 暂时性 差异	递延所 得税负 债	应纳税 暂时性 差异	递延所 得税负 债	应纳税 暂时性 差异	递延所 得税负 债	应纳税 暂时性 差异	递延所 得税负 债
长期资产税 会差异	2,031.57	335.21	2,363.52	389.98	3,323.32	548.35	3,160.03	521.40
股权激励暂 时性差异	17.29	3.65	356.65	85.80	696.00	166.95	1,143.81	275.54
使用权资产 税会差异	516.08	109.76	234.64	34.14	326.37	77.47	593.77	131.97
内部交易未 实现损益	-	-	70.78	2.72	150.69	24.44	305.75	61.46
公允价值变 动收益	14.04	3.51	94.24	23.56	-	-	48.01	9.59
合计	2,578.99	452.13	3,119.83	536.20	4,496.38	817.21	5,251.37	999.96

报告期各期末,公司递延所得税负债金额分别为 999.96 万元、817.21 万元、536.20 万元和 452.13 万元。

(3)报告期各期末,公司以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债情况如下:

单位: 万元

	2025.6.30		2024.	2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
项目	递延所得 税资产和 负债互抵 金额	抵销后递 延所得税 资产或负 债余额	递延所得 税资产和 负债互抵 金额	抵销后递 延所得税 资产或负 债余额	递延所得 税资产和 负债互抵 金额	抵销后递 延所得税 资产或负 债余额	递延所得 税资产和 负债互抵 金额	抵销后递 延所得税 资产或负 债余额	
递延所得税资产	121.39	6,490.75	152.02	5,544.01	249.89	3,032.83	421.27	1,799.67	
递延所得税负债	121.39	330.74	152.02	384.18	249.89	567.32	421.27	578.68	

11、其他非流动资产

报告期各期末,公司其他非流动资产构成情况如下:

单位:万元

				1 压• /4/0
项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
长期定期存款	38,705.74	38,856.32	39,701.44	8,067.74
专利转让款	1,608.10	1,608.10	1,608.10	1,608.10
设备款	7,336.88	5,445.05	2,354.68	7,997.87
技术开发款	1,177.76	1,177.76	-	-
工程款	-	-	39.50	16.05

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
预付购房款	-	-	304.41	-
小计	48,828.48	47,087.22	44,008.13	17,689.75
减: 一年内到期的 长期定期存款	38,705.74	10,744.34	-	-
合计	10,122.73	36,342.88	44,008.13	17,689.75

报告期各期末,公司其他非流动资产的金额分别为 17,689.75 万元、44,008.13 万元、36,342.88 万元和 10,122.73 万元,占非流动资产的比例分别为 22.81%、29.25%、20.53%和 6.53%,主要为长期定期存款、预付的设备款和专利技术款等。截至 2022 年末,公司其他非流动资产余额增长 568.56%,主要系期末预付的机器设备采购款和购买的 1 年期以上大额存单增加所致。报告期各期末,专利转让款均为光刻材料树脂配方及生产技术预付款。截至 2023 年末和 2024 年末,公司购买的 1 年期以上大额存单增加导致其他非流动资产快速增长。2024 年末,技术开发款为委托开发树脂材料支付的款项。截至 2025 年 6 月末,部分长期定期存款转入一年内到期的非流动资产,其他非流动资产相应减少。

(四) 营运能力分析

1、主要营运能力指标

报告期内,公司资产周转能力的主要财务指标如下:

财务指标	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
应收账款周转率(次/年)	5.47	5.33	5.26	8.14
存货周转率(次/年)	1.86	1.74	1.57	2.03

注:应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额,存货周转率=营业成本/存货平均余额;2025年1-6月为简单年化数据。

报告期内,公司应收账款周转率分别为 8.14 次/年、5.26 次/年、5.33 次/年和 5.47 次/年。2023 年,受第四季度客户需求回暖影响,公司第四季度营业收入与上年同期相比有所增长,应收账款期末余额增加,导致应收账款周转率有所下降。2024 年度和 2015 年 1-6 月应收账款周转率有所回升。公司建立了完善的应收账款管理制度,定期与客户进行对账和催收,整体而言,公司应收账款周转情况较好。

报告期内,公司存货周转率分别为 2.03 次/年、1.57 次/年、1.74 次/年和 1.86

次/年。2023年,存货周转率有所下降,主要系公司增加了相关原材料的备货。 2024年和2025年1-6月,存货周转率有所上升,主要系市场需求回暖,公司存 货周转率加快。

2、与同行业上市公司的对比分析

报告期内,公司营运能力指标与同行业可比上市公司比较情况如下:

单位:次/年

证券简称	江坐华河		应收账款	次周转率				
业分 间你	证券代码	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度			
彤程新材	603650.SH	4.15	4.33	4.13	3.92			
艾森股份	688720.SH	2.64	2.35	2.60	2.64			
上海新阳	300236.SZ	2.56	2.34	2.21	2.83			
南大光电	300346.SZ	4.02	4.52	4.56	5.02			
飞凯材料	300398.SZ	2.91	2.97	3.05	3.56			
晶瑞电材	300655.SZ	3.80	3.32	3.26	4.99			
平均	平均值		3.31	3.30	3.83			
本么	本公司		5.33	5.26	8.14			
证券简称	证券代码	存货周转率						
近分 則你	业分八 均	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度			
彤程新材	603650.SH	4.88	5.23	5.38	6.25			
艾森股份	688720.SH	5.99	6.09	6.86	6.47			
上海新阳	300236.SZ	2.90	2.93	2.72	2.86			
南大光电	300346.SZ	1.88	1.99	1.73	2.24			
飞凯材料	300398.SZ	2.61	2.82	2.55	2.50			
晶瑞电材	300655.SZ	7.03	7.13	7.51	11.47			
平均		4.21	4.37	4.46	5.30			
本公司		1.86	1.74	1.57	2.03			

注: 同行业可比上市公司相关指标取自其定期报告或招股书。

报告期内,公司应收账款周转率高于同行业可比上市公司,主要系报告期内业务规模保持快速增长,且公司客户均为行业内知名企业,客户回款及时。

报告期内,公司处于快速扩张阶段,存货增长较快,存货周转率低于同行业上市公司平均水平,与南大光电存货周转率相近,公司存货周转情况与其自身经营情况匹配。

十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

(一) 负债构成及变动情况分析

报告期各期末,公司负债规模及构成情况如下:

单位:万元,%

165 日	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	89,090.12	64.28	76,326.71	66.69	47,269.77	66.63	27,912.90	77.03
非流动负债	49,499.38	35.72	38,121.19	33.31	23,670.28	33.37	8,322.35	22.97
负债合计	138,589.50	100.00	114,447.90	100.00	70,940.05	100.00	36,235.25	100.00

从负债规模来看,报告期各期末,公司负债总额分别为 36,235.25 万元、70,940.05 万元、114,447.90 万元和 138,589.50 万元。报告期各期末,随着业务规模的不断扩大,公司负债规模整体呈扩大趋势,并与资产增长情况相匹配。

从负债结构来看,报告期各期末,公司流动负债占负债总额比例分别为77.03%、66.63%、66.69%和64.28%,系公司负债的主要构成。

(二) 流动负债构成及变动分析

报告期各期末,公司流动负债结构如下表所示:

单位:万元,%

16 日	项目 2025.6.30		2024.1	2.31	2023.1	2.31	2022.1	2.31
坝日	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	58,102.71	65.22	40,085.39	52.52	18,295.04	38.70	10,140.77	36.33
交易性金 融负债	20.59	0.02	-	-	-	-	67.58	0.24
应付票据	1,638.96	1.84	993.03	1.30	1	1	1	_
应付账款	19,320.36	21.69	20,558.57	26.93	17,510.09	37.04	10,098.40	36.18
预收款项	11.53	0.01	40.87	0.05	9.24	0.02	-	-
合同负债	807.09	0.91	1,085.32	1.42	865.98	1.83	113.02	0.40
应付职工 薪酬	2,901.96	3.26	4,498.07	5.89	2,879.62	6.09	1,981.34	7.10
应交税费	876.11	0.98	1,114.26	1.46	1,567.66	3.32	995.39	3.57
其他应付 款	1,203.66	1.35	5,404.63	7.08	5,049.21	10.68	4,014.51	14.38
一年内到	4,207.15	4.72	2,546.57	3.34	1,040.08	2.20	369.84	1.32

项目 2025.6.30		.30	2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
坝日	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
期的非流 动负债								
其他流动 负债	1	1	1	1	52.85	0.11	132.06	0.47
流动负 债合计	89,090.12	100.00	76,326.71	100.00	47,269.77	100.00	27,912.90	100.00

报告期各期末,公司流动负债主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬和 其他应付款构成,上述四项合计占公司流动负债的比例分别为 93.99%、92.52%、 92.43%和 91.51%。

1、短期借款

报告期各期末,公司短期借款的具体构成情况如下:

单位:万元,%

							1 1-4	, , , _,	
项目	2025.6.30		2024.1	2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
グロ	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
票据贴现 借款	48,178.96	82.92	35,566.52	88.73	17,168.13	93.84	7,364.86	72.63	
信用借款	5,730.42	9.86	2,947.42	7.35	1,049.00	5.73	2,200.00	21.69	
抵押借款	2,586.35	4.45	-	-	-	-	-	-	
抵押、保 证借款	1,415.18	2.44	1,425.18	3.56	-	-	500.00	4.93	
应付利息	191.80	0.33	146.27	0.36	77.91	0.43	75.91	0.75	
合计	58,102.71	100.00	40,085.39	100.00	18,295.04	100.00	10,140.77	100.00	

报告期各期末,公司短期借款余额分别为 10,140.77 万元、18,295.04 万元、40,085.39 万元和 58,102.71 万元。报告期内,随着公司业务规模的增长,公司通过短期银行融资以满足自身经营相关需求。

报告期内,公司未发生逾期偿还银行贷款的情形。

2、交易性金融负债

单位:万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
外汇衍生交易	20.59	-	-	67.58
合计	20.59	-	-	67.58

为降低美元兑人民币汇率波动风险,公司购买了外汇衍生产品。报告期各期末,交易性金融负债为未交割的远期外汇合约的公允价值变动金额。

3、应付票据

单位: 万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
银行承兑汇票	1,638.96	993.03	-	-
合计	1,638.96	993.03	-	-

2024年末和2025年6月末,公司应付票据余额分别为993.03万元和1,638.96万元,均为银行承兑汇票,系公司为支付货款而向银行申请开具的票据。随着公司业务规模的扩大,为提高资金使用效率,公司使用汇票进行结算。

4、应付账款

单位:万元、%

项目	2025.0	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
应付工程款	6,651.19	34.43	9,520.49	46.31	8,891.53	50.78	5,556.25	55.02	
应付设备款	8,006.95	41.44	7,135.49	34.71	5,839.80	33.35	712.70	7.06	
应付货款	3,571.45	18.49	2,759.84	13.42	909.28	5.19	1,097.63	10.87	
应付采购佣 金	639.39	3.31	883.26	4.30	1,348.20	7.70	1,901.24	18.83	
应付费用款	451.38	2.34	259.50	1.26	521.28	2.98	170.77	1.69	
应付专利技 术款	-	-	-	-	-	-	659.82	6.53	
合计	19,320.36	100.00	20,558.57	100.00	17,510.09	100.00	10,098.40	100.00	

报告期各期末,公司应付账款主要为应付货款、工程款、设备款和采购佣金等。报告期各期末,公司应付账款余额分别为 10,098.40 万元、17,510.09 万元、20,558.57 万元和 19,320.36 万元,占流动负债比例分别为 36.18%、37.04%、26.93%和 21.69%。公司应付账款规模整体呈持续上升趋势,主要系公司生产规模整体逐步扩大,采购金额整体增加所致。

5、预收款项

报告期各期末,公司预收款项的具体构成情况如下:

单位:万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
预收租金	11.53	40.87	9.24	-
合计	11.53	40.87	9.24	-

6、合同负债

报告期各期末,公司合同负债的具体构成情况如下:

单位:万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
预提实物返利	797.75	1,085.32	689.90	113.02
预收货款	9.35	-	176.08	-
合计	807.09	1,085.32	865.98	113.02

报告期各期末,公司合同负债余额分别为 113.02 万元、865.98 万元、1,085.32 万元和 807.09 万元,占流动负债的比例分别为 0.40%、1.83%、1.42%和 0.91%,主要为未兑付的商品款。针对部分客户,公司根据销售情况,在销售过程中通过阶梯定价、买赠、返利等方式给予客户一定的折扣。

7、应付职工薪酬

报告期各期末,公司应付职工薪酬的具体构成情况如下:

单位: 万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
一、短期薪酬	2,897.78	4,487.46	2,863.81	1,978.77
(一) 工资、奖金、津贴和补贴	2,897.78	4,481.51	2,858.82	1,970.84
(二) 职工福利费	-	-	-	-
(三)社会保险费	-	1.43	1.40	6.35
1、医疗保险费	-	1.41	1.36	6.31
2、工伤保险费	-	0.03	0.03	0.04
3、生育保险费	-	-	-	-
(四)住房公积金	-	1.22	1.09	1.25
(五)工会经费和职工教育经费	-	3.30	2.50	0.33
二、离职后福利-设定提存计划	0.24	2.82	2.49	2.57
(一) 基本养老保险	0.24	2.74	2.42	2.49
(二) 失业保险费	-	0.08	0.07	0.08

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
三、辞退福利	3.95	7.78	13.33	-
合计	2,901.96	4,498.07	2,879.62	1,981.34

报告期各期末,公司应付职工薪酬余额分别为1,981.34万元、2,879.62万元、4,498.07万元和2,901.96万元,主要由期末计提的尚未支付的短期薪酬构成,随着公司经营规模的扩大呈增长趋势。

8、应交税费

报告期各期末,公司应交税费的具体构成情况如下:

单位:万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
企业所得税	673.63	946.63	1,260.89	831.11
房产税	135.65	90.01	37.93	63.94
代扣个人所得税	26.02	38.69	218.70	67.53
印花税	21.18	19.04	18.89	17.31
土地使用税	19.43	19.43	14.00	14.00
增值税	0.06	0.40	17.18	0.19
城市维护建设税	-	-	0.01	0.36
教育费附加	-	-	0.00	0.15
地方教育附加	-	-	0.00	0.10
其他税金	0.13	0.05	0.05	0.70
合计	876.11	1,114.26	1,567.66	995.39

报告期各期末,公司应交税费分别为 995.39 万元、1,567.66 万元、1,114.26 万元和 876.11 万元,主要由应交企业所得税、应交房产税、应交个人所得税等构成。报告期各期末,公司应交税费呈现上升趋势,主要系随着公司经营规模的扩大,使得当期应交所得税逐年增加。

9、其他应付款

单位:万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
代收代付款	928.91	5,146.10	4,756.04	3,797.65
预提物流费用	120.52	141.07	88.25	122.96

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
保证金及押金	79.96	71.30	35.22	42.15
员工往来	58.50	43.68	96.69	30.02
员工代扣代缴	12.09	1.65	0.24	1.85
合并范围外关联往来	0.84	0.84	72.76	6.91
其他往来款	2.84	-	-	12.97
合计	1,203.66	5,404.63	5,049.21	4,014.51

报告期各期末,公司的其他应付款分别为 4,014.51 万元、5,049.21 万元、5,404.63 万元和 1,203.66 万元,占公司流动负债的比例分别为 14.38%、10.68%、7.08%和 1.35%,主要为公司在开展引进产品销售业务中,按照净额法确认收入政策下所形成的代收代付款。

10、一年内到期的非流动负债

单位: 万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
一年内到期的长期借款	3,877.54	2,375.59	715.79	-
一年内到期的租赁负债	329.61	170.97	324.29	369.84
合计	4,207.15	2,546.57	1,040.08	369.84

报告期各期末,公司一年內到期的非流动负债金额分别为 369.84 万元、1,040.08 万元、2,546.57 万元和 4,207.15 万元,主要为一年內到期的长期借款和租赁负债。

11、其他流动负债

单位:万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
预计售后支出	-	-	52.85	132.06
合计	-	-	52.85	132.06

2022 年至 2023 年末,公司的其他流动负债余额分别为 132.06 万元和 52.85 万元,主要由于产品质量问题而发生的预计售后支出。

(三)非流动负债构成及变动分析

报告期各期末,公司非流动负债的具体构成如下:

单位:万元,%

项目 2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	20,564.31	41.54	21,046.47	55.21	15,635.40	66.05	-	-
租赁负债	153.84	0.31	60.56	0.16	81.44	0.34	264.55	3.18
递延收益	28,450.48	57.48	16,629.98	43.62	7,386.13	31.20	7,479.11	89.87
递延所得税 负债	330.74	0.67	384.18	1.01	567.32	2.40	578.68	6.95
非流动负债 合计	49,499.38	100.00	38,121.19	100.00	23,670.28	100.00	8,322.35	100.00

报告期各期末,公司非流动负债余额分别为 8,322.35 万元、23,670.28 万元、38,121.19 万元和 49,499.38 万元,主要由长期借款及递延收益构成。

1、长期借款

单位:万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
抵押、保证借款	20,126.18	18,910.85	11,651.33	-
保证借款	4,295.47	4,492.47	4,688.47	-
应付利息	20.20	18.75	11.40	-
小计	24,441.85	23,422.07	16,351.20	-
减: 一年内到期的长期借款	3,877.54	2,375.59	715.79	-
合计	20,564.31	21,046.47	15,635.40	-

报告期内,公司长期借款主要为项目建设及设备购置产生的银行贷款,公司及时偿还借款及利息,未发生逾期。

2、租赁负债

报告期各期末,公司租赁负债的具体构成情况如下:

单位: 万元

				1 座。/3/8
项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
租赁付款额	494.36	234.19	413.50	658.81
减:未确认融资费用	10.90	2.65	7.77	24.41
小计	483.46	231.53	405.73	634.39
减: 一年內到期的租赁负债	329.61	170.97	324.29	369.84
合计	153.84	60.56	81.44	264.55

报告期各期末,公司租赁负债金额为 264.55 万元、81.44 万元、60.56 万元 和 153.84 万元,主要系公司自 2021 年起执行新租赁准则并计提相应租赁负债。

3、递延收益

报告期各期末,公司递延收益的具体构成情况如下:

单位: 万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
政府补助	28,450.48	16,629.98	7,386.13	7,479.11
合计	28,450.48	16,629.98	7,386.13	7,479.11

报告期各期末,公司递延收益余额分别为 7,479.11 万元、7,386.13 万元、16,629.98 万元和 28,450.48 万元,占非流动负债比例分别为 89.87%、31.20%、43.62%和 57.48%,均为已收到但未达到收益确认条件的政府补助。

报告期各期末,公司递延收益中所涉及的具体政府补助项目情况如下:

单位: 万元

	2025年1-6月					
项目 	期初余额	本期新增 补助余额	本期计入其 他收益金额	期末余额	与资产相关/ 收益相关	
材料攻关项目C	8,051.50	12,080.00	50.73	20,080.78	与资产相关	
国家 02 专项补助	2,363.74	-	200.60	2,163.14	与资产相关	
材料攻关项目A	1,384.26	-	14.62	1,369.63	与资产相关	
大连前驱体项目投资补 助	1,181.53	1	36.92	1,144.60	与资产相关	
国家发改委专项补助	1,006.79	1	72.80	933.99	与资产相关	
重大技术装备补助	702.38	1	69.55	632.83	与资产相关	
材料攻关项目B	497.67	-	2.00	495.67	与资产相关	
福建省工程研究中心补助	483.33	-	25.00	458.33	与资产相关	
厦门干式 Arf Barc 量产应用开发	303.55	1	19.80	283.75	与资产相关	
大连新型技术改造试点 补助	1	271.29	-	271.29	与资产相关	
大连 2021 新建重点项目 补助	213.03	1	15.40	197.63	与资产相关	
2021 年省产业领军团队 补助	196.29	-	13.73	182.56	与资产相关	
"雏鹰计划"青年拔尖人 才支持资金	168.38	-	4.05	164.33	与资产相关	

2024 年度省级新型研发 机构设备后补助项目	53.12	-	3.84	49.28	与资产相关		
研发设备补助	24.41	-	1.74	22.67	与资产相关		
合计	16,629.98	12,351.29	530.79	28,450.48	-		
	2024 年度						
项目	期初余额	本期新增 补助余额	本期计入其 他收益金额	期末余额	与资产相关/ 收益相关		
材料攻关项目C	-	8,052.00	0.50	8,051.50	与资产相关		
国家 02 专项补助	2,764.94	-	401.21	2,363.74	与资产相关		
材料攻关项目A	-	1,400.00	15.74	1,384.26	与资产相关		
大连前驱体项目投资补 助	1,255.37	-	73.85	1,181.53	与资产相关		
国家发改委专项补助	1,152.39	-	145.60	1,006.79	与资产相关		
重大技术装备补助	841.47	-	139.09	702.38	与资产相关		
福建省工程研究中心补助	500.00	-	16.67	483.33	与资产相关		
材料攻关项目B	-	500.00	2.33	497.67	与资产相关		
厦门干式 ArfBarc 量产 应用开发	264.56	74.80	35.82	303.55	与资产相关		
大连 2021 新建重点项目 补助	243.83	-	30.80	213.03	与资产相关		
2021 年省产业领军团队 补助	223.76	-	27.47	196.29	与资产相关		
"雏鹰计划"青年拔尖 人才支持资金	84.14	90.00	5.76	168.38	与资产相关		
2024 年度省级新型研发 机构设备后补助项目	-	55.04	1.92	53.12	与资产相关		
研发设备补助	27.90	-	3.49	24.41	与资产相关		
无尘车间装修补助	27.75	-	27.75	-	与资产相关		
合计	7,386.13	10,171.84	927.99	16,629.98			
			2023 年度				
项目	期初余额	本期新增 补助余额	本期计入其 他收益金额	期末余额	与资产相关/ 收益相关		
国家 02 专项补助	3,166.15	-	401.21	2,764.94	与资产相关		
大连前驱体项目投资补 助	1,329.22	-	73.85	1,255.37	与资产相关		
国家发改委专项补助	1,297.99	-	145.60	1,152.39	与资产相关		
重大技术装备补助	980.56	-	139.09	841.47	与资产相关		
福建省工程研究中心补助	-	500.00	-	500.00	与资产相关		
厦门干式 ArF BARC 量产应用开发	216.92	74.80	27.16	264.56	与资产相关		

大连 2021 新建重点项目 补助	274.63	-	30.80	243.83	与资产相关
2021 年省产业领军团队 补助	117.50	125.00	18.74	223.76	与资产相关
"雏鹰计划"青年拔尖 人才支持资金	-	85.00	0.86	84.14	与资产相关
研发设备补助	31.39	-	3.49	27.90	与资产相关
无尘车间装修补助	64.76	-	37.00	27.75	与资产相关
合计	7,479.11	784.80	877.78	7,386.13	
			2022 年度		
项目	期初余额	本期新增 补助余额	本期计入其 他收益金额	期末余额	与资产相关/ 收益相关
国家 02 专项补助	3,567.35	-	401.21	3,166.15	与资产相关
大连前驱体项目投资补 助	1,403.06	-	73.85	1,329.22	与资产相关
国家发改委专项补助	1,443.59	1	145.60	1,297.99	与资产相关
重大技术装备补助	1,119.65	-	139.09	980.56	与资产相关
大连 2021 新建重点项目 补助	305.43	-	30.80	274.63	与资产相关
厦门干式 Arf Barc 量产 应用开发	-	224.40	7.48	216.92	与资产相关
2021 年省产业领军团队 补助	125.00	1	7.50	117.50	与资产相关
无尘车间装修补助	101.76	-	37.00	64.76	与资产相关
研发设备补助	-	31.39	-	31.39	与资产相关
合计	8,065.85	255.79	842.53	7,479.11	

4、递延所得税负债

报告期各期末,公司经抵销后的递延所得税负债分别为 578.68 万元、567.32 万元、384.18 万元和 330.74 万元。公司未经抵销的递延所得税资产、递延所得税负债详见本节之"十一、资产质量分析"之"(三)非流动资产构成及变动分析"之"10、递延所得税资产/递延所得税负债"。

(四)偿债能力分析

1、主要偿债能力指标

报告期内,公司偿债能力的主要财务指标如下:

财务指标	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
流动比率 (倍)	1.56	1.15	1.24	3.07
速动比率 (倍)	1.34	0.94	0.98	2.91
资产负债率	47.18%	43.26%	33.92%	22.19%
财务指标	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
息税折旧摊销前利润(万元)	8,948.01	18,017.11	15,496.39	17,071.84
利息保障倍数 (倍)	15.33	19.54	51.33	43.24

报告期各期末,公司的流动比率分别为 3.07 倍、1.24 倍、1.15 倍和 1.56 倍, 速动比率分别为 2.91 倍、0.98 倍、0.94 倍和 1.34 倍。报告期各期末,公司流动 比率均大于 1,公司短期偿债能力较强。

报告期各期末,公司资产负债率分别为 22.19%、33.92%、43.26%和 47.18%, 资产负债率处于合理水平,其中 2022 年资产负债率较低主要系当年完成了外部 股权融资。

报告期内,公司息税折旧摊销前利润分别为 17,071.84 万元、15,496.39 万元、18,017.11 万元和 8,948.01 万元,利息保障倍数分别为 43.24 倍、51.33 倍、19.54 倍和 15.33 倍,整体呈现增长趋势且保持在较高水平,公司整体偿债能力较强。

2、与同行业上市公司的对比分析

报告期内,公司与同行业上市公司偿债能力指标比较如下:

证券简称	江坐仏前	流动比率(倍)			
业分 间外	证券代码 	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
彤程新材	603650.SH	1.23	1.06	1.41	1.12
艾森股份	688720.SH	2.28	2.18	3.97	2.34
上海新阳	300236.SZ	2.02	2.41	2.64	2.33
南大光电	300346.SZ	2.71	2.36	2.78	3.36
飞凯材料	300398.SZ	1.96	1.85	2.04	1.95
晶瑞电材	300655.SZ	5.91	5.00	3.36	2.20
平块	·····································	2.68	2.48	2.70	2.22
本么	公司	1.56	1.15	1.24	3.07
> 工 火 & 	证券代码		速动比率	医(倍)	
<u>证券简称</u>	近分八時	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31

彤程新材	603650.SH	1.03	0.89	1.17	0.94
艾森股份	688720.SH	2.03	1.94	3.79	2.03
上海新阳	300236.SZ	1.64	2.00	2.28	2.00
南大光电	300346.SZ	2.13	1.93	2.24	2.76
飞凯材料	300398.SZ	1.53	1.46	1.64	1.52
晶瑞电材	300655.SZ	5.50	4.69	3.13	2.04
平均	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.31	2.15	2.38	1.88
本公	公司	1.34	0.94	0.98	2.91
) 16 AA-76	\T\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	资产负债率(%)			
江光祭粉	江米伊田		页/ 火顶	** (/0 /	
证券简称	证券代码	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
证券简称 形程新材	证券代码 603650.SH	2025.6.30 61.48			2022.12.31 54.20
			2024.12.31	2023.12.31	
彤程新材	603650.SH	61.48	2024.12.31 58.86	2023.12.31 52.21	54.20
形程新材 艾森股份	603650.SH 688720.SH	61.48	2024.12.31 58.86 21.38	2023.12.31 52.21 20.60	54.20 21.53
形程新材 艾森股份 上海新阳	603650.SH 688720.SH 300236.SZ	61.48 25.18 24.19	2024.12.31 58.86 21.38 22.03	2023.12.31 52.21 20.60 24.35	54.20 21.53 26.08
形程新材	603650.SH 688720.SH 300236.SZ 300346.SZ	61.48 25.18 24.19 37.26	2024.12.31 58.86 21.38 22.03 38.41	2023.12.31 52.21 20.60 24.35 52.68	54.20 21.53 26.08 50.42
形程新材 艾森股份 上海新阳 南大光电 飞凯材料 晶瑞电材	603650.SH 688720.SH 300236.SZ 300346.SZ 300398.SZ	61.48 25.18 24.19 37.26 27.35	2024.12.31 58.86 21.38 22.03 38.41 36.91	2023.12.31 52.21 20.60 24.35 52.68 39.10	54.20 21.53 26.08 50.42 39.52

注: 同行业可比上市公司相关指标取自其定期报告或招股书。

2022 年公司通过引入外部投资者,三项指标均优于同行业上市公司,公司总体偿债能力较好。为了满足生产和经营的需要,公司不断加大在长期资产方面的投资,导致 2023 年末和 2024 年末公司流动比率、速动比率低于同行业可比上市公司,但资产负债率仍保持合理水平。2025 年 6 月末,流动比率、速动比率有所回升。

报告期内,公司银行资信状况良好,公司将继续与银行保持良好合作的同时进一步借助资本市场融资,拓宽融资渠道,提高偿债能力,维持合理的财务杠杆水平。

(五)股东权益情况分析

报告期各期末,公司股东权益结构如下:

单位:万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
股本	38,192.17	38,192.17	38,192.17	38,192.17
资本公积	78,733.26	77,878.01	76,181.93	74,821.27
其他综合收益	1,115.34	1,168.23	840.39	576.94
专项储备	730.98	620.60	410.41	213.95
盈余公积	510.29	510.29	386.96	279.38
未分配利润	35,878.86	31,718.82	22,150.22	13,272.88
归属于母公司股东权益合计	155,160.90	150,088.11	138,162.07	127,356.58
少数股东权益	0.26	0.62	6.48	-302.24
股东权益合计	155,161.16	150,088.73	138,168.55	127,054.35

报告期各期末,公司所有者权益金额分别为 127,054.35 万元、138,168.55 万元、150,088.73 万元和 155,161.16 万元,呈现逐年上升趋势,主要系报告期内公司持续盈利,随着公司经营利润积累及引入投资者增资等因素,公司所有者权益不断增加。

(六) 股利分配情况

报告期内,公司不存在股利分配的情况。

(七) 流动性风险分析

1、长短期债务配置期限分析

报告期内,公司流动负债和非流动负债的比重维持在相对稳定的水平,并以经营性的流动负债为主,流动比率较高,短期偿债能力较好,公司的资本结构稳健,长期偿债能力较强,长短期债务配置期限与公司现阶段的业务发展情况相适应。

2、影响现金流量的重要事件或承诺事项

公司财务政策较为稳健,资信状况良好,报告期内不存在逾期债务未偿还的情况。截至本招股意向书签署日,公司不存在影响现金流量的重要事件或承诺事项。

3、风险管理政策

公司主要通过如下措施管理流动性风险,增强偿债能力:

- (1)与客户保持良好合作关系的同时,加强对应收账款的管理,及时催收回款;
- (2)与主要供应商建立长期稳定的合作关系,合理利用商业信用,获得供应商的流动性支持;
 - (3) 加深与所在地银行的合作,申请扩大授信额度,分散借款来源;
 - (4)根据公司经营需要,科学合理安排债务期限结构,避免债务集中到期;
- (5)通过首次公开发行股票并上市,进一步充实公司股本,拓展融资渠道, 降低融资成本。

(八) 持续经营能力情况

公司致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用,是中国境内少数具备 12 英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一,主要从事光刻材料和前驱体材料的研发、生产和销售。公司客户涵盖了多家中国境内领先的 12 英寸集成电路晶圆厂,已实现境外同类产品替代,打破集成电路关键材料国外垄断。报告期内,公司实现营业收入分别为 32,176.52 万元、36,770.78 万元、54,793.88 万元和 29,433.73 万元,最近三年年均复合增长率达到 30.50%,公司处于高速发展期,预计公司未来将继续保持良好的盈利能力。

行业及产业政策方面,"十四五"规划明确指出要推动集成电路技术创新和应用,推进前沿新材料研发应用,国家出台了各类鼓励性与支持性政策持续扶持集成电路产业以解决供应链安全问题,在国家战略持续深化的背景下,中国境内集成电路产业快速成长;产品及技术创新方面,公司高度重视产品研发和技术创新,积极拓展产品维度与应用场景,不断提升公司产品的稳定性与可靠性。依托公司在集成电路关键材料领域的领先地位,公司时刻跟进行业趋势与市场方向,以行业发展和客户需求为导向,研发与布局多项集成电路先进制程所需的关键材料,从而持续获取更多优质客户,形成新的收入增长点;市场及行业竞争方面,公司经过多年的发展积累了良好的口碑,具有优质的客户基础和客户黏性,通过积极配合客户工艺制程发展规划,不断增强客户订单的连续性和稳定性。

报告期内,公司营业收入呈上升趋势,市场环境、经营模式、产品结构均未发生重大变化。未来计划将募集资金投入集成电路前驱体二期项目、集成电路用

先进材料项目,将进一步完善公司产品线布局,丰富公司产品种类,推动公司技术创新,提高公司核心竞争力,同时满足客户持续增长的国产化需求。

因此,综合考虑公司报告期内的业绩、半导体行业市场规模的持续增长,以及所处行业及产业政策、技术发展等情况,公司不存在重大的持续经营风险。

十三、现金流量分析

报告期内,公司的现金流量基本情况如下所示:

单位:万元

				1 1- 7 7 7
项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	19,128.30	19,158.76	8,796.42	14,933.43
投资活动产生的现金流量净额	-22,608.44	-41,544.85	-53,830.98	-48,631.00
筹资活动产生的现金流量净额	20,619.46	25,681.49	26,314.17	59,431.83
现金及现金等价物净增加额	16,846.97	3,744.82	-18,628.46	25,942.90
期末现金及现金等价物余额	41,576.17	24,729.20	20,984.38	39,612.85

(一) 经营活动现金流量分析

1、经营活动现金流量变动情况

报告期内,公司的经营活动产生的现金流量情况如下所示:

单位:万元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	34,101.89	57,866.87	36,548.98	32,531.83
收到的税费返还	1,891.18	1,346.37	2,464.45	2,752.44
收到其他与经营活动有关的现金	36,344.70	59,116.26	40,855.70	46,718.46
经营活动现金流入小计	72,337.77	118,329.51	79,869.13	82,002.73
购买商品、接受劳务支付的现金	23,663.72	29,603.49	23,021.69	10,604.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6,016.24	8,439.53	6,371.77	4,559.38
支付的各项税费	1,807.09	4,535.85	3,051.83	2,968.46
支付其他与经营活动有关的现金	21,722.42	56,591.87	38,627.42	48,937.06
经营活动现金流出小计	53,209.47	99,170.75	71,072.71	67,069.30
经营活动产生的现金流量净额	19,128.30	19,158.76	8,796.42	14,933.43

报告期内,公司经营活动现金流入主要来自销售商品、提供劳务收到的现金,经营活动现金流出主要来自购买商品、接受劳务支付的现金。报告期内,公司经

营活动产生的现金流量净额分别为 14,933.43 万元、8,796.42 万元、19,158.76 万元和 19,128.30 万元。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额均为正,主要系公司业务发展迅速,销售回款情况良好所致。

2、经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配情况

报告期内,公司净利润与经营活动产生的现金流量净额之间的差异及主要影响因素如下:

单位:万元

项目	2025年1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
净利润	4,159.64	9,691.11	8,976.26	9,972.83
加:资产减值准备	433.87	618.30	143.89	942.42
信用减值损失	-41.71	54.50	97.41	29.25
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气 资产折耗、生产性生物资产折旧	3,438.36	5,133.76	3,445.58	2,915.12
使用权资产折旧	139.41	305.66	324.31	289.22
无形资产摊销	166.66	276.08	261.17	248.75
长期待摊费用摊销	169.03	665.27	717.42	682.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"一"号填列)	-463.35	-4.58	31.40	-1.60
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)	41.55	-	3.74	1.03
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)	13.09	-100.75	-3.32	21.44
财务费用(收益以"一"号填列)	317.77	-773.33	-1,014.11	140.47
投资损失(收益以"一"号填列)	363.94	385.97	-232.13	-62.54
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	-946.74	-2,511.18	-1,233.16	-333.23
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)	-53.44	-183.14	-11.37	226.19
存货的减少(增加以"一"号填列)	-4,019.39	-4,385.74	-7,351.27	-1,796.37
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	6,712.15	-4,710.39	-75.51	-782.45
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	7,731.81	12,540.00	2,905.94	1,353.84
其他	965.64	2,157.22	1,810.17	1,086.66
经营活动产生的现金流量净额	19,128.30	19,158.76	8,796.42	14,933.43

报告期各期,公司经营活动产生的现金流量净额与净利润均为正。

(二) 投资活动现金流量分析

报告期内,公司的投资活动产生的现金流量情况如下所示:

单位:万元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
收回投资收到的现金	4,000.00	5,395.69	52,224.27	63,499.55
取得投资收益收到的现金	548.61	114.14	278.73	630.07
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	812.91	-	55.52	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	6,800.00	7.52
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	-	73.41	-	-
投资活动现金流入小计	5,361.53	5,583.24	59,358.52	64,137.14
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	12,238.80	40,927.29	36,860.44	27,137.05
投资支付的现金	15,731.17	6,200.80	76,329.05	78,831.08
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	6,800.00
投资活动现金流出小计	27,969.97	47,128.09	113,189.49	112,768.13
投资活动产生的现金流量净额	-22,608.44	-41,544.85	-53,830.98	-48,631.00

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-48,631.00万元、-53,830.98万元、-41,544.85万元和-22,608.44万元,公司投资活动现金流入主要为公司赎回理财产品收到的现金,投资活动现金流出主要系购买理财产品支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,其中公司报告期内购买了结构性存款、定期存单等中低风险的理财产品,并在年度内滚存投入和赎回。2022年和2023年,公司购买大额银行存单增加,故投资支付的现金金额较大。

(三) 筹资活动现金流量分析

报告期内,公司筹资活动现金流量构成如下:

单位:万元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
吸收投资收到的现金	-	-	-	64,307.27
取得借款收到的现金	54,619.61	73,218.21	36,105.30	21,868.79
收到其他与筹资活动有关的现金	3,565.09	8,524.52	4,949.77	3,000.00
筹资活动现金流入小计	58,184.70	81,742.72	41,055.06	89,176.07
偿还债务支付的现金	35,445.92	44,432.70	11,613.22	21,353.93

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	835.02	1,064.74	319.96	310.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,284.30	10,563.79	2,807.72	8,079.48
筹资活动现金流出小计	37,565.24	56,061.23	14,740.90	29,744.24
筹资活动产生的现金流量净额	20,619.46	25,681.49	26,314.17	59,431.83

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 59,431.83 万元、26,314.17 万元、25,681.49 万元和 20,619.46 万元,公司筹资活动现金流入主要系吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金,主要系公司通过股权融资、向银行借款等形式取得现金以满足业务扩张对营运资金的需求;公司筹资活动现金流出主要系偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金,主要系偿还借款及利息等。

十四、重大资本性支出分析

(一) 报告期内的重大资本支出情况

报告期内,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 27,137.05 万元、36,860.44 万元、40,927.29 万元和 12,238.80 万元,主要系购建厂房及机器设备的支出。除此之外,公司不存在其他重大资本性支出。

(二) 未来可预见的重大资本性支出计划

公司计划将本次发行募集资金用于集成电路前驱体二期项目、集成电路用先进材料项目,具体参见本招股意向书"第七节募集资金运用与未来发展规划"。

除本次发行募集资金有关投资项目外,公司未来的资本性支出计划将基于公司实际业务发展需要,根据届时的行业情况、市场竞争状况、战略发展目标等综合因素合理安排并适当调整。

十五、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 资产负债表期后事项

截至本招股意向书签署日,发行人不存在应披露的资产负债表期后事项。

(二) 或有事项

截至本招股意向书签署日,发行人不存在需要披露的重大或有事项。

(三) 其他重要事项

截至本招股意向书签署日,发行人不存在需要披露的其他重要事项。

十六、盈利预测情况

公司未编制盈利预测报告。

十七、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况

(一) 审计基准日后主要经营情况

本招股意向书已披露的财务报告的审计基准日为 2025 年 6 月 30 日。自财务报告审计截止日后至招股意向书签署日之间,公司经营情况良好,公司产业政策、税收政策、行业市场环境、主要经营模式、主要客户及供应商的构成、经营管理层及核心技术人员未发生重大变化,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

(二) 2025年1-9月业绩预计

基于公司目前的经营状况和市场环境,公司预计 2025 年 1-9 月主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例
营业收入	44,000.00 至 50,000.00	39,118.38	12.48%至 27.82%
归属于母公司所有者的净 利润	6,200.00 至 6,800.00	7,004.39	-11.48%至-2.92%
扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润	4,900.00 至 5,500.00	6,685.16	-26.70%至-17.73%

2025年1-9月,公司预计营业收入较上年同期增加12.48%至27.82%,扣非前后归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期减少11.48%至2.92%、26.70%至17.73%,主要变动原因与2025年1-6月相关变动原因一致。

上述 2025 年 1-9 月业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计,未经注册会计师审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金概况

(一)募集资金投资方向

2025 年 3 月 26 日,公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于调整公司募投项目的议案》,为满足公司漳州二期工程建设需要,公司对原计划用于 "SiARC 开发与产业化项目"实施的场地用途进行了调整,因此同意"SiARC 开发与产业化项目"不再作为募投项目,拟募资总额降低至 100,669.50 万元。

公司本次拟公开发行人民币普通股 6,739.7940 万股, 所募集资金扣除发行费用后, 将按项目建设轻重缓急投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	实施主体
1	集成电路前驱体二期项目	51,911.33	39,980.22	大连恒坤
2	集成电路用先进材料项目	90,916.74	60,689.28	安徽恒坤
	合计	142,828.07	100,669.50	

如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,不足部分将由公司以银行贷款或其他途径解决。如本次发行实际募集资金超过预计募集资金数额的,剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

(二) 募集资金投资项目备案及环评批复情况

公司本次募集资金投资项目已获得相关主管部门的备案和环评批复,具体情况如下:

序号	项目名称	备案项目代码	项目环评批复
1	集成电路前驱体二 期项目	2020-210200-26-03-002606	大环评准字【2022】100190号、 大环评准字[2024]000028号
2	集成电路用先进材 料项目	2109-340100-04-01-686466	环建审(2024)12038 号

(三) 募集资金使用管理制度

公司已经根据相关法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定

了《募集资金管理办法》。《募集资金管理办法》对募集资金的存储、使用、管理 与监督进行了明确的规定,公司将严格履行募集资金使用的相关审批手续,保障 募集资金的安全和高效使用。

根据规定,本次募集资金将存放于董事会批准设立的专项账户集中管理、专款专用。公司将严格按照中国证监会和证券交易所的有关规定管理使用本次募集资金。

(四)募集资金对公司主营业务发展的贡献、对公司未来经营战略的影响、 募集资金重点投向科技创新领域的具体安排

1、募集资金投资项目对公司主营业务发展的贡献

公司致力于集成电路领域关键材料的研发、生产和销售,目前主要产品包括 SOC、BARC、i-Line、KrF、ArF 等光刻材料和 TEOS 等前驱体材料,相关产品 广泛应用于 12 英寸集成电路晶圆制造各类工艺,客户覆盖了多家中国境内领先的 12 英寸集成电路晶圆厂。公司自主生产销售的光刻材料产品已成功打破国外垄断,实现替代。

本次募投项目的实施将进一步完善公司产品线布局,丰富公司产品种类,推动公司技术创新,提高公司核心竞争力,同时满足客户的国产化需求。

2、募集资金投资项目对公司未来经营战略的影响

本次募集资金投资项目与公司未来发展战略紧密相连,项目的实施是公司未来发展的重要环节。本次募集资金投资项目紧密契合公司主营业务规模不断扩大的需求,紧跟集成电路领域关键材料国产化趋势,对于公司增强竞争优势、落实未来发展战略具有重要意义。

3、募集资金重点投向科技创新领域的具体安排

本次募集资金投资项目对公司持续的产品和技术创新与业务规模增长提供 了有力的支持。公司主要从事集成电路领域关键材料的研发、生产和销售,通过 本次募投项目的实施,将带动公司创新产品的研发与应用,进一步完善公司产品 结构,推动公司技术创新,促进相关产品国产化水平的提升。

二、募集资金投资项目实施的必要性和可行性

(一)募集资金投资项目的必要性

1、集成电路关键材料国产化率亟待提高,保障高端芯片制造供应链安全

长期以来,光刻材料、前驱体等集成电路关键材料被欧美、日韩等国外头部厂商所垄断,中国境内集成电路关键材料企业在原材料供应、研制设备、技术积累、人才培养以及资金储备等方面仍然与国外头部厂商存在较大差距。目前,国产集成电路关键材料市场份额较低,且主要集中在中、低端领域。随着欧美、日韩等在集成电路领域对我国的限制不断升级,导致中国境内集成电路产业供应链为保障中国境内集成电路产品的稳定供应,需加快推进集成电路关键材料的国产化,尤其是受限制最严重的高端集成电路领域。

公司本次募投项目的实施,将促进前驱体、KrF、ArF 等集成电路关键材料的研发和产业化落地,提升相关产品的国产化水平,保障高端集成电路领域的供应链安全。

2、抢占市场先机,实现公司战略发展目标

目前,我国光刻材料、前驱体等集成电路关键材料主要依赖于进口,中国境内厂商在业务规模、产品质量、批次稳定性上都相对落后。随着中国境内晶圆代工能力的逐步增强,以及下游需求的快速增长,中国境内主要晶圆厂的产能持续扩张,加之国外头部厂商对我国集成电路行业的限制不断升级,中国境内集成电路关键材料厂商迎来黄金的发展窗口期。对于已经具有集成电路客户基础的厂商,快速研发出符合参数标准、工艺要求的产品,并保证批量供应能力和产品质量稳定性,将有利于抢占国产化的市场份额。

通过本次募投项目的实施,公司将在前驱体、KrF、ArF 等集成电路关键材料实现国产化,填补国内集成电路行业在相关材料领域的空白,有助于公司把握细分市场进入机会,抢占市场先机,实现公司战略发展目标。

3、丰富公司产品矩阵,扩大公司品牌影响力

报告期内,公司主要产品包括光刻材料和前驱体材料,相关产品广泛应用于12 英寸集成电路晶圆制造各类工艺,客户覆盖了多家中国境内领先的12 英寸集

成电路晶圆厂。前驱体材料方面,公司在研和生产的包括 TEOS 等硅基前驱体材料和四氯化铪等金属基前驱体。光刻材料方面,KrF、ArF 将更好地满足客户先进制程的需求; Top Coating 是用于超高端芯片制造的辅助材料,即顶部抗水涂层,搭配浸没式光刻胶 ArFi 使用,可防止光刻胶的有机物成分进入光刻机中导致的污染光刻机镜头,可适用于 45nm~7nm 芯片制造。

本次募投项目的实施将进一步丰富公司产品矩阵,更好地满足客户的国产化 需求,扩大公司品牌影响力。

(二) 募集资金投资项目的可行性

1、符合国家产业政策导向及受相关政策支持,本项目具有政策可行性

本次募投项目相关产品的开发和产业化属于《重点新材料首批次应用示范指导目录(2024年版)》中重点发展的品类。2022年1月,国务院发布《"十四五"数字经济发展规划》通知,提出为了加快推动数字产业化,需要增强关键技术创新能力及提高核心产业竞争力,瞄准集成电路、新材料等战略性前瞻性领域,发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势,提升关键基础材料和生产装备的供给水平,强化关键产品自给保障能力。2022年12月,中共中央、国务院根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,制定《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,提出加快发展新产业新产品以提高供给质量和带动需求更好实现。全面提升信息技术产业核心竞争力,推动集成电路技术创新和应用,推进前沿新材料研发应用。2023年2月,中共中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实,开展材料质量提升关键共性技术研发和应用验证,提高材料质量稳定性、一致性、适用性水平。

为进一步落实"十四五"的战略规划,国家各部委以及地方政府出台了一系列政策指导,扶持集成电路相关产业的发展。国务院出台的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》给予集成电路设计、装备、材料、封装测试企业更为优惠的税收政策,进一步减轻集成电路企业的负担;《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》明确了国家鼓励的集成电路生产、设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业的税收优惠政策;

《福建省"十四五"制造业高质量发展专项规划》明确指出,要增强集成电路材料和装备本地配套及服务能力,支持大尺寸硅片、光刻胶、高纯化学试剂、电子气体、化合物半导体材料、溅射靶材以及沉积设备、刻蚀设备、半导体检测设备等研发和产业化。

综上,国家从产业政策、税收优惠等各个方面积极推动集成电路关键材料的 发展,为本次募投项目的实施奠定了政策基础。

2、公司建立了强大的研发团队和研发体系,本项目具有技术可行性

公司聚集了一支高学历、高素质、富有开拓进取和创新精神的研发队伍及具有丰富经验的生产技术专家,积极开展集成电路关键材料的研究开发。公司核心团队既包括曾任职于境内主流晶圆厂的光刻工艺技术专家,也包括拥有材料专业背景的高级人才,专业涵盖了集成电路关键材料的前端合成与分析测试以及后端应用,在集成电路材料行业积累了数年的丰富经验和先进技术。

在前驱体方面,目前公司已经有多款产品实现量产,具备完善的配套设备以及优秀的研发团队,不仅可以满足产品各项性能的测试,而且在精馏提纯等关键生产步骤上积累了丰富的经验。本次募投项目计划研发的多种前驱体已经完成产品的设计,并按照研发流程逐步推进优化改性、客户端测试验证、中试以及量产化等产业化步骤。在 KrF、ArF 方面,公司已有多款产品在客户进行验证或完成验证。

综上,优秀的研发团队和丰富的经验技术,为本次募投项目的实施提供了技术保障。

3、先进制程芯片成为主要推动力,本项目具备市场可行性

随着我国集成电路制造工艺制程和封装技术的持续提升,先进制程芯片对集成电路关键材料的需求亦随之大幅增加。前驱体的使用能够改善芯片性能,且芯片制程越先进,所使用的前驱体品种越多、价格越高。KrF、ArF 作为高端光刻胶,在先进制程光刻工序得到广泛应用,且目前国产化率极低。

根据弗若斯特沙利文预测,中国境内集成电路前驱体的市场规模将由 2023 年 52.5 亿元增长到 2028 年 176.0 亿元,年复合增长 27.4%。其中,硅基前驱体将由 2023 年 25.6 亿元增长到 2028 年 72.6 亿元,年复合增长率 23.2%;金属基

前驱体将由 2023 年 26.9 亿元增长到 2028 年 103.4 亿元,年复合增长率 30.9%。中国境内半导体光刻胶的市场规模将由 2023 年 64.2 亿元增长到 2028 年 150.3 亿元,年复合增长率 18.5%。其中,ArF 光刻胶市场规模将由 2023 年 15.2 亿元增长至 2028 年 57.6 亿,年复合增长率达 30.5%; KrF 光刻胶市场规模将由 2023 年 21.5 亿元增长至 2028 年 49.3 亿,年复合增长率达 18.1%。

综上,先进制程芯片对集成电路关键材料的需求增长,为本次募投项目的实施创造了市场条件。

(三)募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的联系

公司主营业务为集成电路领域关键材料的研发、生产和销售,相关产品广泛应用于 12 英寸集成电路晶圆制造各类工艺。公司本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于与主营业务相关的项目。本次募投项目的实施将进一步完善公司产品线布局,丰富公司产品种类,推动公司技术创新,提高公司核心竞争力,同时满足客户持续增长的国产化需求。

综上,本次募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间具有紧 密的联系。

三、募集资金投资项目对同业竞争和发行人独立性的影响

公司本次募集资金投资项目不涉及与他人合作的情况,项目实施后不产生同业竞争,也不存在对发行人独立性产生不利影响的情形。

四、募集资金投资项目实施对财务状况和经营成果的影响

(一) 对净资产和每股净资产的影响

本次发行募集资金到位后,公司净资产总额及每股净资产有较大幅度增加, 将大大增强公司后续持续融资能力和抗风险能力。

(二)对净资产收益率和盈利能力的影响

本次首次公开发行股票并上市后,公司的股本及净资产均将有所增加。随着 本次募集资金的陆续投入,公司将显著增加营运资金、扩大业务规模、促进业务 发展,对未来经营业绩产生积极影响。但募集资金产生效益需要一定的过程和时 间,在募集资金投入产生效益之前,公司利润和股东回报仍主要依赖现有业务。 若公司受经济周期、投资规划、技术进步、募集资金投资项目实施等各项因素影响,净利润不能保持较快的增长速度,则公司短期内可能存在因股本总额增加导致每股收益、净资产收益率等即期回报指标被摊薄。

(三)费用支出和折旧对未来经营成果的影响

本次募集资金投资项目将新增固定资产和无形资产,项目建设后固定资产折旧和无形资产摊销将有一定幅度的增加。随着项目达到预定可使用状态,项目新增主营业务收入也将不断增加,项目新增销售收入足以抵消新增折旧的影响。因此,新增固定资产折旧不会对公司的经营成果产生不利影响。

(四)对资产负债率和资本结构的影响

本次募集资金到位后,公司资产负债率将进一步下降,资产流动性将显著提高,偿债风险将大为降低、财务结构将显著改善,防范财务风险的能力将得到进一步的提高。

五、未来发展与规划

(一) 公司发展战略

集成电路是信息技术产业的核心和国民经济信息化的基础,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,是国家创新驱动发展战略的重点发展领域。集成电路关键材料作为集成电路产业的基石,在集成电路制造技术升级和产业创新发展中扮演着重要角色。目前,我国集成电路关键材料虽然基本实现了重点材料领域的布局或量产,但产品整体仍然以中低端为主,高端材料依然被欧美、日韩等境外厂商主导,在产能及市场占有率方面与境外厂商也有较大差距,自主化率低,国产化需求迫切,市场空间巨大。

公司历经多年发展,已成为一家致力于光刻材料、前驱体等集成电路关键材料研发、生产和销售的创新企业,拥有自主研发能力和知识产权,产品主要应用于 12 英寸集成电路晶圆制造各类工艺,填补多项国内空白。

公司未来将持续深耕集成电路关键材料领域,加大技术开发和产业化布局,不断拓展产品线,稳固产品品质,积极参与客户的定制化开发,为客户提供集成电路关键材料整体解决方案;协同上下游产业链创新发展,建立安全可控的供应

链;打造品牌效应,积极拓展海外市场,力争成为具有核心竞争力,国内领先、国际先进的集成电路关键材料本土企业。

(二)报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

1、拓展核心技术攻关及产品应用开发

公司一直致力于集成电路关键材料的核心技术攻关及产品在客户端的应用开发,在技术研发和产业化布局方面有着卓越的前瞻性和行动力。报告期内,公司研发费用分别为 4,274.36 万元、5,366.27 万元、8,860.85 万元和 4,160.43 万元,占各期营业收入的比例分别为 13.28%、14.59%、16.17%和 14.13%,研发投入保持上升趋势。

报告期内,公司承接了国家 02 科技重大专项课题、国家发改专项研究任务等核心技术攻关任务并取得成功突破实现量产。截至报告期末,公司已获得发明专利 43 项,自产产品在研发、验证以及量供款数累计已超过百款。其中 SOC、BARC、TEOS 等产品技术均达到国际先进水平,具体体现为境内率先在集成电路制造先进制程应用上实现正式量产供应的企业之一,填补了国内行业空白。此外,公司光刻胶 i-Line、KrF、ArF 系列产品也取得了技术突破,多款产品已经通过客户验证并实现批量供应。

2、重视产品质量,拓展优质客户

公司高度重视产品质量,制定了完善的质量管理体系,将质量管理贯穿于产品研发、原材料采购和产品生产的全过程。公司凭借多年的生产实践经验、科学的生产工艺以及先进的生产设备,不断提高产品质量的稳定性。报告期内,公司在集成电路关键材料及制造领域积累了良好的口碑和声誉,积累了一批优质客户,涵盖多家中国境内领先的12英寸集成电路晶圆厂,产品质量获得客户广泛认可,并与对方建立了持续稳定的合作关系。

3、不断引进集成电路领域高层次人才并完善激励机制

截至报告期末,公司聚集了一支高学历、高素质、富有开拓进取和创新精神的研发队伍及具有丰富经验的生产技术专家,核心团队既包括曾任职于境内主流晶圆厂的光刻工艺技术专家,也包括拥有材料专业背景的高层次人才。在继续加大力度招贤纳才的同时,公司制定了员工期权、绩效考核等激励机制,通过制定

绩效目标,进行全方位考核并予以相应奖励,充分调动了团队整体的积极性,提高了团队凝聚力,在公司内部形成努力拼搏、积极向上的氛围和文化。

4、完善内部管理结构,提高内部管理水平

报告期内,为满足公司业务扩张的需要,公司制定了一系列内部管理制度,在人才培养与引进层面建立了较为完善晋升与薪酬机制、绩效考核体系等,在战略层面对研发体系、供应链管理、信息化建设进行了整体规划,持续加强管理效率,优化决策程序,为公司内部协同管理注入活力。同时,公司按照上市公司的要求,持续完善法人治理结构,规范股东会董事会的运作,完善公司管理层的工作制度,建立科学有效的公司决策机制。

(三) 未来的具体发展规划与措施

1、引入高端人才与先进设备,提升公司核心竞争力

通过专业化的人才自主培养和引进高端人才相结合的模式,培育和壮大先进研发团队,并通过完善的激励机制,充分调动员工的积极性,为公司保持产品和市场的核心竞争力提供有力的人才保障。同时,通过引进先进的实验、生产和检测设备,提高公司产品的研发和生产效率,实现产品的产业化和规模化发展,进一步提升公司的核心竞争力。

2、推进新技术、新产品开发,提升公司品牌影响力

公司将持续加大新技术、新产品的开发,不断积累规模化量产经验,稳固产品品质,利用已布局的漳州、大连和合肥三个生产基地,实现集成电路关键材料的核心技术攻关并实现产业化,在深耕中国境内现有 12 英寸集成电路晶圆制造业务的同时,进一步布局产品在新应用领域和新市场的业务拓展,提升公司的品牌影响力。

3、加强产业链布局,提升公司综合竞争力

公司将利用资本市场和资源优势,通过自主研发、技术或股权合作方式,向 产业链上游拓展,以专业化的技术和良好的管理体系为基础,加快布局上游关键 原材料,推动产业链上下游协同创新,保障供应链的安全,进一步增强公司产品 的成本优势与质量稳定性,全面提升公司的综合竞争力。

第八节 公司治理与独立性

一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

公司自整体变更成股份公司以来,按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求,制定了《公司章程》,逐步建立健全了股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度以及专门委员会制度,并制定了公司治理相关的规章制度。公司治理结构相关制度制定以来,公司股东会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作,履行职责,公司治理结构不断健全和完善。报告期内,公司治理规范,不存在重大缺陷。

公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行的详细情况参见本招股意向书"第十二节 附件"之"七、股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况"部分,专门委员会的设置情况参见本招股意向书"第十二节 附件"之"八、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明"部分。

二、发行人的内部控制情况

(一)公司董事会对内部控制的自我评价

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况:于内部控制评价报告基准日内,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日起至内部控制评价报告发出日止,期间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司已经建立起的内部控制体系在完整性、 合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

(二) 注册会计师的鉴证意见

容诚会计师出具了《内部控制审计报告》(容诚审字[2025]510Z0204号),认

为恒坤新材于2025年6月30日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、报告期内发行人存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况

报告期内,公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展经营,不存在重大违法违规行为,不存在受到监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况。报告期内,发行人及其子公司受到的行政处罚情况如下:

1、税务管理

2024 年 1 月,发行人子公司漳州链芯因城市维护建设税(县城、镇(增值税附征))未按期进行申报,被国家税务总局漳州高新技术产业开发区税务局处以 50 元罚款。前述行政处罚均系税务主管机关以《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条作为处罚依据,适用简易程序作出。

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定,上述违法行为情节较轻且罚款金额小,未达到情节严重的标准,不属于重大行政处罚。

2、海关管理

2022年12月,发行人子公司福建泓光因进口物品申报不规范问题被海关处以罚款4.800元。

根据《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》第四十六条以及当时有效的《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》(2019年修订)第十五条相关规定,上述罚款金额属于法定处罚幅度内金额较小的情形,不属于情节严重的情形。

综上所述,发行人及其子公司报告期内受到的上述行政处罚不属于重大行政 处罚,不构成本次发行上市的实质性法律障碍。除此之外,发行人报告期内不存 在其他受到行政处罚的情形。

四、公司控股股东资金占用及为控股股东担保的情况

报告期内,公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。除为子公司提供担保,发

行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行对外担保的情形。

五、发行人面向市场独立持续经营能力的情况

公司自成立以来,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于公司控股股东、实际控制人,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力,拥有完整的研发、采购、生产和销售体系。

(一) 资产完整情况

公司系由恒坤有限整体变更设立的股份有限公司,承继了原有限公司所有的资产、负债及权益。公司相关资产的权属变更手续已办理完毕,公司与控股股东、实际控制人之间产权关系明确、界线清晰。公司合法拥有独立于股东的、完整的经营资产,包括与研发、采购、生产和销售系统等相关的配套设施,以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,对公司资产拥有所有权、完全的控制权和支配权,不存在被控股股东、实际控制人及其关联方控制和占用的情况。

(二) 人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定选举或聘任;公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

(三)财务独立情况

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务 会计制度和对子公司的财务管理制度;公司未与控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业共用银行账户。公司已设立独立的财务部门,并配备专职财务人员, 公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。

(四)机构独立情况

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求,设置股东会作为最高权力机构,董事会为决策机构,监事会为监督机构,具有完备的法人治理结构。公司已建立

健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

(五)业务独立情况

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在非公平竞争或者显失公平的关联交易,不存在通过客户或供应商进行利益输送、相互或单方让渡商业机会等情形。

(六) 其他影响公司独立持续经营的事项

公司最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生 重大不利变化。公司控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人 的股份权属清晰,最近2年实际控制人没有发生变更,不存在导致控制权可能变 更的重大权属纠纷。

报告期内,公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷,重大偿债风险,重大担保、诉讼、仲裁等或有事项,经营环境已经或将要发生的重大变化等对公司独立持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争情况

(一)发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业与公司不存在同业竞争的情况

公司的主营业务是集成电路领域关键材料的研发与产业化应用,主要覆盖关键材料包括光刻材料与前驱体两大类,并根据客户需求引进包括电子特气等其他关键材料产品。

公司的控股股东、实际控制人为易荣坤。截至本招股意向书签署日,除发行人外,控股股东、实际控制人控制的其他企业如下:

序号	企业名称	实际从事的主营业务
1	恒坤投资	股权投资
2	厦门积能	光电显示材料的销售
3	厦门神箭新材料科技有限公司	光电类产品的加工与销售
4	深圳神箭新能源科技有限公司	光电类产品的加工与销售

序号	企业名称	实际从事的主营业务
5	深圳欣恒坤	光电类产品的加工与销售
6	厦门市翌光企业管理合伙企业 (有限合伙)	股权投资
7	厦门神剑	员工持股平台
8	晟临芯	员工持股平台
9	兆莅恒	员工持股平台

截至本招股意向书签署日,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在实际从事与发行人相同或相似业务的情况,不存在同业竞争。

(二)发行人控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争事宜,公司控股股东、实际控制人易荣坤已向公司出具《关于避免同业竞争的承诺》,具体情况参见本招股意向书"第十二节 附件"之"六、本次发行相关各方作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施"之"(十)控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺"的相关内容。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方和关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,截至报告期末,发行人的关联方及关联关系情况如下:

1、发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人

公司控股股东、实际控制人为易荣坤。肖楠、杨波、张蕾、王廷通、陈江福、李湘江为易荣坤的一致行动人,具体情况参见本招股意向书"第四节发行人基本情况"之"七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况"之"(一)控股股东、实际控制人及其一致行动人"。

2、持有发行人5%以上股份的其他股东

截至报告期末,除易荣坤之外,公司不存在持有发行人 5%以上股份的其他 股东。

3、发行人的董事、监事和高级管理人员

截至报告期末,发行人共有 7 名董事,即易荣坤、王廷通、肖楠、庄超颖、邹友思、苏小榕和黄兴孪;发行人共有 3 名监事,即庄海华、王艺缘和王玉琴;发行人共有 5 名高级管理人员,即易荣坤、王廷通、肖楠、陈志明和陈颖峥。公司董事、监事及高级管理人员基本情况参见本招股意向书"第四节 发行人基本情况"之"十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况"部分相关内容。

4、发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接或者 间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的法人 或其他组织

除上述已披露的关联方之外,截至报告期末,发行人的控股股东、实际控制 人及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员直接或者间接控制的、或者担任 董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的法人或其他组织情况如下:

序号	关联方名称	与发行人关系
1	恒坤投资	易荣坤直接持有 94%股权的公司
2	晟临芯	易荣坤担任执行事务合伙人的合伙企业
3	厦门神剑	易荣坤担任执行事务合伙人的合伙企业
4	兆莅恒	易荣坤担任执行事务合伙人的合伙企业
5	厦门市翌光企业管理合伙企业(有限合伙)	易荣坤担任执行事务合伙人的合伙企业
6	厦门神箭新材料科技有限公司	易荣坤通过恒坤投资间接控制的企业
7	深圳神箭新能源科技有限公司	易荣坤通过厦门神箭新材料科技有限公司间接控 制的企业
8	深圳欣恒坤	易荣坤通过厦门神箭新材料科技有限公司间接控 制的企业
9	厦门积能	易荣坤通过恒坤投资间接控制的企业
10	厦门东方神箭科技有限公司	易荣坤通过恒坤投资可以施加重大影响的企业
11	大晶信息	肖楠担任董事,发行人持股 6.67%的参股公司
12	上海八亿时空	肖楠担任董事,发行人持股11.11%的参股公司
13	晟临坤	庄海华担任执行事务合伙人的合伙企业
14	厦门市思明区日月荣光工艺品店	陈志明担任经营者的个体工商户
15	厦门北星博辉科技有限公司	庄超颖担任执行董事兼总经理的企业

序号	关联方名称	与发行人关系	
16	厦门北星博辉科技有限公司大 连分公司	庄超颖担任负责人的企业	
17	苏州同九舟企业管理合伙企业(有限合伙)	陈江福担任执行事务合伙人的合伙企业	
18	苏州同九源企业管理合伙企业(有限合伙)	陈江福担任执行事务合伙人的合伙企业	
19	苏州恒坤	易荣坤报告期内间接控制的公司,已于 2024 年 9 月转让给陈江福,陈江福通过苏州同九源企业管理合伙企业(有限合伙)间接控制并担任执行董事兼总经理的公司	
20	勾陈资本	李湘江持有 100%股权的公司	
21	勾陈合伙	李湘江通过勾陈资本控制的合伙企业	
22	明宸(厦门)投资管理有限公司	李湘江持有 73%股权的公司	
23	厦门随位网络科技有限公司		
24	厦门随心互动传媒有限公司	□李湘江持有 42%股权,为大股东的公司及其控□股子公司	
25	广西晟娱网络科技有限公司	127	
26	湖畔万村(厦门)投资咨询有限 公司	李湘江担任执行董事、经理的公司	
27	厦门豪彘食品有限公司	李湘江担任董事,并通过勾陈资本持有 28.16% 股权的公司	
28	两岸融通(厦门)教育咨询有限 责任公司	李湘江在关联关系存续期间通过勾陈资本持有 97%股权的公司	
29	杭州高新材料科技股份有限公司	李湘江在关联关系存续期间担任董事的公司	
30	广州市莱檬生物科技有限公司	李湘江在关联关系存续期间担任董事的公司	
31	成都国盛天丰网络科技有限公 司	李湘江在关联关系存续期间担任董事的公司	

5、发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员及其直接或间接控制的,或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的法人或其他组织

除上述已披露的关联方之外,发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事 及高级管理人员关系密切的家庭成员及其直接或间接控制的,或者担任董事(不 含同为双方的独立董事)、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人 或其他组织为发行人的关联方。

6、其他关联方

除上述已披露的关联方之外,报告期内发行人还存在下述主要关联方:

序号	关联方姓名或名称	与发行人关系
1	吕俊钦	报告期内曾持股 5%以上的股东
2	李湘江	报告期内曾持股 5%以上的股东
3	庞博	报告期内曾任发行人董事
4	廖泉文	报告期内曾任发行人董事
5	刘亚恋	报告期内曾任发行人监事
6	张梓伦	报告期内曾任发行人监事
7	宁大伟	报告期内曾任发行人监事
8	宋增超	报告期内曾任发行人副总经理
9	陈明亮	报告期内曾任发行人副总经理
10	陈艺琴	易荣坤的配偶
11	厦门叁仟奕投资合伙企 业(有限合伙)	易荣坤配偶之妹陈艺芬担任执行事务合伙人的合伙企业
12	翌光半导体	发行人曾经持股 100%的子公司,已于 2022 年 9 月注销
13	晟明坤	发行人曾经持股 70%的子公司, 已于 2024 年 8 月注销
14	重庆恒鼎坤精密电子有 限公司	易荣坤报告期内通过恒坤投资间接控制的公司,已于 2023 年 8 月注销
15	苏州恒伟达新材料科技 有限公司	易荣坤报告期内间接控制的公司,已于 2021 年 5 月对外 转让
16	倍晶新材料(山东)有限公司	易荣坤报告期内通过恒坤投资间接控制的公司,已于 2024年3月对外转让
17	厦门瞳景物联科技股份 有限公司	易荣坤报告期内担任董事,已于 2021 年 5 月卸任
18	厦门一网天下电子商务 有限公司	陈艺琴持有 100%股权,并担任执行董事、总经理的企业, 已于 2021 年 12 月注销
19	厦门阿拉灯电子商务有 限公司	2021 年 7 月注销
20	厦门合羹合异投资合伙 企业(有限合伙)	张蕾、杨波报告期内合计持有 100%股权的公司,已于 2023 年 6 月注销
21	厦门坤特电子有限公司	易荣坤之弟易荣裕持有 77%股权的企业,已于 2022 年 5 月注销
22	泉州市大升建筑设计有 限公司	庄超颖之弟陈超彦曾经持有股权并担任执行董事兼总经理的企业,已于 2022 年 12 月卸任
23	易造工业设计(北京) 有限公司	庄超颖配偶的妹夫林朝晖直接持有 97%股权的公司,已于 2024 年 10 月注销
24	恒星电子	肖楠担任董事,发行人曾持股 47%的参股公司,已于 2024年7月注销
25	厦门市湖里区王玉琴兴 建材店	王玉琴担任经营者的个体工商户,已于 2023 年 5 月注销
26	新罗区树萍日用品店	王玉琴配偶的妹妹钟树萍担任经营者的个体工商户,已于 2023 年 11 月注销
27	漳平市小豆营销策划 服务部	易荣坤妻妹陈艺芬担任经营者的企业,已于 2024 年 6 月注销

序号	关联方姓名或名称	与发行人关系
28	上海桃稷电子科技有限 公司	张蕾、杨波、肖楠报告期内合计持有 54%股权的公司,已于 2022 年 8 月注销
29	厦门祐尼三的新材料科 技有限公司	易荣坤合计控制 21.37%股权,且曾经担任副董事长并于 2021 年 7 月卸任,发行人的参股公司
30	湖南盛世龙腾网络科技 有限公司	张梓伦报告期内担任董事,已于 2021 年 12 月卸任
31	福建中海管理咨询有限 责任公司(已吊销)	廖泉文报告期内担任董事,已于2022年9月卸任
32	吕俊钦在关联关系存续其	期间控制、担任董事或高级管理人员的法人或非法人组织

报告期及报告期前 12 个月内, 曾经具有本节 "(一) 关联方和关联关系" 所列情形的主体, 均为发行人报告期内曾经的关联方。

(二) 关联交易

1、重大关联交易判断标准

参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》,重大关联交易指对发行人财务状况和经营成果具有重大影响的关联交易,具体标准如下:公司与关联法人发生的成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以上的交易,且超过 300 万元的关联交易,以及公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易。此外,公司接受关联方担保等行为属于公司单方面获得利益的交易,关键管理人员薪酬为公司正常经营活动的必要支出,均为一般关联交易。

2、报告期内所发生的全部关联交易的简要汇总表

报告期内,公司关联交易汇总情况如下:

单位:万元

项目	交易内容	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经常性 关联交 易	关键管理人员薪酬	718.17	1,545.52	1,313.64	1,260.09
	房屋租赁及代收水电费	5.52	14.15	1.65	-
	采购原材料	192.33	94.66	12.68	-
偶发性		参见本节"七、	关联方及关联交易	易"之"(二)	关联交易"
关联交	关联担保	之"4、一般关联	交易"之"(2)作	禺发性关联交	易"之"①
易		关联担保"相关	内容		

3、重大关联交易

(1) 经常性关联交易

报告期内,发行人不存在与关联方进行的重大经常性关联交易。

(2) 偶发性关联交易

报告期内,发行人不存在与关联方进行的重大偶发性关联交易。

4、一般关联交易

(1) 经常性关联交易

①关键管理人员薪酬

报告期内,公司董事、监事和高级管理人员薪酬总额及占公司利润总额的比例情况如下:

单位: 万元

项目	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
薪酬	283.32	684.83	459.76	520.22
股份支付费用	434.85	860.69	853.88	739.87
合计	718.17	1,545.52	1,313.64	1,260.09
利润总额	4,450.98	10,714.30	10,446.05	12,541.56
占比	16.14%	14.42%	12.58%	10.05%

②房屋租赁及代收水电费

报告期内,关联方向公司租赁房产的情况如下:

单位: 万元

项目	目 2025年1-6月 2024年度		2023 年度	2022 年度		
承租方: 厦门东方神箭科技有限公司						
租赁及代收水电费等收入	5.52	10.99	1.65	-		
承租方: 厦门积能						
租赁及代收水电费等收入	-	3.16	-	-		

为提高资产的使用效率,发行人将位于厦门市海沧区东孚镇山边路 389 号的部分闲置房产对外出租。发行人向关联方出租的租金系双方协商确定,与发行人向其他无关联第三方收取的租金不存在重大差异,交易具有合理性和公允性,关

联方不存在为公司进行利益输送的情形。

③采购原材料

报告期内,为持续开展光刻胶的研发工作,公司与关联方就树脂产品进行合作开发,向关联方采购其为新产品定向开发的树脂产品,具体如下:

单位:万元

关联方	交易内容	2025年1-6月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
上海八亿时空	树脂溶液	192.33	94.66	12.68	-

根据双方协议约定,关联方所开发的产品在通过量产测试后,将向发行人独家供应,产品定价将考虑采购数量、交期等因素由双方协商确定。

(2) 偶发性关联交易

①关联担保

报告期内,存在关联方为本公司提供担保的情况,具体如下:

序号	借款/授信银行	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	关联方提供 担保情况
1	兴业银行股份有限 公司厦门分行	600.00	2021/1/21	2022/1/20	是	易荣坤、陈 艺琴
2	兴业银行股份有限 公司厦门分行	2,800.00	2021/11/16	2022/11/15	是	易荣坤
3	兴业银行股份有限 公司厦门分行	500.00	2022/1/21	2023/1/20	是	易荣坤
4	兴业银行股份有限 公司厦门分行	1,115.44	2022/3/24	2023/3/24	是	易荣坤
5	兴业银行股份有限 公司厦门分行	1,769.89	2022/6/7	2023/6/7	是	易荣坤
6	兴业银行股份有限 公司厦门分行	1,530.83	2022/8/8	2023/8/8	是	易荣坤
7	中国光大银行股份 有限公司厦门分行	2,438.56	2022/6/14	2023/6/14	是	易荣坤
8	中国光大银行股份 有限公司厦门分行	510.14	2022/8/8	2023/8/8	是	易荣坤
9	兴业银行股份有限 公司厦门分行	2,500.00	2022/9/30	2022/11/3	是	易荣坤
10	中国光大银行股份 有限公司厦门分行	1,555.24	2023/7/6	2024/1/5	是	易荣坤
11	中国光大银行股份 有限公司厦门分行	908.69	2023/8/7	2024/2/7	是	易荣坤
12	中国光大银行股份 有限公司厦门分行	1,979.79	2024/1/25	2024/7/24	是	易荣坤

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 万元

项目 名称	\.	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	关联方	账面 余额	坏账 准备	账面 余额	坏账 准备	余额	坏账 准备	账面 余额	坏账 准备
其他应收款	肖楠	-	-	0.01	-	2.03	0.10	-	-

(2) 应付项目

单位:万元

项目名称	关联方	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
应付账款	上海八亿时空	48.52	15.45	1	-
预收款项	厦门东方神箭 科技有限公司	-	0.84	0.80	-
	厦门东方神箭 科技有限公司	0.84	0.84	0.84	-
	肖楠	-	-	16.51	6.91
其他应付款	陈志明	-	-	10.00	-
六 [E]	王廷通	-	-	15.00	-
	杨波	-	-	15.42	-
	张蕾	-	-	15.00	-

6、报告期内关联交易对公司经营成果和财务状况的影响

发行人已建立了独立的供应、生产、销售系统,与关联企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均相互独立,对关联方不存在重大依赖,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。报告期内与关联企业在采购、销售等方面发生的交易具备商业合理性且交易价格公允,公司关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

报告期内,公司发生的关联交易对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

(三)报告期内关联交易原因、履行的程序及独立董事的意见

1、关联交易原因

报告期内,公司经常性关联交易和偶发性关联交易均是基于正常经营过程的需要发生,相关关联交易的原因具备合理性。

2、关联交易决策程序的执行情况

为规范公司与关联方之间的关联交易,维护公司股东特别是中小股东的合法权益,根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定,公司在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等公司制度中对关联方及关联交易的类型、关联方的回避措施、关联交易的披露及独立董事的作用等方面进行了严格规定。

2024年10月8日,发行人2024年第五次临时股东会审议通过《关于确认公司报告期内(2021年至2024年6月)关联交易公允性的议案》,对发行人报告期内发生的关联交易予以确认,其中关联股东均已回避表决。

公司与关联方发生的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,公司对报告期内发生的关联交易均履行了公司章程规定的相应的审批程序。

3、独立董事对关联交易的意见

2024年9月23日,独立董事就发行人第四届董事会第十八次会议审议的《关于确认公司报告期内(2021年至2024年6月)关联交易公允性的议案》发表了如下独立意见:报告期内发生的关联交易履行了相关程序,不存在违反公开、公平、公正原则的情形,不存在损害公司及股东利益的行为,也不会影响公司的独立性。

(四)减少关联交易的措施

公司在资产、业务、人员、机构、财务等方面均独立于各关联方,具备面向市场的独立经营能力。

对于正常的、不可避免的且有利于公司发展的关联交易,公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则,严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司章程(草案)》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》等有关规定,严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度、信息披露等措施来规范该等关联交易。

发行人控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员已出具关于规范 关联交易的书面承诺,具体内容参见本招股意向书"第十二节 附件"之"六、 本次发行相关各方作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施"之"(九)关于规范和减少关联交易的承诺"。

(五)关联方变化情况

发行人报告期内关联方的变化情况参见本招股意向书"第八节公司治理与独立性"之"七、关联方及关联交易"之"(一)关联方和关联关系"之"6、其他关联方"。

第九节 投资者保护

一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序

公司报告期内未进行股利分配。2024年10月8日,公司2024年第五次临时股东会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》,同意如公司本次发行上市申请获得批准注册并成功实施,则公司本次发行上市前的滚存利润由本次发行上市后的新老股东按照届时的持股比例共同享有。

二、发行人股利分配政策

(一) 本次发行前后股利分配政策的差异情况

本次发行前公司的股利分配政策主要依据《公司法》中有关税后利润分配的相关规定,在弥补亏损和提取公积金后按照股东持有股份比例分配所余税后利润。

本次发行后的利润分配政策根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关利润分配的规范和政策制定,明确了公司利润分配原则、利润分配的形式、现金分配的条件、利润分配的时间间隔、利润分配的比例、利润分配方案的决策程序和机制、利润分配政策的调整机制等具体事项,维护公司股东特别是中小股东的利益。

(二) 本次发行后的股利分配政策

1、公司章程中利润分配相关规定

2024年10月8日,公司2024年第五次临时股东会审议通过了《公司章程(草案)》,自发行人首次公开发行股票并上市之日起实施,约定了公司本次发行后的股利分配政策如下:

- **第一百六十条** 公司实施积极的利润分配政策,重视投资者的合理投资回报,综合考虑公司的长远发展。公司的利润分配政策为:
- (一)利润分配原则:公司实施较为积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(二)利润分配的形式:采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利,现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配;采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(三) 实施现金分红应同时满足的条件:

- 1、公司该年度或半年度实现的可分配利润的净利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营:
 - 2、公司累计可供分配的利润为正值;
- 3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(半年度利润分配按有关规定执行):
- 4、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指: (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元人民币。(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

(四)现金分红的比例与时间间隔:公司原则上每年进行一次现金分红,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%,公司原则上在每年年度股东会审议通过后进行一次现金分红。

公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规 定的程序,提出差异化的现金分红政策:

- (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
- (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
- (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
- (五)发放股票股利的条件:在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值考虑,公司可以发放股票股利,具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。

(六)现金分红与股票股利分配的优先顺序及比例:在制定利润分配预案时,公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并根据中国证监会的相关规定,区分不同情形,按照章程规定的程序,确定利润分配中现金分红的比例。公司具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配,现金方式优先于股票股利方式。

(七)公司利润分配的决策机制与程序

利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议后方能提交股东会审议。董 事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一 以上独立董事表决同意。董事会审议现金分红方案时,应当认真研究和论证现金 分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜,独立董事应当发表明 确意见。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的,有 权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的,应当在董 事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。

监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过半数以上表决同意。

股东会在审议利润分配方案时,须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意;股东会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东,特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求。

(八)公司利润分配政策调整的决策机制与程序

公司调整利润分配方案,必须由董事会进行专题讨论,详细论证并说明理由。公司董事会在利润分配政策的调整过程中,应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意,独立董事应当对调整利润分配方案发表独立意见;监事会在审议利润分配政策调整时,须经全体监事过半数以上表决同意。

利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东会审议。

公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司股东会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(九) 利润分配政策的信息披露

公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求;现金分红标准和比例是否明确和清晰;相关的决策程序和机制是否完备;独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会;中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

2、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由

为明确公司首次公开发行股票并上市后对新老股东的回报,增强利润分配决策的透明度和可操作性,便于股东对公司的股利分配进行监督,公司拟订了《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》。2024年9月23日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划的议案》。

制定本规划考虑的因素如下:公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展,在综合考虑公司战略发展目标、股东意愿的基础上,结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、现金流量状况、社会资金成本以及外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,并对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

本规划制定的利润分配基本原则如下:公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

3、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分配 利润的使用安排

(1) 发行人上市后三年内的利润分配计划

1) 利润分配的原则

公司实施较为积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

2) 利润分配的形式

采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利,现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配;采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3) 现金分红的条件

①公司该年度或半年度实现的可分配利润的净利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

- ②公司累计可供分配的利润为正值:
- ③审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(半年度

利润分配按有关规定执行);

④公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指: (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元人民币。(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

4) 现金分红的比例与时间间隔

公司原则上每年进行一次现金分红,公司每年以现金方式分配的利润不少于 当年实现的可分配利润的 10%,公司原则上在每年年度股东会审议通过后进行一 次现金分红。

公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规 定的程序,提出差异化的现金分红政策:

- ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
- ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
- ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

5) 发放股票股利的条件

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业

价值考虑,公司可以发放股票股利,具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。

6) 现金分红与股票股利分配的优先顺序及比例:在制定利润分配预案时,公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并根据中国证监会的相关规定,区分不同情形,按照章程规定的程序,确定利润分配中现金分红的比例。公司具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配,现金方式优先于股票股利方式。

7) 公司利润分配的决策机制与程序

利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议后方能提交股东会审议。董 事会在审议利润分配预案时,需经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一 以上独立董事表决同意。董事会审议现金分红方案时,应当认真研究和论证现金 分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜,独立董事应当发表明 确意见。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的,有 权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的,应当在董 事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。

监事会在审议利润分配预案时, 需经全体监事过半数以上表决同意。

股东会在审议利润分配方案时,需经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意;股东会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东,特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求。

8) 公司利润分配政策调整的决策机制与程序

公司调整利润分配方案,必须由董事会进行专题讨论,详细论证并说明理由。公司董事会在利润分配政策的调整过程中,应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时,需经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意,独立董事应当对调整利润分配方案发表独立意见;监事会在审议利润分配政策调整时,需经全体监事过半数以上表决同意。

利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东会审

议。

公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司股东会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

9) 利润分配政策的信息披露

公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求;现金分红标准和比例是否明确和清晰;相关的决策程序和机制是否完备;独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会;中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

(2)制订的依据和可行性

公司上市后三年内的利润分配计划的制定依据参见本节之"二、发行人股利分配政策"之"(二)本次发行后的股利分配政策"之"2、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由",上述利润分配计划具有可行性。

(3) 未分配利润的使用安排

公司充分考虑了所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素,为更好地保障公司战略规划的顺利实施和公司的可持续发展,维护股东的长远利益,公司报告期内未进行股利分配,将未分配利润继续用于公司生产经营和研发投入。

公司上市后,上市前的滚存未分配利润,由本次公开发行股票后的新老股东按发行后的持股比例共享。公司关于未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和全体股东利益。

4、公司长期回报规划内容及制定考虑因素

公司将着眼于长远和可行性发展,综合考虑公司实际情况、发展目标,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制,从而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的稳定性和连续性。

公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿,在保证公司正常经营业务发展的前提下,坚持现金分红为主这一基本原则,综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》,并由公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当前资金需求,制定年底或中期分红方案。

公司长期回报规划的内容参见本节之"二、发行人股利分配政策"之"(二) 本次发行后的股利分配政策"之"1、公司章程中利润分配相关规定"。

三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排, 不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况

根据《公司章程(草案)》,股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务; 持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。《公司章程(草案)》 未针对特定股东设置特别表决权股份,公司股东亦不存在协议控制的特殊安排情况。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

(一) 重大销售合同

截至报告期末,公司与前五大客户签署的销售框架合同,或未签署销售框架合同情况下金额大于 500 万元的所有订单(前五大客户未签署 500 万元以上订单的为大于 100 万元的前三大订单)的具体情况如下表所示:

单位:万元

序	合并口	عد دار بیت یک در در		told the LL serve	A = A ANG	签署时间/生	本位: 刀九 截至报告期末
号	径客户 名称	単体客户名称	合同类型	销售内容	合同金额	效时间	履行情况
1	客户 A	客户 A1	框架协议	光刻材料、前驱体材料、电子特气	以实际订单为准	2023年8月	履行中
	各广 A	客户 A2	框架协议	光刻材料、前 驱 体 材料、电子特气	以实际订单为准	2024年8月	履行中
2	客户 C	客户 Cl	框架协议	光刻材料、前驱体材料、电子特气	以实际订单为准	2018年6月	由客户 C2 继续 履行
2	各户已	客户 C2	框架协议	光刻材料、前驱体材料、电子特气	以实际订单为准	2023年7月	履行中
		客户 B2	框架协议	光刻材料、 其他	以 实 际 订 单为准	2021年6月	履行中
3	客户 B	客户 B3	框架协议	光刻材料、 其他	以 实 际 订 单为准	2021年9月	履行中
		客户 B1	框架协议	其他	以 实 际 订 单为准	2019年10月	履行完毕
		客户 E1	订单	光刻材料	259.00	2022年1月	履行完毕
4	客户 E	客户 E4	订单	光刻材料	231.00	2024年7月	履行中
		客户 E2	订单	光刻材料	230.46	2025年1月	履行中
			订单	电子特气	593.26	2023年12月	履行中
5	客户 D	客户 D	订单	电子特气	520.00	2022年5月	履行完毕
			订单	电子特气	518.20	2025年2月	履行中
6	客户 F	客户 F	框架协议	光刻材料、前驱体材料	以实际订单为准	2021年6月	履行中
7	客户 H	客户 H	订单	光刻材料	514.60	2023年12月	履行完毕
	合/ П	(音) · Ⅱ	订单	光刻材料	293.60	2024年6月	履行完毕

序号	合并口 径客户 名称	单体客户名称	合同类型	销售内容	合同金额	签署时间/生 效时间	截至报告期末 履行情况
			订单	光刻材料、前驱体材料	361.84	2025年2月	履行中

注:框架合同签署日期/生效时间为最新一次的签署日期或生效时间。

(二) 重大采购合同

截至报告期末,公司与前五大供应商签署的采购框架合同,或未签署采购框架合同情况下金额大于 100 万元最大订单的具体情况如下表所示:

单位: 万元

序号	供应商名称	合同类型	采购产品	合同金额	签署时间/生效	截至报告期末
,,,,	D 10—114 A 14	A 1 42 4—	7147.47 1	7.72	时间	履行情况
1	供应商 A	框架合同	树脂、环己 酮、活性剂 等、设备	以实际订单 为准	2023年1月	履行中
2	供应商 C	框架合同	树脂、 PGMEA、化 学助剂等	以实际订单 为准	2022年12月	履行中
3	供应商 F	框架合同	TEOS (原材 料)	以实际订单 为准	2022年6月	履行中
4	供应商 B1	框架合同	滤芯等	以实际订单 为准	2023年11月	履行中
5	供应商 D	框架合同	滤芯等	以实际订单 为准	2024年9月	履行中
6	供应商 K	订单	加仑瓶	380.16	2025年3月	履行中
7	上海韵申新能源科技 有限公司	订单	阀门等	179.40	2021年10月	履行完毕

注:框架合同签署日期/生效时间为最新一次的签署日期或生效时间。

(三) 借款合同

截至报告期末,公司签订的合同金额超过1,000.00万元的借款合同或虽未达到前述标准但对公司的生产经营、未来发展或财务状况具有重大影响的重大借款合同情况如下表所示:

单位:万元

序号	借款 主体	贷款银行	合同金额	担保方式	期限 起始日	期限 到期日	截至报告期 末履行情况
1	福建 泓光	兴业银行漳 州分行	1,000.00	担保方: 恒坤新材	2023/3/31	2028/3/31	履行中
2	福建泓光	兴业银行漳 州分行	1,198.00	担保方:恒坤新材; 抵押物:福建泓光在建 工程	2023/5/17	2028/3/31	履行中
3	福建 泓光	兴业银行漳 州分行	2,309.00	担保方: 恒坤新材	2023/6/1	2028/3/31	履行中
4	福建泓光	兴业银行漳 州分行	5,000.00	担保方:恒坤新材; 抵押物:福建泓光在建 工程	2023/10/30	2028/3/31	履行中

序号	借款 主体	贷款银行	合同金额	担保方式	期限起始日	期限 到期日	截至报告期 末履行情况
5	安徽恒坤	中国银行合 肥分行	27,000.00	担保方:恒坤新材; 抵押物:安徽恒坤土地 使用权	2023/8/22	2029/8/21	履行中
6	厦门恒坤	兴业银行厦 门分行、厦门 国际信托有 限公司	4,700.00	担保方:福建泓光; 抵押物:恒坤新材房产	2023/7/26	2028/5/15	履行中
7	厦门 恒坤	中国进出口 银行厦门分 行	5,000.00	抵押物: 恒坤新材房产	2024/9/20	2025/9/30	履行中
8	厦门恒坤	建设银行厦门分行	2,620.00	无	2024/12/31	2025/6/30	履行中,实 际借款时间 为 2025/1/2-202 5/7/2
9	厦门 恒坤	招商银行厦 门分行	15,000.00	无	2025/5/19	2026/5/18	履行中
10	福建 泓光	招商银行厦 门分行	3,000.00	无	2025/5/19	2026/5/18	履行中
11	上海 楚坤	招商银行厦 门分行	1,000.00	无	2025/5/19	2026/5/18	履行中
12	厦门 恒坤	中国银行厦 门分行	1,500.00	无	2022/9/22	2023/9/21	履行完毕
13	厦门 恒坤	招商银行厦 门分行	3,000.00	无	2022/9/29	2023/3/29	履行完毕
14	香港 恒坤	浦发银行厦 门分行	176.58 万美元	担保方: 恒坤新材	2022/9/16	2022/12/15	履行完毕
15	香港 恒坤	浦发银行厦 门分行	314.50 万美元	担保方: 恒坤新材	2022/9/20	2022/10/20	履行完毕
16	厦门 恒坤	中信银行厦 门分行	3,000.00	无	2022/9/29	2022/12/29	履行完毕
17	厦门 恒坤	兴业银行厦 门分行	2,500.00	担保方:易荣坤; 抵押物:恒坤新材房产	2022/9/30	2023/9/29	履行完毕
18	厦门 恒坤	兴业银行厦 门分行	2,800.00	担保方:易荣坤; 抵押物:恒坤新材房产	2021/11/16	2022/11/15	履行完毕
19	大连恒坤	农业银行大 连经济技术 开发区分行	5,000.00	担保方:易荣坤、陈艺琴、恒坤新材; 抵押物:大连恒坤土地 使用权、在建工程及机 器设备	2019/11/20	2024/11/20	提前还款, 履行完毕

(四)技术转让与授权协议

序号	合作方名称	合同 类型	具体内容	合同金额	签署时间	截至报告期末 履行情况
1	供应商 G	技术 转让	受让 SOC、KrF 光刻 胶树脂制造工艺技术		2021年8月	履行中
2	Soulbrain	技术授权	授予公司独家许可, 在境内建造、设置和 运营工厂,制造、使 用以及销售 TEOS。	初始费用 400 万美元,实现销售后根据 TEOS 销售额 7%定期支付,支付期限为实现销售后 15年。	2018年8月	履行中

(五) 其他重要合同

序号	供应商名称	合同类型	采购产品	合同金额	签署时间	截至报告期末 履行情况
1	1 SKMP	框架合同	引进光刻材料	以实际订单 为准	2020年9月	履行完毕
1					2023年9月	履行中
2	Soulbrain	框架合同	引进前驱体材料、 湿电子化学品	以实际订单 为准	2017年5月	履行中

二、对外担保情况

截至本招股意向书签署日,公司除为合并报表范围内的子公司提供担保之外, 不存在对外担保情况。

三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署日,发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书签署日,公司控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,均不存在作为一方当事人可能对公司产生重大不利影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁。

第十一节 声明

一、全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。

全体董事签名:	五区流	Solley.
易菜坤	五人なりと	当が落
庄超颖 黄兴孪	邹友思	苏小榕
全体监事签名:	W &	JAR.
庄海华 全体高级管理人员签名:	王玉琴	王艺缘
易荣坤	E (3) TA	—————————————————————————————————————
陈志明	陈颖峥	

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人签名:

1204

易荣坤

2015年10月30日

三、保荐人(主承销商)声明

本公司已对招股意向书进行核查,确认招股意向书的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

吴建航

an ho th

法定代表人/董事长签名:

中信建投证券股份有限公司

声明

本人已认真阅读厦门恒坤新材料科技股份有限公司招股意向书的全部内容,确认招股意向书不存在虚假记载、误导性、陈述或者重大遗漏,并对招股意向书 真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理签名:

金剑华

法定代表人/董事长签名:

中信建投证券股份有限公司

三、联席主承销商声明

本公司已对招股意向书进行核查,确认招股意向书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

法定代表人/董事长签名:

王 洪



四、发行人律师声明

上海市锦

负责人:

沈国权

本所及经办律师已阅读厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书,确认招股意向书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股意向书中引用的法律意见书的内容无异议,确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办律师:

多和屋.

李和金

经办律师:

张东晓

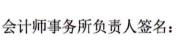
经办律师:

2025年6月30日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读厦门恒坤新材料科技股份有限公司的招股意向书,确认招股意向书与本所出具的审计报告、审阅报告、内部控制审计报告及经本所签证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对厦门恒坤新材料科技股份有限公司在招股意向书中引用的上述审计报告、审阅报告、内部控制审计报告及经本所签证的非经常性损益明细表等的内容无异议,确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

本声明仅供厦门恒坤新材料科技股份有限公司申请首次公开发行股票之目的使 用,不得用作任何其他目的。









六、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股意向书,确认招股意向书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股意向书中引用的资产评估报告的内容无异议,确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

签字资产评估师:	【已离职】	【已离职】
	陈林亮	林雨仁

资产评估机构负责人:

プー スタ W Y Y D 赵 向 阳

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2025年10月30日

承担评估业务的资产评估机构关于经办资产评估事项

的签字资产评估师离职的说明

本机构作为厦门恒坤新材料科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的资产评估机构,2013年12月22日出具了《资产评估报告》(国融兴华评报字[2013]第1-185号),签字资产评估师为陈林亮、林雨仁,现将资产评估相关情况说明如下:

截至本说明出具之日,陈林亮、林雨仁因个人原因已从本机构离职,故厦门恒坤新材料科技股份有限公司本次发行声明文件中资产评估机构声明无签字资产评估师陈林亮、林雨仁的签名,陈林亮、林雨仁的离职不影响本机构出具的上述资产评估报告的法律效力。

特此说明。

资产评估机构负责人:

マンVOV 赵向阳



七、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股意向书,确认招股意向书与本机构出具的验资报告([2014]京会兴验字第 12220001 号)无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股意向书中引用的验资报告的内容无异议,确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

签字注册会计师:	【已离职】	【已离职】
	王伟明	王 扬

会计师事务所负责人:



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

关于签字注册会计师离职的说明

本机构作为厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的验资机构,出具了《验资报告》([2014]京会兴验字第 12220001 号),签字注册会计师为王伟明、王扬。

王伟明、王扬已从本机构离职,故无法在《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》之"验资机构声明"中签字。 王伟明、王扬的离职不影响本机构出具的上述验资报告的法律效力。

特此说明。

会计师事务所负责人:

张恩军

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

2025年10月30日

北京兴华会计师事务所有限责任公司转制情况说明

北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2013 年 10 月 10 日取得了北京市财政局《关于同意设立北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可(2013)0060号),转制设立北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙),并依法办理了会计师事务所设立登记手续。

特此说明。

会计师事务所负责人:

张恩军

北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)

41205年 6月30日

验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读厦门恒坤新材料科技股份有限公司的招股意向 书,确认招股意向书与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会 计师对厦门恒坤新材料科技股份有限公司在招股意向书中引用的上述验资复核报告 的内容无异议,确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并承担相应的法律责任。



会计师事务所负责人签名:



签字注册会计师签名:







第十二节 附件

一、备查文件

投资者可查阅与本次发行有关的所有正式法律文件,具体如下:

- (一)发行保荐书;
- (二)上市保荐书;
- (三) 法律意见书;
- (四) 财务报告及审计报告;
- (五)公司章程(草案);
- (六)与投资者保护相关的承诺;
- (七)发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺 事项;
 - (八)内部控制审计报告;
 - (九)经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表;
 - (十) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、申报前十二个月新增股东的基本情况

1、杭州嘉港

企业名称	杭州嘉港世纪创业投资合伙企业(有限合伙)
社会统一信用代码	91330102MACTLK0D08
企业类型	有限合伙企业
注册资本	10,270 万元
执行事务合伙人	浙江海港产融投资管理有限公司
成立日期	2023-09-01
营业期限	长期
注册地址	浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号397室
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至本招股意向书签署日,杭州嘉港的出资结构如下:

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	浙江新世纪期货有限公司	20.00	0.19	普通合伙人
2	浙江海港产融投资管理有限公司	10,250.00	99.81	有限合伙人
	合计	10,270.00	100.00	-

杭州嘉港于 2023 年 9 月 18 日取得中国证券投资基金业协会基金备案证明, 基金编号为 SABB53; 其私募管理人浙江海港产融投资管理有限公司于 2016 年 12 月 9 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为 P1060515。浙江海港产融投资管理有限公司基本情况如下:

企业名称	浙江海港产融投资管理有限公司	
社会统一信用代码	91330106MA27Y79X99	
企业类型	其他有限责任公司	
注册资本	10,000 万元	
法定代表人	王松辉	
成立日期	2016-07-15	
营业期限	2016-07-15至无固定期限	
注册地址	浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块16号4幢159室	
经营范围	投资管理,资产管理,实业投资,(上述经营范围未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。	

2、成都交子

企业名称	成都交子九颂数智创业投资合伙企业(有限合伙)	
社会统一信用代码	91510106MAC7H5QT4U	
企业类型	有限合伙企业	
注册资本	40,000万元	
执行事务合伙人	成都九颂繁星创业投资有限公司	
成立日期	2023-01-18	
营业期限	2023-01-18至无固定期限	
注册地址	四川省成都市金牛区二环路北四段89号2栋15层1号附16室	
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	

截至本招股意向书签署日,成都交子的出资结构如下:

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类型
1	成都九颂繁星创业投资有限公司	400.00	1.00	普通合伙人
2	深圳九颂坤信投资中心(有限合伙)	17,600.00	44.00	有限合伙人
3	成都市金牛区交子股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	12,000.00	30.00	有限合伙人
4	成都新经济产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000.00	25.00	有限合伙人
合计		40,000.00	100.00	-

成都交子于 2023 年 3 月 1 日取得中国证券投资基金业协会基金备案证明, 基金编号为 SZG481; 其私募管理人成都九颂繁星创业投资有限公司于 2022 年 3 月 14 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为 P1073193。成都九颂繁星创业投资有限公司基本情况如下:

企业名称	成都九颂繁星创业投资有限公司	
社会统一信用代码	91510106MA6B3CWR1K	
企业类型	其他有限责任公司	
注册资本	1,000 万元	
法定代表人	敖鲲	
成立日期	2021-03-23	
营业期限	2021-03-23至无固定期限	
注册地址	四川省成都市金牛区泰宏路9号212室	
经营范围	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	

3、淄博金控

企业名称	淄博市财金控股集团有限公司	
社会统一信用代码	91370300059038716J	
注册地址	张店区人民西路228号金融大厦19楼	
法定代表人	薛云	
企业类型	有限责任公司(国有独资)	
注册资本	300,000万元	
成立日期	2012-12-19	
营业期限	2012-12-19至2032-12-19	
经营范围	许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件	

企业名称	淄博市财金控股集团有限公司
	为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;园区管理服务;创业投资(限投资未上市企业);自有资金投资的资产管理服务;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;金属材料销售;电气设备销售;金属制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;高性能纤维及复合材料制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;建筑材料销售;金属矿石销售;电子产品销售;电工仪器仪表销售;电力电子元器件销售;办公用品销售;日用品销售;光伏设备及元器件销售;五金产品零售;家用电器销售;安防设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备表。(除依法须经批准的项目外,
	凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至本招股意向书签署日,淄博金控的出资结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	淄博市财政局	300,000.00	100.00
	合计	300,000.00	100.00

淄博金控系淄博市财政局出资的国有独资企业,无需按照《证券投资基金法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规履行登记或备案程序。

4、吕文旭

吕文旭先生,1970年10月生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为3505231970*******。

5、姚婉珠

姚婉珠女士,1989年1月生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为3505831989*******。

三、落实投资者管理相关规定的安排

为切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益、完善公司治理结构,公司根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定,建立了完善的投资者权益保护制度并严格执行,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息,积极合理地实施利润分配政策,保证投资者依法获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面的权利。

(一) 信息披露制度和流程

为规范公司信息披露行为,确保信息披露真实、准确、完整、及时,切实保护公司、股东及投资者的合法权益,发行人根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程(草案)》的有关规定,制定了《信息披露管理制度》,明确了公司管理人员在信息披露中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通,提升规范运作和公司治理水平,为投资者尤其是中小投资者提供了制度保障。

本次发行上市后,发行人将严格执行上述制度与办法,保障投资者的知情权、 决策参与权,切实保护投资者的合法权益。

(二) 投资者沟通渠道

公司董事会负责公司投资者关系管理,监事会对投资者管理工作制度的实施情况进行监督。公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人,并配备专门工作人员,负责开展投资者关系管理工作,管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台。公司证券部为投资者关系管理职能部门,具体负责公司投资者关系的日常管理工作。

(三) 未来开展投资者关系管理的规划

为加强投资者关系管理,提高信息披露质量,促进投资者对公司的了解,发行人将依照《投资者关系管理制度》切实开展投资者关系构建、管理和维护的相关工作,积极听取投资者的意见与建议,为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台,保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策与选择管理者的相关权利,切实维护全体股东,尤其是中小股东的利益,努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

四、股利分配决策程序

公司发行上市后的股利分配决策程序参见本招股意向书"第九节 投资者保护"之"二、发行人股利分配政策"。

五、股东投票机制的建立

公司《公司章程(草案)》《股东会议事规则》对股东投票机制作出了规定,包括采取累积投票制选举公司董事、中小投资者单独计票机制、法定事项采取网络投票方式召开股东会进行审议表决、征集投票权的相关安排等,具体内容如下:

(一) 累积投票机制

《公司章程(草案)》规定,累积投票制是指股东会在选举董事或监事时采用的一种投票方式。即出席股东会的股东,对于采用累积投票制的议案,每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数,可以集中投给一名候选人,也可以投给数名候选人。

(二) 中小投资者单独计票机制

根据《公司章程(草案)》,股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

(三) 网络投票机制

本公司召开股东会的地点为:厦门市厦门中心 E 座 19 楼公司会议室,或股东会召集人通知的其他具体地点。股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。

(四)征集投票权机制

公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、 行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票 权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提 出最低持股比例限制。

六、本次发行相关各方作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺 的约束措施

(一)关于股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

1、控股股东、实际控制人承诺:

- "1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该部分股份。
- 2、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
- 3、本人所持公司股份锁定期限届满后 2 年内减持的,减持价格不低于公司 首次公开发行股票的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。
- 4、发行人上市当年较上市前一年净利润(以扣除非经常性损益后归母净利润为准,下同)下滑 50%以上的,延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月;发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月;发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月。前述"届时所持股份"分别指本人上市前取得,上市当年及之后第二年、第三年发行人年报披露时仍持有的股份。
- 5、上述股份锁定期届满后,在本人担任董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份;若在任期届满前离职的,则在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
 - 6、本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺。

7、若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承 诺的,则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。"

2、控股股东、实际控制人之一致行动人肖楠、王廷通承诺:

- "1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该部分股份。
- 2、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
- 3、本人所持公司股份锁定期限届满后 2 年内减持的,减持价格不低于公司 首次公开发行股票的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。
- 4、发行人上市当年较上市前一年净利润(以扣除非经常性损益后归母净利润为准,下同)下滑 50%以上的,延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月;发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月;发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月。前述"届时所持股份"分别指本人上市前取得,上市当年及之后第二年、第三年发行人年报披露时仍持有的股份。
- 5、上述股份锁定期届满后,在本人担任董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份;若在任期届满前离职的,则在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
- 6、本人不因一致行动关系解除、职务变更或离职等原因而终止履行上述承 诺。
 - 7、若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承

诺的,则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。"

3、控股股东、实际控制人之一致行动人张蕾、杨波、陈江福、李湘江承诺:

- "1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该部分股份。
- 2、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
- 3、本人所持公司股份锁定期限届满后 2 年内减持的,减持价格不低于公司 首次公开发行股票的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。
- 4、发行人上市当年较上市前一年净利润(以扣除非经常性损益后归母净利润为准,下同)下滑 50%以上的,延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月;发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月;发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月。前述"届时所持股份"分别指本人上市前取得,上市当年及之后第二年、第三年发行人年报披露时仍持有的股份。
- 5、本人不因一致行动关系解除、亲属关系变更、职务变更或离职等原因而 终止履行上述承诺。
- 6、若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承 诺的,则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。"

4、股东厦门神剑、晟临芯、兆莅恒承诺:

"自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该部分股份。

若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的,则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。"

5、持股监事承诺:

- "1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该部分股份。
- 2、上述股份锁定期届满后,在本人担任监事期间,每年转让的股份不超过 所直接或间接持有公司股份总数的 25%;离任后半年内,不转让直接或间接持有 的公司股份;若在任期届满前离职的,则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
 - 3、本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺。
- 4、若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承 诺的,则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。"

6、持股高级管理人员承诺:

- "1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该部分股份。
- 2、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 (若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 (若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
- 3、本人所持公司股份锁定期限届满后 2 年内减持的,减持价格不低于公司 首次公开发行股票的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。
- 4、上述股份锁定期届满后,在本人担任高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%;离任后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份;若在任期届满前离职的,则在就任时确定的任期内和任期

届满后6个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

- 5、本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺。
- 6、若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承 诺的,则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。"

7、持股核心技术人员承诺:

- "1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该部分股份。
- 2、上述股份锁定期届满之日起四年内,在本人担任核心技术人员期间,每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%,减持比例可以累积使用;离任后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份。
 - 3、本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺。
- 4、若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承 诺的,则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。"
- 8、发行人申报前 12 个月内通过股权转让等情形新增的股东杭州嘉港、成都 交子、吕文旭、姚婉珠承诺:
- "1、自公司股票在中国境内证券交易所上市之日起 12 个月内,本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
- 2、就本人/本企业在公司提交首发上市申请前 12 个月内取得的公司股份, 自本人/本企业取得该部分股份之日起 36 个月内,本人/本企业不转让或者委托他 人管理该部分股份,也不由公司回购该部分股份。
- 3、本人/本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动的有关规定。在持股期间,若股份锁定和减持的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人/本企业将严格遵守变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
 - 4、本人/本企业将忠实履行承诺,如因违反上述承诺事项给公司或者其他投

资者造成损失的,本人/企业将依法承担赔偿责任。"

(二)关于股东持股和减持意向的承诺

1、控股股东、实际控制人承诺:

- "一、本人持续看好公司及其所处行业的发展前景,愿意长期持有公司的股份。
- 二、对于公司首次公开发行股票并上市前本人持有的公司股份,本人将严格 遵守已做出的关于所持股份限售的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前持 有的公司股份。
- 三、于锁定期届满后两年内,在满足以下条件的前提下,可进行减持: (1) 锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延; (2)如发 生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔偿责任。
- 四、本人所持公司股份锁定期届满后,本人减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求:
- 1、减持方式:减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
- 2、减持意向:在锁定期满后两年内,本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应调整。
- 3、减持价格:在锁定期满后两年内,本人减持所持有的公司股份的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权、除息事项的,发行价应相应进行调整)。
- 4、减持期限:本人将根据相关法律法规及证券交易所规则的要求,结合证券市场情况、公司股价走势及公开信息等情况,审慎制定减持计划。
- 5、本人减持公司股票前,应提前三个交易日予以公告,通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前十五个交易日予以公告,并按照证券交易所的规

则及时、准确地履行信息披露义务。

6、相关法律法规及证券交易所规则的其他要求。

五、本人将忠实履行承诺,如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,本人将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,且违规减持公司股票所得(以下简称"违规减持所得")归公司所有。如本人未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见的,本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期进行修订并予以执行。"

2、控股股东、实际控制人之一致行动人肖楠、王廷通承诺:

- "一、本人持续看好公司及其所处行业的发展前景,愿意长期持有公司的股份。
- 二、对于公司首次公开发行股票并上市前本人持有的公司股份,本人将严格 遵守已做出的关于所持股份限售的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前持 有的公司股份。
- 三、于锁定期届满后两年内,在满足以下条件的前提下,可进行减持: (1) 锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延; (2)如发 生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔偿责任。

四、本人所持公司股份锁定期届满后,本人减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求:

- 1、减持方式:减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
- 2、减持意向:在锁定期满后两年内,本人每年减持所持有的公司股份数量 合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。
- 3、减持价格:在锁定期满后两年内,本人减持所持有的公司股份的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权、除息事项的,发行价应相应进行

调整)。

- 4、减持期限:本人将根据相关法律法规及证券交易所规则的要求,结合证券市场情况、公司股价走势及公开信息等情况,审慎制定减持计划。
- 5、本人减持公司股票前,应提前三个交易日予以公告,通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前十五个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
 - 6、相关法律法规及证券交易所规则的其他要求。

五、本人将忠实履行承诺,如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,本人将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,且违规减持公司股票所得(以下简称"违规减持所得")归公司所有。如本人未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见的,本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期进行修订并予以执行。"

- 3、控股股东、实际控制人之一致行动人张蕾、杨波、陈江福、李湘江承诺:
- "一、本人持续看好公司及其所处行业的发展前景,愿意长期持有公司的股份。
- 二、对于公司首次公开发行股票并上市前本人持有的公司股份,本人将严格 遵守已做出的关于所持股份限售的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份。
- 三、于锁定期届满后两年内,在满足以下条件的前提下,可进行减持: (1) 锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延; (2)如发 生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔偿责任。
- 四、本人所持公司股份锁定期届满后,本人减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求:
- 1、减持方式:减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

- 2、减持意向:在锁定期满后两年内,本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的100%。
- 3、减持价格:在锁定期满后两年内,本人减持所持有的公司股份的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权、除息事项的,发行价应相应进行调整)。
- 4、减持期限:本人将根据相关法律法规及证券交易所规则的要求,结合证券市场情况、公司股价走势及公开信息等情况,审慎制定减持计划。
- 5、本人减持公司股票前,应提前三个交易日予以公告,通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前十五个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
 - 6、相关法律法规及证券交易所规则的其他要求。

五、本人将忠实履行承诺,如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,本人将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,且违规减持公司股票所得(以下简称"违规减持所得")归公司所有。如本人未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见的,本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期进行修订并予以执行。"

4、持股核心技术人员承诺:

- "一、本人持续看好公司及其所处行业的发展前景,愿意长期持有公司的股份。
- 二、对于公司首次公开发行股票并上市前本人持有的公司股份,本人将严格 遵守已做出的关于所持股份限售的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份。
- 三、于锁定期届满后四年内,在满足以下条件的前提下,可进行减持:(1)锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;(2)如发

生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔偿责任。

四、本人所持公司股份锁定期届满后,本人减持所持有的公司股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求:

- 1、减持方式:减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
- 2、减持意向:在锁定期满后四年内,本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的25%。
- 3、减持价格:在锁定期满后四年内,本人减持所持有的公司股份的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权、除息事项的,发行价应相应进行调整)。
- 4、减持期限:本人将根据相关法律法规及证券交易所规则的要求,结合证券市场情况、公司股价走势及公开信息等情况,审慎制定减持计划。
- 5、本人减持公司股票前,应提前三个交易日予以公告,通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前十五个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
 - 6、相关法律法规及证券交易所规则的其他要求。

五、本人将忠实履行承诺,如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,本人将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,且违规减持公司股票所得(以下简称"违规减持所得")归公司所有。如本人未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见的,本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期进行修订并予以执行。"

(三)关于稳定股价措施的承诺

1、发行人承诺:

"1、本公司将严格根据《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定

股价预案的议案》的相关规定,在启动股价稳定措施时,遵守发行人董事会、股 东会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议 案》,并根据该等议案实施股份回购等稳定股价措施。

- 2、在触发稳定股价措施的条件满足时,如本公司未采取上述稳定股价措施的,本公司将在股东会以及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因,并向本公司股东和社会公众投资者道歉。
- 3、自本公司首次公开发行股票并上市之日起 3 年内,如本公司新聘任董事 (非独立董事)、高级管理人员的,本公司将要求该等新聘任的董事(非独立董 事)、高级管理人员签署承诺书,保证其履行本公司首次公开发行股票并上市时 董事(非独立董事)、高级管理人员已作出的相应承诺。"

2、控股股东、实际控制人承诺:

- "1、本人将严格根据《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》的相关规定,在启动股价稳定措施时,遵守发行人董事会、股东会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》,并根据该等议案实施增持发行人股份等稳定股价措施。
- 2、本人将在董事会、股东会审议发行人实施股份回购等稳定股价措施相关 议案时,投出赞成票。
- 3、在触发发行人控股股东、实际控制人股份增持条件满足时,如本人未采取上述稳定股价措施的,本人将在股东会以及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因,并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时,在前述事项发生之日起停止在发行人领取薪酬以及股东分红(如有),且本人直接或者间接持有的发行人股份将不得转让,直至本人根据《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》的规定采取相应的稳定股价措施并实施完成时止。"

3、非独立董事、高级管理人员承诺:

"1、本人将严格根据《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》的相关规定,在启动股价稳定措施时,遵守发行人董事会、股东会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议

- 案》,并根据该等议案实施增持发行人股份等稳定股价措施。
- 2、本人将在董事会审议发行人实施股份回购等稳定股价措施相关议案时, 投出赞成票。
- 3、在触发发行人董事(非独立董事)、高级管理人员股份增持条件满足时,如本人未采取上述稳定股价措施的,本人将在股东会以及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因,并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时,在前述事项发生之日起停止在发行人领取薪酬以及股东分红(如有),且本人直接或者间接持有的发行人股份(如有)将不得转让,直至本人根据《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》的规定采取相应的稳定股价措施并实施完成时止。
 - 4、本承诺不因本人职务变更、离职等情形而终止或者失效。"

(四)关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、发行人承诺:

- "1、本公司将严格遵守发行人董事会、股东会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》,执行该议案关于填补即期回报的相关措施。
- 2、若本公司违反或未履行拟采取的填补被摊薄即期回报的若干措施,本公司将在股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;无条件接受中国证监会、证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出的处罚或采取的相关监管措施;若给股东造成损失的,公司依法承担补偿责任。
- 3、自本公司首次公开发行股票并上市之日起3年内,如本公司新聘任董事、 高级管理人员的,本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员签署承诺书, 保证其履行本公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的相应 承诺。"

2、控股股东、实际控制人承诺:

"1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益;

2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的承诺,若本人违反该等承诺或拒不履行承诺,本人将在公司股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;若给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担对公司或者股东的补偿责任。"

3、董事、高级管理人员承诺:

- "1、承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益:
- 2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 - 3、承诺对本人职务消费行为进行约束:
 - 4、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
- 5、承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东会审议前述薪酬制度的相关议案投票赞成(如有表决权);
- 6、如公司拟实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司 拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董 事会和股东会审议前述股权激励方案的相关议案投票赞成(如有表决权);
- 7、作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺严格履行所作出的上述承诺 事项,确保公司填补被摊薄回报措施能够得到切实履行。若违反上述承诺或拒不 履行上述承诺,同意按照中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构 制定或发布的有关规定、规则,对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。"

(五)关于利润分配政策的承诺

1、发行人承诺:

"本公司将严格按照经股东会审议通过的《公司章程(草案)》《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划的议案》规定的利润分配政策向股东分配利润,严格履行利润分配方案的审议程序。

如本公司违反承诺给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担责任。"

2、控股股东、实际控制人承诺:

"本人将督促公司严格按照经股东会审议通过的《公司章程(草案)》《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划的议案》规定的利润分配政策向股东分配利润,严格履行利润分配方案的审议程序。

如本人违反承诺给投资者造成损失的,本人将向投资者依法承担责任。"

(六)关于未能履行承诺时的约束措施的承诺

1、发行人承诺:

- "除个别承诺中提到的约束措施外,还需遵守如下约束措施:
- 1、公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承 诺事项,积极接受社会监督;
- 2、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的 承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如 下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
- (1) 在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉:
 - (2) 不得进行公开再融资;
- (3)对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;
- (4)不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请, 但可以进行职务变更;
 - (5) 给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。
- 3、本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺 (相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约 束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
- (1) 在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉;

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。"

2、控股股东、实际控制人承诺:

- "除个别承诺中提到的约束措施外,还需遵守如下约束措施;
- 1、本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开 承诺事项,积极接受社会监督;
- 2、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
- (1) 在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉;
- (2)不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;
 - (3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分;
- (4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并 在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户:
 - (5) 本人未履行相关承诺,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。
- 3、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺 并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
- (1) 在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉:
- (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。"

3、董事、监事、高级管理人员承诺:

- "除个别承诺中提到的约束措施外,还需遵守如下约束措施:
- 1、本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开 承诺事项,积极接受社会监督;

- 2、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
- (1) 在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉:
- (2)不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;
 - (3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分;
 - (4) 可以职务变更但不得主动要求离职;
 - (5) 主动申请调减或停发薪酬或津贴;
- (6)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并 在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;
 - (7) 本人未履行相关承诺,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。
- 3、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺 并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
- (1) 在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉:
- (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。"

(七) 对欺诈发行上市的股份购回的承诺

1、发行人承诺:

- "1、本公司申请本次发行上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述 或 重大遗漏,不存在任何欺诈发行的情形,公司对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。
- 2、如本公司本次发行上市相关申报文件被中国证监会、证券交易所或司法 机关等相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,或存在欺诈发行上市情形

- 的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将自中国证监会或相关监管 机构认定本公司存在上述情形并要求购回股票之日起 5 个工作日内提出股份回 购预案,在提交股东会审议通过,并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份 回购措施。回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后 发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价格做相应调 整。上述购回措施实施时法律法规另有规定的从其规定。
- 3、如公司未履行上述承诺,应在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉,同时按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的法律责任。"

2、控股股东、实际控制人承诺:

- "1、发行人申请本次发行上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不存在任何欺诈发行的情形,本人将对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
- 2、如发行人本次发行上市相关申报文件被中国证监会、证券交易所或司法 机关等相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行 人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,或存在欺诈发行上市情 形的,本人将依法回购首次公开发行的全部新股。本人将自中国证监会或相关监 管机构认定公司存在上述情形并要求购回股票之日起 5 个工作日内提出股份回 购预案,并启动股份回购措施。回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素 确定。公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述 发行价格做相应调整。上述购回措施实施时法律法规另有规定的从其规定。
- 3、如本人未履行上述承诺,本人将在中国证监会指定的信息披露平台上公 开说明未履行承诺的原因并公开道歉。本人同意发行人自本人违反承诺之日起有 权扣留应向本人发放的现金红利、工资、奖金和津贴等,以用于执行未履行的承 诺,直至本人履行上述承诺或支付应由本人承担的投资者损失为止。本人未履行 上述承诺期间,本人所持发行人股份不得转让。
- 4、本承诺自作出之日起即对本人具有法律约束力,不因本人在公司的职务变更、离职、股份变动等原因而豁免履行。本人将积极采取合法措施履行本承诺

函的全部内容,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,如有违反,本人将按照本承诺的规定承担相应的法律责任。"

(八)关于依法承担赔偿责任的承诺

1、发行人承诺:

- "1、本公司申请本次发行上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,不存在任何欺诈发行的情形,公司对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。
- 2、如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定本公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,或存在欺诈发行上市情形,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿,通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
- 3、如本公司未履行上述承诺,应在中国证监会指定的信息披露平台上公开 说明未履行承诺的原因并公开道歉,同时按照有关法律、法规的规定及监管部门 的要求承担相应的法律责任。"

2、控股股东、实际控制人承诺:

- "1、发行人申请本次发行上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,本人将对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
- 2、如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定发行人招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,或存在欺诈发行上市情形,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿,积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
 - 3、如本人未履行上述承诺,本人将在中国证监会指定的信息披露平台上公

开说明未履行承诺的原因并公开道歉。本人同意发行人自本人违反承诺之日起有 权扣留应向本人发放的现金红利、工资、奖金和津贴等,以用于执行未履行的承 诺,直至本人履行上述承诺或支付应由本人承担的投资者损失为止。本人未履行 上述承诺期间,本人所持发行人股份不得转让。

4、本承诺自作出之日起即对本人具有法律约束力,不因本人在发行人的职务变更、离职、股份变动等原因而豁免履行。本人将积极采取合法措施履行本承诺函的全部内容,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,如有违反,本人将按照本承诺的规定承担相应的法律责任。"

3、董事、监事、高级管理人员承诺:

- "1、本人确认发行人申请本次发行上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
- 2、如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定发行人招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,或存在欺诈发行上市情形,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿,积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
- 3、如本人未履行上述承诺,本人将在中国证监会指定的信息披露平台上公 开说明未履行承诺的原因并公开道歉。本人同意发行人自本人违反承诺之日起有 权扣留应向本人发放的现金红利、工资、奖金和津贴等,以用于执行未履行的承 诺,直至本人履行上述承诺或支付应由本人承担的投资者损失为止。本人未履行 上述承诺期间,本人所持发行人股份不得转让。
- 4、本承诺自作出之日起即对本人具有法律约束力,不因本人在公司的职务变更、离职、股份变动等原因而豁免履行。本人将积极采取合法措施履行本承诺函的全部内容,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,如有违反,本人将按照本承诺的规定承担相应的法律责任。"

(九) 关于规范和减少关联交易的承诺

1、控股股东、实际控制人承诺:

- "一、严格遵守《中华人民共和国公司法》《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》《厦门恒坤新材料科技股份有限公司关联交易管理办法》《厦门恒坤新材料科技股份有限公司董材料科技股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定,避免和减少关联交易,自觉维护发行人及全体股东的利益,不利用本人在发行人中的地位,为本人、本人控制的企业或本人任职的除发行人及其控股子公司以外的企业,在与发行人或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益。
- 二、如果本人、本人控制的企业或本人任职的除发行人及其控股子公司以外 企业与发行人或其控股子公司不可避免地出现关联交易,本人将严格执行相关回 避制度,依法诚信地履行相关义务,不会利用关联人的地位,就上述关联交易采 取任何行动以促使发行人股东会、董事会作出侵犯发行人及其他股东合法权益的 决议。
- 三、发行人或其控股子公司与本人、本人控制的企业或本人任职的除发行人 及其控股子公司以外的企业之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行,确保 交易价格公允,不损害发行人及其控股子公司的合法权益。

若因违反上述承诺而所获得的利益及权益将归发行人所有,并赔偿因违反上 述承诺而给发行人造成的全部损失。"

2、董事、监事、高级管理人员承诺

- "一、严格遵守《中华人民共和国公司法》《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》《厦门恒坤新材料科技股份有限公司关联交易管理办法》《厦门恒坤新材料科技股份有限公司董材料科技股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定,避免和减少关联交易,自觉维护发行人及全体股东的利益,不利用本人在发行人中的地位,为本人、本人控制的企业或本人任职的除发行人及其控股子公司以外的企业,在与发行人或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益。
 - 二、如果本人、本人控制的企业或本人任职的除发行人及其控股子公司以外

的企业与发行人或其控股子公司不可避免地出现关联交易,本人将严格执行相关 回避制度,依法诚信地履行相关义务,不会利用关联人的地位,就上述关联交易 采取任何行动以促使发行人股东会、董事会作出侵犯发行人及其他股东合法权益 的决议。

三、发行人或其控股子公司与本人、本人控制的企业或本人任职的除发行人 及其控股子公司以外的企业之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行,确保 交易价格公允,不损害发行人及其控股子公司的合法权益。

若因违反上述承诺而所获得的利益及权益将归发行人所有,并赔偿因违反上 述承诺而给发行人造成的全部损失。"

(十) 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

控股股东、实际控制人为了避免因同业竞争而给发行人和社会公众利益带来 损害,作出如下声明及承诺:

- "1、本人及本人控制的其他企业目前在中国境内外未生产、开发任何与发行人所生产、开发产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接从事或参与任何与发行人所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
- 2、本人及本人控制的其他企业将来也不在中国境内外生产、开发任何与发行人所生产、开发产品构成竞争或可能构成竞争的产品;不直接或间接从事或参与任何与发行人所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务;不参与投资任何与发行人所生产产品或所经营业务构成竞争或可能构成竞争的法人或组织;不在任何与发行人所生产产品或所经营业务构成竞争或可能构成竞争的法人或组织中担任任何职务。
- 3、如发行人进一步拓展其产品和业务范围,本人将不直接或间接生产、开发与发行人拓展后的产品相竞争的产品,从事或参与发行人拓展后的业务相竞争的业务;若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争,本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的产品或业务的方式、或将相竞争的业务纳入发行人经营的方式、或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。

若因违反上述承诺而所获得的利益及权益将归发行人所有,并赔偿因违反上

述承诺而给发行人造成的全部损失。"

(十一) 关于避免资金占用的承诺

- 1、控股股东、实际控制人承诺:
- "本人及本人的关联方将不会占用发行人资金,包括但不限于如下行为:
- 1、本人及本人的关联方不要求且不会促使发行人为本人及本人的关联方代 垫费用,也不互相代为承担成本、费用或者其他支出。
- 2、本人及本人的关联方不会要求且不会促使发行人通过下列方式将资金直接或者间接提供给本人及本人的关联方使用:
 - (1) 有偿或者无偿地拆借发行人的资金给本人及本人的关联方使用;
 - (2) 通过银行或者非银行金融机构向本人及本人的关联方提供委托贷款;
 - (3) 委托本人及本人的关联方进行投资活动;
 - (4) 为本人及本人的关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
 - (5) 代本人及本人的关联方偿还债务;
 - (6) 其他实质导致发行人资金被占用的行为。
- 3、如因未履行上述承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有;如因 未履行上述承诺事项给发行人造成损失的,本人将向发行人承担赔偿责任。
 - 4、上述承诺在本人作为发行人控股股东或者实际控制人期间持续有效。"
 - 2、董事、监事、高级管理人员承诺:
 - "本人及本人的关联方将不会占用发行人资金,包括但不限于如下行为:
- 1、本人及本人的关联方不要求且不会促使发行人为本人及本人的关联方代 垫费用,也不互相代为承担成本、费用或者其他支出。
- 2、本人及本人的关联方不会要求且不会促使发行人通过下列方式将资金直接或者间接提供给本人及本人的关联方使用:
 - (1) 有偿或者无偿地拆借发行人的资金给本人及本人的关联方使用;
 - (2) 通过银行或者非银行金融机构向本人及本人的关联方提供委托贷款;

- (3) 委托本人及本人的关联方进行投资活动;
- (4) 为本人及本人的关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
- (5) 代本人及本人的关联方偿还债务;
- (6) 其他实质导致发行人资金被占用的行为。
- 3、如因未履行上述承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有;如因未履行上述承诺事项给发行人造成损失的,本人将向发行人承担赔偿责任。
 - 4、上述承诺在本人作为发行人董事/监事/高级管理人员期间持续有效。"

(十二) 控股股东、实际控制人关于社会保险与住房公积金的承诺

控股股东、实际控制人承诺如下:

"发行人及子公司均已执行法律、法规及规范性文件所规定的社会保险制度和住房公积金制度,为公司员工缴存社会保险和住房公积金。如因国家有权部门要求或决定发行人及其子公司需为其员工补缴社保、住房公积金或因此而受到任何罚款或损失,相关费用和责任由本人全额承担、赔偿,本人将根据有权部门的要求及时予以缴纳。如因此给发行人及其子公司带来损失,本人愿意向发行人及其子公司给予全额补偿。本人在承担前述补偿后,不会就该等费用向发行人及其子公司行使追索权。"

(十三) 发行人关于在审期间不进行现金分红的承诺

发行人承诺如下:

- "一、如本公司本次发行上市申请获得批准注册并成功实施,则本公司本次发行前滚存的未分配利润,将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有;
- 二、在本公司本次发行上市的申报受理后至本公司股票在上海证券交易所科 创板上市前不进行现金分红或提出现金分红的方案;
- 三、上述承诺为本公司的真实意思表示,本公司自接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。"

(十四) 控股股东、实际控制人关于保证公司独立性的承诺

控股股东、实际控制人为保证公司独立性,作出如下声明及承诺:

"本人将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及公司章程等的相关规 定行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东地位谋取不当利益,保证公司 在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立,维护公司独立性。

本承诺在本人为公司控股股东、实际控制人期间持续有效。若因违反上述承诺而所获得的利益及权益将归公司所有,并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的全部损失。"

(十五) 发行人关于股东信息披露的专项承诺

公司关于股东信息披露作出如下承诺:

- "1、本公司已及时向为本次发行上市而聘请的中介机构提供了真实、准确、 完整的资料,积极和全面配合了中介机构开展尽职调查,依法在本次发行上市的 招股意向书等申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,履行了信息披露 义务。
- 2、本公司历史上存在的股权代持情形已依法解除,并已在本招股意向书中相应披露。截至本承诺函出具之日,本公司现有股东持有的股份真实、合法、有效,本公司股份权属清晰,不存在委托持股、委托投资或其他协议安排。
- 3、截至本承诺出具之日,本公司股东无锡新投春霖科创投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业(有限合伙)为本次发行保荐机构中信建投证券股份有限公司实际控制的企业。除上述情况外,本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形,直接或间接持有本公司股份的主体与本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。
- 4、截至本承诺函出具之日,本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形,直接或间接持有本公司股份的主体均具备法律、法规规定的股东资格。

- 5、截至本承诺函出具之日,本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送情形以及《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定(试行)》规定的"不当入股"的情形;本公司不存在涉及中国证监会系统离职人员入股的重大媒体质疑;各股东作为持股主体符合中国法律法规的规定。
 - 6、如本公司违反上述承诺,将承担由此引起的一切法律责任。"

七、股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及《公司章程》,建立健全了股东会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度,形成了权力机构、决策机构、监督机构及执行机构相互协调、相互制衡的运行机制。

为进一步健全法人治理结构,公司在董事会下设立了"战略委员会"、"审计委员会"、"提名委员会"、"薪酬与考核委员会",并制定了相应的工作制度,明确了各专门委员会的权责、决策程序及议事规则。自设立以来,公司股东会、董事会、监事会均按照《公司法》等相关法律法规独立有效运作,无违法、违规情况。

(一) 股东会制度的建立、健全及运行情况

根据《公司法》及有关规定,公司制定了《公司章程》《股东会议事规则》,其中《公司章程》中规定了股东会的职责、权限及股东会会议的基本制度,《股东会议事规则》针对股东会的召开程序制定了详细规则。

自 2021 年 1 月 1 日至本招股意向书签署日,公司共计召开 49 次股东(大)会。公司股东(大)会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的要求规范运行,对公司董事、监事和独立董事的选举、公司财务预决算、利润分配、《公司章程》及其他主要管理制度的制订和修改、首次公开发行股票并上市的决策和募集资金投向等重大事宜作出了有效决议。

公司股东(大)会的召开及决议内容合法有效,不存在违反《公司法》及其 他规定行使职权的情形。

(二) 董事会制度的建立、健全及运行情况

公司建立了《董事会议事规则》,对董事会的职权、召开方式与条件、表决方式等进行了明确规定。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利,履行义务。

公司董事会由 7 名董事组成,自 2021 年 1 月 1 日至本招股意向书签署日,公司共计召开 60 次董事会。公司董事会成员严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的职权,公司历次董事会的召集、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作,对高级管理人员的聘任、公司财务预决算、利润分配、股东(大)会的召开、《公司章程》及其他主要管理制度的制订和修改、首次公开发行股票并上市的决策和募集资金投向等重大事宜作出了有效决议。

公司董事会的召开及决议内容合法有效,不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

(三) 监事会制度的建立、健全及运行情况

公司建立了《监事会议事规则》,对监事会的职权、召开方式与条件、表决方式等进行了明确规定。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利,履行义务。

公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 2 名。自 2021 年 1 月 1 日 至本招股意向书签署日,公司共计召开 38 次监事会。

公司监事会的召开、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作,对公司财务预决算、利润分配等重大事宜作出了有效决议。公司监事会的召开及决议内容合法有效,不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

(四)独立董事制度的建立、健全及运行情况

公司董事会设 3 名独立董事,达到董事会总人数的三分之一。独立董事自聘任以来,依据有关法律、法规及有关上市规则、《公司法》和《独立董事制度》 谨慎、认真、勤勉地履行权利和义务,积极参与本公司重大经营决策,完善了公 司治理结构,维护了全体股东的利益,在完善公司治理结构、公司战略发展选择等方面起到了促进作用。

截至本招股意向书签署日,未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

(五) 董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司的高级管理人员,对董事会负责。董事会秘书自受聘以来,严格按照《公司章程》《董事会秘书工作细则》的相关规定筹备董事会和股东会,勤勉尽职地履行了其职责。

(六) 未来公司治理结构调整计划的说明

根据中国证监会于 2024 年 12 月发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求,公司将于 2026 年 1 月 1 日之前完成对现有治理结构的调整。调整完成后,公司将不再设立监事会或监事,改由董事会中的审计委员会依法行使《公司法》所规定的监事会职权。同时,公司将对公司章程及配套治理制度进行相应修订,以确保与上述调整事项保持一致。

八、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

发行人董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会为董事会的专门工作机构,专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案提交董事会审议决定。

(一)战略委员会

公司董事会战略委员会由易荣坤(董事长)、王廷通(董事)、肖楠(董事)、 庄超颖(董事)、邹友思(独立董事)5位委员组成,由易荣坤担任主任委员并 负责主持工作。

战略委员会的主要职责为: "(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议; (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (五)对以上事项的实施进行检查; (六)董事会授权的其他事项。"

(二) 审计委员会

公司董事会审计委员会由黄兴孪(独立董事)、苏小榕(独立董事)、庄超颖(董事)3位委员组成,由黄兴孪担任主任委员并负责主持工作。

审计委员会主要职责为: "(一)提议聘请或更换外部审计机构; (二)指导和监督公司的内部审计制度建立及实施; (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (四)审核公司的财务信息及其披露; (五)审查公司的内控制度,对重大关联交易进行审计; (六)公司董事会授予的其他事宜。"

(三) 提名委员会

公司董事会提名委员会由邹友思(独立董事)、易荣坤(董事)、苏小榕(独立董事)3位委员组成,由邹友思担任主任委员并负责主持工作。

提名委员会的主要职责为: "(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;(三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;(四)对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议;(五)董事会授权的其它事宜。"

(四) 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由苏小榕(独立董事)、黄兴孪(独立董事)、 易荣坤(董事)3位委员组成,由苏小榕担任主任委员并负责主持工作。

薪酬与考核委员会的主要职责为: "(一)根据本公司行业的特点,以及董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及本地区其他相关上市公司相关岗位的薪酬水平,制定并执行适合市场环境变化的绩效评价体系,具备竞争优势的薪酬政策以及与经营业绩相关联的奖惩激励措施;上述薪酬政策主要包括但不限于绩效评价标准,程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;(二)审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;(三)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;(四)对公司董事及管理层进行年度考核;(五)董事会授权的其他事宜。"

九、公司不动产权情况

序号	权利 人	不动产权证号	坐落位置	面积	(m ²)	权利性质	用途	权利类型	权利期限	他项权利
1	恒坤 新材	闽 (2020) 厦门市 不 动 产 权 第 0075398号	海沧区山边路 389 号加工厂房	宗地面积: 建筑面积:	16,738.38; 5,663.66	出让/自 建房	工业/厂房	国有建设用地使 用权/房屋所有权		已办理抵 押登记
2	恒坤新材	闽 (2020) 厦门市 不 动 产 权 第 0075397号	海沧区山边路 389 号设备用房	宗地面积:建筑面积:	16,738.38; 262.45	出让/自 建房	工业/设备用房	国有建设用地使 用权/房屋所有权	国有建设用地使用权: 2006年	己办理抵 押登记
3	恒坤 新材	闽 (2020) 厦门市 不 动 产 权 第 0075396号	海沧区山边路 389 号一号厂房、连廊、 研发楼	宗地面积:建筑面积:		出让/自 建房	工业/厂房	国有建设用地使 用权/房屋所有权	1月18日起 至2056年1 月18日止	己办理抵 押登记
4	恒坤 新材	闽 (2024) 厦门市 不 动 产 权 第 0011888 号	海沧区山边路 389-4 号	宗地面积:建筑面积:		出让/自 建房	工业/车库及设 备用房/机房/生 产厂房/梯间	国有建设用地使 用权/房屋所有权	使又 使工 使工	己办理抵 押登记
5	大连 恒坤	辽(2022)大连普湾不动产权第 11002551号	大连松木岛化工园 区松源街 1-5 号	宗地面积:建筑面积:	29,958.90; 81.16	出让/其	工业用地/控制室	国有建设用地使 用权/房屋所有权		无
6	大连 恒坤	辽(2022)大连普湾不动产权第 11002552号	大连松木岛化工园 区松源街 1-4 号	宗地面积: 建筑面积:	29,958.90; 1,422.86	出让/其	工业用地/仓库	国有建设用地使 用权/房屋所有权	国有建设用地使用	无
7	大连 恒坤	辽(2022)大连普湾不动产权第 11002553号	大连松木岛化工园 区松源街 1-3 号	宗地面积:建筑面积:	29,958.90; 733.03	出让/其	工业用地/仓库	国有建设用地使 用权/房屋所有权		无
8	大连 恒坤	辽(2022)大连普湾不动产权第 11002554号	大连松木岛化工园 区松源街 1-2 号	宗地面积: 建筑面积:	29,958.90; 689.08	出让/其	工业用地/厂房	国有建设用地使 用权/房屋所有权	月2日止	无
9	大连 恒坤	辽(2022)大连普湾不动产权第 11002555号	大连松木岛化工园 区松源街 1-1 号	宗地面积:建筑面积:	29,958.90; 4,134.09	出让/其	工业用地/综合 楼	国有建设用地使 用权/房屋所有权		无

序号	权利 人	不动产权证号	坐落位置	面积	(m ²)	权利性质	用途	权利类型	权利期限	他项权利
10	福建泓光	闽(2023)漳州高 新开发区不动产权 第 0006366 号		宗地面积:建筑面积:		出让/自 建房	工矿仓储用地- 工业用地(化学 原料和化学制 品制造业)	国有建设用地使 用权/房屋所有权	国有建设用地使用权: 2021年12月28日起至 2071年12月27日止	已办理抵 押登记
11	安徽恒坤	皖 (2022) 合肥市 不 动 产 权 第 1209903号		宗地面积:	66,613.34	出让	工业用地	国有建设用地使 用权	2022年8月 23 日起至 2072年8月 22日止	已办理抵 押登记
12	恒坤 新材	闽(2024)厦门市 不 动 产 权 第 0007998号	海沧区海沧大道 567号 1909 单元	宗地面积: 建筑面积:		出让/商 品房	商务金融用地 (办公)/开敞 办公	国有建设用地使 用权/房屋所有权		无
13	恒坤 新材	闽(2024)厦门市 不 动 产 权 第 0008003号	海沧区海沧大道 567 号 1911 单元	宗地面积: 建筑面积:		出让/商品房	商务金融用地 (办公)/开敞 办公	国有建设用地使 用权/房屋所有权	日方母机	无
14	恒坤 新材	闽(2024)厦门市 不 动 产 权 第 0008009号	海沧区海沧大道 567号 1912 单元	宗地面积: 建筑面积:		出让/商 品房	商务金融用地 (办公)/开敞 办公	国有建设用地使 用权/房屋所有权		无
15	恒坤 新材	闽(2024)厦门市 不 动 产 权 第 0008030号	海沧区海沧大道 567号 1904 单元	宗地面积: 建筑面积:		出让/商 品房	商务金融用地 (办公)/开敞 办公	国有建设用地使用权/房屋所有权	起至 2062 年 10 月 24	无
16	恒坤 新材	闽(2024)厦门市 不 动 产 权 第 0008069号	海沧区海沧大道 567号 1907 单元	宗地面积: 建筑面积:		出让/商 品房	商务金融用地 (办公)/开敞 办公	国有建设用地使 用权/房屋所有权	日止	无
17	恒坤 新材	闽(2024)厦门市 不 动 产 权 第 0008076号	海沧区海沧大道 567号 1902 单元	宗地面积: 建筑面积:		出让/商品房	商务金融用地 (办公)/开敞 办公	国有建设用地使 用权/房屋所有权		无

序号	权利 人	不动产权证号	坐落位置	面积	(m ²)	权利性质	用途	权利类型	权利期限	他项权利
18	恒坤新材	闽(2024)厦门市 不 动 产 权 第 0008088号	海沧区海沧大道 567 号 1908 单元	宗地面积: 建筑面积:	29,318.06; 116.39	出让/商品房	商务金融用地 (办公)/开敞 办公	国有建设用地使用权/房屋所有权		无
19	恒坤 新材	闽 (2024) 厦门市不 动 产 权 第0008105号	海沧区海沧大道 567 号 1903 单元	宗地面积: 建筑面积:	29,318.06; 155.54	出让/商品房	商务金融用地 (办公)/开敞 办公	国有建设用地使用权/房屋所有权		无
20	恒坤 新材	闽 (2024) 厦门市 不 动 产 权 第 0008107号	海沧区海沧大道 567 号 1901 单元	宗地面积:建筑面积:	29,318.06; 141.76	出让/商 品房	商务金融用地 (办公)/开敞 办公	国有建设用地使 用权/房屋所有权		无
21	恒坤 新材	闽 (2024) 厦门市不 动 产 权 第0008114号	海沧区海沧大道 567 号 1905 单元	宗地面积:建筑面积:	29,318.06; 209.4	出让/商 品房	商务金融用地 (办公)/开敞 办公	国有建设用地使用权/房屋所有权		无
22	恒坤 新材	闽 (2024) 厦门市不 动 产 权 第0008128号	海沧区海沧大道 567 号 1906 单元	宗地面积:建筑面积:	29,318.06; 125.23	出让/商 品房	商务金融用地 (办公)/开敞 办公	国有建设用地使用权/房屋所有权		无
23	恒坤 新材	闽 (2024) 厦门市 不 动 产 权 第 0008150号	海沧区海沧大道 567 号 1910 单元	宗地面积: 建筑面积:	29,318.06; 142.41	出让/商品房	商务金融用地 (办公)/开敞 办公	国有建设用地使用权/房屋所有权		无
24	司理 可	闽(2024)漳州高 新开发区不动产权 第0002288号	漳州高新区九湖工 业园区纵二路以东、 横二路以北(九湖镇 林前村)	宗地面积:	32,595	出让	工矿仓储用地—工业用地— 计算机、通信和 其他电子设备 制造业	国有建设用地使用权	2024年3月 27 日起至 2074年3月 26日止	无
25	大连 恒坤	辽(2024)大连普湾 不 动 产 权 第 11004070号	大连市金州区炮台 街道松源街 1-15 号	宗地面积: 建筑面积:		出让/其	工业工地/控制室2	国有建设用地使用权/房屋所有权	国有建设用地使用权: 2019年	无
26	大连 恒坤	辽(2024)大连普湾 不 动 产 权 第 11004071号	大连市金州区炮台 街道松源街 1-14 号	宗地面积: 建筑面积:		出让/其	工业工地/仓库	国有建设用地使 用权/房屋所有权	1月3日起 至2069年1 月2日止	无

序号	权利 人	不动产权证号	坐落位置	面积(m²)	权利性质	用途	权利类型	权利期限	他项权利
27	大连 恒坤	辽 (2024) 大连普湾 不 动 产 权 第 11004072 号	人 生 市 金 州 区 旭 台	宗地面积: 29958.90; 建筑面积: 1770.95	出让/其	工业工地/厂房	国有建设用地使用权/房屋所有权		无
28	大连 恒坤	辽 (2024) 大连普湾 不 动 产 权 第 11004073 号		宗地面积: 29958.90; 建筑面积: 634.57	出让/其	工业工地/厂房	国有建设用地使用权/房屋所有权		无

十、公司专利情况

序号	专利号	持有 人	专利 类别	专利名称	申请日	取得方式	权利限制
1	201811620801.2	恒坤新材	发明 专利	含立方烷的丙烯酸酯 系成膜树脂和 ArF 光 刻胶及其制备方法和 光刻方法	2018.12.28	原始取得	无
2	201910619629.7	恒坤 新材	发明 专利	含萘侧基聚合物及其 制备方法和硬掩膜组 合物及图案形成方法	2019.07.10	原始 取得	无
3	202010087861.3	恒坤 新材	发明 专利	硬掩膜组合物和硬掩 膜及形成图案的方法	2020.02.12	原始 取得	无
4	202010087862.8	恒坤 新材	发明 专利	硬掩膜组合物和硬掩 膜及形成图案的方法	2020.02.12	原始 取得	无
5	201910609647.7	恒坤 新材	发明 专利	聚合物、硬掩膜组合物 及形成图案的方法	2019.07.08	原始 取得	无
6	202111004197.2	恒坤 新材	发明 专利	一种底部抗反射涂料 组合物及光刻胶浮雕 图像的形成方法	2021.08.30	原始 取得	无
7	202111003136.4	恒坤新材	发明 专利	一种与光刻胶配合使用的底部抗反射涂料组合物及光刻胶浮雕图像形成方法	2021.08.30	原始取得	无
8	202110685998.3	恒坤 新材	发明 专利	一种底部抗反射膜树 脂和组合物及图案形 成方法	2021.06.21	原始 取得	无
9	202111196554.X	恒坤新材	发明专利	一种含可自交联巯基 三聚氰胺聚合物的抗 反射涂层组合物及其 制备方法和图案形成 方法	2021.10.14	原始取得	无
10	202111196544.6	恒坤新材	发明 专利	一种可自交联异氰尿 酸酯聚合物和抗反射 涂层组合物及其制备 方法和图案形成方法	2021.10.14	原始取得	无
11	202111201706.0	恒坤 新材	发明 专利	一种聚醚高聚物和抗 反射涂层溶液及其制 备方法	2021.10.15	原始 取得	无
12	202111201717.9	恒坤 新材	发明 专利	一种功能性聚合物和 底部抗反射涂层组合 物及其制备方法	2021.10.15	原始 取得	无
13	202310094469.5	恒坤新材	发明 专利	一种抗反射涂料组合 物及其制备方法以及 光刻胶图案的形成方 法	2023.02.10	原始 取得	无
14	202111287637.X	恒坤 新材	发明 专利	一种硬掩膜组合物及 其制备方法、形成图案 的方法	2021.11.02	原始 取得	无

序号	专利号	持有 人	专利 类别	专利名称	申请日	取得方式	权利限制
15	202111287631.2	恒坤 新材	发明 专利	一种硬掩膜组合物及 其制备方法、形成图案 的方法	2021.11.02	原始 取得	无
16	202111287837.5	恒坤 新材	发明 专利	一种硬掩膜组合物及 其制备方法、形成图案 的方法	2021.11.02	原始 取得	无
17	202211485550.8	恒坤 新材	发明 专利	一种有机抗反射涂层 组合物及其制备方法 和图案形成方法	2022.11.24	原始 取得	无
18	201810796829.5	恒坤 新材	发明 专利	抗反射硬掩膜组合物	2018.07.19	继受 取得	无
19	202122663120.8	恒坤 新材	实用 新型	一种用于固液分层体 系的浮动抽液装置	2021.11.02	原始 取得	无
20	202122663472.3	恒坤 新材	实用 新型	一种用于去除树脂溶 液中金属离子的过滤 装置	2021.11.02	原始取得	无
21	202020665660.2	恒坤 新材	实用 新型	一种光刻胶产品运输 用保温包装箱	2020.04.27	原始 取得	无
22	202020665670.6	恒坤 新材	实用 新型	一种光刻胶灌装装置	2020.04.27	原始 取得	无
23	202020665672.5	恒坤 新材	实用 新型	一种光刻胶灌装机用 空气过滤装置	2020.04.27	原始 取得	无
24	202020668959.3	恒坤 新材	实用 新型	一种光刻胶生产车间 用温度调节装置	2020.04.28	原始 取得	无
25	202020671316.4	恒坤 新材	实用 新型	一种光刻胶生产用废 液回收装置	2020.04.28	原始 取得	无
26	202020671396.3	恒坤 新材	实用 新型	一种光刻胶生产用原 料取样装置	2020.04.28	原始 取得	无
27	202020671524.4	恒坤新材	实用新型	一种光刻胶运输用温 度检测装置的防护装 置	2020.04.28	原始取得	无
28	202020671612.4	恒坤 新材	实用 新型	一种匀胶显影机用光 刻胶回收装置	2020.04.28	原始 取得	无
29	202223316009.2	恒坤 新材	实用 新型	一种光刻胶树脂生产 尾气处理装置	2022.12.09	原始 取得	无
30	202223316217.2	恒坤 新材	实用 新型	一种移动泵车	2022.12.09	原始 取得	无
31	202223392163.8	恒坤 新材	实用 新型	一种光刻胶挥发物取 样的高温烘烤设备	2022.12.16	原始 取得	无
32	202223436713.1	恒坤 新材	实用 新型	一种圆瓶贴标机	2022.12.21	原始 取得	无
33	202320187873.2	恒坤 新材	实用 新型	光刻胶冷藏包装箱	2023.02.07	原始 取得	无
34	202322599550.7	恒坤新材	实用 新型	正硅酸乙酯冷凝回流 罐系统	2023.09.25	原始 取得	无
35	201811265909.4	福建泓光	发明 专利	一种耐刻蚀的光刻胶 及其制备方法和应用 以及光刻方法	2018.10.29	原始取得	无

序号	专利号	持有人	专利 类别	专利名称	申请日	取得方式	权利限制
36	201811265920.0	福建 泓光	发明 专利	一种光刻胶及其制备 方法和应用以及光刻 方法	2018.10.29	原始 取得	无
37	201910387042.8	福建泓光	发明 专利	一种抗蚀剂下层膜单 体和组合物及图案形 成方法	2019.05.10	原始 取得	无
38	201910387056.X	福建泓光	发明 专利	一种抗蚀剂下层膜单 体和组合物及图案形 成方法	2019.05.10	原始 取得	无
39	202210102218.2	福建泓光	发明 专利	一种底部抗反射涂料 组合物及其制备方法 和微电子结构的形成 方法	2022.01.27	原始取得	无
40	202210102205.5	福建泓光	发明 专利	含有有机刚性笼状化合物的底部抗反射涂料组合物及其制备方法和微电子结构的形成方法	2022.01.27	原始取得	无
41	201910387089.4	福建 泓光	发明 专利	一种硬掩膜单体和组 合物及图案形成方法	2019.05.10	原始 取得	无
42	201910387117.2	福建 泓光	发明 专利	一种抗蚀剂下层膜单 体和组合物及图案形 成方法	2019.05.10	原始 取得	无
43	201910387120.4	福建泓光	发明 专利	一种抗蚀剂下层膜单 体和组合物及图案形 成方法	2019.05.10	原始 取得	无
44	202111633280.6	福建泓光	发明 专利	一种梯形结构顶部抗 反射涂层聚合物和顶 部抗反射涂层组合物 及其制备方法	2021.12.29	原始取得	无
45	201921368594.6	福建 泓光	实用 新型	一种光刻胶生产用管 道仪表阀门	2019.08.22	原始 取得	无
46	201921368611.6	福建 泓光	实用 新型	一种用于光刻胶循环 过滤的压力保护装置	2019.08.22	原始 取得	无
47	201921368622.4	福建 泓光	实用 新型	一种用于光刻胶生产 的循环过滤装置	2019.08.22	原始 取得	无
48	201921368624.3	福建 泓光	实用 新型	一种光刻胶高端精细 过滤装置	2019.08.22	原始 取得	无
49	201921368642.1	福建 泓光	实用 新型	一种用于光刻胶生产 的混合设备	2019.08.22	原始 取得	无
50	201921368644.0	福建 泓光	实用 新型	一种全自动光刻胶灌 装装置	2019.08.22	原始 取得	无
51	201921368645.5	福建 泓光	实用 新型	一种光刻胶灌装机灌 装内部洁净装置	2019.08.22	原始 取得	无
52	201921368661.4	福建 泓光	实用 新型	一种光刻胶匀胶显影 机的供应装置	2019.08.22	原始 取得	无
53	201921368666.7	福建 泓光	实用 新型	一种光刻胶匀胶显影 机的供液消泡装置	2019.08.22	原始 取得	无

序号	专利号	持有人	专利 类别	专利名称	申请日	取得方式	权利限制
54	201921368667.1	福建泓光	实用 新型	一种用于光刻胶生产 的自动进料设备	2019.08.22	原始 取得	无
55	201921368772.5	福建 泓光	实用 新型	一种光刻胶匀胶显影 机的冷却保温装置	2019.08.22	原始 取得	无
56	201921368773.X	福建 泓光	实用 新型	一种用于光刻胶生产 的尾气处理装置	2019.08.22	原始 取得	无
57	201921368841.2	福建 泓光	实用 新型	一种光刻胶自动贴标 装置	2019.08.22	原始 取得	无
58	202322894065.2	福建泓光	实用 新型	一种光刻胶冷藏装置	2023.10.26	原始 取得	无
59	202310849522.8	大连 恒坤	发明 专利	一种高纯正硅酸乙酯 的制备方法和生产系 统	2023.07.11	原始 取得	无
60	201920308360.6	大连 恒坤	实用 新型	一种正硅酸乙酯的提 纯装置	2019.03.12	原始 取得	无
61	201921697909.1	大连 恒坤	实用 新型	一种防爆、防渗漏颗粒 测试装置	2019.10.11	原始 取得	无
62	201921697932.0	大连 恒坤	实用 新型	一种化学品用自动灌 装机	2019.10.11	原始 取得	无
63	201921697942.4	大连 恒坤	实用 新型	一种水分测试装置	2019.10.11	原始 取得	无
64	201921697943.9	大连 恒坤	实用 新型	一种正硅酸乙酯产品 罐	2019.10.11	原始 取得	无
65	201921816916.9	大连 恒坤	实用 新型	一种双塔釜精馏塔	2019.10.25	原始 取得	无
66	201921952645.X	大连 恒坤	实用 新型	一种产品罐自动清洗 机及清洗系统	2019.11.12	原始 取得	无
67	202123004745.X	大连 恒坤	实用 新型	一种用于半导体材料 容器阀门循环吹扫装 置	2021.12.02	原始 取得	无
68	202220022979.2	大连 恒坤	实用 新型	一种用于水分测试的 防爆、防渗漏装置	2022.01.06	原始 取得	无
69	202123306008.5	大连 恒坤	实用 新型	一种储存半导体材料 的容器真空置换及测 漏装置	2021.12.24	原始 取得	无
70	202220511043.6	大连 恒坤	实用 新型	母液清洗机	2022.03.10	原始 取得	无
71	202221374667.4	大连 恒坤	实用 新型	一种小型升华装置	2022.06.02	原始 取得	无
72	202221895769.0	大连 恒坤	实用 新型	一种用于合成氨基金 属配合物的一体式装 置	2022.07.21	原始 取得	无
73	202221526073.0	大连 恒坤	实用 新型	一种用于常减压精馏 的夹层回流比控制装 置	2022.06.17	原始 取得	无
74	202221526059.0	大连 恒坤	实用 新型	一种用于氨基硅烷制 备的易拆洗过滤装置	2022.06.17	原始 取得	无

序号	专利号	持有人	专利 类别	专利名称	申请日	取得方式	权利限制
75	202222141434.6	大连 恒坤	实用 新型	一种正硅酸乙酯封闭 式抽料管	2022.08.15	原始 取得	无
76	202221985836.8	大连 恒坤	实用 新型	一种应用于超高纯化 学品的过滤器	2022.07.29	原始 取得	无
77	202221901587.X	大连 恒坤	实用 新型	一种四二甲氨基金属 配合物的制备与纯化 装置	2022.07.22	原始 取得	无
78	202320645198.3	大连 恒坤	实用 新型	一种蒸发器	2023.03.28	原始 取得	无
79	202322217430.6	大连 恒坤	实用 新型	正硅酸乙酯自动灌装 系统	2023.08.17	原始 取得	无
80	201910434076.8	福建恒晶	发明 专利	一种聚硅氮烷涂层材料、制备方法和应用方 法	2019.05.23	继受 取得	无
81	202310618190.2	恒坤 新材	发明 专利	正性光刻胶用聚酰亚 胺树脂及其制备方法 和应用	2023.05.29	原始 取得	无
82	202310568802.1	恒坤 新材	发明 专利	一种 KrF 光刻胶及其 制备方法和图案化方 法	2023.05.19	原始取得	无
83	202211717298.9	福建泓光	发明 专利	一种酚醛树脂组合物 及其制备方法和应用 以及固化浮雕图案的 制备方法	2022.12.29	原始取得	无
84	202311603977.8	福建 泓光	发明 专利	一种硬掩模组合物及 形成图案的方法	2023.11.28	原始 取得	无
85	202410003309.X	福建泓光	发明 专利	一种含硅表面改性剂 和抗刻蚀剂下层膜组 合物及其制备方法与 应用	2024.01.02	原始取得	无
86	202323381601.5	福建 泓光	实用 新型	一种光刻胶自动过滤 装置	2023.12.12	原始 取得	无
87	201910183201.2	大连 恒坤	发明 专利	一种正硅酸乙酯的提 纯方法	2019.03.12	原始 取得	无
88	202322815391.X	大连 恒坤	实用 新型	分装装置	2023.10.18	原始 取得	无
89	202420385562.1	大连 恒坤	实用 新型	一种用于前驱体固体 源的钢瓶	2024.02.29	原始 取得	无
90	202311003938.4	大连 恒坤	发明 专利	一种含第 IV 族金属元素膜的制备方法及其前体组合物	2023.08.10	原始 取得	无
91	202311781167.1	大连 恒坤	发明 专利	一种硅氧化物膜的成 膜方法	2023.12.22	原始 取得	无
92	202420410653.6	大连 恒坤	实用 新型	一种无水无氧储存柜	2024.03.04	原始 取得	无
93	202311757699.1	福建 泓光	发明 专利	一种非离子型含氟的 表面活性剂的制备方 法及其应用	2023.12.20	原始 取得	无

序号	专利号	持有 人	专利 类别	专利名称	申请日	取得方式	权利限制
94	202311817320.1	福建泓光	发明 专利	一种丙烯酸酯光刻胶成膜树脂和 ArF 光刻胶及其制备方法与应用	2023.12.27	原始 取得	无
95	202421748709.5	福建 泓光	实用 新型	一种光刻胶产品自动 拧盖设备	2024.07.23	原始 取得	无
96	202422124628.4	福建 泓光	实用 新型	一种光刻胶小型混配 灌装装置	2024.08.30	原始 取得	无
97	202310094446.4	恒坤 新材	发明 专利	一种硫代缩醛聚合物 及其制备方法和应用	2023.02.10	原始 取得	无
98	202310427438.7	恒坤 新材	发明 专利	一种含硅聚合物和底 部抗反射涂层组合物 及其制备方法	2023.04.20	原始 取得	无
99	202311862460.0	恒坤新材	发明 专利	一种自交联聚合物和 底部抗反射涂层组合 物及其制备方法和应 用	2023.12.29	原始取得	无
100	202421920314.9	恒坤 新材	实用 新型	一种光刻胶灌装设备	2024.08.09	原始 取得	无
101	202421920723.9	恒坤 新材	实用 新型	一种高纯光刻胶用配 方清洗液颗粒仪在线 检测设备	2024.08.09	原始 取得	无

注 1: 第1项恒坤新材名下的 201811620801.2 号专利系由泓坤微电子继受取得,属于合并范围内转让

注 2: 第 35 项福建泓光名下的 201811265909.4 号专利系由泓坤微电子继受取得,属于合并范围内转让

注 3: 第 36 项福建泓光名下的 201811265920.0 号专利系由泓坤微电子继受取得,属于合并范围内转让

注 4: 第 18 项恒坤新材名下的 201810796829.5 号专利系继受取得,继受取得前,公司系申请人之一

注 5: 第80项福建恒晶名下的201910434076.8号专利系继受取得,申请人已为公司员工

注 6: 发明专利自申请日起 20 年有效; 实用新型专利自申请日起 10 年有效;

十一、公司商标情况

序号	权利 人	商标标识	注册号	类别	有效期限	取得方式	他项 权利
1	恒坤 新材	HENGKUN恒坤	6655165	9 类	2020.09.28-2030.09.27	原始 取得	无
2	恒坤 新材	HENGKUN	31807781	1 类	2019.08.28-2029.08.27	原始 取得	无
3	恒坤 新材	KASA	33275409	3 类	2019.06.07-2029.06.06	原始 取得	无
4	恒坤 新材	PURESA	33277909	3 类	2019.09.07-2029.09.06	原始 取得	无
5	恒坤 新材	INTEBASE	33283267	3 类	2019.06.07-2029.06.06	原始 取得	无

序号	权利 人	商标标识	注册号	类别	有效期限	取得方式	他项 权利
6	恒坤 新材	PURESA	33284757	1 类	2019.09.28-2029.09.27	原始 取得	无
7	恒坤 新材	GUTEMEL	33286768	3 类	2019.06.07-2029.06.06	原始 取得	无
8	恒坤 新材	GUTEMEL	33286990	1 类	2019.06.07-2029.06.06	原始 取得	无
9	恒坤 新材	KASA	33290105	1 类	2019.10.28-2029.10.27	原始 取得	无
10	恒坤 新材	AMME	33290117	1 类	2019.09.28-2029.09.27	原始 取得	无
11	恒坤 新材	INTEBASE	33292790	1 类	2019.06.07-2029.06.06	原始 取得	无
12	恒坤 新材	U	38960851	3 类	2020.02.07-2030.02.06	原始 取得	无
13	恒坤 新材	(#)	38968673	1 类	2020.02.21-2030.02.20	原始 取得	无
14	恒坤 新材	(#)	38968733	42 类	2020.02.21-2030.02.20	原始 取得	无
15	恒坤 新材	H	38968766	42 类	2020.03.21-2030.03.20	原始 取得	无
16	恒坤 新材	★	38974217	3 类	2020.05.21-2030.05.20	原始 取得	无
17	恒坤 新材		38986655	1 类	2020.05.21-2030.05.20	原始 取得	无
18	恒坤 新材	(#)	38988087	3 类	2020.02.21-2030.02.20	原始 取得	无
19	恒坤 新材	AD	38988122	1 类	2020.02.21-2030.02.20	原始 取得	无
20	福建泓光		72370170	3 类	2023.12.07-2033.12.06	原始 取得	无
21	福建 泓光	HENSLEY	72374657	1 类	2023.12.21-2033.12.20	原始 取得	无
22	福建 泓光	GRISSOM	72389823	1 类	2023.12.07-2033.12.06	原始 取得	无
23	福建 泓光	PILGER	72367097	1 类	2023.12.21-2033.12.20	原始 取得	无

序号	权利 人	商标标识	注册号	类别	有效期限	取得 方式	他项 权利
24	福建泓光	HONGGUANG	69257054	42 类	2023.10.14-2033.10.13	原始 取得	无
25	福建 泓光	HONGGUANG	69257046	1 类	2024.01.14-2034.01.13	原始 取得	无
26	福建泓光		69245190	1 类	2023.10.14-2033.10.13	原始 取得	无
27	福建 泓光	CHESTON	72367088	1 类	2024.01.07-2034.01.06	原始 取得	无
28	福建 泓光	KAMOS	31805486	1 类	2019.04.07-2029.04.06	原始 取得	无
29	福建 泓光		72367600	1 类	2024.08.21-2034.08.20	原始取得	无

注: 第28项福建泓光名下的第31805486号商标系由恒坤新材继受取得,属于合并范围内转让

十二、募集资金投资项目具体情况

(一) 集成电路前驱体二期项目

1、项目概况

本项目拟投资 51,911.33 万元人民币,分 60 个月投入。此投资将用于集成电路前驱体产品的开发和产业化。本项目有利于公司在已有的产品和研发基础能力上制造在中国境内领先的集成电路前驱体产品,项目建成后公司预计每年将实现3.3 亿元集成电路前驱体产品销售额。

2、项目投资概算及运用

本项目投资总额为51,911.33万元人民币,具体投资构成如下:

单位:万元

序号	项目内容	投资金额	占募集资金比例
1	场地建设及装修费用	5,762.50	11.10%
2	设备费用	42,000.00	80.91%
3	研发费用	1,318.87	2.54%
4	铺底流动资金	2,829.96	5.45%
	合计	51,911.33	100.00%

3、项目组织方式和建设工程预计进展情况

本项目实施主体为大连恒坤新材料有限公司。公司将根据投资计划安排,按

实施阶段分步进行。本项目的建设周期预计为 60 个月,建设工程预计进展如下表所示:

	建设期									
进度阶段		T1		T2		Т3		T4		5
	Н1	Н2	H1	Н2	H1	Н2	H1	Н2	H1	Н2
可行性研究										
厂房建设										
设备采购及安装										
人员招聘										
研发集成电路前驱体技术										
产品化										

4、项目用地情况

本项目建设地点位于辽宁省大连市,公司已取得辽(2019)大连普湾不动产权第 11900059 号《不动产权证书》。随着厂房陆续完成,对应不动产权证书已更新为"辽(2022)大连普湾不动产权第 11002551 号、第 11002552 号、第 11002553 号、第 11002554 号、第 11002555 号和辽(2024)大连普湾不动产权第 11004070 号、第 11004071 号、第 11004072 号、第 11004073 号"。

5、项目效益分析

本项目顺利建成投产后,达产年预计可实现销售收入 33,099.50 万元,达产年净利润 12,998.59 万元,财务内部收益率(税后)为 16.83%,税后投资回收期(含建设期)为 7.90 年,经济效益较好。

6、项目环保情况

(1) 废气

本项目运营期废气包括生产过程的浓缩废气、精馏废气、分析检验废气、危 废暂存间废气等,污染物主要是挥发性有机物、颗粒物、氯化氢等。挥发性有机 物采用燃烧、吸附方式进行处理,颗粒物由设备自带水洗单元进行处理,氯化氢 采用碱吸收塔进行处理,污染物经以上处理措施处理后可以达标排放。

(2) 废水

本项目新钢瓶清洗废水依托厂区污水处理站处理后,与纯水制备浓水、蒸汽 冷凝水及经化粪池氧化分解的生活污水一起,经厂区现有污水排放口排入市政污水管网,最终进入污水处理厂进行集中处理。

(3) 噪声

本项目新增设备选购低噪声设备,加强运行设备的维护和定期检修,并采取 必要的隔声减振措施。

(4) 固体废物

本项目产生的危险废物暂存于现有危险废物暂存间内,定期委托有危废处理 资质单位进行处置;一般工业固体废物委托综合利用。

本项目已取得《关于大连恒坤新材料有限公司集成电路前驱体二期项目环境 影响报告表的审批决定》(大环评准字[2022]100190)和《关于对<大连恒坤新材 料有限公司集成电路前驱体项目(二期)改扩建工程环境影响报告书>的批准决 定》(大环评准字[2024]000028号)。

(二) 集成电路用先进材料项目

1、项目概况

本项目拟投资 90,916.74 万元人民币,分 60 个月投入。此投资将用于 ArF 与 KrF 光刻胶产品的开发和产业化,以及其他光刻材料的生产。本项目的建成将 使公司具备年产 500 吨包含 ArF、KrF 光刻胶以及其他光刻材料如 ArF BARC、KrF BARC、SOC 和 Top Coating 的生产能力,产品性能达到国际同类产品先进 水平,实现 ArF 和 KrF 光刻胶的规模化生产以及批量销售。

2、项目投资概算及运用

本项目投资总额为90,916.74万元人民币,具体投资构成如下:

单位: 万元

序号	项目内容	投资金额	占募集资金比例
1	场地建设及装修费用	31,965.69	35.16%
2	设备费用	55,519.32	61.07%
3	研发费用	2,543.73	2.80%

序号	项目内容	投资金额	占募集资金比例
4	铺底流动资金	888.00	0.98%
	合计	90,916.74	100.00%

3、项目组织方式和建设工程预计进展情况

本项目实施主体为安徽恒坤新材料科技有限公司。公司将根据投资计划安排,按实施阶段分步进行。本项目的建设周期预计为 60 个月,建设工程预计进展如下表所示:

	建设期									
进度阶段	Т	<u>`1</u>	Т	2	Т	3	T	'4	Т	`5
	H1	Н2	H1	Н2	H1	Н2	H1	Н2	H1	H2
可行性研究										
厂房建设										
设备采购及安装										
人员招聘										
研发 KrF、ArF 光刻胶技术										
产品化										

4、项目用地情况

本项目建设地点位于安徽省合肥市,公司已取得皖(2022)合肥市不动产权第 1209903 号《不动产权证书》。

5、项目效益分析

本项目顺利建成投产后,达产年预计可实现销售收入 81,626.92 万元,达产年净利润 31,224.00 万元,财务内部收益率(税后)为 18.64%,税后投资回收期(含建设期)为 7.49 年,经济效益较好。

6、项目环保情况

(1) 废气

本项目 2#光刻胶生产车间设置一级水喷淋吸收+气液分离+二级活性碳吸附装置,及 1 根 15 米高 DA001 排气筒。4#光刻胶生产车间设置一级水喷淋吸收+气液分离+二级活性碳吸附装置,及 1 根 15 米高 DA002 排气筒。危废库

设置两级活性炭吸附装置,及一根 15m 高 DA003 排气筒。研发质检楼设置两套一级酸喷淋吸收、两套两级活性炭吸附装置及两根 25m 高排气筒。污水处理站设置一套两级活性炭吸附装置及一根 15m 高 DA006 排气筒。

(2) 废水

本项目新建一个处理能力为 60m3/d 污水处理站,在化工园区工业污水处理设施建成投入运行前,本项目废气处理系统置换废水与实验废水经"一体化芬顿氧化"预处理后,与地坪拖洗废水、循环冷却水系统置换排水、初期雨水及生活污水经"调节(中和调节 pH)+A/O+MBR"处理,污水处理站出水与超纯水制备系统排水混合,达到相关排放限值,并满足蔡田铺污水处理厂接管要求后,送化工园区工业污水处理设施集中处理。在化工园区工业污水处理设施建成投入运行前,污水处理站出水与超纯水制备系统排水混合,达到相关排放限值,并满足化工园区工业污水处理厂接管要求,进入园区污水管网,进入蔡田铺污水处理厂集中处理后,排入板桥河。

(3) 噪声

本项目对主要产噪设备采取消声、隔声、减振等综合防治措施,确保厂界噪 声达标。

(4) 固体废物

本项目固体废物包括:废原料包装、废液、废溶剂、废滤芯、废活性炭、废机油、废导热油、实验废物、污泥、生活垃圾及超纯水制备的废 UV 灯管、废活性炭、废树脂、废过滤器、废 RO 膜、废超滤膜等。废危化品包装物、废液、废溶剂、废滤芯、废活性炭、废机油、废导热油、实验废物、物化污泥、废 UV 灯管等作为危险废物暂存于厂区 168m2 危险废物暂存仓库,定期委托有危险废物处置资质单位处理处置。生活垃圾、生化污泥、超纯水制备的废活性炭、废树脂、废过滤器、废 RO 膜、废超滤膜为一般固体废弃物,交由环卫部门统一处置,废纸板桶为一般废物外售物质回收部门。

本项目已取得《合肥市生态环境局关于安徽恒坤新材料科技有限公司集成电路用先进材料项目(重新报批)环境影响报告书的批复》(环建审(2024)12038号)。

十三、发行人非重要子公司及参股公司情况

(一) 非重要子公司

1、泓坤微电子

公司名称	泓坤微电子(厦门)有限公司
成立日期	2018年8月23日
注册资本	2,000 万元
实收资本	210 万元
主营业务情况	集成电路关键材料原材料的技术研发
股东构成	恒坤新材持股 100%

2、武汉恒坤

公司名称	武汉恒坤新材料科技有限公司
成立日期	2019年6月20日
注册资本	2,000 万元
实收资本	40 万元
主营业务情况	为电子半导体研发提供技术服务
股东构成	恒坤新材持股 100%

3、福建恒晶

公司名称	福建恒晶新材料科技有限公司
成立日期	2019年11月4日
注册资本	1,200 万元
实收资本	1,200 万元
主营业务情况	集成电路关键材料的研发生产
股东构成	恒坤新材持股 100%

4、漳州链芯

公司名称	漳州链芯半导体有限公司
成立日期	2023年4月13日
注册资本	300 万元
实收资本	0 万元
主营业务情况	系发行人新设立的子公司,尚未投入实际生产经营

股东构成	恒坤新材持股 100%
5、日本精容	
公司名称	精容株式会社
成立日期	2005年2月2日
可发行股份	2,000 股
登记发行股份	200 股
出资额	1,000 万日元
主营业务情况	境外先进技术的研发合作及市场拓展
股东构成	恒坤新材通过香港恒坤间接持股 95%
6、司理可	
公司名称	福建司理可新材料有限公司
成立日期	2023年11月29日
注册资本	10,000 万元
实收资本	1,995 万元
主营业务情况	集成电路关键材料新产品的研发、生产与销售
股东构成	恒坤新材持股 100%
7、上海芯远	
公司名称	上海芯远精材新材料有限公司
成立日期	2023年12月6日
注册资本	500 万元
实收资本	0 万元
主营业务情况	为发行人及子公司提供研发服务
股东构成	恒坤新材持股 100%
8、恒坤创研	
公司名称	厦门恒坤新材创研有限公司
成立日期	2025年9月22日
注册资本	5,000 万元
实收资本	0万元

为发行人及子公司提供研发服务

主营业务情况

股东构成

恒坤新材持股 100%

(二) 参股公司

1、祐尼三的

公司名称	厦门祐尼三的新材料科技有限公司						
成立日期	2016年6月21日						
注册资本	3,552.63 万元	3,552.63 万元					
实收资本	3,552.63 万元						
主营业务情况	从事 3D 玻璃冷弯贴合研发及制造						
	股东名称/姓名	持股比例					
	李裕文	50.35%					
	恒坤投资	12.03%					
	恒坤新材	9.34%					
44 - 14 - 14 - 17 U	厦门天比新材料科技有限公司	8.08%					
股东构成	深圳彤鑫资产管理企业(有限合伙)	5.00%					
	尤智伟	4.75%					
	勾陈合伙	4.75%					
	陈秀绢	3.80%					
	张永梅	1.90%					

2、湖北三维

公司名称	湖北三维半导体集成创新中心有限责任公司		
成立日期	2019年6月5日		
注册资本	11,600 万元		
	11,500 万元		
主营业务情况	半导体工程化技术研发,三维集成制造技术	商业化应用	
	股东名称	持股比例	
	武汉新芯集成电路股份有限公司	27.59%	
	武汉精测电子集团股份有限公司	8.62%	
股东构成	武汉光谷产业投资有限公司	8.62%	
	武汉产业发展基金有限公司 8.62%		
	湖北鼎汇微电子材料有限公司	5.17%	
	紫光展锐(上海)科技股份有限公司 4.3		

湖北兴福电子材料股份有限公司	4.31%
江苏南大光电材料股份有限公司	4.31%
格科微电子(上海)有限公司	4.31%
安集微电子科技(上海)股份有限公司	4.31%
恒坤新材	4.31%
北京京仪自动化装备技术股份有限公司	4.31%
上海硅产业集团股份有限公司	4.31%
宏茂微电子(上海)有限公司	1.72%
湖北湖大资产经营有限公司	1.72%
华智众创(北京)投资管理有限责任公司	1.72%
北京华卓精科科技股份有限公司	1.72%

3、大晶信息

公司名称	大晶信息化学品(徐州)有限公司			
成立日期	2015年5月26日	2015年5月26日		
注册资本	25,000.5 万元			
	25,000.5 万元			
主营业务情况	信息化学品(感光材料、试剂、原料)、涂料、化学生物医药原料的生产及销售,科研开发			
	股东名称 持股比例			
₩ ҂ ₩ ₽	天津久日新材料股份有限公司 91.33%			
股东构成 恒坤新材		6.67%		
	康文兵 2.00%			

4、长存产投

企业名称	长存产业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)		
成立日期	2023 年 8 月 15 日		
注册资本	204,300 万元		
	142,610 万元		
主营业务情况	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务		
股东名称 持股		持股比例	
股东构成	铭哲长风四号(淄博)股权投资合伙企业 (有限合伙)	18.75%	
AC/3113/94	湖北集成电路产业投资基金股份有限公司	14.68%	
	长存资本(武汉)投资管理有限公司	11.26%	

武汉光谷半导体产业投资有限公司	9.79%
湖北兴发化工集团股份有限公司	4.89%
武汉光谷产业投资有限公司	4.89%
新疆芯前沿企业管理有限公司	4.89%
新疆明时长信股权投资合伙企业(有限合伙)	4.89%
平湖经开创业投资有限公司	4.89%
上海新阳半导体材料股份有限公司	4.89%
恒坤新材	3.43%
安集微电子科技(上海)股份有限公司	2.45%
中信证券投资有限公司	2.45%
铭哲云展五号(淄博)股权投资合伙企业 (有限合伙)	1.96%
三亚同达兴邦投资中心(有限合伙)	1.47%
三亚置信宏达投资中心(有限合伙)	1.34%
淄博华函启明股权投资合伙企业(有限合 伙)	1.11%
武汉芯泽企业管理合伙企业(有限合伙)	0.98%
长存(武汉)私募基金管理有限公司	0.93%
湖北国芯产业投资管理有限责任公司	0.05%

5、上海八亿时空

公司名称	上海八亿时空先进材料有限公司			
成立日期	2021年2月1日	2021年2月1日		
 注册资本	18,000 万元			
实收资本	18,000 万元			
主营业务情况	技术服务开发,合成材料销售,电子专用材料研发及销售			
	股东名称 持股比例			
股东构成	北京八亿时空液晶科技股份有限公司 88.89%			
	恒坤新材 11.11%			

十四、员工持股平台

(一) 厦门神剑

厦门神剑系发行人早期设立的员工跟投平台,其实施情况如下:

1、员工跟投平台出资价格及公允性,以及人员构成、备案情况

厦门神剑系发行人早期设立的员工跟投平台。2014年6月,发行人召开2013年度股东大会同意注册资本增加至3,040万元,其中厦门神剑作为员工跟投平台增资入股432万元,增资价格为2.2元/股,与同期其他投资者增资价格相同,具有公允性。此后,由于发行人资产重组、出资人离职等原因,截至本招股意向书签署日,仅有6名出资人在发行人处任职,具体情况如下:

合伙人姓名	任职单位	备注
易荣坤、陈志明、庄颖、庄海 华、王玉琴、王艺缘	恒坤新材	/
张壬福、陈明亮、罗光章、何 妃亦、匡傅亮、门书晓、余家 田、梁节煅、徐成、黄丽恩	厦门积能、深圳恒坤、苏州恒坤	该等出资人在入股时任职单位均为 发行人的控股子公司,其任职单位未 发生变化,因发行人 2019 年业务重 组,其任职单位被剥离出发行人体系
朱小岩、曾英安、蔡真真、刘 亚恋	/	曾任职于恒坤新材或恒坤新材原控 股子公司,现已离职
黄智辉	/	未在发行人或其关联方处任职

厦门神剑入股时间、未在发行人任职人员取得财产份额时间早于现行《证券法》实施时间(2020年3月1日),根据相关规定,未在发行人任职人员持有厦门神剑的财产份额,可以不进行清理。据此,厦门神剑作为员工跟投平台的出资人构成,符合《证券期货法律适用意见第17号》之规定。

2、员工跟投计划章程或者协议约定情况

厦门神剑的《合伙协议》对亏损分担办法、入伙、退伙、解散与清算、违约责任等进行了约定,根据该协议,"新合伙人入伙,经全体合伙人一致同意,依法订立书面入伙协议""合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时,须经其他合伙人一致同意。在同等条件下,其他合伙人有优先购买权。合伙人之间转让在合伙企业中的全部或部分财产份额时,应当书面通知其他合伙人"。据此,神剑投资已建立健全持股在平台内部的流转、退出机制,以及股权管理机制。

3、员工跟投平台规范运行情况及备案情况

员工跟投平台遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在以摊派、强 行分配等方式强制实施员工持股计划的情形。参与持股计划的员工,通过厦门神 剑间接持有发行人的股份,与其他投资者权益平等,盈亏自负,风险自担,不存 在利用知悉公司相关信息的优势,侵害其他投资者合法权益的情形,员工跟投平 台运行合法合规,不存在损害发行人利益的情形。

截至本招股意向书签署日,	厦门油剑且休人	员构成加下:
	/友	

序号	合伙人姓名	性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	易荣坤	董事长、高级管理人员、 平台执行事务合伙人	88.6060	12.58
2	陈志明	高级管理人员	16.2800	2.31
3	庄海华	监事	9.2400	1.31
4	王玉琴	监事	4.6200	0.66
5	王艺缘	监事	2.3100	0.33
6	庄颖	员工	15.4000	2.19
7	10 名合伙人	恒坤新材原控股子公司 员工	389.1240	55.26
8	4 名合伙人	离职员工	13.6400	1.94
9	黄智辉	外部人员	165.0000	23.43
	合	मे	704.2200	100.00

厦门神剑的出资人入股均以自有/自筹货币出资并已足额缴纳,不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形,不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《证券投资基金法》所规范的私募投资基金或基金管理人,无需按照相关规定履行私募投资基金备案和基金管理人登记程序。

(二) 晟临坤、晟临芯、兆莅恒及恒众坤合

1、员工持股平台出资价格及公允性,以及人员构成情况、备案情况

晟临坤、晟临芯、兆莅恒以及恒众坤合的出资价格及公允性如下:

持股平台名称	晟临坤	晟临芯	兆莅恒	恒众坤合
执行事务合伙人	庄海华	易荣坤	易荣坤	郭永亮
成立时间	2022.03.28	2022.03.28	2021.06.24	2022.11.21
实施程序及价格 公允性	平台,详见本招 "十八、发行人 的股权激励及打	激励计划的实施 股意向书第四节 已经制定或实施 执行情况"相关 格构成股份支付	第八次临时股东 大会同意,以4.125 元/股价格认购发	12.3142 元/股价格 认 购 发 行 人

			部投资人入股价 格相同,具有公允 性	
参与计划时是否 均为公司员工	是	是	是	是

晟临坤、晟临芯、兆莅恒以及恒众坤合的出资人入股均以自有/自筹货币出资并已足额缴纳,不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形,不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《证券投资基金法》所规范的私募投资基金或基金管理人,无需按照相关规定履行私募投资基金备案和基金管理人登记程序。

截至本招股意向书签署日,上述持股平台的具体人员构成如下:

①晟临坤

序号	合伙人姓名	性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	易荣坤	董事长、高级管理人员	29.7000	3.31
2	庄海华	监事、平台执行事务合伙人	66.0000	7.36
3	王艺缘	监事	66.0000	7.36
4	王玉琴	监事	66.0000	7.36
5	其他 24 名合伙人	员工	668.4503	74.59
	合	।	896.1503	100.00

②晟临芯

序号	合伙人姓名	性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	易荣坤	董事长、高级管理人员、平 台执行事务合伙人	2,574.00	92.86
2	陈志明	高级管理人员	198.00	7.14
合计			2,772.00	100.00

③兆莅恒

序号	合伙人姓名	性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	易荣坤	董事长、高级管理人员、平 台执行事务合伙人	275.5500	45.61
2	王玉琴	监事	24.7500	4.10
3	王艺缘	监事	12.3750	2.05
4	庄海华	监事	12.3750	2.05
5	其他 19 名合伙人	员工	279.0579	46.19
	合	604.1079	100.00	

④恒众坤合

序号	合伙人姓名	性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	宋里千	核心技术人员	135.4562	29.74
2	王静	核心技术人员	24.6284	5.41
3	其他 21 名合伙人	员工	295.4374	64.86
合计			455.5220	100.00

2、员工持股计划的实施合法合规

根据晟临坤、晟临芯、兆莅恒以及恒众坤合的《合伙协议》《合伙协议之补充协议》和全体出资人出具的声明文件,并经发行人及员工持股平台说明,发行人通过合伙企业间接持股实施员工持股计划,并已建立健全持股在平台内部的流转、退出机制,以及股权管理机制;晟临坤、晟临芯、兆莅恒以及恒众坤合遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制实施员工持股计划的情形。参与上述持股计划的员工,通过晟临坤、晟临芯、兆莅恒以及恒众坤合间接持有发行人的股份,与其他投资者权益平等,盈亏自负,风险自担,不存在利用知悉公司相关信息的优势,侵害其他投资者合法权益的情形,晟临坤、晟临芯、兆莅恒以及恒众坤合运行合法合规,不存在损害发行人利益的情形。

3、员工持股计划股东人数计算

序号	直接股东	直接股东	
1	厦门神剑	员工及其他内部人员计算为1人,外部人员按实际人数计算(剔除重复计算股东)	2
2		为发行人的员工持股平台,且出资对象均为公司或其子公司在职员工,按1人计算股东人数	4

员工持股计划计算股东人数符合《证券期货法律适用意见第 17 号》第五条规定。

十五、发行人高级管理人员与核心员工拟参与战略配售情况

(一) 共赢 58 号员工资管计划

参与认购共赢 58 号员工资管计划的发行人高级管理人员和核心员工为 13 名。 共赢 58 号员工资管计划的委托人姓名、劳动/劳务合同签署单位、主要职务、认 购金额及持有资产管理计划份额比例等情况如下:

序 号	姓名	任职单位	职务	人员类型	认购金额 (万元)	资管计划 份额比例
1	安辉	发行人	销售副总	核心员工	400.00	16.23%
2	康文兵	发行人	研发副总	核心员工	300.00	12.17%
3	唐正隆	发行人	工程技术副总	核心员工	285.00	11.56%
4	肖忠根	上海楚坤	商业开发总监	核心员工	250.00	10.14%
5	赵永红	发行人	光刻技术副总	核心员工	200.00	8.11%
6	宋里千	发行人	运营总监	核心员工	150.00	6.09%
7	陶懿宗	上海楚坤	销售总监	核心员工	150.00	6.09%
8	王静	发行人	研发总监	核心员工	150.00	6.09%
9	李刚	厦门恒坤新 材料科技股 份有限公司 北京分公司	客户质量经理	核心员工	150.00	6.09%
10	阮国锋	发行人	财务经理	核心员工	130.00	5.27%
11	李凌蓝	发行人	财务经理	核心员工	100.00	4.06%
12	毛鸿超	发行人	研发总监	核心员工	100.00	4.06%
13	王艺缘	发行人	采购经理、职 工代表监事	核心员工	100.00	4.06%
	合计					100.00%

注:除康文兵为退休返聘人员与发行人签署劳务合同外,上述其他人员均与发行人或其下属子公司签署劳动合同。

(二)共赢62号员工资管计划

参与认购共赢 62 号员工资管计划的发行人高级管理人员和核心员工为 6 名。 共赢 62 号员工资管计划的委托人姓名、劳动合同签署单位、主要职务、认购金 额及持有资产管理计划份额比例等情况如下:

序 号	姓名	任职单位	职务	人员类型	认购金额 (万元)	资管计划 份额比例
1	易荣坤	发行人	董事长、总经理	高级管理人员	4,150.00	74.98%
2	肖楠	发行人	董事、副总经理	高级管理人员	585.00	10.57%
3	王廷通	发行人	董事、副总经理	高级管理人员	300.00	5.42%
4	杨波	发行人	新事业发展中心 副总经理	核心员工	200.00	3.61%
5	张蕾	发行人	新事业发展中心 副总经理	核心员工	200.00	3.61%
6	陈志明	发行人	财务总监	高级管理人员	100.00	1.81%
合计					5,535.00	100.00%